

澜起科技股份有限公司

Montage Technology Co., Ltd.

(上海市徐汇区宜山路 900 号 1 幢 A6)



关于澜起科技股份有限公司
首次发行股票并在科创板上市申请文件的
审核问询函之回复报告

保荐机构（牵头主承销商）



(广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座)

上海证券交易所：

贵所于 2019 年 4 月 12 日出具的《关于澜起科技股份有限公司首次发行股票并在科创板上市申请文件的审核问询函》（以下简称“问询函”）收悉，中信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为澜起科技股份有限公司（以下简称“澜起科技”、“公司”或“发行人”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构（牵头主承销商），会同澜起科技、国浩律师（上海）事务所（以下简称“发行人律师”）、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“申报会计师”）等相关各方对问询函相关问题逐项进行了落实，现对问询函回复如下，请审核。

除另有说明外，本回复报告所用简称与招股说明书所用简称一致。

问询函所列问题	黑体（不加粗）
对问题的回答	宋体（不加粗）
引用原招股说明书内容	楷体（不加粗）
对招股说明书的修改、补充	楷体（加粗）

目录

问题一	4
问题二	12
问题三	16
问题四	21
问题五	24
问题六	33
问题七	34
问题八	40
问题九	44
问题十	47
问题十一	53
问题十二	65
问题十三	69
问题十四	71
问题十五	73
问题十六	78
问题十七	93
问题十八	96
问题十九	104
问题二十	110
问题二十一	116
问题二十二	128
问题二十三	137
问题二十四	147
问题二十五	154

问题二十六.....	163
问题二十七.....	163
问题二十八.....	172
问题二十九.....	187
问题三十.....	195
问题三十一.....	215
问题三十二.....	217
问题三十三.....	227
问题三十四.....	234
问题三十五.....	245
问题三十六.....	257
问题三十七.....	263
问题三十八.....	270
问题三十九.....	279
问题四十.....	281
问题四十一.....	286
问题四十二.....	290
问题四十三.....	292
问题四十四.....	295
问题四十五.....	298
问题四十六.....	303
问题四十七.....	305
问题四十八.....	316
问题四十九.....	319

问题一

报告期内，公司股权较为分散，所有股东均无法单独控制股东大会半数以上表决权，亦无法单独控制董事会半数以上成员，不能单独控制公司，公司不存在控股股东和实际控制人。2004年，杨崇和与Stephen Kuong-Io Tai共同创立公司，自创立至今，杨崇和一直任公司董事长兼首席执行官，Stephen Kuong-Io Tai一直任公司董事兼总经理。2018年4月之前，Montage Holding间接控制发行人。

请发行人说明：（1）公司各股东之间是否存在一致行动关系，在公司章程、私有化及入股发行人时是否存在特殊利益安排（比如重大事项否决权、董事提名/任命权等），是否影响公司的实际控制权；（2）结合发行人董事会的具体构成、董事提名来源、董事的任职经历及历史关系等情况，说明某方股东是否对发行人董事会实施控制或存在重大影响；（3）请结合杨崇和、Stephen Kuong-Io Tai共同创立澜起科技、在发行人处历史任职情况、直接或间接持有发行人股权的情况、对发行人日常经营管理的影响等，进一步说明杨崇和、Stephen Kuong-Io Tai是否可以实质控制发行人；（4）请结合最近2年内Montage Holding的股权结构及变动情况，说明Montage Holding是否属于杨崇和控制的主体，其实际控制权是否存在变更；（5）Xinyun Capital Fund I L.P.将其在澜起科技的表决权委托给Xinyun Capital Management,Ltd.的原因，是否对发行人实际控制权存在重大影响；（6）公司认定无实际控制人对公司治理有效性的影响，公司股权结构是否稳定，以及未来维持公司股权稳定的有效措施。

请保荐机构、发行人律师核查最近2年内公司章程、协议或其他安排以及发行人股东大会（股东出席会议情况、表决过程、审议结果、董事提名和任命等）、董事会（重大决策的提议和表决过程等）、监事会及发行人经营管理的实际运作情况，以及发行人各股东之间是否存在一致行动协议等安排，Montage Holding的股权结构、变动情况及实际控制人等，对发行人最近2年内是否存在实际控制人、实际控制人是否发生变更、是否存在导致控制权可能变更的重大权属纠纷，以及上市后发行人的股权结构是否稳定发表明确意见。

回复：

1.1 发行人说明

一、公司各股东之间是否存在一致行动关系，在公司章程、私有化及入股发行人时是否存在特殊利益安排（比如重大事项否决权、董事提名/任命权等），是否影响公司的实际控制权

公司下列股东之间存在一致行动关系：

序号	股东名称	持股比例（%）	一致行动关系
1	中电投控	15.90	嘉兴芯电的普通合伙人受中电投控控制
	嘉兴芯电	2.08	
2	WLT	8.64	合伙人存在近亲属关系
	珠海融英	6.81	
3	上海临理	5.26	受同一普通合伙人控制
	上海临丰	1.83	
	上海临骥	1.50	
	上海临利	1.31	
	上海临国	1.29	
	临桐建发	0.91	
	上海临齐	0.69	
4	嘉兴宏越	4.35	股东的投票权均受同一主体控制
	嘉兴莫奈	2.03	
	Xinyun I	4.35	
	Xinyun	1.19	
	Xinyun III	0.20	
5	蒋石一号	2.24	股东的投票权均受同一主体控制
	蒋石二号	1.28	
	蒋石三号	3.24	
6	中睿一期	3.47	受同一普通合伙人控制
	中睿二期	0.55	
7	珠海融扬	2.55	拥有共同的普通合伙人
	Theon Investment	0.58	
8	泰瑞嘉德	1.58	受同一普通合伙人控制
	华天宇投资	0.96	

在 2018 年 4 月完成境外架构拆除后，公司章程及合资合同中约定，公司董事会由 6 名董事构成，其中中电投控委派 2 名董事，WLT 委派 2 名董事，中证投资委派 1 名董事，上海临理、上海临丰、上海临骥、上海临利、上海临国、临桐建发、上海临齐共同委派 1 名董事。公司整体变更后未对董事委派及提名有任何特殊安排。

此外，2018 年 12 月，Intel Capital 及 SVIC No. 28 Investment 对公司进行增资，在增资协议中，各方就 Intel Capital 在成为公司股东后的相关保护性事项进行了约定，包括未经 Intel Capital 同意，公司不得自行停业、解散或清算，不得以任何方式造成公司控制权变更、不得进行重大经营范围变更等事项，相关权利在公司完成上市之日终止。在股东协议中，各方在违约补偿条款中就 Intel Capital、SVIC No. 28 Investment 的回购权事项进行了约定，在公司违反反贿赂及反腐败的相关规定，或至 2021 年 5 月公司仍未实现上市等情况出现时，Intel Capital、SVIC No. 28 Investment 有权要求公司以其增资认购价格回购所持公司股份，该股东协议在公司正式提交上市申请文件时终止。

除上述外，在公司章程、私有化及股东入股公司时不存在重大事项否决权、董事提名/任命等特殊利益安排。上述约定不影响公司无实际控制人的认定。

二、结合发行人董事会的具体构成、董事提名来源、董事的任职经历及历史关系等情况，说明某方股东是否对发行人董事会实施控制或存在重大影响

2017 年 1 月 1 日至 2018 年 4 月完成境外架构拆除前，澜起有限由 Montage Holding 间接控制。Montage Holding 董事会成员为杨崇和、Stephen Kuong-Io Tai、邓向东、李荣信、李亚军、Yao SUN。

2017 年 1 月 1 日至 2018 年 4 月完成境外架构拆除前，澜起有限董事均由股东 Montage HK 委派产生，董事会成员为杨崇和、Stephen Kuong-Io Tai、Jung-Kung Yang。

2018 年 4 月，澜起有限完成境外架构拆除，Montage Holding 董事会成员平移至澜起有限，澜起有限董事会成员由 3 名增加为 6 名，其中变动 1 人、增加 3 人，董事由澜起有限股东根据公司章程约定委派产生。其中，邓向东、李荣信由中电投控委派，杨崇和、Stephen Kuong-Io Tai 由 WLT 委派，李亚军由上海临理、上海临丰、上海临骥、上海临利、上海临国、临桐建发、上海临齐共同委派，Yao

SUN 由中证投资委派。

2018 年 10 月，澜起有限完成股改，公司董事会由 9 名成员构成，参照上市公司要求，由董事会提名新增 3 名独立董事，全体董事由澜起有限董事会提名，由股东大会选举产生，董事会成员为杨崇和、Stephen Kuong-Io Tai、邓向东、李荣信、李亚军、Yao SUN、吕长江、刘敬东、俞波。

2018 年 12 月，公司董事会成员由 9 名增加至 11 名，新增非独立董事及独立董事各 1 名，均由公司董事会提名，由股东大会选举产生，新增董事 Brent Alexander Young、周禹鹏。

2019 年 3 月，公司独立董事周禹鹏因个人原因辞职，公司增补独立董事尹志尧。补选董事由董事会提名，由股东大会选举产生。

公司目前董事会成员共 11 名，其中 9 名由澜起有限董事会提名，经创立大会选举产生，另外 2 名由公司董事会提名，分别经公司 2018 年第一次临时股东大会、2019 年第一次临时股东大会选举产生。

综上所述，最近两年，不存在某一股东委派代表占据董事会多数的情形，不存在某一股东可以单独对公司董事会实施控制或重大影响。

三、请结合杨崇和、Stephen Kuong-Io Tai 共同创立澜起科技、在发行人处历史任职情况、直接或间接持有发行人股权的情况、对发行人日常经营管理的影响等，进一步说明杨崇和、Stephen Kuong-Io Tai 是否可以实质控制发行人

Montage Group 于 2004 年设立，后 Montage Group 设立澜起有限。

2017 年 1 月至今，杨崇和担任公司董事长，Stephen Kuong-Io Tai 担任公司董事、总经理。截至本问询函回复签署日，杨崇和、Stephen Kuong-Io Tai 通过 WLT 分别间接持有公司 2.0151% 股份，其关联方 WLT、珠海融英合计直接持有公司 15.45% 股权。杨崇和、Stephen Kuong-Io Tai 及关联方合并计算持股自 2017 年 1 月 1 日起并非第一大股东，杨崇和、Stephen Kuong-Io Tai 无法实际控制公司。

公司建立了现代化企业管理制度和规范的治理架构，依据《公司法》、《证券法》等相关法律、法规和规范性文件的要求，制定了《公司章程》，建立了由股东大会、董事会、监事会和高级管理人员组成的公司治理架构，《公司章程》对股东及董事表决权等事项无特殊约定安排。在公司日常经营中，杨崇和与 Stephen

Kuong-Io Tai 根据公司股东大会及董事会的决策履行其职权,无法实质控制公司。

四、请结合最近2年内Montage Holding的股权结构及变动情况,说明Montage Holding 是否属于杨崇和控制的主体,其实际控制权是否存在变更

截至 2016 年 12 月 31 日, Montage Holding 的普通股股权结构如下:

序号	股东	持有股份数(股)	持股比例
1	CEC Industrial Development Investment Inc.	6,468,671	21.36%
2	PKM Holding Co., Ltd.	5,202,011	17.18%
3	Xinyun Capital Fund, L.P.	4,867,252	16.07%
4	Neptune Connection Limited	4,067,330	13.43%
5	WLT Partners, L.P.	4,009,145	13.24%
6	持股 5% 以下小股东	5,666,862	18.71%
	合计	30,281,271	100.00%

自 2017 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日(自 2018 年 4 月公司完成境外架构拆除后, Montage Holding 已不再是公司间接股东), 杨崇和仅通过 WLT 间接持有 Montage Holding 股权, WLT 持有的 Montage Holding 股权比例始终未超过 15%, 且始终非第一大股东, 杨崇和无法通过 WLT 控制 Montage Holding, Montage Holding 不属于杨崇和控制的企业。

上述期间, Montage Holding 股权结构相对分散, 始终处于无实际控制状态, 第一大股东未发生变化, 且主要股东未发生重大变化, Montage Holding 股权控制结构未发生变化。

五、Xinyun Capital Fund I L.P.将其在澜起科技的表决权委托给Xinyun Capital Management,Ltd.的原因, 是否对发行人实际控制权存在重大影响

Xinyun Capital Fund I L.P.持有的 Montage Holding 股权受让于 Xinyun Capital Fund, L.P., 根据双方股权转让时的协商, Xinyun Capital Fund I L.P.将在 Montage Holding 表决权委托给 Xinyun Capital Management, Ltd.的设置系 Xinyun Capital Fund, L.P.基于商业目的, 将其持有 Montage Holding 的部分股权转让给 Xinyun Capital Fund I, L.P.的前提条件, 相关表决权委托在澜起有限完成境外架构拆除后延续至澜起有限层面。公司股权结构清晰, 上述委托投票相关方已根据监管要求, 将所持股份锁定 36 个月, 上述委托投票安排对公司股权结构及控制权的稳定性

未产生重大影响。

六、公司认定无实际控制人对公司治理有效性的影响，公司股权结构是否稳定，以及未来维持公司股权稳定的有效措施

2017年1月1日至2018年4月公司完成境外架构拆除前，公司原境外母公司 Montage Holding 董事分别为杨崇和、Stephen Kuong-Lo Tai、邓向东、李荣信、李亚军、Yao SUN，上述六人从2018年4月完成境外架构拆除后即为公司董事至今。报告期内，公司高级管理人员均为 Stephen Kuong-Lo Tai、梁铂钴及苏琳，未发生变化。报告期内，公司董事会及经营管理层保持稳定，公司主营业务未发生重大变化，经营情况和盈利能力持续提升。

公司已建立了健全的组织机构，由股东大会、监事会、董事会、总经理等高级管理人员和公司各部门组成，其中股东大会为公司的最高权力机构、董事会为公司的经营决策机构、监事会为公司的监督机构，相关人员和机构能够依法履行职责。公司还设置了研发部、质控部、运营部、市场应用技术部、市场部、销售部、公共关系部、行政部、财务部、人力资源部、法务部、董事会办公室、内审部等部门。

截至本问询函回复签署日，公司共召开四次股东大会，六次董事会，三次监事会，上述会议议案除关联方回避表决外均全票通过。报告期内公司的股权及控制结构不影响公司治理有效性。2017年1月1日以来，公司第一大股东未发生变化（均为中电投控控制主体）；主要股东（持股前51%的股东）也未发生重大变化，公司整体股权和控制结构未产生重大变化。

此外，持股前51%的主要股东均已签署了股份锁定承诺，承诺自公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前持有的本公司股份，也不由本公司回购该部分股份。最近两年内，公司不存在实际控制人，股权及控制结构稳定，上述相关主体采取股份锁定措施的承诺也有利于公司股权及控制结构的稳定。

综上所述，公司认定无实际控制人对公司治理有效性不存在重大不利影响，公司股权结构稳定。

1.2 保荐机构和发行人律师核查过程和核查意见

1、保荐机构和发行人律师获取并核查了发行人各股东的工商资料、章程/合伙协议等文件；获取了股东关于股东之间关联关系的声明；获取并审阅了公司章程、历次增资入股协议等文件；

2、获取并审阅了公司原境外母公司Montage Holding股东名册、董事名册；获取了公司董事调查表；获取了公司历次董事会变动涉及的会议文件；

3、获取了杨崇和、Stephen Kuong-Io Tai签署的调查表；获取并审阅了公司股东大会、董事会、监事会相关决议文件；

4、获取了WLT合伙协议等文件；对杨崇和进行了访谈；

5、获取并审阅了委托投票权相关的具体协议，获取了委托方及受托方有关此次委托投票权的确认函；

6、获取并审阅了公司相关治理制度；获取了公司前51%股东有关股份锁定的承诺。

经核查，保荐机构认为：

发行人最近2年内不存在实际控制人，实际控制人没有发生变更，不存在导致控制权可能变更的重大权属纠纷，上市后发行人的股权结构保持稳定。

1、除招股说明书披露的股东间关联关系、以及最近2年曾存在的董事提名权及部分股东拥有的保护条款外，公司近两年的公司章程、私有化及股东入股发行人时不存在重大事项否决权、董事提名/任命等特殊利益安排，上述约定不影响公司无实际控制人的认定；

2、最近2年，不存在某一股东委派代表占据董事会多数的情形，不存在某一股东可以单独对发行人董事会实施控制；

3、在公司日常经营中，杨崇和与Stephen Kuong-Io Tai根据公司股东大会及董事会的决策履行其职权，无法实质控制公司；

4、Montage Holding不属于杨崇和控制的企业。最近2年，Montage Holding始终处于无实际控制状态，其股权控制结构未发生变化；

5、公司股权结构清晰，委托投票安排对公司股权结构及控制权的稳定性未产生不利影响；

6、公司认定无实际控制人对公司治理有效性不存在重大不利影响，公司股权结构稳定。

发行人律师认为发行人最近2年内不存在实际控制人，实际控制人没有发生变更，不存在导致控制权可能变更的重大权属纠纷，上市后发行人的股权结构稳定。

问题二

招股说明书将杨崇和、山岗、常仲元、史刚认定为核心技术人员。Stephen Kuong-Io Tai拥有逾25年的半导体架构、设计和工程管理经验，自2004年澜起科技创立至今任公司董事兼总经理。

请发行人：（1）根据《科创板股票发行上市审核问答》（以下简称《问答》），明确披露核心技术人员的认定依据；（2）结合公司研发部门主要成员、主要专利发明人、主要研发项目参与人、员工持股数量及变化等情况充分、恰当地认定核心技术人员；（3）披露报告期内核心技术人员的变化情况，最近2年内是否发生重大不利变化。

请发行人说明Stephen Kuong-Io Tai等公司董事、高管未被认定为核心技术人员的原因及合理性。

请保荐机构、发行人律师结合公司研发部门主要成员、主要专利发明人、主要研发项目参与人、员工持股数量及变化等情况，对公司核心技术人员的认定是否全面、恰当，最近2年内是否发生重大不利变化发表明确意见。

回复：

2.1 发行人说明

一、根据《科创板股票发行上市审核问答》（以下简称《问答》），明确披露核心技术人员的认定依据

根据《科创板股票发行上市审核问答》，公司将在招股说明书中补充披露核心技术人员认定依据，具体内容如下：

“公司核心技术人员为公司主要技术负责人及公司相关研发部门负责人。”

二、结合公司研发部门主要成员、主要专利发明人、主要研发项目参与人、员工持股数量及变化等情况充分、恰当地认定核心技术人员

公司核心技术人员为杨崇和、山岗、常仲元和史刚。其中，杨崇和作为公司董事长，主要负责公司战略方向和核心技术研发方向。公司主要研发部门包括市场应用技术部、研发部以及运营部。山岗、常仲元及史刚，分别担任上述部门负责人，直接参与公司研发工作，是公司主要研发项目参与人、负责人。公司将杨

崇和、山岗、常仲元及史刚认定为核心技术人员，具体情况如下：

杨崇和先生为公司董事长兼首席执行官，自公司成立以来主要负责公司的战略发展及核心技术研发方向。自 2016 年以来，杨崇和先生参与的职务发明共获得授权及申请专利 9 项，为公司主要专利发明人之一。

山岗先生为公司市场应用技术部负责人。公司市场应用技术部主要负责芯片应用方案设计、技术支持等事务，包括应用方案中软件开发、测试、硬件设计、技术支持等工作。自 2016 年以来，山岗先生参与的职务发明共获得授权及申请专利 13 项，为公司主要专利发明人之一。

常仲元先生为公司研发部负责人。公司研发部主要负责公司集成电路设计的相关事务，包括数字电路设计、模拟电路设计、芯片验证、后端设计、辅助设计等工作。自 2016 年以来，常仲元先生参与的职务发明共获得授权及申请专利 3 项，为公司主要专利发明人之一。

史刚先生为公司运营部负责人。公司运营部主要负责芯片营运、量产等相关事务，包括物料管理、晶圆工艺设计、芯片封装测试、量产管理等工作。自 2017 年 8 月加入公司以来，史刚先生参与的职务发明共申请专利 1 项。

综上所述，杨崇和、山岗、常仲元、史刚为主要技术负责人及公司主要研发部门负责人，为公司主要专利发明人及研发项目参与者。公司核心技术人员均间接持有公司股份，并与公司签署了保密协议及竞业禁止协议，保证了公司具有较强的持续研发能力。核心技术人员认定依据充分、恰当。

三、披露报告期内核心技术人员的变化情况，最近 2 年内是否发生重大不利变化

最近 2 年，公司核心技术人员变动情况如下：

时间	成员	职位	核心技术人员数	变动原因
2017 年 1 月	杨崇和	核心技术人员	3	
	山岗	核心技术人员		
	常仲元	核心技术人员		
2017 年 8 月	杨崇和	核心技术人员	4	史刚先生 2017 年 8 月加入公司
	山岗	核心技术人员		
	常仲元	核心技术人员		
	史刚	核心技术人员		

史刚先生于 2017 年 8 月加入公司担任运营部负责人，其他核心技术人员均在公司长期任职未发生变化。综上所述，最近 2 年内公司核心技术人员未发生重大不利变化。

四、请发行人说明 Stephen Kuong-Lo Tai 等公司董事、高管未被认定为核心技术人员的理由及合理性

Stephen Kuong-Lo Tai 为公司董事、总经理。Stephen Kuong-Lo Tai 先生拥有逾 25 年的半导体架构、设计和工程管理经验，在公司设立初期参与公司产品的研发。但近年来，根据公司内部分工，Stephen Kuong-Lo Tai 先生作为公司总经理主要负责公司的日常经营，重点分管市场拓展和销售工作，不再直接从事公司的产品研发工作。自 2016 年以来并无授权及申请专利，因此未将 Stephen Kuong-Lo Tai 先生认定为核心技术人员。

除杨崇和及 Stephen Kuong-Lo Tai 外，公司其他董事均未在公司担任其他职务，未认定为核心技术人员。

梁铂钻先生为公司副总经理兼董事会秘书，苏琳女士为公司副总经理兼财务负责人，均未参与公司的研发，因此未认定为公司核心技术人员。

因此，公司未将 Stephen Kuong-Lo Tai 等公司董事、高管认定为核心技术人员具有合理性。

2.2 保荐机构和发行人律师核查过程和核查意见

保荐机构和发行人律师获取了发行人发明专利清单及证书；获取了发行人内部职能部门的工作职责说明；获取了公司在研项目清单及主要参与人员名单；对发行人核心技术人员进行了访谈；获取了发行人核心技术人员基本情况调查表，了解公司核心技术人员间接持股情况。

经核查，保荐机构和发行人律师认为，发行人核心技术人员为公司主要技术负责人及公司主要研发部门负责人，发行人未将 Stephen Kuong-Lo Tai 等公司董事、高管认定为核心技术人员具有合理性，公司对核心技术人员的认定全面、恰当，最近 2 年发行人核心技术人员未发生重大不利变化。

2.3 补充披露情况

发行人已在招股说明书“第五节 发行人基本情况”之“十一、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员概况”之“（四）核心技术人员”部分中补充披露如下：

公司核心技术人员为公司主要技术负责人及公司相关研发部门负责人。

问题三

2017年1月至2018年4月之间，发行人有3名董事，2018年4月至今，发行人董事人数逐渐增加至11名。

请发行人补充披露最近2年内董事的变动人数及比例，对发行人生产经营的影响，以及各位董事的提名来源。

请保荐机构、发行人律师核查最近2年内发行人董事的变动比例是否较大、其核心人员是否发生变化、对发行人生产经营是否产生重大不利影响，并对发行人董事是否发生重大不利变化发表明确意见。

回复：

3.1 发行人说明

时间	董事会成员	提名/委派来源	变动人数情况	变动原因及对生产经营的影响
2017年1月	杨崇和	由股东 Montage HK 委派	-	-
	Stephen Kuong-Io Tai			
	Jung-Kung Yang			
2018年4月	杨崇和	由股东 WLT 委派	变动1人，增加3人	澜起有限拆除境外架构，将 Montage Holding 董事会平移至境内。对生产经营无不利影响。
	Stephen Kuong-Io Tai			
	邓向东	由股东中电投控委派		
	李荣信			
	李亚军	由上海临理、上海临丰、上海临骥、上海临利、上海临国、临桐建发、上海临齐共同委派		
Yao SUN	由股东中证投资委派			
2018年10月	杨崇和	由澜起有限董事会提名	增加3人	澜起有限整体变更设立股份有限公司，选举股份公司第一届董事会成员。董事会
	Stephen Kuong-Io Tai			
	邓向东			
	李荣信			
	李亚军			

时间	董事会成员	提名/委派来源	变动人数情况	变动原因及对生产经营的影响
	Yao SUN			由 9 名董事组成，其中新增 3 名为独立董事。对生产经营无不利影响。
	吕长江			
	刘敬东			
	俞波			
2018 年 11 月	杨崇和	新增董事由公司董事会提名	增加 2 人	公司第六次增资修改公司章程，为完善公司治理结构，新增董事 2 名。对生产经营无不利影响。
	Stephen Kuong-Io Tai			
	邓向东			
	李荣信			
	李亚军			
	Yao SUN			
	Brent Alexander Young			
	周禹鹏			
	吕长江			
	刘敬东			
俞波				
2019 年 3 月	杨崇和	变更 1 人由公司董事会提名	变更 1 人	公司 1 名独立董事因个人原因辞职，公司增补选举 1 名新独立董事。对生产经营无不利影响。
	Stephen Kuong-Io Tai			
	邓向东			
	李荣信			
	李亚军			
	Yao SUN			
	Brent Alexander Young			
	尹志尧			
	吕长江			
	刘敬东			
俞波				

上述董事变动中，2018 年 4 月公司董事由 3 名增加为 6 名，其中变动 1 人，

增加 3 人。该次变动系因公司拆除境外架构，将 Montage Holding 董事会平移至澜起有限。自 2017 年 1 月 1 日至 2018 年 4 月公司拆除境外架构前，公司原境外母公司 Montage Holding 董事为杨崇和、Stephen Kuong-Io Tai、邓向东、李荣信、李亚军、Yao SUN，上述董事目前均仍为公司董事，该次变动并未导致核心人员发生变化。

综上所述，公司最近 2 年董事变动比例较小，相关人员增加均为满足公司治理的要求，核心人员未发生变化，对公司的生产经营未产生重大不利影响，公司董事未发生重大不利变化。

3.2 保荐机构和发行人律师核查过程和核查意见

保荐机构和发行人律师获取并审阅最近两年公司章程、合资合同、股东协议等文件；获取了董事调查表；获取了发行人原境外母公司 Montage Holding 董事名册；获取并审阅了发行人股东大会/股东会、董事会会议文件；获取并审阅了发行人董事委派函。

经核查，保荐机构和发行人律师认为发行人最近 2 年董事会核心人员未发生变化，董事变动对发行人生产经营未产生重大不利影响，发行人董事未发生重大不利变化。

3.3 补充披露情况

发行人已在招股说明书“第五节 发行人基本情况”之“十七、报告期内公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员最近两年的变动情况（一）董事变动情况”中补充披露如下：

时间	董事会成员	提名/委派来源	变动人数情况	变动原因及对生产经营的影响
2017 年 1 月	杨崇和	由股东 Montage HK 委派	-	-
	Stephen Kuong-Io Tai			
	Jung-Kung Yang			
2018 年 4 月	杨崇和	由股东 WLT 委派	变动 1 人，增加 3 人	澜起有限拆除境外架构，将
	Stephen Kuong-Io Tai			

时间	董事会成员	提名/委派来源	变动人数情况	变动原因及对生产经营的影响
	邓向东	由股东中电投控委派		Montage Holding 董事会平移至境内。对生产经营无不利影响。
	李荣信			
	李亚军	由上海临理、上海临丰、上海临骥、上海临利、上海临国、临桐建发、上海临齐共同委派		
	Yao SUN	由股东中证投资委派		
2018年10月	杨崇和	由澜起有限董事会提名	增加3人	澜起有限整体变更设立股份有限公司，选举股份公司第一届董事会成员。董事会由9名董事组成，其中新增3名为独立董事。对生产经营无不利影响。
	Stephen Kuong-Io Tai			
	邓向东			
	李荣信			
	李亚军			
	Yao SUN			
	吕长江			
	刘敬东			
俞波				
2018年11月	杨崇和	新增董事由公司董事会提名	增加2人	公司第六次增资修改公司章程，为完善公司治理结构，新增董事2名。对生产经营无不利影响。
	Stephen Kuong-Io Tai			
	邓向东			
	李荣信			
	李亚军			
	Yao SUN			
	Brent Alexander Young			
	周禹鹏			
	吕长江			
	刘敬东			
俞波				
2019年3月	杨崇和	变更1人由公司董事会提名	变更1人	公司1名独立董事因个人原因辞
	Stephen Kuong-Io Tai			

时间	董事会成员	提名/委派来源	变动人数 情况	变动原因及 对生产经营 的影响
	邓向东			职，公司增 补选举1名 新独立董 事。 对生产经营 无不利影 响。
	李荣信			
	李亚军			
	Yao SUN			
	Brent Alexander Young			
	尹志尧			
	吕长江			
	刘敬东			
	俞波			

问题四

申报材料显示，2019年2月22日，第一届董事会第四次会议审议通过《关于提请召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》，全体股东签署了豁免股东大会通知期限的豁免函，将股东大会通知期限由提前15日变更为提前3日。2019年2月28日，发出《2019年第一次临时股东大会会议通知》，3月5日召开2019年第一次临时股东大会。

请发行人披露《公司章程》《股东大会议事规则》中关于年度股东大会通知的规定、本次股东大会的召开程序以及是否存在全体股东对于上述股东大会决议效力的确认意见，必要时请作重大事项提示。

请保荐机构、发行人律师进行核查，并就发行人本次股东大会召开程序是否符合《公司法》《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定，是否属于重大违法违规行，是否存在相关股东起诉请求撤销股东大会决议的风险，公司治理结构是否健全并有效运作，以及对本次发行上市的影响发表明确意见。

回复：

4.1 发行人说明

请发行人披露《公司章程》《股东大会议事规则》中关于年度股东大会通知的规定、本次股东大会的召开程序以及是否存在全体股东对于上述股东大会决议效力的确认意见，必要时请作重大事项提示

2019年2月20日，公司全体股东签署《关于豁免股东大会通知期限的同意函》，全体股东同意如公司召开股东大会审议与上市相关的议案，股东大会通知期限由提前15日变更为提前3日。

2019年2月22日，公司第一届董事会第四次会议审议通过了《关于提请召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》，决议于2019年3月5日召开2019年第一次临时股东大会审议与上市相关的议案。2019年2月28日，董事会向全体股东发出召开股东大会的通知。

2019年3月5日，公司召开2019年第一次临时股东大会，公司全体股东均自行或委托代理人出席了本次会议，全体股东对本次发行并上市的议案均投赞成

票，审议通过了与本次发行并上市有关的议案，并对决议进行签署确认。

公司《公司章程》第五十二条规定：召集人将在年度股东大会召开 20 日前通知各股东，临时股东大会将于会议召开 15 日前通知各股东。公司在计算起始期限时，不包括会议召开当日。公司《股东大会议事规则》第十四条规定：召集人应当在年度股东大会召开 20 日前以公告方式通知各股东，临时股东大会应当于会议召开 15 日前以公告方式通知各股东。

公司 2019 年第一次临时股东大会的通知期限不足《公司法》、《公司章程》以及《股东大会议事规则》的规定通知时限，但全体股东均在该次股东大会通知发出前，对于股东大会的通知时间进行了豁免，同意缩短股东大会通知期限，此外公司全体股东均自行或委托代理人出席了公司 2019 年第一次临时股东大会，审议通过了与本次发行并上市有关的议案，且对本次发行并上市的议案均 100% 投赞成票。

4.2 保荐机构和发行人律师核查过程和核查意见

保荐机构和发行人律师获取并审阅了发行人第一届董事会四次会议文件、2019年第一次临时股东大会文件；获取并审阅了发行人全体股东签署的《关于豁免股东大会通知期限的同意函》；获取并审阅了发行人公司章程、股东大会议事规则。

经核查，保荐机构和发行人律师认为，上述情况不存在损害股东利益的情况，不属于重大违法违规行为，不存在相关股东起诉请求撤销2019年第一次临时股东大会决议的风险，发行人的治理结构健全并有效运作，上述事项对本次发行上市无实质不利影响。

4.3 补充披露情况

发行人已在招股说明书“第七节 公司治理及独立性”之“二、股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书以及审计委员会等机构和人员的运行及履职情况（一）股东大会的运行情况”中补充披露如下：

自公司设立以来，截至本招股说明书签署日，公司共计召开了 4 次股东大会，相关股东或股东代表出席了会议，其中发行人 2019 年第一次临时股东大会

的通知期限不足规定的通知时限，但全体股东均在该次股东大会通知发出前，对于股东大会的通知时间进行了豁免，并同意缩短股东大会通知期限，股东大会决议有效。

问题五

请发行人说明：（1）珠海融扬股权投资合伙企业（有限合伙）与珠海融英股权投资合伙企业（有限合伙）之间、CEC Industrial Development Investment Inc.与CEC Capital 管理的两个基金之间是否存在关联关系或一致行动关系，珠海融英股权投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人杨崇颐是否与发行人董事长杨崇和存在亲属关系，如存在，请在招股说明书中充分披露上述信息；（2）发行人股东中是否存在私募股权基金，是否按照《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》等规定履行登记备案程序，发行人历史上股东穿透后的人数是否存在超过200人的情况；（3）发行人直接或间接股东中是否存在“三类股东”，出资的资金来源是否合法合规，是否存在股份代持、委托持股等情形，发行人股份是否清晰稳定；（4）发行人改制、历次股权转让、未分配利润转增股本时，各股东缴纳所得税的情况。

请保荐机构、发行人律师进行核查，说明核查方式、过程及依据，并发表明确意见。

回复：

5.1 发行人说明

一、珠海融扬股权投资合伙企业（有限合伙）与珠海融英股权投资合伙企业（有限合伙）之间、CEC Industrial Development Investment Inc.与CEC Capital 管理的两个基金之间是否存在关联关系或一致行动关系，珠海融英股权投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人杨崇颐是否与发行人董事长杨崇和存在亲属关系，如存在，请在招股说明书中充分披露上述信息

1、截至本问询函回复签署日，珠海融英的合伙人出资情况如下：

序号	合伙人姓名/名称	合伙人类型	出资比例（%）
1	青岛蓝色半岛股权投资管理有限公司	普通合伙人	0.00
2	杨崇颐	普通合伙人	0.00
3	Harmonialux Holdings(Hong Kong) Limited	有限合伙人	100.00
合计			100.00

截至本问询函回复签署日，珠海融扬的合伙人出资情况如下：

序号	合伙人姓名/名称	合伙人类型	出资比例（%）
1	Theon Management Limited	普通合伙人	0.00
2	杨智涵	普通合伙人	0.00
3	Theon Investment Hong Kong Limited	有限合伙人	100.00
合计			100.00

珠海融英与珠海融扬向上穿透的合伙人之间不存在重叠。根据珠海融英与珠海融扬的确认，截至本问询函回复签署日双方之间不存在关联关系或一致行动关系。

2、CEC Industrial Development Investment Inc.为中电投控的全资子公司。CEC Capital Fund, L.P.、CEC Capital Fund II, L.P.为自然人袁霞控制的主体。

CEC Capital Fund, L.P.已更名为 Xinyun Capital Fund, L.P.，截至本问询函回复签署日，其合伙人出资情况如下：

序号	合伙人姓名/名称	合伙人类型	出资比例（%）
1	Xinyun Capital Management,Ltd.	普通合伙人	0.00
2	Tonex Controls Limited	有限合伙人	91.74
3	Leslie Lee	有限合伙人	8.26
合计			100.00

CEC Capital Fund II, L.P.已更名为 Xinyun Capital Fund III, L.P.，截至本问询函回复签署日，其合伙人出资情况如下：

序号	合伙人姓名/名称	合伙人类型	出资比例（%）
1	Xinyun Capital Management III,Ltd.	普通合伙人	0.00
2	Li Tong	有限合伙人	56.25
3	Sino French Resources Limited	有限合伙人	16.41
4	Sun Fanghong	有限合伙人	19.79
5	Jimmy Lee	有限合伙人	7.55
合计			100.00

CEC Capital Fund, L.P. 为自然人袁霞控制的主体，与中电投控之间不存在股权关系或其他关联关系，因其在私有化澜起科技过程中与中电投控有合作关系，

因此历史上曾采用了 CEC Capital Fund, L.P. 的名称。CEC Capital Fund II, L.P. 也为袁霞控制的主体。

根据 Xinyun Capital Fund, L.P.、Xinyun Capital Fund III, L.P. 及中电投控的确认，截至本问询函回复签署日，CEC Industrial Development Investment Inc. 与 CEC Capital Fund, L.P.、CEC Capital Fund II, L.P. 之间不存在关联关系或一致行动关系。

3、珠海融英股权投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人杨崇颐与公司董事长杨崇和是姐弟关系。

二、发行人股东中是否存在私募股权基金，是否按照《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》等规定履行登记备案程序，发行人历史上股东穿透后的人数是否存在超过 200 人的情况

公司股东存在私募基金，相关股东已根据《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》等规定履行登记备案程序，私募基金管理人均已完成登记手续，私募基金均已完成备案，具体情况如下：

序号	股东名称	基金备案情况
1	嘉兴芯电	基金编号：SET974
2	上海临理	基金编号：SE0214
3	上海临丰	基金编号：SJ0626
4	上海临骥	基金编号：SE5972
5	上海临利	基金编号：SH3810
6	上海临国	基金编号：SL4550
7	临桐建发	基金编号：SH2771
8	上海临齐	基金编号：SE5169
9	嘉兴宏越	基金编号：SEJ421
10	嘉兴莫奈	基金编号：SEU160
11	臻石一号	基金编号：ST2241
12	臻石二号	基金编号：ST2274
13	臻石三号	基金编号：ST2277
14	中睿一期	基金编号：S84745
15	中睿二期	基金编号：S84726
16	泰瑞嘉德	基金编号：SL7233

17	华天宇投资	基金编号：SX3082
18	上海华伊	基金编号：SX9682
19	宁波信远	基金编号：SK5879
20	杭州调露	基金编号：ST4407
21	上海君弼	基金编号：SE7906

公司原境外母公司 Montage Group 曾为美国 Nasdaq 上市公司，穿透后股东人数曾超过 200 人。2014 年，Montage Group 完成私有化并从 Nasdaq 退市，2018 年 4 月，公司拆除境外架构后形成目前以私募基金为主的股权结构。相关私募基金均已完成基金备案，目前公司股东共 46 名，穿透后人数不超过 200 人，具体情况如下：

序号	股东姓名/名称	是否穿透计算	原因	计算股东数量
1	中电投控	是	-	17
2	WLT	是	-	5
3	珠海融英	是	-	3
4	Xinyun	是	-	4
5	Xinyun III	是	-	4
6	中证投资	是	-	1
7	Theon Investment	是	-	10
8	珠海融扬	是	-	12
9	光大投资	是	-	1
10	西藏长乐	是	-	1
11	前海珂玺	是	-	2
12	New Speed	是	-	4
13	Pine Stone Capital	是	-	1
14	Intel Capital	是	-	1
15	嘉兴芯电	否	已备案私募基金	1
16	上海临理	否	已备案私募基金	1
17	上海临丰	否	已备案私募基金	1
18	上海临骥	否	已备案私募基金	1
19	上海临利	否	已备案私募基金	1
20	上海临国	否	已备案私募基金	1
21	临桐建发	否	已备案私募基金	1

序号	股东姓名/名称	是否穿透计算	原因	计算股东数量
22	上海临齐	否	已备案私募基金	1
23	嘉兴宏越	否	已备案私募基金	1
24	嘉兴莫奈	否	已备案私募基金	1
25	臻石一号	否	已备案私募基金	1
26	臻石二号	否	已备案私募基金	1
27	臻石三号	否	已备案私募基金	1
28	中睿一期	否	已备案私募基金	1
29	中睿二期	否	已备案私募基金	1
30	泰瑞嘉德	否	已备案私募基金	1
31	华天宇投资	否	已备案私募基金	1
32	上海华伊	否	已备案私募基金	1
33	宁波信远	否	已备案私募基金	1
34	杭州调露	否	已备案私募基金	1
35	上海君弼	否	已备案私募基金	1
36	Xinyun I	否	非专门投资于公司的境外知名基金	1
37	TransLink	否	非专门投资于公司的境外知名基金	1
38	BICI	否	非专门投资于公司的境外知名基金	1
39	SVIC No. 28 Investment	否	非专门投资于公司的境外知名基金	1
40	Green Spark	否	非专门投资于公司的境外知名基金	1
41	Chen Xiao	否	自然人	1
42	Lip-Bu Tan	否	自然人	1
43	Ko Ping Keung	否	自然人	1
44	Xi Jin	否	自然人	1
45	Shun-Wen Chang	否	自然人	1
46	Qian-Shen Bai	否	自然人	1
合计				98

注：计算股东数量是指穿透计算最上层自然人、国资委、上市公司、境外知名基金。

三、发行人直接或间接股东中是否存在“三类股东”，出资的资金来源是否合法合规，是否存在股份代持、委托持股等情形，发行人股份是否清晰稳定

1、公司直接股东中不存在“三类股东”。

2、持有公司 5%以上股份的股东向上穿透后不存在“三类股东”。

3、持有公司 5%以下股份的股东向上穿透后存在“三类股东”，相关“三类股东”间接持有公司股份比例合计不超过 5%。具体情况如下：

(1) 公司股东中睿一期穿透后存在“三类股东”，为鹏华资产管理（深圳）有限公司管理的鹏华资产信益财富 6 期专项资产管理计划（以下简称“鹏华信益 6 期”）。

鹏华信益 6 期已于 2015 年 9 月 2 日在基金业协会完成资产管理计划备案，产品编码：SC9075，资产管理人为鹏华资产管理有限公司（原名称为鹏华资产管理（深圳）有限公司），已依法注册登记。

中睿一期已完成私募基金备案，基金编号：S84745。

根据相关股东及公司董事、监事、高级管理人员和本次发行的中介机构签字人员的确认，相关股东用于投资公司的资金来源合法合规，鹏华信益 6 期出资人不存在股份代持、委托持股等情形，公司董事、监事、高级管理人员和本次发行的中介机构及其签字人员未在鹏华资产信益财富 6 期中持有权益。

(2) 公司股东中睿二期穿透后存在“三类股东”，为鹏华资产管理（深圳）有限公司管理的鹏华资产信益财富 7 期专项资产管理计划（以下简称“鹏华信益 7 期”）。

鹏华信益 7 期已于 2015 年 9 月 2 日在基金业协会完成资产管理计划备案，产品编码：SC9076，资产管理人为鹏华资产管理有限公司（原名称为鹏华资产管理（深圳）有限公司），已依法注册登记。

中睿二期已完成私募基金备案，基金编号：S84726。

根据相关股东及公司董事、监事、高级管理人员和本次发行的中介机构签字人员的确认，相关股东用于投资公司的资金来源合法合规，鹏华信益 7 期出资人不存在股份代持、委托持股等情形，公司董事、监事、高级管理人员和本次发行的中介机构及其签字人员未在鹏华资产信益财富 7 期中持有权益。

(3) 公司股东上海华伊、泰瑞嘉德穿透后的合伙人苏州工业园区元禾秉胜

股权投资基金合伙企业（有限合伙）穿透后存在“三类股东”，均为上海国泰君安证券资产管理有限公司管理的国君资管 1628 定向资产管理合同（以下简称“国君 1628 定向资管”）。

国君 1628 定向资管已于 2016 年 8 月 17 日在基金业协会完成资产管理计划备案，产品编码：SG8603，资管管理人为上海国泰君安证券资产管理有限公司，已依法注册登记。

上海华伊已完成私募基金备案，基金编号：SX9682。泰瑞嘉德已完成私募基金备案，基金编号：SL7233。

根据相关股东及公司董事、监事、高级管理人员和本次发行的中介机构签字人员的确认，相关股东用于投资公司的资金来源合法合规，公司董事、监事、高级管理人员和本次发行的中介机构及其签字人员未在国君 1628 定向资管中持有权益。

公司股东出资的资金来源合法合规，不存在股份代持、委托持股等情形，股份清晰稳定。

四、发行人改制、历次股权转让、未分配利润转增股本时，各股东缴纳所得税的情况

公司历史上不存在未分配利润转增股本的情形，其改制、历次股权转让时，各股东缴纳所得税的情况如下：

1、改制时缴纳所得税情况

公司改制时发起人股东中，境外非自然人股东已向国家税务总局上海市徐汇区税务局递交境外投资者递延缴纳预提所得税报告并获得其确认，可以享受递延纳税待遇。

根据《财政部、国家税务总局关于个人所得税若干政策问题的通知》的规定，外籍个人从外商投资企业取得的股息、红利所得暂免征收个人所得税。

根据境内法人股东及境内合伙企业股东的确认，其将按照法律、法规及规范性文件的要求，向主管税务机关申报相应税款。

2、历次股权转让所得税缴纳情况

(1) 第一次股权转让

2010年11月，Montage Group 将其所持澜起有限 100% 股权（对应注册资本 1,000 万美元）转让予 Montage HK。转让价格为原股东的投入成本，转让方无需就本次股权转让缴纳所得税。

(2) 第二次股权转让

2018年4月，Montage HK 将其所持澜起有限 83.757% 股权转让给包括中电投控、嘉兴芯电、WLT 在内的 39 名境内外主体，对于受让方是境外主体的，Montage HK 向澜起有限主管税务机关上海市徐汇区税务局办理了所得税申报手续；对于受让方是境内主体的，该等境内受让方作为扣缴义务人均已向各自税务主管机关报送了对外支付税务备案表。

5.2 保荐机构和发行人律师核查过程和核查意见

1、保荐机构和发行人律师获取并审阅了发行人股东珠海融英、珠海融扬的工商登记资料、调查问卷、穿透后股权结构；获取并审阅了 CEC Industrial Development Investment Inc. 股东名册；获取并审阅了 Xinyun Capital Fund, L.P.、Xinyun Capital Fund III, L.P. 合伙人名册、调查问卷、穿透后股权结构；取得 Xinyun Capital Fund, L.P.、Xinyun Capital Fund III, L.P. 出具的确认函；获取并审阅了发行人董事长杨崇和的调查问卷；

2、获取并审阅了发行人股东工商内档、股东名册、调查问卷、穿透后股权结构；获取并审阅了发行人私募基金股东私募基金备案公示信息；获取并审阅了发行人工商内档；

3、获取并审阅了“三类股东”涉及的资管合同、产品备案信息，取得最终出资人确认文件；

4、获取了各股东的税务备案表以及股东出具的有关纳税的声明。

经核查，保荐机构和发行人律师认为：

1、珠海融英与珠海融扬向上穿透的合伙人之间不存在重叠。截至本问询函

回复签署日，双方之间不存在任何关联关系或一致行动关系； CEC Industrial Development Investment Inc.与 CEC Capital Fund, L.P.、CEC Capital Fund II, L.P.之间不存在关联关系或一致行动关系；珠海融英股权投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人杨崇颐与发行人董事长杨崇和系姐弟关系；

2、发行人原境外母公司Montage Group曾为美国Nasdaq上市公司，穿透后股东人数曾超过200人。截至本问询函回复签署日，发行人穿透后股东不超过200人；

3、发行人股东中持有发行人5%以下股份的股东向上穿透后存在“三类股东”，相关“三类股东”间接持有公司股份比例合计不超过5%。发行人股东出资的资金来源合法合规，不存在纠纷或潜在纠纷，不影响发行人股权的稳定性；

4、发行人改制、历次股权转让、未分配利润转增股本时，除无需办理税务缴纳的股东外，发行人各股东已按照或承诺将按照相关税务法律法规的规定办理了纳税申报。

5.3 补充披露情况

发行人已在招股说明书“第五节 发行人基本情况”之“十、发行人股本情况（五）本次发行前各股东间的关联关系”中补充披露如下：

珠海融英的执行事务合伙人杨崇颐与发行人董事长杨崇和是姐弟关系。

问题六

请发行人说明：（1）上海临理、上海临丰、上海临骥、上海临利、上海临国、临桐建发、上海临齐、臻石一号、臻石二号、臻石三号等股东是否存在将发行人股份进行质押的情形，如存在，请在招股说明中充分披露相关信息；（2）如存在股份质押，请逐项说明质押时间、出质人、质权人、质押股份数量、主债务合同及质押合同的情况，并结合出质人的财务状况及清偿能力，说明质权人是否可能强制处分质押股份，该等情形对发行人实际控制权及股权稳定性的影响，以及上述股东的应对措施。

请保荐机构、发行人律师进行核查，说明核查方式、过程，并发表明确意见。

回复：

6.1 发行人说明

截至公司递交上市申请之日，上海临理、上海临丰、上海临骥、上海临利、上海临国、临桐建发、上海临齐、臻石一号、臻石二号、臻石三号等股东不存在将公司股份质押的情形。

自公司递交上市申请之日起至本问询函回复报告签署日，公司股东持有公司的股份不存在质押的情形。

6.2 保荐机构和发行人律师核查过程和核查意见

保荐机构和发行人律师获取并审阅了发行人的工商内档；获取并审阅国家企业信用信息公示系统；取得发行人及其股东的确认文件。

经核查、保荐机构和发行人律师认为，截至发行人递交上市申请之日，上海临理、上海临丰、上海临骥、上海临利、上海临国、临桐建发、上海临齐、臻石一号、臻石二号、臻石三号等股东均不存在将发行人股份质押的情形。自发行人递交上市申请之日起至本问询函回复签署日，发行人股东持有发行人的股份不存在质押的情形。

问题七

对于申报前一年内发行人通过增资或股权转让引入的新股东,请发行人补充披露相关股东的股权结构及实际控制人,如为合伙企业的,请补充披露其基本情况及其普通合伙人的基本信息,如为自然人的,请补充披露其基本信息。

请保荐机构、发行人律师核查相关股东的基本情况、引入新股东的原因、股权转让或增资的价格及定价依据,有关股权转让是否是双方真实意思表示,是否存在纠纷或潜在纠纷,新股东与发行人其他股东、董事、监事、高级管理人员、本次发行中介机构负责人及其签字人员、发行人的客户及供应商是否存在亲属关系、关联关系、委托持股、信托持股或其他利益输送安排,新股东是否具备法律、法规规定的股东资格,并发表明确意见。

回复:

7.1 发行人说明

申报前一年,公司发生过一次转让及一次增资,具体情况如下:

(1) 公司股权转让

2018年4月26日,澜起有限决议同意股东 Montage HK 将其所持澜起有限83.757%股权转让予包括中电投控、嘉兴宏越、嘉兴芯电在内的39名境内外主体。此次股权转让的目的实际为公司拆除境外架构以实现公司间接股东直接持有澜起有限股权,由 Montage Holding 股东出具授权书对转让股份的受让方进行指定,因此此次股权转让受让股份的股东不属于公司引入的新股东。此次股权转让受让的股东其基本情况已在招股说明书“第五节 发行人基本情况”之“九、公司股东及实际控制人的基本情况”之“(一)持有5%以上股份的股东基本情况”及“第五节 发行人基本情况”之“九、公司股东及实际控制人的基本情况”之“(二)其他股东”部分进行了披露。

(2) 公司增加注册资本

2018年11月23日,公司2018年第一次临时股东大会作出决议,同意 Intel Capital 以175,074,860美元的价格认购101,683,250股新增股份,SVIC No. 28 Investment 以19,452,762美元的价格认购11,298,150股新增股份,增资价格系公

司与增资方协商确定。此次增资后公司注册资本由 903,851,100 元增加至 1,016,832,500 元。

此次增资引入新股东 Intel Capital 及 SVIC No. 28 Investment 其实际控制人分别为 Intel Corporation 及三星电子，为公司客户、供应商。2018 年 4 月，公司拆除境外架构，Intel Capital 及 SVIC No. 28 Investment 作为 Montage Holding 境外优先股股东存在增资公司的意愿，但考虑到目前境内拟上市公司暂无优先股股权设置，同时由于公司业绩增长迅速，经过谈判 Intel Capital 及 SVIC No. 28 Investment 投资公司相关事宜于 2018 年 12 月完成，相关价格为谈判结果。

公司新增股东的基本情况具体如下：

1) Intel Capital Corporation 的基本情况如下：

公司名称	Intel Capital Corporation
成立时间	1998 年 4 月 6 日
公司注册编号	2880872
主营业务	投资

截至本问询函回复签署日，股东构成及出资比例如下表所示：

序号	股东名称	出资比例 (%)
1	Intel Corporation	100.00
	合计	100.00

2) SVIC No. 28 Investment 基本情况如下：

公司名称	SVIC No. 28 New Technology Business Investment L.L.P.
成立时间	2015 年 2 月 5 日
公司注册编号	214-80-12280
经营范围	投资

截至本问询函回复签署日，SVIC No. 28 Investment 合伙人构成及出资比例如下表所示：

序号	合伙人名称	合伙人类型	出资比例 (%)
1	Samsung Venture Investment Co., Ltd.	普通合伙人	1.00
2	Samsung Electronics Co., Ltd.	有限合伙人	99.00
	合计		100.00

普通合伙人 Samsung Venture Investment Co., Ltd 基本情况如下： .

公司名称	Samsung Venture Investment Co., Ltd.
成立时间	1999 年 10 月 8 日
公司注册编号	110111-1785538
经营范围	投资

(3) 公司申报前一年通过转让及增资引入的股东同公司的关系情况如下：

公司股东之间的关联关系详见本问询函回复第一题。

股东与发行人董事、监事、高级管理人员、本次发行中介机构负责人及其签字人员、发行人的客户及供应商之间的关系

序号	股东名称/姓名	备注
1	中电投控	公司董事邓向东任董事长、总经理
2	嘉兴芯电	公司董事邓向东在其控股股东中电投控任职
3	WLT	公司董事长杨崇和及总经理 Stephen Kuong-Io Tai 在 WLT 分别持有 23.33% 的权益
4	上海临理	公司董事李亚军担任其普通合伙人临芯投资董事长、总经理
5	上海临丰	公司董事李亚军担任其普通合伙人临芯投资董事长、总经理
6	上海临骥	公司董事李亚军担任其普通合伙人临芯投资董事长、总经理
7	上海临利	公司董事李亚军担任其普通合伙人临芯投资董事长、总经理
8	上海临国	公司董事李亚军担任其普通合伙人临芯投资董事长、总经理
9	临桐建发	公司董事李亚军担任其普通合伙人临芯投资董事长、总经理
10	上海临齐	公司董事李亚军担任其普通合伙人临芯投资董事长、总经理
11	嘉兴宏越	无
12	嘉兴莫奈	无
13	Xinyun I	无
14	Xinyun	无
15	Xinyun III	无
16	中证投资	保荐机构中信证券全资子公司, 公司董事 Yao SUN 任职的公司
17	中睿一期	无

序号	股东名称/姓名	备注
18	中睿二期	无
19	泰瑞嘉德	无
20	华天宇投资	无
21	上海华伊	无
22	光大投资	无
23	西藏长乐	无
24	宁波信远	无
25	杭州调露	无
26	上海君弼	无
27	Green Spark	无
28	Chen Xiao	无
29	New Speed	无
30	TransLink	无
31	Pine Stone Capital	无
32	BICI	无
33	Lip-Bu Tan	无
34	Ko Ping Keung	无
35	前海珂玺	无
36	Xi Jin	无
37	Shun-Wen Chang	无
38	Qian-Shen Bai	无
39	Intel Capital	其控股股东 Intel Corporation 为公司客户、供应商，公司董事 Brent Alexander Young 在其实际控制人及关联方中任职
40	SVIC No. 28 Investment	其实际控制人三星电子为公司客户

除上述事项外，公司申报一年内通过转让及增资引入的股东与公司其他股东、董事、监事、高级管理人员、本次发行中介机构负责人及其签字人员不存在亲属关系、关联关系、委托持股、信托持股或其他利益输送安排，同时具备法律、法规规定的股东资格。相关股东均已出具声明，对上述事项进行确认。

7.2 保荐机构和发行人律师核查过程和核查意见

保荐机构和发行人律师获取并审阅发行人申报一年内股权转让及增资的工

商变更文件及协议；获取并审阅了公司拆除境外架构前后的股权结构；获取了公司间接股东出具的指定主体承接公司股份的授权书；获取了各股东出具的股东声明及调查表。

经核查，保荐机构和发行人律师认为发行人申报前一年股权转让及增资定价公允，相关股权转让及增资系双方真实意思表示，不存在纠纷及潜在纠纷。除上述披露事项外，公司增资引入的股东与发行人其他股东、董事、监事、高级管理人员、本次发行中介机构负责人及其签字人员不存在亲属关系、关联关系、委托持股、信托持股或其他利益输送安排，同时具备法律、法规规定的股东资格。

7.3 补充披露情况

发行人已在招股说明书“第五节 发行人基本情况”之“十、发行人股本情况（四）发行人新增股东情况”中补充披露如下：

1) **Intel Capital Corporation** 的基本情况如下详见本招股说明书本节之“九、公司股东及实际控制人的基本情况”之“(一) 持有 5% 以上股份的股东基本情况”。

2) **SVIC No. 28 Investment** 基本情况如下：

公司名称	SVIC No. 28 New Technology Business Investment L.L.P.
成立时间	2015 年 2 月 5 日
公司注册编号	214-80-12280
经营范围	投资

截至本招股说明书签署日，**SVIC No. 28 Investment** 的合伙人构成及出资比例如下表所示：

序号	合伙人名称	合伙人类型	出资比例 (%)
1	Samsung Venture Investment Co., Ltd.	普通合伙人	1.00
2	Samsung Electronics Co., Ltd.	有限合伙人	99.00
合计			100.00

普通合伙人 **Samsung Venture Investment Co., Ltd** 基本情况如下：.

公司名称	Samsung Venture Investment Co., Ltd.
成立时间	1999 年 10 月 8 日

公司名称	Samsung Venture Investment Co., Ltd.
公司注册编号	110111-1785538
经营范围	投资

问题八

请发行人严格按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第41号—科创板公司招股说明书》（以下简称《准则》）的要求，充分披露：（1）董事、监事、高级管理人员及核心技术人员与发行人及其业务相关的对外投资情况（包括5%以下），包括投资金额、持股比例、有关承诺和协议，对于存在利益冲突情形的，应披露解决情况；（2）发行人与董事、监事、高级管理人员及核心技术人员所签定的对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的协议，以及有关协议的履行情况；（3）董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的薪酬确定依据、所履行的程序，最近一年从发行人及其关联企业领取收入的情况，以及所享受的其他待遇和退休金计划等。

回复：

8.1 发行人说明

一、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员与发行人及其业务相关的对外投资情况（包括5%以下），包括投资金额、持股比例、有关承诺和协议，对于存在利益冲突情形的，应披露解决情况；

截至本问询函回复签署日，公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员对外投资情况如下：

姓名	本公司任职	对外投资企业	出资比例 (%)
杨崇和	董事长、核心技术人员	WLT	23.33
Stephen Kuong-Lo Tai	董事兼总经理	WLT	23.33
苏琳	副总经理兼财务负责人	嘉兴铂林投资管理有限公司	50.00
		蒋石三号	7.58
梁铂钴	副总经理兼董事会秘书	嘉兴铂林投资管理有限公司	50.00
		蒋石三号	9.86
邓向东	董事	武汉伊莱克启明股权投资基金管理有限公司	96.00
		鑫安资本有限责任公司	52.50
		天津伊莱克长庚企业管理合伙企业（有限合	50.00

姓名	本公司任职	对外投资企业	出资比例 (%)
		伙)	
		武汉伊莱克股权投资基金合伙企业 (有限合伙)	6.20
		天津伊莱克晨星企业管理合伙企业 (有限合伙)	2.00
李亚军	董事	上海君尧商务咨询中心	100.00
		嘉兴君望投资管理有限公司	90.00
		广州新珀尔信息技术股份有限公司	51.00
		上海临芯投资管理有限公司	35.00
		上海习元资产管理有限公司	25.00
		深圳市卓越创智科技合伙企业 (有限合伙)	20.00
		宁波利科投资管理股份有限公司	3.70
		上海清云图投资合伙企业 (有限合伙)	3.33
		嘉兴康帅股权投资合伙企业 (有限合伙)	3.23
		浙江风向标科技有限公司	2.52
		上海临巍电子科技有限公司	0.01
尹志尧	独立董事	中微半导体设备 (上海) 股份有限公司	1.29
		Futago Pte. Ltd.	0.23
		Grenade Pte. Ltd.	1.92
夏晓燕	监事	上海光锐投资中心 (有限合伙)	99.00
		上海锋收投资中心 (有限合伙)	9.70
梁显效	监事	天津伊莱克晨星企业管理合伙企业 (有限合伙)	49.00
		四川特飞科技股份有限公司	2.00
		武汉伊莱克股权投资基金合伙企业 (有限合伙)	0.18
山岗	核心技术人员	蔘石三号	12.93
常仲元	核心技术人员	Theon Investment II,LP	13.84
史刚	核心技术人员	蔘石二号	2.53

其中除 WLT、嘉兴铂林投资管理有限公司、蔘石二号、蔘石三号、武汉伊莱克启明股权投资基金管理有限公司、武汉伊莱克股权投资基金合伙企业 (有限合伙)、上海清云图投资合伙企业 (有限合伙)、上海临芯投资管理有限公司、Theon Investment II,LP 为公司直接或间接股东外, 与公司及其业务均不存在相关关系, 且与公司均不存在利益冲突。

二、发行人与董事、监事、高级管理人员及核心技术人员所签定的对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的协议，以及有关协议的履行情况；

在公司任职的董事、高级管理人员及核心技术人员均与公司（或其控股子公司）签署了劳动合同，并与公司签署了雇员保密、竞业禁止和发明权利归属协议，其中对保密、竞业禁止、专利归属等事项均进行了详细约定。

除上述协议外，公司的董事、高级管理人员及核心技术人员未与公司签订其他协议。自签署协议签订以来，相关董事、高级管理人员、核心技术人员均严格履行合同约定的义务和职责，遵守相关承诺，迄今未发生违反合同义务、责任或承诺的情形。

三、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的薪酬确定依据、所履行的程序，最近一年从发行人及其关联企业领取收入的情况，以及所享受的其他待遇和退休金计划等。

公司内部董事、职工代表监事、高级管理人员及核心技术人员的薪酬由基本工资、奖金、社保福利等构成。其中基本工资及社保福利由劳动合同进行约定；奖金视公司当年度业绩情况进行确定。

公司独立董事在公司领取独立董事津贴；未在公司担任其他职务的外部董事（独立董事除外）、非职工代表监事不在公司领取报酬。

8.2 保荐机构核查过程和核查意见

保荐机构获取并审阅了公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员的调查表，并通过公开信息等渠道核查确认其对外投资企业同发行人及其业务的关系；获取了公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员签署的劳动合同、保密协议；获取了公司内部关于薪酬制度的说明文件。

8.3 补充披露情况

一、发行人已在招股说明书“第五节 公司治理及独立性”之“十二、公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员个人投资情况（二）董事、监事、高级管理人员及核心技术人员其他对外投资情况”中补充披露如下：

除作为发行人直接或间接股东外，发行人董事、监事、高级管理人员及核

心技术人员不存在与发行人及其业务相关或与公司存在利益冲突的对外投资。

二、发行人已在招股说明书“第五节 公司治理及独立性”之“十四、公司与董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的有关协议及重要承诺（一）劳动合同及保密协议”中补充披露如下：

在公司任职的董事、高级管理人员及核心技术人员均与公司（或其控股子公司）签署了劳动合同，并与公司签署了雇员保密、竞业禁止和发明权利归属协议，其中对保密、竞业禁止、专利归属等事项均进行了详细约定。

除上述协议外，公司的董事、高级管理人员及核心技术人员未与公司签订其他协议。自签署协议签订以来，相关董事、高级管理人员、核心技术人员均严格履行合同约定的义务和职责，遵守相关承诺，迄今未发生违反合同义务、责任或承诺的情形。

三、发行人已在招股说明书“第五节 公司治理及独立性”之“十三、公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员薪酬情况”中补充披露如下：

公司内部董事、职工代表监事、高级管理人员及核心技术人员的薪酬由基本工资、奖金、社保福利等构成。其中基本工资及社保福利由劳动合同进行约定；奖金视公司当年度业绩情况进行确定。

公司独立董事在公司领取独立董事津贴；未在公司担任其他职务的外部董事（独立董事除外）、非职工代表监事不在公司领取报酬。

问题九

申报材料显示，发行人境外上市期间曾实施股权激励方案，发行境外员工期权、限制性股票。公司实施私有化方案时，由私有化实施主体100%收购全部境外上市股权，包括之前境外发放的员工期权。

请发行人按照《问答》的规定，披露本次申报前已经制定或实施的股权激励或相关安排，股权激励对公司经营状况、财务状况、控制权变化等方面的影响。

请发行人说明：（1）相关股权激励方案、境外员工期权、限制性股票涉及的员工情况，发行人制定、实施及终止相关方案是否履行了必要的决策程序及审批手续，是否符合相关法律法规的规定，是否存在争议或纠纷；（2）私有化实施主体收购员工期权的具体情况、收购价格及定价依据，收购资金是否支付完毕，是否存在纠纷或潜在纠纷。

请保荐机构、发行人律师对上述事项进行核查，说明核查方式、过程及依据，并发表明确意见。

回复：

9.1 发行人说明

一、请发行人按照《问答》的规定，披露本次申报前已经制定或实施的股权激励或相关安排，股权激励对公司经营状况、财务状况、控制权变化等方面的影响

截至本问询函回复签署日，公司不存在已经制定或正在实施的股权激励或相关安排，历史上曾存在的股权激励为公司原境外母公司 Montage Group 发放，且已终止，对公司经营状况、财务状况、控制权变化等方面不存在影响。

二、相关股权激励方案、境外员工期权、限制性股票涉及的员工情况，发行人制定、实施及终止相关方案是否履行了必要的决策程序及审批手续，是否符合相关法律法规的规定，是否存在争议或纠纷

公司原境外母公司 Montage Group 曾于 2013 年在美国 Nasdaq 市场上市，其历史沿革中曾制定并实施了两次股权激励计划，分别为《2006 年股权激励计划》和《2013 年业绩股权激励计划》。Montage Group 就相关股权激励事项在上市后

于 2013 年 10 月 30 日发布股权激励事项公告，对上述股权激励方案进行了公告及确认。澜起有限受 Montage Group 委托对上述股权激励于 2013 年向国家外汇管理局上海市分局办理了相关外汇程序，符合相关法律法规的规定。

2014 年 6 月 11 日，Montage Group 发布公告，Montage Group 同上海浦东科技投资有限公司（以下简称“浦东科投”）签署合并计划与协议，该协议已经董事会审议通过，协议约定私有化交易价格为每股 22.60 美元。

2014 年 8 月 1 日，Montage Group 发布公告，Montage Group 于 2014 年 7 月 31 日召开股东大会，审议通过了同浦东科投签署合并计划与协议，批准了 Montage Group 私有化交易的实施。

2014 年 11 月 19 日，Montage Group 发布公告，Montage Holding 完成对 Montage Group 的收购，Montage Group 股票于 Nasdaq 退市。此次私有化为全面收购，相关股权激励计划由私有化实施主体出资收购。

2014 年 6 月 30 日，Montage Group 发布内部文件，通知全体员工股权激励终止事项。2014 年 11 月 19 日，Montage Group 发布公告，确认相关股权激励终止。2015 年 1 月 12 日，澜起有限受 Montage Group 委托向国家外汇管理局上海市分局办理了股权激励相关外汇账户的撤销，符合相关法律法规的规定，不存在纠纷及潜在纠纷。

三、私有化实施主体收购员工期权的具体情况、收购价格及定价依据，收购资金是否支付完毕，是否存在纠纷或潜在纠纷

2014 年 11 月 19 日，Montage Group 完成私有化交易，此次收购为全面收购，针对员工期权的收购价格为私有化价格与行权价格的差额，针对限制性股票的收购价格为私有化价格，相关收购资金已由 Montage Holding 于私有化时足额支付。Montage Group 经与员工协商，对相关员工期权、限制性股票款项采用了分期支付的方式，截至本问询函回复签署日，上述款项已足额支付，不存在纠纷及潜在纠纷。

9.2 保荐机构和发行人律师核查过程和核查意见

保荐机构和发行人律师获取并审阅了 Montage Group 境外公告文件；获取并审阅 Montage Group 股权激励相关决策文件；获取并审阅了 Montage Group 股权

激励相关员工清单,并对收购资金流水进行了抽查,对相关员工进行了抽查访谈,确认相关员工对股权激励事项的发放及终止知情,且无纠纷及潜在纠纷;获取并审阅了澜起有限受 Montage Group 委托办理以及撤销的外汇账户的相关手续;获取并审阅了股权激励相关银行账户的流水。

经核查,保荐机构和发行人律师认为, Montage Group 制定、实施及终止相关股权激励方案履行了必要的决策程序及审批手续,符合相关法律法规的规定,不存在争议或纠纷;私有化实施主体收购员工期权及限制性股票已履行完毕,不存在纠纷或潜在纠纷。

9.3 补充披露情况

发行人已在招股说明书“第五节 公司治理及独立性”之“十八、发行人员工及社会保障情况（三）员工薪酬情况”中补充披露如下：

截止本招股说明书签署之日,公司无正在执行的对董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、员工实行的股权激励及其他制度安排。

问题十

2013年9月26日，发行人原母公司Montage Group在美国Nasdaq上市交易，上市发行价为10美元，融资7,100万美元。2014年6月11日，上海浦东科技投资有限公司按照每普通股22.60美元的价格向Montage Group提出非约束性私有化要约，总交易金额约6.93亿美元。2014年11月19日，该笔交易完成，Montage Group股票于Nasdaq退市。

请发行人说明：（1）Montage Group境外上市的背景情况，上市期间是否受到Nasdaq的处罚，发行人2013年上市后短期内私有化退市的原因；（2）Montage Group在Nasdaq上市期间是否存在诉讼，如存在，请说明该等诉讼的事由及解决情况；（3）实施主体对Montage Group提出私有化要约的背景及私有化实施主体的情况，实施主体存在变更的原因；（4）Montage Holding在2015年至2016年之间的股权变动情况，Montage Holding向Intel Capital Corporation、SVIC No. 28 New Technology Business Investment L.L.P.发行A类优先股的价格、定价依据、优先股股东的权利义务等情况；（5）私有化交易价格相较于发行价溢价较高的原因及合理性，相关资金的具体来源、是否支付完毕，实施主体是否存在大额借款，如存在，请说明该等借款是否已偿还完毕，是否存在涉及到发行人股份的质押，借款各方是否存在争议或纠纷；（6）私有化过程是否存在异议股东以及相关争议的解决情况，相关方义务是否已经履行完毕，是否存在纠纷或潜在纠纷；（7）该等私有化交易在境内外履行的审批程序，涉及的税收、外汇等手续是否办理完毕，私有化交易是否合法有效。

请保荐机构、发行人律师对上述事项进行核查，说明核查方式、过程及依据，并发表明确意见。

回复：

10.1 发行人说明

一、Montage Group 境外上市的背景情况，上市期间是否受到 Nasdaq 的处罚，发行人 2013 年上市后短期内私有化退市的原因

Montage Group 是一家成立在境外，以境外投资方为主且主要在境外经营的

公司。由于 Montage Group 经营情况良好,为进一步增强资本实力,提升竞争力, Montage Group 决定在境外上市,并于 2013 年 9 月 26 日,在美国 Nasdaq 市场上市交易。

根据 O'Melveny & Myers LLP (以下简称“OMM”) 律师事务所出具的备忘录, Montage Group 在美国上市期间从未受到 Nasdaq 的处罚。

浦东科投长期关注集成电路行业的投资机会,在 2013 年就已关注到 Montage Group,在其上市后,根据其股价波动情况及其未来发展的考量作出决策,于 2014 年 3 月发出私有化要约。Montage Group 董事会结合私有化价格、未来发展战略等多方面因素,决定以每股 22.60 美元的价格接受浦东科投私有化要约,并经 Montage Group 股东大会审议通过,于 2014 年 11 月 19 日完成私有化交易,具有合理性。

二、Montage Group 在 Nasdaq 上市期间是否存在诉讼,如存在,请说明该等诉讼的事由及解决情况

根据 OMM 律师事务所出具的备忘录, Montage Group 在 Nasdaq 上市期间存在的诉讼情况如下: 2014 年 2 月,一家名为 Gravity Research 的做空机构发布针对 Montage Group 的做空报告,导致 Montage Group 股价出现一定波动,相关股东在纽约及加州地区合计发起 4 起针对 Montage Group 的诉讼。2014 年 5 月,上述诉讼合并为一起诉讼由美国加州北部地区法庭审理。该项诉讼已于 2017 年最终和解,和解费用为 725 万美金,相关和解不代表 Montage Group 有任何违法违规行为,不代表 Montage Group 信息披露存在误导性陈述,同时所有原股东也不得再以该事项对 Montage Group 及其董事、高级管理人员另行发起诉讼。2017 年 12 月 15 日,法院进行终审判决,裁定双方和解有效,上述集体诉讼正式完结。

根据该备忘录,截至 2019 年 3 月 20 日, Montage Group 不存在金额在 1 万美元以上的诉讼或行政处罚。

三、实施主体对 Montage Group 提出私有化要约的背景及私有化实施主体的情况,实施主体存在变更的原因

Montage Group 自上市后,经营情况良好,股价较发行价格持续上升,浦东科投作为境内知名的投资机构,一直密切关注相关的集成电路领域的投资机会,并对 Montage Group 进行了长期的跟踪和关注。浦东科投根据其投资策略结合

Montage Group 股价波动的情况，决定在 2014 年 3 月发起私有化要约，进行全面收购。在发布私有化要约公告后，中电投控等其他私有化参与方根据各自投资判断与浦东科投取得联系，最终决定共同参与此次 Montage Group 私有化，具有合理性。

2014 年 6 月，Montage Group 同浦东科投签署合并计划与协议，根据该协议的相关约定，实施主体可为浦东科投参与发起成立的投资平台。此次私有化的实施主体为 Montage Holding，系浦东科投与中电投控等投资方成立的境外投资平台，不存在实施主体的变更。

四、Montage Holding 在 2015 年至 2016 年之间的股权变动情况，Montage Holding 向 Intel Capital Corporation、SVIC No. 28 New Technology Business Investment L.L.P. 发行 A 类优先股的价格、定价依据、优先股股东的权利义务等情况

1、2014 年 12 月 31 日，Montage Holding 普通股股权结构为：

序号	股东	持有股份数（股）	持股比例
1	Neptune Connection Limited	11,595,133	38.29%
2	CEC Industrial Development Investment Inc.	11,118,280	36.72%
3	PKM Holding Co., Ltd.	6,061,515	20.02%
4	Xinyun Capital Fund, L.P.	1,376,343	4.55%
5	SK Telecom China Fund I, L.P.	130,000	0.43%
	合计	30,281,271	100.00%

此后，Montage Holding 的股东根据各自投资周期安排、经营需要等商业因素考虑，进行了多次股权转让，其中 Neptune Connection Limited 将部分股权转让给 WLT Partners, L.P.、Xinyun Capital Fund III, L.P. 等相关主体，CEC Industrial Development Investment Inc. 将其部分股权转让给 Xinyun Capital Fund, L.P. 等主体，PKM Holding Co., Ltd. 将其部分股权转让给 China Everbright Investment and Assets Management (HK) Limited。

2016 年 12 月 31 日，Montage Holding 普通股股权结构为：

序号	股东	持有股份数（股）	持股比例
1	CEC Industrial Development Investment Inc.	6,468,671	21.36%

序号	股东	持有股份数（股）	持股比例
2	PKM Holding Co., Ltd.	5,202,011	17.18%
3	Xinyun Capital Fund, L.P.	4,867,252	16.07%
4	Neptune Connection Limited	4,067,330	13.43%
5	WLT Partners, L.P.	4,009,145	13.24%
6	持股 5% 以下小股东	5,666,862	18.71%
合计		30,281,271	100.00%

2、Montage Holding 向 Intel Capital、SVIC No. 28 Investment 发行 A 类优先股的价格为每股 44.255 美元，该价格系各方结合 Montage Holding 的具体情况协商谈判确定。

3、Montage Holding 章程中就 A 类优先股股东的相关权利义务进行了规定，其主要内容包括为：

（1）优先股股东可以依据章程的约定享受优先分红的权利，Montage Holding 如进行分红，应当优先向 A 类优先股股东支付相当于其投资价格年化 8% 利息的收益；

（2）如 Montage Holding 新发行的普通股价格低于优先股价格，优先股股东有权要求调整其入股价格；

（3）优先股股东就章程等文件中涉及其重要利益的事项享有一票否决权；

（4）优先股股东有权按照约定的价格选择转为普通股；

（5）在满足约定的条件下，优先股股东有权要求 Montage Holding 全部回购其所持有的全部优先股股票。

（6）清算时优先向 A 类优先股股东进行分配。

五、私有化交易价格相较于发行价溢价较高的原因及合理性，相关资金的具体来源、是否支付完毕，实施主体是否存在大额借款，如存在，请说明该等借款是否已偿还完毕，是否存在涉及到发行人股份的质押，借款各方是否存在争议或纠纷

Montage Group 的 IPO 价格为每股 10 美元，其上市后由于投资人看好 Montage Group 的投资价值，导致其股价在一段时间内持续上升，于 2014 年 1 月达到历史最高价每股 26.70 美元，后期股价出现波动。2014 年 3 月 10 日，

Montage Group 宣布其接到浦东科投初步的非约束性私有化要约。根据该要约，浦东科投将以每股 21.5 美元的价格现金收购 Montage Group 的全部股份。该价格参考 2014 年 3 月 7 日 Montage Group 收盘价每股 17.16 美元，相比私有化要约发布前一天公开市场价格溢价 25.29%，之后经多次谈判，2014 年 6 月 11 日 Montage Group 发布公告，宣布同浦东科投签署合并计划与协议，该协议已经公司董事会通过，协议约定私有化交易价格为每股 22.60 美元，相比私有化要约发布前一天公开市场价格溢价 31.70%，由于此次收购系私有化全面收购，相较于公开市场价格存在溢价，符合市场惯例，具有合理性。

此次私有化款项已足额支付，实施主体 Montage Holding 不存在大额借款，不存在涉及到公司股份的质押，不存在争议或纠纷。

六、私有化过程是否存在异议股东以及相关争议的解决情况，相关方义务是否已经履行完毕，是否存在纠纷或潜在纠纷

Montage Group 于 2014 年 7 月 31 日召开股东大会，审议通过了 Montage Group 同浦东科投签署合并计划与协议，批准了此次私有化交易的实施。此次私有化不存在异议股东及相关争议，相关私有化款项已足额支付。

根据 OMM 律师事务所出具的备忘录，Montage Group 私有化不存在诉讼及纠纷。根据 Maples and Calder (Hong Kong) LLP 出具的法律意见书，截至 2019 年 3 月 27 日，此次私有化实施主体 Montage Holding 不存在纠纷及诉讼情形。

七、该等私有化交易在境内外履行的审批程序，涉及的税收、外汇等手续是否办理完毕，私有化交易是否合法有效

针对此次私有化交易，相关实施主体获得了商务部 ODI 证书、发改委项目备案通知书以及商务部关于经营者集中审查的审查决定通知，境内涉及的税收及外汇手续均已办理完毕。

且 Montage Group 已在 Nasdaq 履行公告义务，Montage Holding 相关私有化款项已足额支付。同时根据 OMM 律师事务所出具的备忘录，Montage Group 从 Nasdaq 摘牌，符合“Securities Act”“Exchange Act”及“Nasdaq listing rules”等有关摘牌和私有化的相关要求，Montage Group 已在境外完成摘牌。

综上所述，Montage Group 私有化交易合法有效。

10.2 保荐机构和发行人律师核查过程和核查意见

保荐机构和发行人律师获取并审阅了 Montage Group 境外公开披露文件；获取并审阅 Montage Group 及 Montage Holding 相关境外法律意见书；获取并审阅了 Montage Group 法律判决书等诉讼相关文件；对 Montage Group 境外上市期间股价变化情况进行了核查；获取并审阅了 Montage Group 私有化过程中签署的相关协议；获取并审阅了 Montage Holding 境外股权登记文件；获取并审阅了私有化的审批文件。

经核查，保荐机构和发行人律师认为 Montage Group 境外上市过程中未受到 Nasdaq 处罚，其上市后短时间退市具有合理原因；Montage Group 上市期间相关诉讼已完结，不存在纠纷及未决事项，且私有化实施主体未发生变更；Montage Group 私有化价格符合市场惯例、具有合理性，相关价款已足额支付，且履行了境内外审批手续，其私有化交易合法有效。

问题十一

2016年3月，澜起有限收购同一控制下的公司澜起开曼。2018年4月26日，澜起有限的股东Montage HK将其所持澜起有限83.757%股权转让给包括中国电子投资控股有限公司、嘉兴芯电投资合伙企业（有限合伙）、WLT Partners, L.P.在内的39名境内外主体。此次股权转让的目的实际为公司拆除境外架构以实现公司间接股东直接持有澜起有限股权。

请发行人说明：（1）澜起有限收购澜起开曼的定价依据、资金来源、实际支付情况，收购价格是否合理，是否存在利益输送，履行的决策程序及审批手续，资金境外汇出及税收缴纳情况，是否符合外汇、税收相关规定，相关收购是否合法有效；（2）发行人境外架构拆除前，发行人股东是否涉及返程投资并需要办理外汇登记手续，是否符合外汇管理法律法规的规定；（3）境外架构拆除前后，发行人的股权结构，平移后相关股权一一对应的关系，各股东直接或间接持有发行人的股权比例是否存在重大差异，如存在，请说明原因；（4）发行人股东注册地的情况，对于设立在国际避税区且持股层次复杂的股东，说明发行人设置此类架构的原因、合法性及合理性、持股的真实性、是否存在委托持股、信托持股、是否有各种影响控股权的约定、股东的出资来源等，发行人如何确保其公司治理和内控的有效性；（5）境外架构拆除时，是否履行了必要的决策程序，Intel、SVIC等股东未受让发行人股权的原因，是否损害了该等股东的权益，各股东之间是否存在其他利益安排；（6）境外架构拆除的估值作价与整体变更基准日（2018年7月31日）估值差异较大的原因，定价是否公允，是否存在利益输送，资金出入境及税收缴纳情况，是否符合外汇、税收相关规定，是否履行了必要的审批程序，是否存在争议或潜在纠纷；（7）境外架构拆除资金流转的路径，相关资金来源是否合法合规，如涉及借款，相关股东款项是否偿还完毕，是否影响发行人股权结构及控制权的稳定性；（8）境外架构拆除后Montage Holding、Montage Group、Montage HK等境外公司未注销的原因，是否存在与发行人经营相同或相似业务的情形；（9）境外架构搭建、存续及解除是否符合境内外外汇、税务等法律法规的规定。

请保荐机构、发行人律师对上述事项进行核查，说明核查方式、过程及依据，

并发表明确意见。

回复：

11.1 发行人说明

一、澜起有限收购澜起开曼的定价依据、资金来源、实际支付情况，收购价格是否合理，是否存在利益输送，履行的决策程序及审批手续，资金境外汇出及税收缴纳情况，是否符合外汇、税收相关规定，相关收购是否合法有效

2016年3月，澜起有限收购澜起开曼股权之前，澜起有限为 Montage Group 通过 Montage HK 间接持有 100% 股权的全资子公司，Montage Group 亦持有澜起开曼 100% 股权，澜起有限收购澜起开曼股权实为同一控制下的内部的股权调整。

根据澜起有限与 Montage Group 签订的《股权转让协议》及其补充协议，Montage Group 向澜起有限转让澜起开曼 100% 股权的价格为等值于人民币 4,524,382,992 元的美金（实际支付 6.88 亿美元）。该次股权转让价格系参考 Montage Group 私有化价格确定。于该次股权转让实施前，Montage Group 对其集团范围内的境外资产进行了整合调整，调整完成后 Montage Group 在境外的主要经营性资产已调整至澜起开曼名下，因此转让澜起开曼 100% 股权的价格参照 Montage Group 私有化价格实施符合其实际价值，具有合理性。同时，因该次股权转让系 Montage Group 同一控制下的内部的股权调整，不存在利益输送情形。

该次股权转让已经澜起有限股东 Montage HK 作出股东决定并经 Montage Group 股东决定通过，股权转让双方已履行必要的内部决策程序。

就上述境外投资事宜，澜起有限已履行必要的政府批准/备案程序，取得了由国家发展改革委员会办公厅下发的发改办外资备 [2016] 190 号《项目备案通知书》以及由上海市商务委员会核发的境外投资证第 N3100201600384 号及第 N3100201600520 号《企业境外投资证书》。

该次股权转让对价已经上海浦东发展银行办理相应汇出手续，款项已足额支付完毕，资金汇出符合外汇管理相关规定。该次股权转让款的资金来源为 Montage HK 对澜起有限的增资。根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“大信验字 [2016] 第 4-00047 号”《验资报告》，确认截至 2016 年 6 月 13 日止澜起有限已足额收到股东 Montage HK 缴付的等值于人民币 4,524,382,992

元的美元的增资款。该次股权转让系开曼群岛主体转让其所持境外公司股权，不涉及在开曼群岛需要缴付税款的情况。

该次股权转让已履行必要的审议、批准程序，股权转让已完成，转让结果合法、有效。

二、发行人境外架构拆除前，发行人股东是否涉及返程投资并需要办理外汇登记手续，是否符合外汇管理法律法规的规定

2004年，相关境外主体设立 Montage Group。至2013年 Montage Group 在美国 NASDAQ 上市之前，Montage Group 通过新设或收购方式拥有多家实体经营的全资子公司，包括澜起美国、澜起澳门和澜起有限。2013年9月26日 Montage Group 在 NASDAQ 上市。2014年，Montage Holding 完成对 Montage Group 的收购，Montage Group 从 NASDAQ 下市。澜起有限自设立至其拆除境外架构之前，澜起有限一直为一家由 Montage Group 间接控制的外商独资企业或中外合资企业。

根据上述结构，澜起有限自始为一家境外有实体运营的集团公司在中国境内设立的控股子公司，不属于红筹架构。澜起有限的境外架构不存在《国家外汇管理局关于境内居民通过特殊目的公司融资及返程投资外汇管理有关问题的通知》或其后《国家外汇管理局关于居民通过特殊目的公司境外投融资及返程投资外汇管理有关问题的通知》中所述的“特殊目的公司”及“返程投资”的情形，公司股东不涉及返程投资或需要办理外汇登记手续的情形。

三、境外架构拆除前后，发行人的股权结构，平移后相关股权一一对应的关系，各股东直接或间接持有发行人的股权比例是否存在重大差异，如存在，请说明原因

1、境外架构拆除前，Montage Holding 通过 Montage HK 间接持有澜起有限 83.757% 股权，Montage Holding 普通股股东持股情况如下：

序号	股东姓名/名称	持有 Montage Holding 股权比例	间接持有澜起有限股权比例
1	CEC Industrial Development Investment Inc.	21.362%	17.892%
2	PKM Holding Co., Ltd.	17.179%	14.388%
3	Neptune Connection Limited	13.432%	11.250%
4	WLT Partners, L.P.	13.240%	11.089%
5	Xinyun Capital Fund, L.P.	10.229%	8.567%

6	Xinyun Capital Fund I, L.P.	5.845%	4.895%
7	Xinyun Capital Fund III, L.P.	3.000%	2.513%
8	Shanghai Huayi Investment Center	2.840%	2.379%
9	Harmonialux Holdings Limited	2.186%	1.831%
10	Apex Result Investments Limited	2.128%	1.782%
11	China Everbright Investment and Assets Management (HK) Limited	1.392%	1.166%
12	Tibet Changle Investment Company Limited	1.350%	1.130%
13	Venus Connection Limited	1.348%	1.129%
14	Green Spark Investment Limited	0.994%	0.833%
15	XIANGGANG JUNBI LIMITED	0.991%	0.830%
16	Chen Xiao	0.495%	0.415%
17	ABC Media Company Limited	0.446%	0.373%
18	New Speed Consultancy Co., Ltd.	0.413%	0.346%
19	TransLink Capital Partners I, L.P.	0.413%	0.346%
20	Hong Kong Pine Stone Capital Limited	0.292%	0.245%
21	Beijing Integrated Circuit Industry International Fund L.P.	0.138%	0.116%
22	Shanghai JunBi Investment & Management Partnership Enterprise (Limited Partnership)	0.097%	0.081%
23	Ko Ping Keung	0.066%	0.055%
24	A&E INVESTMENT LLC	0.066%	0.055%
25	Ian Matthew Brooks	0.026%	0.022%
26	Xi Jin	0.013%	0.011%
27	Shunwen Chang	0.013%	0.011%
28	Qianshen Bai	0.007%	0.006%
	合计	100.0000%	83.757%

2、股权平移的对应关系

Montage Holding 董事会于 2018 年 1 月 8 日作出决议，同意 Montage HK 将其所持澜起有限全部股权转让予 Montage Holding 普通股股东各自指定的受让主体。其后上述 Montage Holding 的 28 家普通股股东根据其合理商业安排选择一家或多家受让主体，并出具授权书，指定其受让澜起有限的股权。本次转让完成后，Montage HK 不再持有澜起有限股权。

(1) CEC Industrial Development Investment Inc.指定中电投控作为股权平移后继受主体, 持有澜起有限161,716,775元注册资本。

(2) PKM Holding Co., Ltd.指定上海临理、上海临丰、上海临骥、上海临利、上海临国、临桐建发、上海临齐作为股权平移后继受主体, 分别持有澜起有限53,506,750元、18,610,575元、15,234,825元、13,339,175元、13,070,825元、9,276,675元、7,011,450元注册资本。

(3) Neptune Connection Limited指定中证投资、中睿一期、中睿二期、华天宇投资作为股权平移后的继受主体, 分别持有澜起有限51,033,325元、35,294,550元、5,597,200元、9,758,175元注册资本。

(4) WLT Partners, L.P.指定其自身、珠海融英作为股权平移后的继受主体, 分别持有澜起有限87,816,687元、69,265,238元注册资本。

(5) Xinyun Capital Fund, L.P.指定嘉兴宏越、嘉兴芯电及其自身作为股权平移后的继受主体, 分别持有澜起有限44,247,750元、21,128,300元、12,057,500元注册资本。

(6) Xinyun Capital Fund I, L.P.指定其自身作为股权平移后的继受主体, 持有澜起有限44,247,750元注册资本。

(7) Xinyun Capital Fund III, L.P.指定嘉定莫奈及其自身作为股权平移后的继受主体, 分别持有澜起有限20,634,525元、2,076,425元注册资本。

(8) Shanghai Huayi Investment Center指定其自身上海华伊作为股权平移后的继受主体, 持有澜起有限21,500,000元注册资本。

(9) Harmonialux Holdings Limited指定珠海融英、杭州调露作为股权平移后的继受主体, 分别持有澜起有限7,301,475元、9,250,000元注册资本。

(10) Apex Result Investments Limited指定泰瑞嘉德作为股权平移后的继受主体, 持有澜起有限16,108,750元注册资本。

(11) China Everbright Investment and Assets Management (HK) Limited指定光大投资作为股权平移后的继受主体, 持有澜起有限10,535,175元注册资本。

(12) Tibet Changle Investment Company Limited指定其自身西藏长乐作为股权平移后的继受主体, 持有澜起有限10,217,075元注册资本。

(13) Venus Connection Limited指定宁波信远作为股权平移后的继受主体，持有澜起有限10,206,675元注册资本。

(14) Green Spark Investment Limited指定其自身作为股权平移后的继受主体，持有澜起有限7,525,000元注册资本。

(15) XIANGGANG JUNBI LIMITED指定上海君弼作为股权平移后的继受主体，持有澜起有限7,500,000元注册资本。

(16) ABC Media Company Limited指定WLT Partners, L.P.作为股权平移后的继受主体，持有澜起有限3,375,000元注册资本。

(17) Chen Xiao指定其自身作为股权平移后的继受主体，持有澜起有限3,750,000元注册资本。

(18) New Speed Consultancy Co., Ltd.定其自身作为股权平移后的继受主体，持有澜起有限3,125,000元注册资本。

(19) TransLink Capital Partners I, L.P.指定其自身作为股权平移后的继受主体，持有澜起有限3,125,000元注册资本。

(20) Hong Kong Pine Stone Capital Limited指定其自身作为股权平移后的继受主体，持有澜起有限2,212,500元注册资本。

(21) Beijing Integrated Circuit Industry International Fund L.P.指定其自身作为股权平移后的继受主体，持有澜起有限1,047,350元注册资本。

(22) Shanghai JunBi Investment & Management Partnership Enterprise (Limited Partnership)指定其自身上海君弼作为股权平移后的继受主体，持有澜起有限735,350元注册资本。

(23) Ko Ping Keung指定其自身作为股权平移后的继受主体，持有澜起有限500,000元注册资本。

(24) A&E INVESTMENT LLC指定Lip-Bu Tan作为股权平移后的继受主体，持有澜起有限500,000元注册资本。

(25) Ian Matthew Brooks指定前海珂玺作为股权平移后的继受主体，持有澜起有限196,250元注册资本。

(26) Xi Jin指定其自身作为股权平移后的继受主体，持有澜起有限100,000元注册资本。

(27) Shunwen Chang指定其自身作为股权平移后的继受主体，持有澜起有限100,000元注册资本。

(28) Qian-Shen Bai指定其自身作为股权平移后的继受主体，持有澜起有限50,000元注册资本。

3、境外架构拆除后，澜起有限股东持股情况如下：

序号	股东姓名/名称	出资额（元）	出资比例（%）
1	中电投控	161,716,775	17.892
2	嘉兴芯电	21,128,300	2.338
3	WLT	87,816,687	9.716
4	珠海融英	69,265,238	7.663
5	上海临理	53,506,750	5.920
6	上海临丰	18,610,575	2.059
7	上海临骥	15,234,825	1.686
8	上海临利	13,339,175	1.476
9	上海临国	13,070,825	1.446
10	临桐建发	9,276,675	1.026
11	上海临齐	7,011,450	0.776
12	嘉兴宏越	44,247,750	4.895
13	嘉兴莫奈	20,634,525	2.283
14	Xinyun I	44,247,750	4.895
15	Xinyun	12,057,500	1.334
16	Xinyun III	2,076,425	0.230
17	臻石一号	22,772,325	2.519
18	臻石二号	13,038,000	1.442
19	臻石三号	32,972,200	3.648
20	中证投资	51,033,325	5.646
21	中睿一期	35,294,550	3.905
22	中睿二期	5,597,200	0.619
23	珠海融扬	25,939,975	2.870
24	Theon Investment	5,920,000	0.655
25	泰瑞嘉德	16,108,750	1.782

序号	股东姓名/名称	出资额（元）	出资比例（%）
26	华天宇投资	9,758,175	1.080
27	上海华伊	21,500,000	2.379
28	光大投资	10,535,175	1.166
29	西藏长乐	10,217,075	1.130
30	宁波信远	10,206,675	1.129
31	杭州调露	9,250,000	1.023
32	上海君弼	8,235,350	0.911
33	Green Spark	7,525,000	0.833
34	Chen Xiao	3,750,000	0.415
35	New Speed	3,125,000	0.346
36	TransLink	3,125,000	0.346
37	Pine Stone Capital	2,212,500	0.245
38	BICI	1,047,350	0.116
39	Lip-Bu Tan	500,000	0.055
40	Ko Ping Keung	500,000	0.055
41	前海珂玺	196,250	0.022
42	Xi Jin	100,000	0.011
43	Shun-Wen Chang	100,000	0.011
44	Qian-Shen Bai	50,000	0.006
合计		903,851,100	100.000

股权平移时，各股东基于商业合理考虑指定平移后的股权继受主体，主要股东持股比例不存在重大差异。

四、发行人股东注册地的情况，对于设立在国际避税区且持股层次复杂的股东，说明发行人设置此类架构的原因、合法性及合理性、持股的真实性、是否存在委托持股、信托持股、是否有各种影响控股权的约定、股东的出资来源等，发行人如何确保其公司治理和内控的有效性

公司股东中非自然人股东共 40 个，其中 28 个股东注册于中国，5 个股东注册于开曼群岛、4 个股东注册于英属维京群岛、1 个股东注册于美国、1 个股东注册于韩国、1 个股东注册于香港特别行政区。

注册于国际避税区的股东情况如下：

位于开曼群岛的股东：WLT、Theon Investment、Xinyun I、Xinyun、Xinyun III。

位于英属维京群岛的股东：Green Spark、New Speed、TransLink、BICI。

公司部分股东设立在国际避税区的情形并非公司设置的架构，而是相关股东参考商业惯例并结合各种因素考虑的自主决定。经上述股东确认，其对公司的出资来源合法、持股真实，除已披露的关联关系及委托投票约定之外，不在委托持股、信托持股，不存在其他影响公司控股权的约定。最近两年公司为一家无实际控制人的企业，股东按其持股比例行使表决权，股东注册地不影响公司治理的有效性。公司通过建立符合公司法的现代公司治理结构和行之有效的内控制度以确保公司治理和内控的有效性。

五、境外架构拆除时，是否履行了必要的决策程序，Intel、SVIC 等股东未受让发行人股权的原因，是否损害了该等股东的权益，各股东之间是否存在其他利益安排

为拆除境外架构，Montage Holding 董事会于 2018 年 1 月 8 日作出决议，同意 Montage HK 将其所持澜起有限全部股权转让予 Montage Holding 普通股股东各自指定的受让主体以拆除境外架构。Montage Holding 的普通股股东均出具授权书，指定澜起有限的股权受让主体。

2018 年 4 月 26 日，澜起有限召开董事会会议，决议同意股东 Montage HK 将其所持澜起有限全部股权转让予包括中电投控、嘉兴宏越、嘉兴芯电在内的 39 名境内外主体。Montage Holding 与澜起有限已履行必要的决策程序。

境外架构拆除时，Intel Capital、SVIC No. 28 Investment 未受让公司股权的原因为 Intel Capital、SVIC No. 28 Investment 原系通过增资方式持有 Montage Holding 的优先股，不同于普通股，所以 Intel Capital、SVIC No. 28 Investment 与公司协商以增资的方式成为公司股东且该协商需要一定谈判时间。

经与 Intel Capital、SVIC No. 28 Investment 确认，上述情况未损害其作为发行人股东的权益。各股东之间不存在其他利益安排。

六、境外架构拆除的估值作价与整体变更基准日（2018 年 7 月 31 日）估值差异较大的原因，定价是否公允，是否存在利益输送，资金出入境及税收缴纳情况，是否符合外汇、税收相关规定，是否履行了必要的审批程序，是否存在争议或潜在纠纷

境外架构拆除价格系参考以 2017 年 8 月 31 日为基准日的评估结果确定，股改的评估基准日为 2018 年 7 月 31 日。两次估值差异较大主要因为以下原因：

1、评估目的不同。2017 年 8 月 31 日评估系对澜起有限的股东全部权益在评估基准日的市场价值进行评估，2018 年 7 月 31 日，整体变更评估系对澜起有限的全部资产和负债在评估基准日的市场价值进行评估。

2、依据的评估方法不同。以 2017 年 8 月 31 日为基准日的评估采取收益法进行评估，2018 年 7 月 31 日整体变更的评估时采用资产基础法进行评估。

3、依据的评估基准日不同，两次评估基准日相差近一年，公司基本财务状况发生较大变化。境外架构拆除的估值作价系参考以 2017 年 8 月 31 日为基准日的评估结果，于该基准日，澜起有限总资产账面值 132,899.68 万元，负债账面值 37,460.73 万元，所有者权益面值 95,438.95 万元，合并报表范围账面值 149,694.48 万元，负债账面值 36,620.90 万元，净资产账面值 113,073.58 万元。整体变更的评估基准日为 2018 年 7 月 31 日，于该基准日，澜起有限总资产账面值 223,479.39 万元，负债账面值 48,502.34 万元，所有者权益账面值 174,977.06 万元。

境外架构拆除定价系按照以 2017 年 8 月 31 日为基准日的公司评估值确定，定价公允，不存在利益输送。该次股权转让经当时公司最高权力机构董事会审议通过、履行了外商主管部门的备案程序并完成了相应的工商变更登记，该次股权转让履行了必要的审批程序。受让方向出让方 Montage HK 支付了股权转让对价，境内受让方的资金均通过银行审批后汇出，符合外汇相关规定。境内受让方和 Montage HK 为该次股权转让涉税事项的代扣代缴主体和纳税申报主体，根据境内受让方及 Montage HK 的报税凭证，该次股权转让符合税收相关规定。根据 Montage Holding 普通股股东为拆除境外架构出具的指定受让主体文件以及公司股东出具的确认文件，各股东真实持有公司股份，不存在争议或潜在纠纷。

七、境外架构拆除资金流转的路径，相关资金来源是否合法合规，如涉及借款，相关股东款项是否偿还完毕，是否影响发行人股权结构及控制权的稳定性

境外架构拆除通过中电投控、嘉兴宏越、嘉兴芯电在内的 39 名境内外主体购买 Montage HK 持有的澜起有限股权方式实现，股权转让对价由股权受让方支付给 Montage HK，其中境外受让方在境外完成股权转让对价的支付，境内受让

方通过银行审批后，向 Montage HK 支付股权转让款，根据该次股权转让的受让方确认，其资金来源均合法合规。

根据公司股东的确认，上海临丰、上海临骥、上海临利、上海临国、临桐建发、上海临齐支付的股权转让款系通过上海临丰、上海临骥、上海临利、上海临国、临桐建发、上海临齐及其控制的子公司向第三方借款获得，目前，相关借款已偿还完毕，对公司股权结构及控制权的稳定性无影响。除上述情况外，其余股东资金来源均为自有资金。

八、境外架构拆除后 Montage Holding、Montage Group、Montage HK 等境外公司未注销的原因，是否存在与发行人经营相同或相似业务的情形

澜起有限境外架构拆除后，Montage Holding、Montage Group、Montage HK 仍持有成都澜至等公司股权，因此该等持股主体未注销。经核查，成都澜至不存在与公司经营相同或相似业务的情形（具体情况详见本问询函回复第二十八题）。

九、境外架构搭建、存续及解除是否符合境内外外汇、税务等法律法规的规定

Montage Group 是一家在境外设立，主要在境外经营的主体，不属于红筹架构，并非先成立境内公司，再搭建境外架构的情况。其后 Montage Group 历经 2013 年美国 Nasdaq 上市、2014 年下市、2018 年拆除澜起有限境外架构等过程（具体详见本题前述回复）。

Montage Group 的设立及其境外子公司的设立不涉及中国境内的外汇管理及税务相关规定。Montage Group 设立澜起有限履行了包括外商主管部门批准、工商管理部门登记、外汇管理部门批准等中国政府部门必要的批准手续，符合中国有关外汇、税务管理规定。根据美国 OMM 律师事务所出具的意见，Montage Group 在美国 Nasdaq 上市及其后私有化退市符合美国 Nasdaq 相关规定（具体情况详见本问询函回复第十题）。澜起有限 2018 年拆除境外架构符合相关外汇、税务的法律法规规定（详见本题第二部分之回复），对于受让方是境外主体的，Montage HK 向澜起有限主管税务机关上海市徐汇区税务局办理了所得税申报手续；对于受让方是境内主体的，该等境内受让方作为扣缴义务人均已向各自税务主管机关报送了对外支付税务备案表。

11.2 保荐机构和发行人律师核查过程和核查意见

保荐机构和发行人律师获取并审阅了澜起有限收购澜起开曼股权相关的《股权转让协议》，股权转让对价支付凭证；获取并审阅了澜起有限及Montage Group关于同意澜起开曼股权转让的内部决策文件；获取并审阅了中国相关政府部门关于同意澜起有限收购澜起开曼股权的批准/备案文件；获取并审阅了拆除境外架构过程中，Montage Holding股东指定其股权继受主体的指定函。

经核查，保荐机构和发行人律师认为：

1、澜起有限收购澜起开曼交易已履行必要的审议、批准程序，股权转让已完成，转让结果合法、有效；

2、发行人境外架构拆除前，发行人股东不涉及返程投资或需要办理外汇登记手续的情形；

3、发行人拆除境外架构股权平移时，各股东基于商业合理考虑，指定平移后的股权继受主体，主要股东持股比例不存在重大差异；

4、发行人的出资来源合法、持股真实，除已披露的关联关系及委托投票约定之外，不存在委托持股、信托持股，不存在其他影响发行人控股权的约定。最近2年股东按其持股比例行使表决权，股东注册地不影响发行人治理的有效性。发行人通过建立符合公司法的现代公司治理结构和行之有效的内控制度以确保公司治理和内控的有效性；

5、公司境外架构拆除已履行了必要的决策程序，未损害 Intel Capital、SVIC No 28.Investment 作为发行人股东的权益，各股东之间不存在其他利益安排；

6、境外架构拆除的估值定价公允，不存在利益输送，资金出入境及税收缴纳均符合外汇、税收相关规定，履行了必要的审批程序，不存在争议或潜在纠纷；

7、公司境外架构拆除资金来源合法合规，不影响发行人股权结构及控制权的稳定性；

8、澜起有限境外架构拆除后，Montage Holding、Montage Group、Montage HK 仍持有成都澜至等公司股权，其经营业务同发行人不存在同业竞争；

9、境外架构搭建、存续及解除符合境内外外汇、税务等法律法规的规定。

问题十二

发行人董事长及核心技术人员均在IDT担任过职务，常仲元于2010年至2013年任上海贝岭首席技术官。IDT是发行人主要竞争对手之一，上海贝岭主营业务中包括集成电路设计。

请发行人说明：（1）杨崇和及各位核心技术人员从IDT离职并创立或加入发行人的背景情况，与IDT、上海贝岭之间是否存在竞业禁止、保密协议等约定，上述人员是否违反了相关约定，与IDT、上海贝岭是否存在纠纷或潜在纠纷；（2）发行人专利、集成电路布图设计专有权、核心技术等是否来源于IDT，是否为杨崇和及核心技术人员在IDT等竞争方的职务发明，使用或申请专利是否需要取得IDT等竞争方的同意，发行人是否采取了防范风险、解决争议或潜在纠纷的有效措施；（3）发行人的管理层团队、研发团队、主要技术等与IDT的具体联系，发行人核心技术与IDT的差异；（4）发行人人员、技术是否独立，是否存在对IDT的重大依赖，是否存在纠纷或潜在纠纷。

请保荐机构及发行人律师对上述事项进行核查，说明核查方式、过程及依据，并发表明确意见。

回复：

12.1 发行人说明

一、杨崇和及各位核心技术人员从 IDT 离职并创立或加入发行人的背景情况，与 IDT、上海贝岭之间是否存在竞业禁止、保密协议等约定，上述人员是否违反了相关约定，与 IDT、上海贝岭是否存在纠纷或潜在纠纷

公司核心技术人员在 IDT 的任职及离职情况如下：

杨崇和于 1997 年与同仁共同创建了新涛科技，主要从事通信及消费类芯片的研发工作，该公司于 2001 年与 IDT 公司成功合并，2001 年杨崇和因 IDT 收购新涛科技任职于 IDT 副总裁，并继续担任 IDT-新涛科技总经理（此时 IDT-新涛科技的产品为通信类芯片）。杨崇和在 IDT 工作期间同 IDT 签署了保密协议，无竞业禁止协议。2004 年杨崇和自 IDT 离职，并同 Stephen Kuong-Io Tai 共同创立澜起科技，主要产品为机顶盒芯片以及内存接口芯片，同杨崇和在 IDT-新涛科

技任职期间负责的通信类芯片业务不同，两类业务在商业和技术上均不存在重合。自 2004 年创立公司至今，IDT 从未对杨崇和创立澜起科技并参与研发提起过诉讼或仲裁，不存在纠纷及潜在纠纷。

山岗于 2000 年曾就职于新涛科技，主要负责语音编解码芯片的研发工作，2001 年山岗因 IDT 收购新涛科技任职于 IDT-新涛科技，任芯片设计经理，负责语音编解码芯片及时钟芯片等的研发工作。山岗在 IDT 任职期间签署了保密协议，其中存在竞业禁止条款，自其离职后一年终止。2005 年山岗根据职业规划考虑决定加入澜起有限，主要负责公司内存接口芯片、津逮[®]服务器平台芯片的应用测试以及新产品定义等工作。由于山岗从事产品研发同其在 IDT-新涛科技任职期间技术、产品均完全不同，因此不存在违反竞业禁止协议的情形。自 2005 年加入澜起有限以来，IDT 从未对山岗的任职及参与研发提起过诉讼或仲裁，不存在纠纷及潜在纠纷。

常仲元于 2000 年曾就职于新涛科技，主要负责通信类及电源管理、音响等消费类芯片产品的设计和研发工作，2001 年常仲元因 IDT 收购新涛科技任职于 IDT，任研发副总裁，继续主要负责原新涛科技通信类等芯片的研发。2010 年自 IDT 离职后常仲元加入上海贝岭任首席技术官，主要负责电源管理等芯片的研发。常仲元在 IDT 及上海贝岭任职期间同雇主签署了保密协议，并未签署竞业禁止协议。2013 年常仲元离职加入澜起有限，任研发部负责人，主要负责澜起科技内存接口芯片、津逮[®]服务器平台芯片的研发和设计工作。自 2013 年加入澜起有限以来，IDT 及上海贝岭对常仲元的任职及参与研发从未发起过诉讼或仲裁，不存在纠纷及潜在纠纷。

史刚于 1998 年任新涛科技营运副总经理，主要负责生产、封装、产品管控等工作，2001 年史刚因 IDT 收购新涛科技任职于 IDT-新涛科技，任营运副总经理；2004 年从 IDT 离职，任上海新进半导体制造有限公司营运副总裁、第一产品事业群总经理；2012 年至 2017 年任 Diodes Inc 分立器件事业群保护类产品事业部总经理兼分立器件事业群中国市场总监。史刚在 IDT 任职期间，签署了保密协议，其中竞业禁止条款有效期 1 年，其之后加入上海新进半导体及 Diodes Inc 等公司，同其在 IDT 从事业务均不同，不存在违反竞业禁止协议的情形。史刚同新进半导体、Diodes Inc 等雇主均签署了保密协议，未签署竞业禁止协议。2017

年史刚离职加入澜起有限，任运营部负责人，负责生产工艺管控、供应商质量管控等。自 2017 年加入澜起有限以来，IDT 及其他雇主对史刚的任职及参与研发从未发起过诉讼或仲裁，不存在纠纷及潜在纠纷。

综上所述，杨崇和等核心技术人员于 IDT 任职，主要原因系 IDT 于 2001 年收购新涛科技导致，相关人员在 IDT 负责的产品技术同目前在公司所研发的产品不同。公司核心技术人员在 IDT 任职期间均签署了保密协议，同时不存在违反竞业禁止协议的情形，不存在纠纷及潜在纠纷。

二、发行人专利、集成电路布图设计专有权、核心技术等是否来源于 IDT，是否为杨崇和及核心技术人员在 IDT 等竞争方的职务发明，使用或申请专利是否需要取得 IDT 等竞争方的同意，发行人是否采取了防范风险、解决争议或潜在纠纷的有效措施

公司核心技术人员在 IDT 等公司任职时，均签署了保密协议，任职期间职务发明所有权归前雇主所有，且其在前雇主参与研发的产品、技术等同公司目前产品、技术等均不同。公司专利、集成电路布图设计专有权、核心技术等均来源于公司自主研发，无需取得 IDT 等竞争方同意。

自成立以来，公司就十分重视对核心技术的保密，及时将研发成果申请专利，并制定了严格完善的内控制度，保障核心技术的保密性，报告期内不存在有关专利产权的诉讼或纠纷。

三、发行人的管理层团队、研发团队、主要技术等与 IDT 的具体联系，发行人核心技术与 IDT 的差异；

公司自成立以来，核心技术均为自主研发，并非来源于第三方（包括 IDT）。公司内存接口芯片产品同 IDT 在市场上为竞争关系，在符合行业标准的前提下，各市场参与者在产品能耗、信号完整性、产品可靠性等方面进行竞争，其产品具体的实现方式和实现路径等存在差异。其中澜起科技发明的 DDR4 全缓冲“1+9”架构被 JEDEC（全球微电子产业的领导标准机构）采纳为国际标准在行业内得到广泛采用，凸显了公司的技术水平及技术能力。

公司高管及核心技术人员除上述已披露的工作经历外，与 IDT 无其他技术及业务联系。

四、发行人人员、技术是否独立，是否存在对 IDT 的重大依赖，是否存在

纠纷或潜在纠纷。

公司在 2004 年成立以来，始终坚持自主研发的理念，其专利等核心技术均为自主研发获得，并通过自有技术同 IDT 等竞争对手进行竞争，其研发人员及技术均保持独立，不存在对 IDT 的任何依赖。自公司成立以来，包括公司原境外母公司与美国上市期间，公司从未受到过 IDT 等竞争对手发起的相关诉讼或仲裁，不存在纠纷或潜在纠纷。

12.2 保荐机构和发行人律师核查过程和核查意见

保荐机构和发行人律师对公司核心技术人员进行了访谈，了解其从业经历及技术研发经历；获取并审阅了公司核心技术人员调查表；获取并审阅了公司专利清单及集成电路设计清单；收集并整理了相关行业研究报告，对竞争对手技术等进行分析；核查了公司核心技术人员相关诉讼事项。

经核查，保荐机构和发行人律师认为杨崇和及各位核心技术人员从 IDT 等前雇主离职不存在违反竞业禁止协议的情形；发行人人员、技术等均具有独立性，专利、集成电路布图设计专有权、核心技术均为自主研发获得，并非来源于 IDT，不是公司核心技术人员在 IDT 等竞争方的职务发明，对 IDT 等竞争方不存在依赖，不存在纠纷或潜在纠纷。

问题十三

请发行人说明报告期内注销或转让子公司的情况、具体原因、上述公司在报告期内的股权结构、主营业务、财务状况等，以及相关资产、人员、债务的处置情况。

请保荐机构、发行人律师核查报告期内上述公司是否存在违法违规行为，是否属于破产清算或吊销营业执照的情形，是否存在纠纷或潜在纠纷，相关债务处置是否合法合规，是否存在关联交易非关联化的情况，并发表明确意见。

回复：

13.1 发行人说明

报告期内公司注销子公司 2 家，未转让子公司，具体情况如下：

1. 澜起苏州

澜起苏州成立于 2011 年 3 月 3 日，该公司于 2018 年 12 月 29 日完成工商注销。报告期内为公司全资子公司，主营业务为消费电子芯片业务提供研发服务，2017 年公司决定转让消费电子业务相关资产后，澜起苏州无实质业务。

报告期内财务状况如下：

单位：元

项目	2018-12-31/ 2018 年度	2017-12-31/ 2017 年度	2016-12-31/ 2016 年度
总资产	19,300,440.49	19,488,552.21	20,732,066.70
净资产	19,300,440.49	19,358,130.56	19,096,788.21
净利润	-57,690.07	28,661.79	2,470,120.81

2017 年 12 月 31 日，澜起苏州名下无员工及债务，注销完成后，银行账户剩余存款已转至公司。

澜起苏州在报告期内不存在重大违法违规行为。苏州澜起注销系经澜起有限作出股东决定后实施，不属于破产清算或吊销营业执照的情形，不存在纠纷或潜在纠纷。澜起苏州注销时不存在未清偿债务，其注销不存在关联交易非关联化的情况。

2. Montage Technology Company Limited

Montage Technology Company Limited 于 2008 年 4 月 7 日在香港特别行政区

完成商业登记注册，并于 2016 年 2 月 19 日注销。报告期内为公司全资子公司。Montage Technology Company Limited 未开展实质业务。2015 年 10 月 7 日，Montage Technology Company Limited 向香港登记注册处申请撤销注册。

2015 年 12 月 31 日，Montage Technology Company Limited 总资产为 331,825.51 元，净资产 331,825.51 元，名下无员工及债务。Montage Technology Company Limited 注销完成后，银行账户剩余存款已转至澜起有限。

根据莫超权律师行出具的法律意见，报告期内，未发现 Montage Technology Company Limited 存在违法违规行为，没有关于该公司强制性清盘呈请，不存在纠纷或潜在纠纷，其在撤销注册过程中的债务处置符合香港《公司条例》的规定。Montage Technology Company Limited 注销不存在关联交易非关联化的情况。

13.2 保荐机构和发行人律师核查过程和核查意见

保荐机构和发行人律师获取并审阅了澜起苏州及 Montage Technology Company Limited 注销文件；获取并审阅了报告期内澜起苏州财务及 Montage Technology Company Limited 报表；对发行人财务负责人进行访谈；取得境外律师出具的法律意见；取得澜起苏州的政府主管部门合规证明。

经核查、保荐机构和发行人律师认为，报告期内发行人注销子公司澜起苏州及 Montage Technology Company Limited 在报告期内不存在重大违法违规行为。苏州澜起注销系经澜起有限作出股东决定后实施，不属于破产清算或吊销营业执照的情形，不存在纠纷或潜在纠纷，不存在未清偿债务，其注销不存在关联交易非关联化的情况。Montage Technology Company Limited 不属于破产清算或吊销营业执照的情形，不存在纠纷或潜在纠纷，债务处置合法合规，其注销不存在关联交易非关联化的情况

问题十四

请发行人说明：（1）历史沿革中是否存在发行人、控股股东、实际控制人与其他股东的对赌协议，如存在，请说明对赌协议的内容及执行情况，是否存在触发对赌协议生效的情形，对赌各方是否存在纠纷或潜在纠纷；（2）如存在对赌协议，请说明发行人是否作为对赌协议当事人，是否存在可能导致公司控制权变化的约定，对赌协议是否与市值挂钩，是否存在严重影响发行人持续经营能力或者其他严重影响投资者权益的情形。

请保荐机构、发行人律师进行核查，说明核查方式、过程、依据，并发表明确意见。

回复：

14.1 发行人说明

一、历史沿革中是否存在发行人、控股股东、实际控制人与其他股东的对赌协议，如存在，请说明对赌协议的内容及执行情况，是否存在触发对赌协议生效的情形，对赌各方是否存在纠纷或潜在纠纷

2018年12月，Intel Capital、SVIC No. 28 Investment 对公司进行增资，公司与 Intel Capital、SVIC No. 28 Investment 在股东协议中的违约补偿条款中约定：在公司违反反贿赂及反腐败的相关规定，或至 2021 年 5 月公司仍未实现上市等情况出现时，Intel Capital、SVIC No. 28 Investment 有权要求公司以其增资认购价格回购所持公司股份。上述协议在公司提交上市申请文件时已终止，目前不存在触发回购生效的情况。Intel Capital、SVIC No. 28 Investment 所持公司股份不存在纠纷及潜在纠纷。

除上述情况外，公司与其他股东在历史上未签订过对赌协议。

二、如存在对赌协议，请说明发行人是否作为对赌协议当事人，是否存在可能导致公司控制权变化的约定，对赌协议是否与市值挂钩，是否存在严重影响发行人持续经营能力或者其他严重影响投资者权益的情形

上述协议已经终止，上述协议不存在可能导致公司控制权变化的约定，上述协议约定的回购义务的触发条件未与市值挂钩，不存在严重影响公司持续经营能

力或者其他严重影响投资者权益的情形。截至本问询函回复签署日，公司与股东之间不存在对赌协议。

14.2 保荐机构和发行人律师核查过程和核查意见

保荐机构和发行人律师获取并审阅了发行人与股东签署的增资协议、股东协议等文件；取得发行人股东的确认函。

经核查，保荐机构和发行人律师认为发行人历史上股东协议中曾存在约定的回购义务，但该约定已经终止。截至本问询函回复签署日不存在可能导致公司控制权变化的约定，原股东协议约定的回购义务的触发条件未与市值挂钩，不存在严重影响发行人持续经营能力或者其他严重影响投资者权益的情形。截至本问询函回复签署日，发行人与股东之间不存在对赌协议。

问题十五

发行人在“行业技术水平及特点”部分重点披露了内存 DDR 技术的发展情况。

请发行人披露：（1）内存接口芯片技术与内存 DDR 技术的发展路径、发展阶段以及产品推出时间等方面的匹配性；（2）内存接口芯片技术最近三年的发展情况和未来发展趋势；（3）DDR5 目前所处阶段，公司应用于 DDR5 的内存接口芯片目前研发进度情况，量产的预计时间，行业主要竞争对手 DDR5 内存接口芯片的推出进度，并对 DDR5 推出可能给发行人带来的技术迭代、产品替代风险作重大事项提示和风险揭示。

请保荐机构对上述事项进行核查并发表明确意见。

回复：

15.1 发行人说明

一、内存接口芯片技术与内存DDR技术的发展路径、发展阶段以及产品推出时间等方面的匹配性；

内存接口芯片技术与内存 DDR 技术发展路径、发展阶段以及产品推出时间的匹配情况在 DDR3 之前与之后有所不同。在 DDR2 和 DDR3 世代，最新的内存技术首先应用在台式电脑上，之后才在服务器上应用；从 DDR4 世代开始，最新的内存技术首先在服务器上应用。目前内存接口芯片主要应用于服务器上，相关发展阶段和产品推出时间的匹配性参见下表：

DDR 技术世代	内存面世时间 (主要厂商)	澜起科技内存接口芯片面世时间	
		描述	认证时间
DDR2	2003 年	高级内存缓冲器 (AMB) 芯片	2008 年 6 月
DDR3	2007 年	寄存缓冲器芯片、内存缓冲器芯片	2011 年 8 月
DDR4	2014 年	寄存时钟驱动器芯片、数据缓冲器芯片	2013 年 10 月
DDR5	研发中	寄存时钟驱动器芯片、数据缓冲器芯片	研发中

根据 DDR 内存技术和澜起科技内存接口芯片推出的时间表显示，内存接口芯片是紧跟 DDR 内存技术的更新换代而不断演进。针对最新的 DDR5 内存技术，澜起科技正在研发相应的内存接口芯片。

二、内存接口芯片技术最近三年的发展情况和未来发展趋势；

最近三年，DDR4 技术的发展进入了成熟期，成为了内存市场的主流技术。为了实现更高的传输速率和支持更大的内存容量，JEDEC 组织进一步更新和完善了 DDR4 内存接口芯片的技术规格，增加了多种功能，用以支持更高速率和更大容量的内存。2016 年初主流的内存接口芯片支持的最高传输速率为 2400MT/s，2018 年底的主流内存接口芯片支持的最高传输速率为 2933MT/s，最近三年内内存接口芯片所支持的最高传输速率在持续上升。

2018 年底，全球各大主要内存芯片厂商已经公布了各自的 DDR5 研发进度，未来 DDR5 内存技术有望实现对 DDR4 内存技术的更新和替代。澜起科技正全程参与 JEDEC 组织对最新的 DDR5 内存接口产品的规格定义。DDR5 内存接口芯片相比于前一代 DDR4 内存接口芯片，可以支持更高的速率以及更低的电压。

三、DDR5 目前所处阶段，公司应用于 DDR5 的内存接口芯片目前研发进度情况，量产的预计时间，行业主要竞争对手 DDR5 内存接口芯片的推出进度，并对 DDR5 推出可能给发行人带来的技术迭代、产品替代风险作重大事项提示和风险揭示；

根据全球各大主要内存芯片厂商宣布的研发进度情况，第一代 DDR5 内存有望在 2019 年底之前完成相关行业标准的制定。

2018 年，澜起科技启动了 DDR5 内存接口芯片的工程版芯片研发，目前已经完成工程版芯片流片及功能验证，各项指标和功能符合预期。未来，澜起科技将根据 JEDEC 组织关于 DDR5 内存接口芯片后续推出的完整规格书更新芯片设计。公司 DDR5 相关研发项目包括 Gen 1.0 DDR5 寄存时钟驱动器芯片和 Gen 1.0 DDR5 数据缓冲器芯片，目前正处于设计优化阶段，预计于 2020 年底前完成第一代 DDR5 内存接口芯片量产版的研发工作，预计量产时间为 2021-2022 年。

内存接口芯片为 JEDEC 组织定义的标准化产品，澜起科技的竞争对手 IDT、Rambus 目前也正在根据 DDR5 内存接口芯片的规格研发新产品，预计与澜起科技同步推出工程样片。由于该产品基于 JEDEC 行业标准，产品替代须经过 CPU 厂商、DRAM 厂商和 OEM 厂商的重新认证，因此具有较高的壁垒，替代性较低。

DDR5 产品的推出可能给公司带来的风险已在招股说明书“第四节 风险因

素”之“一、技术风险”中补充披露。

15.2 保荐机构的核查过程和核查意见

核查过程：

保荐机构查阅了相关行业研究报告，发行人各代产品和在研项目的相关资料，同行业竞争对手的定期报告，与公司核心技术人员就内存DDR技术和内存接口芯片技术的发展情况及未来趋势进行了访谈，并取得了发行人关于公司内存接口芯片技术与内存DDR技术推出时间匹配性情况的说明。

核查结论：

经核查，保荐机构认为公司的内存接口芯片是随着DDR内存技术的更新换代而不断演进，具有匹配性。内存接口芯片技术未来将支持更高速率和更大容量的内存，DDR5内存接口芯片目前的研发进度符合预期。

15.3 补充披露情况

发行人已在招股说明书“第六节 业务与技术”之“二、行业基本情况（六）行业技术水平及特点”中补充披露：

1、内存 DDR 技术的发展情况

.....

2、内存接口芯片技术与内存 DDR 技术的发展路径、发展阶段以及产品推出时间等方面的匹配性

内存接口芯片技术与内存 DDR 技术发展路径、发展阶段以及产品推出时间的匹配情况在 DDR3 之前与之后有所不同。在 DDR2 和 DDR3 世代，最新的内存技术首先应用在台式电脑上，之后才在服务器上应用；从 DDR4 世代开始，最新的内存技术首先在服务器上应用。目前内存接口芯片主要应用于服务器上，相关发展阶段和产品推出时间的匹配性参见下表：

DDR 技术世代	内存面世时间 (主要厂商)	澜起科技内存接口芯片面世时间	
		描述	认证时间
DDR2	2003 年	高级内存缓冲器 (AMB) 芯片	2008 年 6 月
DDR3	2007 年	寄存缓冲器芯片、内存缓冲器芯片	2011 年 8 月

DDR4	2014 年	寄存时钟驱动器芯片、数据缓冲器芯片	2013 年 10 月
DDR5	研发中	寄存时钟驱动器芯片、数据缓冲器芯片	研发中

根据 DDR 内存技术和澜起科技内存接口芯片推出的时间表显示，内存接口芯片是紧跟 DDR 内存技术的更新换代而不断演进。针对最新的 DDR5 内存技术，澜起科技正在研发相应的内存接口芯片。

发行人已在招股说明书“第六节 业务与技术”之“二、行业基本情况（三）行业发展情况及未来发展趋势”中补充披露：

（3）内存接口芯片发展概况

.....

最近三年，DDR4 技术的发展进入了成熟期，成为了内存市场的主流技术。为了实现更高的传输速率和支持更大的内存容量，JEDEC 组织进一步更新和完善了 DDR4 内存接口芯片的技术规格，增加了多种功能，用以支持更高速率和更大容量的内存。2016 年初主流内存接口芯片支持的最高传输速率为 2400MT/s，2018 年底的主流内存接口芯片支持的最高传输速率为 2933MT/s，最近三年内存接口芯片所支持的最高传输速率在持续上升。

2018 年底，全球各大主要内存芯片厂商已经公布了各自的 DDR5 研发进度，未来 DDR5 内存技术有望实现对 DDR4 内存技术的更新和替代。澜起科技正全程参与 JEDEC 组织对最新的 DDR5 内存接口产品的规格定义。DDR5 内存接口芯片相比于前一代 DDR4 内存接口芯片，可以支持更高的速率以及更低的电压。

DDR5 产品的推出可能给发行人带来的风险已在招股说明书“第四节 风险因素”之“一、技术风险”中补充披露：

（三）技术迭代、产品替代风险

集成电路设计行业技术更新速度较快，新技术层出不穷，不断为行业带来变革。公司经过多年研发，已拥有成熟的内存接口芯片产品系列，并形成一定竞争优势。但新产品和新技术的研发仍存在一定不确定性，包括行业标准技术规格书的修订，内存接口芯片电路设计的高复杂度，新一代 DDR5 内存颗粒以及中央处理器等上下游合作厂商的产品研发进度等，都会影响澜起科技新一代 DDR5 内存接口芯片的研发和量产进度。预计在未来几年，DDR5 相关技术将逐

步取代 DDR4，在内存接口芯片的技术迭代过程中，如果公司在 DDR5 的相关技术开发和应用上不能保持领先地位，或者某项新技术、新产品的应用导致公司技术和产品被替代，可能对公司的市场竞争力带来不利影响。

问题十六

公司正在从事 Gen 1.0 DDR5 寄存时钟驱动器芯片等多个产品的研发项目，其中，5 个项目处于可行性研究阶段，2 个项目处于设计优化阶段。

请发行人披露：（1）正在从事的研发项目、所处阶段及进展情况、相应人员、经费投入、拟达到的目标；（2）结合行业技术发展趋势，披露相关研发项目与行业技术水平的比较；（3）报告期内与其他单位合作研发的情况，包括合作协议的主要内容，权利义务划分约定及采取的保密措施等；（4）研发项目对应产品的预计量产时间，产业化后的预计销售情况及市场空间，对发行人及竞争对手产品的替代性，并结合预计量产时间、技术迭代周期等分析是否存在被新技术更新迭代的风险；（5）核心技术人员、研发人员占员工总数的比例，核心技术人员的学历背景构成，取得的专业资质及重要科研成果和获得奖项情况，对公司研发的具体贡献，发行人对核心技术人员实施的约束激励措施，报告期内核心技术人员的变动情况及对发行人的影响；（6）发行人研发投入与技术先进性、技术储备的关系，发行人保持技术不断创新的机制、技术储备及技术创新的安排等。

请保荐机构对上述事项进行核查并发表明确意见。

回复：

16.1 发行人说明

一、正在从事的研发项目、所处阶段及进展情况、相应人员、经费投入、拟达到的目标

公司正在从事的主要研发项目具体情况如下：

序号	项目名称	研发目标	所处阶段及进展情况	研发所需相应人员
1	Gen 1.0 DDR5 寄存时钟驱动器芯片	可应用于 DDR5 RDIMM 和 LRDIMM，符合 JEDEC DDR5 标准，支持速率高达 4800MT/s。	设计优化	30-50 人
2	Gen 1.0 DDR5 数据缓冲器芯片	可应用于 DDR5 LRDIMM，符合 JEDEC DDR5 标准，支持速率高达 4800MT/s。	设计优化	30-50 人

序号	项目名称	研发目标	所处阶段及进展情况	研发所需相应人员
3	Gen2.0 津逮® 处理器	为服务器平台的核心计算引擎，从而为数据中心市场提供安全可控服务器 CPU 解决方案。	可行性研究	300-500 人
4	Gen2.0 DDR4 混合安全内存模组及所需的 RCD/DB 芯片	基于澜起 M88HS26SA 架构研发的 128GB 大容量混合安全内存模组。新架构可支持大容量内存颗粒架构。	可行性研究	30-50 人
5	Gen2.0 DDR4 精简混合安全内存模组及所需的 RCD 芯片	基于澜起 M88SC26HA 的架构，提升内存读写速度及数据实时保护速度达到 DDR4 3200MT/s。	可行性研究	20-30 人
6	高能效比可编程 AI 处理器及 SoC 芯片系列	可编程 AI 处理器芯片和 SoC 芯片。AI 处理器的超大计算能力可支持多种神经网络模型。	可行性研究	200-300 人
7	用于数据中心的 AI 处理器芯片	AI 处理器采用可编程与可重构技术实现硬件平台的灵活性与通用性平衡，扩展平台系统的应用空间。	可行性研究	200-300 人

注：研发所需相应人员系指该研发项目达到最终研发目标所需的人员规模，不是指公司现有已投入人员数量。

公司正在从事的研发项目进展均符合预期，公司已投入相应的研发人员，并对经费投入预算和拟达到的目标在对应募投项目中均有明确的安排和规划。

报告期内，Gen 1.0 DDR5 寄存时钟驱动器芯片项目和 Gen 1.0 DDR5 数据缓冲器芯片项目合计投入 0、720.22 万元和 12,828.91 万元。其余项目尚处于可行性研究阶段，报告期内尚未投入项目相应的研发经费。

二、结合行业技术发展趋势，披露相关研发项目与行业技术水平的比较；

1、内存接口芯片

内存接口芯片技术未来将实现更高的传输速率和支持更大的内存容量。公司将凭借在 DDR4 世代确立的技术领先优势，进一步研发新一代内存接口芯片产品，不断推动行业技术标准的提升，并形成一定技术壁垒，因此相关研发项目处于行业领先水平。2016 年 6 月，中国电子学会认定公司“低功耗 DDR 系列内存缓冲控制器芯片设计技术整体技术达到国际领先水平”。

2、津逮[®]服务器平台

津逮[®]服务器平台结合了公司的内存监控技术，清华大学的动态安全监控与可重构计算架构，以及 Intel 的 CPU 技术，为数据中心产品市场提供安全、可靠的运算平台，具有独创性。该产品在提供安全性的同时还保障了性能优势，处于行业领先水平。2018 年 11 月，津逮[®]服务器 CPU 及其平台采用的“动态安全监控技术”获评第五届世界互联网大会“世界互联网领先科技成果”。

3、人工智能芯片

公司将人工智能芯片作为未来业务发展方向，聚焦客户需求，长远布局，对相关技术进行积极的研发储备工作，拟达到的研发目标处于行业领先水平。

三、报告期内与其他单位合作研发的情况，包括合作协议的主要内容，权利义务划分约定及采取的保密措施

报告期内公司与其他单位合作研发的情况如下：

合作单位名称	合作协议主要内容	权利义务划分约定	保密措施
聚辰半导体股份有限公司（简称“聚辰半导体”）	澜起科技和聚辰半导体合作开发 DDR5 EEPROM 产品	双方各自享有在开发过程中由各自独立开发的技术和知识产权； 合作开发费用由双方各承担 50%	合同双方均已在协议中约定了较为详尽的保密条款
Global Mixed-Mode Technology（简称“GMT”）	澜起科技和 GMT 合作开发（1）电源管理芯片（PMIC）；（2）温度传感器（TS）	双方各自享有在开发过程中由各自独立开发的技术和知识产权； 合作开发费用由双方各承担 50%	
清华大学与 Intel	三方联合开发津逮 [®] 服务器 CPU 及其平台	公司负责整体模块及部分芯片的设计，清华大学提供可重构计算处理器（RCP）的算法，Intel 提供津逮 [®] 服务器平台中的通用 CPU 内核芯片； 津逮 [®] 服务器 CPU 品牌及产品产权归澜起科技所有	

四、研发项目对应产品的预计量产时间，产业化后的预计销售情况及市场空间，对发行人及竞争对手产品的替代性，并结合预计量产时间、技术迭代周期等分析是否存在被新技术更新迭代的风险；

公司研发项目对应产品的具体情况如下：

序号	项目名称	预计量产时间	产品替代性	技术迭代周期与风险
1	Gen 1.0 DDR5 寄存时钟驱动器芯片	2021-2022	产品虽基于 JEDEC 行业标准，但产品替代须经过 CPU 厂商、DRAM 厂商和 OEM 厂商的认证，将逐步替代 DDR4 世代的芯片。	每一代的产品迭代周期约为 18 个月。公司会在 4800MT/s 的产品基础上，继续研发 5600MT/s，6400MT/s 的产品。
2	Gen 1.0 DDR5 数据缓冲器芯片	2021-2022	产品虽基于 JEDEC 行业标准，但产品替代须经过 CPU 厂商、DRAM 厂商和 OEM 厂商的认证，将逐步替代 DDR4 世代的芯片。	每一代的产品迭代周期约为 18 个月。公司会在 4800MT/s 的产品基础上，继续研发 5600MT/s，6400MT/s 的产品。
3	Gen2.0 津逮®处理器	2021-2022	产品基于公司的内存监控技术，清华大学的动态安全监控与可重构计算架构，以及 Intel 的 CPU 技术。此产品现阶段具有一定的独创性，将逐步替代 Gen 1.0 产品。	产品迭代周期约为 3 年。公司会在澜起科技，清华大学和 Intel 的技术基础上，继续开发新一代的津逮®处理器。
4	Gen2.0 DDR4 混合安全内存模组及所需的 RCD/DB 芯片	2021	产品基于公司的内存监控技术。此产品现阶段具有一定的独创性，将逐步替代 Gen 1.0 产品。	产品迭代周期约为 3 年。公司会在已有的技术基础上，继续开发新一代产品。
5	Gen2.0 DDR4 精简混合安全内存模组及所需的 RCD 芯片	2021	产品基于公司的内存监控技术。此产品现阶段具有一定的独创性，将逐步替代 Gen 1.0 产品。	产品迭代周期约为 3 年。公司会在已有的技术基础上，继续开发新一代产品。
6	高能效比可编程 AI 处理器及 SoC 芯片系列	2021-2022	AI 处理器的超大计算能力可支持多种神经网络模型。产品瞄准全新市场。	产品迭代周期约为 3 年。公司会在已有的技术基础上，继续开发新一代产品。
7	用于数据中心的 AI 处理器芯片	2021	AI 处理器采用可编程与可重构技术实现硬件平台的灵活性与通用性平衡，扩展平台系统的应用空间。产品瞄准全新市场。	产品迭代周期约为 3 年。公司会在已有的技术基础上，继续开发新一代产品。

注：以上预计量产时间为公司根据现有研发进度的合理估计，存在不确定性

产业化后的预计销售情况及市场空间：

(1) 内存接口芯片业务：根据公开数据，2016 年以来澜起科技、IDT 和 Rambus 对应的内存接口芯片业务收入均呈现持续增长趋势。新一代内存接口芯片产业化后公司预计销售情况将在现有内存接口芯片业务基础上进一步提升。市场规模也将在全球数据中心和服务器市场的快速发展带动下保持持续增长趋势。

(2) 津逮®服务器平台：目前第一代津逮®服务器平台已具备量产能力，客户包括联想、长城等国内知名企业。公司大力拓展数据中心产品市场，提供更为

安全、可靠的运算平台，与行业生态系统内主要企业的需求相契合，因此基于当前的客户拓展情况，该产品的销售有望成为公司的业绩增长点。此外，津逮[®]服务器平台受下游数据中心和服务器市场发展的推动，预计未来市场空间较乐观。

(3) 人工智能芯片：国家对人工智能的扶持政策持续加码，人工智能芯片作为人工智能行业发展的基础，具有广阔的市场空间。

公司在研项目中内存接口芯片及津逮[®]服务器平台相关产品，均是根据目前主流行业相关标准研发，在未来 5 年内暂无被其他新技术完全取代的风险；人工智能芯片系瞄准新的市场应用，公司会紧跟行业前沿技术。

五、核心技术人员、研发人员占员工总数的比例，核心技术人员的学历背景构成，取得的专业资质及重要科研成果和获得奖项情况，对公司研发的具体贡献，发行人对核心技术人员实施的约束激励措施，报告期内核心技术人员的主要变动情况及对发行人的影响；

1、核心技术人员、研发人员占员工总数的比例：

截至2018年12月31日，公司研发人员181人，占员工总数比达70.98%，其中核心技术人员4人，占比1.57%。

2、核心技术人员的学历背景构成、取得的专业资质及重要科研成果和获得奖项情况，对公司研发的具体贡献：

杨崇和，男，1957 年出生，美国俄勒岗州立大学电子与计算机工程硕士及博士。杨崇和博士于 2010 年当选美国电气和电子工程师协会院士 (IEEE Fellow)。此外，杨博士还荣获多种奖项，其中包括“IEEE CAS 产业先驱奖”和上海市人民政府授予的“白玉兰荣誉奖”。自公司成立以来，杨博士一直担任公司董事长兼首席执行官，主要分管公司的战略发展和技术研发方向，其参与的职务发明共获得授权及申请专利 21 项，为公司主要专利发明人之一。

山岗，男，1975 年出生，北京航空航天大学电子与通信系统硕士，曾经荣获中国电子学会科技进步奖一等奖，上海市科学技术奖三等奖等。山岗先生目前担任市场应用技术部（公司的研发部门之一）负责人，自加入公司以来，参与的职务发明共获得授权及申请专利 31 项，为公司主要专利发明人之一。

常仲元，男，1959 年出生，比利时鲁汶大学微电子学博士。常博士曾在 IEEE 学术期刊和国际会议上发表了论文逾 20 篇，其中 3 篇发表于 ISSCC 会议，并作为第一作者在美国出版了《Low Noise Wideband Amplifiers in Bipolar and CMOS Technology》。常仲元先生目前担任研发部负责人，自加入公司以来，参与的职务发明共获得授权及申请专利 3 项，为公司主要专利发明人之一。

史刚，男，1969 年出生，复旦大学电子工程系微电子硕士。史刚先生目前担任运营部（公司的研发部门之一）负责人，自加入公司以来，参与的职务发明共申请专利 1 项。

3、公司对核心技术人员实施的约束激励措施

公司建立并实施了严格的保密管理制度和内控管理制度，与核心技术人员签订了保密及竞业禁止协议，对可能引发泄密的行为进行了限定并对涉及技术等影响公司重大利益的事项设置了相应的保密措施进行管理。此外，公司实行了有效的激励制度，为核心技术人员提供具有竞争力的薪酬福利，且所有核心技术人员均间接持有公司股权，以吸引人才、留住人才，实现公司与员工的共同成长和发展，有效防范了泄密风险。

4、报告期内核心技术人员的主要变动情况及对公司的影响

最近 2 年，公司核心技术人员变动情况如下：

时间	成员	职位	核心技术人员数	变动原因
2017 年 1 月	杨崇和	核心技术人员	3	
	山岗	核心技术人员		
	常仲元	核心技术人员		
2017 年 8 月	杨崇和	核心技术人员	4	史刚先生 2017 年 8 月加入公司
	山岗	核心技术人员		
	常仲元	核心技术人员		
	史刚	核心技术人员		

史刚先生于 2017 年 8 月加入公司担任运营部负责人，其他核心技术人员均在公司长期任职未发生变化。综上所述，最近 2 年内公司核心技术人员未发生重大不利变化。

六、发行人研发投入与技术先进性、技术储备的关系，发行人保持技术不

断创新的机制、技术储备及技术创新的安排等；

1、公司研发投入与技术先进性、技术储备的关系

公司核心技术均系自主研发成果，报告期内，公司研发费用占营业收入比例整体保持稳定，具体情况如下：

项目	2018 年度	2017 年度	2016 年度
研发投入（万元）	27,669.52	18,826.93	19,822.69
营业收入（万元）	175,766.46	122,751.49	84,494.46
占比	15.74%	15.34%	23.46%

报告期内，公司研发投入的项目包括 Gen 2 plus DDR4 内存接口芯片、Gen 1.0 津逮®CPU 及混合安全内存模组等，均为当时行业的先进技术。目前，公司在研项目包括新一代 DDR5 内存接口芯片、Gen 2.0 津逮®处理器等，其技术水平在未来三年内处于行业领先地位。

公司始终将自主研发、开放创新作为保持技术先进性的重要战略。相关研发投入具有显著的技术先进性，同时产品保持一定迭代更新速度，技术储备丰富。

未来，公司将持续加大研发投入，加强技术研发和创新，增加公司持续竞争能力，同时积极稳妥地推动募投项目的建设，丰富技术储备，尽快实现项目收益，提升经营效率和盈利能力。

2、公司保持技术不断创新的机制、技术储备及技术创新的安排等

公司重视技术创新，坚持以市场为导向安排研发计划。在技术创新项目的筛选上，公司专注市场调研与分析，以目标客户新增需求为驱动，形成对创新项目的开发思路，围绕现有产品和技术成果，进行技术研发、结构设计、工艺优化等多方面的深入研究。同时，根据新兴市场的发展趋势，不断进行技术升级和储备，持续保持现有产品的更新换代，加快对市场需求的响应速度。以市场为导向的技术研发，保障了创新项目的实用性，有效提高了公司研发投入的转化率。

公司每年在预算中安排一定比例的预算作为研发费用，为技术创新和技术储备提供物质保障。公司鼓励员工进行职务发明，对于申请的专利和布图设计成功的相关团队给予奖励。公司已形成高度规范化的研发流程和质量控制体系，并根据实际执行情况进行不断的完善和更新，全面覆盖产品开发立项、产品设计、产

品验证、产品应用、产品量产认证等阶段，确保每项新产品研发的质量、风险、成本均得到强而有效的管控。公司会定期或不定期召开会议对研发进度和技术储备情况进行审核及研讨，督促研发进度，确保研发成果与市场需求保持一致。

16.2 保荐机构的核查过程和核查意见

核查过程：

1、保荐机构查阅了发行人在研项目资料、对应研发人员和经费投入预算，与公司核心技术人员就在研项目具体情况进行了访谈，取得了研发项目行业技术水平比较、预计销售情况及市场空间、产品替代性和迭代周期与风险的说明性文件，以及与其他单位合作研发的主要协议。

2、取得了核心技术人员、研发人员名单、核心技术人员的履历及变动情况、保密及竞业禁止协议，查阅了公司的相关保密制度、内控制度、激励制度和创新机制，访谈确认了核心技术人员对公司研发的具体贡献及公司技术先进性和储备情况。

核查结论：

经核查，保荐机构认为：

1、发行人正在从事的研发项目进展均符合预期，发行人已投入相应的研发人员，并对经费投入预算和拟达到的目标在对应募投项目中均有明确的安排和规划。

2、发行人相关研发项目行业技术水平领先；研发项目中内存接口芯片及津逮[®]服务器平台相关产品均是根据目前主流行业相关标准研发，目前暂无被其他新技术完全取代的风险；人工智能芯片系瞄准新的市场应用，发行人会紧跟行业前沿技术。

3、公司对核心技术人员实施了较为有效的约束激励措施，有效防范了泄密风险。

4、最近2年内公司核心技术人员未发生重大不利变化。

16.3 补充披露情况

发行人已在招股说明书“第六节 业务与技术”之“六、公司的技术与研发

情况（二）研发项目及进展情况”中补充披露：

1、研发项目基本情况

公司正在从事的主要研发项目分别处于可行性研究和设计优化过程中，具体情况如下：

序号	项目名称	研发目标	所处阶段及进展情况	研发所需相应人员
1	Gen 1.0 DDR5 寄存时钟驱动器芯片	可应用于 DDR5 RDIMM 和 LRDIMM，符合 JEDEC DDR5 标准，支持速率高达 4800MT/s。	设计优化	30-50 人
2	Gen 1.0 DDR5 数据缓冲器芯片	可应用于 DDR5 LRDIMM，符合 JEDEC DDR5 标准，支持速率高达 4800MT/s。	设计优化	30-50 人
3	Gen2.0 津逮® 处理器	为服务器平台的核心计算引擎，从而为数据中心市场提供安全可控服务器 CPU 解决方案。	可行性研究	300-500 人
4	Gen2.0 DDR4 混合安全内存模组及所需的 RCD/DB 芯片	基于澜起 M88HS26SA 架构研发的 128GB 大容量混合安全内存模组。新架构可支持大容量内存颗粒架构。	可行性研究	30-50 人
5	Gen2.0 DDR4 精简混合安全内存模组及所需的 RCD 芯片	基于澜起 M88SC26HA 的架构，提升内存读写速度及数据实时保护速度达到 DDR4 3200MT/s。	可行性研究	20-30 人
6	高能效比可编程 AI 处理器及 SoC 芯片系列	可编程 AI 处理器芯片和 SoC 芯片。AI 处理器的超大计算能力可支持多种神经网络模型。	可行性研究	200-300 人
7	用于数据中心的 AI 处理器芯片	AI 处理器采用可编程与可重构技术实现硬件平台的灵活性与通用性平衡，扩展平台系统的应用空间。	可行性研究	200-300 人

注：研发所需相应人员系指该研发项目达到最终研发目标所需的人员规模，不是指公司现有已投入人员数量。

公司正在从事的研发项目进展均符合预期，公司已投入相应的研发人员，并对经费投入预算和拟达到的目标在对应募投项目中均有明确的安排和规划。

报告期内，Gen 1.0 DDR5 寄存时钟驱动器芯片项目和 Gen 1.0 DDR5 数据缓冲器芯片项目合计投入 0、720.22 万元和 12,828.91 万元。其余项目尚处于可行性研究阶段，报告期内尚未投入项目相应的研发经费。

2、相关研发项目与行业技术水平的比较

(1) 内存接口芯片

内存接口芯片技术未来将实现更高的传输速率和支持更大的内存容量。公司将凭借在 DDR4 世代确立的技术领先优势，进一步研发新一代内存接口芯片产品，不断推动行业技术标准的提升，并形成一定技术壁垒，因此相关研发项目处于行业领先水平。2016 年 6 月，中国电子学会认定公司“低功耗 DDR 系列内存缓冲控制器芯片设计技术整体技术达到国际领先水平”。

(2) 津逮[®]服务器平台

津逮[®]服务器平台结合了公司的内存监控技术，清华大学的动态安全监控与可重构计算架构，以及 Intel 的 CPU 技术，为数据中心产品市场提供安全、可靠的运算平台，具有独创性。该产品在提供安全性的同时还保障了性能优势，处于行业领先水平。2018 年 11 月，津逮[®]服务器 CPU 及其平台采用的“动态安全监控技术”获评第五届世界互联网大会“世界互联网领先科技成果”。

(3) 人工智能芯片

公司将人工智能芯片作为未来业务发展方向，聚焦客户需求，长远布局，对相关技术进行积极的研发储备工作，拟达到的研发目标处于行业领先水平。

.....

4、报告期内与其他单位合作研发的情况

报告期内公司与其他单位合作研发的情况如下：

合作单位名称	合作协议主要内容	权利义务划分约定	产品替代性
聚辰半导体股份有限公司(简称“聚辰半导体”)	澜起科技和聚辰半导体合作开发 DDR5 EEPROM 产品	双方各自享有在开发过程中由各自独立开发的技术和知识产权； 合作开发费用由双方各承担 50%	合同双方均已在协议中约定了较为详尽的保密条款
Global Mixed-Mode Technology (简称“GMT”)	澜起科技和 GMT 合作开发 (1) 电源管理芯片 (PMIC); (2) 温度传感器 (TS)	双方各自享有在开发过程中由各自独立开发的技术和知识产权； 合作开发费用由双方各承担 50%	

合作单位名称	合作协议主要内容	权利义务划分约定	产品替代性
清华大学与 Intel	三方联合开发津速 [®] 服务器 CPU 及其平台	公司负责整体模块及部分芯片的设计,清华大学提供可重构计算处理器 (RCP) 的算法, Intel 提供津速 [®] 服务器平台中的通用 CPU 内核芯片; 津速 [®] 服务器 CPU 品牌及产品产权归澜起科技所有	

5、研发项目对应产品的预计量产时间，产业化后的预计销售情况及市场空间，对发行人及竞争对手产品的替代性

公司研发项目对应产品的具体情况如下：

序号	项目名称	预计量产时间	产品替代性	技术迭代周期与风险
1	Gen 1.0 DDR5 寄存时钟驱动器芯片	2021-2022	产品虽基于 JEDEC 行业标准，但产品替代须经过 CPU 厂商、DRAM 厂商和 OEM 厂商的认证，将逐步替代 DDR4 世代的芯片。	每一代的产品迭代周期约为 18 个月。公司会在 4800MT/s 的产品基础上，继续研发 5600MT/s，6400MT/s 的产品。
2	Gen 1.0 DDR5 数据缓冲器芯片	2021-2022	产品虽基于 JEDEC 行业标准，但产品替代须经过 CPU 厂商、DRAM 厂商和 OEM 厂商的认证，将逐步替代 DDR4 世代的芯片。	每一代的产品迭代周期约为 18 个月。公司会在 4800MT/s 的产品基础上，继续研发 5600MT/s，6400MT/s 的产品。
3	Gen2.0 津速 [®] 处理器	2021-2022	产品基于公司的内存监控技术，清华大学的动态安全监控与可重构计算架构，以及 Intel 的 CPU 技术。此产品现阶段具有一定的独创性，将逐步替代 Gen 1.0 产品。	产品迭代周期约为 3 年。公司会在澜起科技，清华大学和 Intel 的技术基础上，继续开发新一代的安全可控处理器。
4	Gen2.0 DDR4 混合安全内存模组及所需的 RCD/DB 芯片	2021	产品基于公司的内存监控技术。此产品现阶段具有一定的独创性，将逐步替代 Gen 1.0 产品。	产品迭代周期约为 3 年。公司会在已有的技术基础上，继续开发新一代产品。
5	Gen2.0 DDR4 精简混合安全内存模组及所需的 RCD 芯片	2021	产品基于公司的内存监控技术。此产品现阶段具有一定的独创性，将逐步替代 Gen 1.0 产品。	产品迭代周期约为 3 年。公司会在已有的技术基础上，继续开发新一代产品。

序号	项目名称	预计量产时间	产品替代性	技术迭代周期与风险
6	高能效比可编程 AI 处理器及 SoC 芯片系列	2021-2022	AI 处理器的超大计算能力可支持多种神经网络模型。产品瞄准全新市场。	产品迭代周期约为 3 年。公司会在已有的技术基础上，继续开发新一代产品。
7	用于数据中心的 AI 处理器芯片	2021	AI 处理器采用可编程与可重构技术实现硬件平台的灵活性与通用性平衡，扩展平台系统的应用空间。产品瞄准全新市场。	产品迭代周期约为 3 年，公司会在已有的技术基础上，继续开发新一代产品。

注：以上预计量产时间为公司根据现有研发进度的合理估计，存在不确定性
产业化后的预计销售情况及市场空间：

(1) 内存接口芯片业务：根据公开数据，2016 年以来澜起科技、IDT 和 Rambus 对应的内存接口芯片业务收入均呈现持续增长趋势。新一代内存接口芯片产业化后公司预计销售情况将在现有内存接口芯片业务基础上进一步提升。市场规模也将在全球数据中心和服务器市场的快速发展带动下保持持续增长趋势。

(2) 津逮[®]服务器平台：目前第一代津逮[®]服务器平台已具备量产能力，客户包括联想、长城等国内知名企业。公司大力拓展数据中心产品市场，提供更为安全、可靠的运算平台，与行业生态系统内主要企业的需求相契合，因此基于当前的客户拓展情况，该产品的销售有望成为公司的业绩增长点。此外，津逮[®]服务器平台受下游数据中心和服务器市场发展的推动，预计未来市场空间较乐观。

(3) 人工智能芯片：国家对人工智能的扶持政策持续加码，人工智能芯片作为人工智能行业发展的基础，具有广阔的市场空间。

公司在研项目中内存接口芯片及津逮[®]服务器平台相关产品，均是根据目前主流行业相关标准研发，在未来 5 年内暂无被其他新技术完全取代的风险；人工智能芯片系瞄准新的市场应用，公司会紧跟行业前沿技术。

发行人已在招股说明书“第六节 业务与技术”之“六、公司的技术与研发情况（四）核心技术人员和研发团队情况”中补充披露：

1、核心技术人员、研发人员占员工总数的比例

截至2018年12月31日，公司研发人员181人，占员工总数比高达70.98%，其中核心技术人员4人，占比1.57%。

2、核心技术人员的学历背景构成、取得的专业资质及重要科研成果和获得奖项情况，对公司研发的具体贡献：

杨崇和，男，1957年出生，美国俄勒冈州立大学电子与计算机工程硕士及博士。杨崇和博士于2010年当选美国电气和电子工程师协会院士 (IEEE Fellow)。此外，杨博士还荣获多种奖项，其中包括“IEEE CAS 产业先驱奖”和上海市人民政府授予的“白玉兰荣誉奖”。自公司成立以来，杨博士一直担任公司董事长兼首席执行官，主要分管公司的战略发展和技术研发方向，其参与的职务发明共获得授权及申请专利21项，为公司主要专利发明人之一。

山岗，男，1975年出生，北京航空航天大学电子与通信系统硕士，曾经荣获中国电子学会科技进步奖一等奖，上海市科学技术奖三等奖等。山岗先生目前担任市场应用技术部（公司的研发部门之一）负责人，自加入公司以来，参与的职务发明共获得授权及申请专利31项，为公司主要专利发明人之一。

常仲元，男，1959年出生，比利时鲁汶大学微电子学博士。常博士曾在 IEEE 学术期刊和国际会议上发表了论文逾 20 篇，其中 3 篇发表于 ISSCC 会议，并作为第一作者在美国出版了《Low Noise Wideband Amplifiers in Bipolar and CMOS Technology》。常仲元先生目前担任研发部负责人，自加入公司以来，参与的职务发明共获得授权及申请专利3项，为公司主要专利发明人之一。

史刚，男，1969年出生，复旦大学电子工程系微电子硕士。史刚先生目前担任运营部（公司的研发部门之一）负责人，自加入公司以来，参与的职务发明共申请专利1项。

3、公司对核心技术人员实施的约束激励措施

公司建立并实施了严格的保密管理制度和内控管理制度，与核心技术人员签订了保密及竞业禁止协议，对可能引发泄密的行为进行了限定并对涉及技术等影响公司重大利益的事项设置了相应的保密措施进行管理。此外，公司实行了有效的激励制度，为核心技术人员提供具有竞争力的薪酬福利，且所有核心

技术人员均间接持有公司股权，以吸引人才、留住人才，实现公司与员工的共同成长和发展，有效防范了泄密风险。

4、报告期内核心技术人员的主要变动情况及对公司的影响

史刚先生于 2017 年 8 月加入公司担任运营部负责人，其他核心技术人员均在公司长期任职未发生变化。综上所述，最近 2 年内公司核心技术人员未发生重大不利变化。

发行人已在招股说明书“第六节 业务与技术”之“六、公司的技术与研发情况（三）研发投入情况”中补充披露：

公司核心技术均系自主研发成果，报告期内，公司研发费用占营业收入比例整体保持稳定，具体情况如下：

项目	2018 年度	2017 年度	2016 年度
研发投入（万元）	27,669.52	18,826.93	19,822.69
营业收入（万元）	175,766.46	122,751.49	84,494.46
占比	15.74%	15.34%	23.46%

发行人始终将自主研发、开放创新作为保持技术先进性的重要战略。相关研发投入具有显著的技术先进性，同时产品保持一定迭代更新速度，技术储备丰富。

未来，公司将持续加大研发投入，加强技术研发和创新，增加公司持续竞争能力，同时积极稳妥地推动募投项目的建设，丰富技术储备，尽快实现项目收益，提升经营效率和盈利能力。

发行人已在招股说明书“第六节 业务与技术”之“六、公司的技术与研发情况（五）技术与研发的组织体系与创新机制”中补充披露：

2、创新机制

.....

公司重视技术创新，坚持以市场为导向安排研发计划。在技术创新项目的筛选上，公司专注市场调研与分析，以目标客户新增需求为驱动，形成对创新项目的开发思路，围绕现有产品和技术成果，进行技术研发、结构设计、工艺优化等多方面的深入研究。同时，根据新兴市场的发展趋势，不断进行技术升级和储备，持续保持现有产品的更新换代，加快对市场需求的响应速度。以市场为导向的技

术研发，保障了创新项目的实用性，有效提高了公司研发投入的转化率。

公司每年在预算中安排一定比例的预算作为研发费用，为技术创新和技术储备提供物质保障。公司鼓励员工进行职务发明，对于申请的专利和布图设计成功的相关团队给予奖励。公司已形成高度规范化的研发流程和质量控制体系，并根据实际执行情况进行不断的完善和更新，全面覆盖产品开发立项、产品设计、产品验证、产品应用、产品量产认证等阶段，确保每项新产品研发的质量、风险、成本均得到强而有效的管控。公司会定期或不定期召开会议对研发进度和技术储备情况进行审核及研讨，督促研发进度，确保研发成果与市场需求保持一致。

问题十七

2016 年以来，公司与 Intel 及清华大学合作研发津逮[®]系列服务器 CPU，津逮[®]CPU 在英特尔[®]x86 处理器的基础上集成了清华大学的 DSC 技术，与公司的混合安全内存模组搭配而组成津逮[®]服务器平台，为云计算服务器提供芯片级的动态安全监控功能；发行人募投项目津逮[®]服务器 CPU 及其平台技术升级项目与 Intel 合作，Intel 持有发行人 10% 的股份。

请发行人补充披露：（1）与 Intel、清华大学合作研发的情况，包括合作研发的具体模式、合同签署、主要协议约定、研发主要项目、研发成果、研发成果所有权归属、相关利益安排等，合作研发成果是否属于发行人的核心技术，该等合作研发成果与发行人产品的对应关系，对发行人生产经营的重要程度；（2）上述募投项目实施后，预计新增与 Intel 关联交易的规模，是否对发行人的独立性产生不利影响，是否满足《准则》第八十三条“募投项目实施后对发行人的独立性不产生不利影响”的要求。

请保荐机构、发行人律师进行核查，并发表明确意见。

回复：

17.1 发行人说明

一、与 Intel、清华大学合作研发的情况，包括合作研发的具体模式、合同签署、主要协议约定、研发主要项目、研发成果、研发成果所有权归属、相关利益安排等，合作研发成果是否属于发行人的核心技术，该等合作研发成果与发行人产品的对应关系，对发行人生产经营的重要程度；

报告期内，公司与清华大学、Intel 合作研发津逮[®]服务器 CPU，其中公司负责整体模块及部分芯片的设计，清华大学提供可重构计算处理器（RCP）的算法，Intel 提供其通用 CPU 内核芯片，并由公司委托第三方进行芯片制造、封装和测试。

2015 年 9 月，公司与清华大学、Intel 就合作事宜签署谅解备忘录，三方约定，将基于英特尔 x86 架构的可重构计算研究与关于存储缓冲器的研究进行结合，以提供一个整体服务器平台解决方案。备忘录中确定了研发成果归属的基本原则：共同开发的知识产权的所有权，将通过公平且各方同意的机制在三方之间进行分

配。各方将继续拥有其原有的知识产权，并且对在合作过程中由其单独开发的任何知识产权享有所有权。2016年1月，公司与 Intel 就合作细节签署了合作协议，双方就合作的具体事宜如分工、知识产权保护及归属等权利义务进行了约定。

该联合研发项目研发成果为津逮®系列服务器 CPU 及其平台，该成果中包含了公司的核心技术。津逮®服务器 CPU 品牌及产品产权归澜起科技所有。

报告期内，津逮®服务器 CPU 处于研发阶段，其销售收入占公司收入比重较低，对报告期内公司的经营影响较小。但该系列产品将作为公司未来三年的重点发展方向之一。

二、上述募投项目实施后，预计新增与 Intel 关联交易的规模，是否对发行人的独立性产生不利影响，是否满足《准则》第八十三条“募投项目实施后对发行人的独立性不产生不利影响”的要求

报告期内，公司主要产品为内存接口芯片，其收入占比较高。在未来三年内，内存接口芯片业务仍将为公司主要收入和利润来源。为丰富公司的产品线布局，储备未来业务的增长点，提升公司的综合竞争能力，公司同清华大学及 Intel 联合研发了津逮®服务器 CPU，其品牌及产品产权归公司所有，且由公司委托第三方进行芯片制造、封装和测试，形成最终产品后由公司统一销售。公司向 Intel 相关主体采购其通用 CPU 内核芯片，是基于前述背景的正常业务合作与采购。

与 Intel 已发生的交易均经过关联交易决策程序，定价公允。募投项目津逮®服务器 CPU 及其平台技术升级项目实施后，公司将根据届时的市场情况确定与 Intel 关联交易的规模。未来将根据相关规定履行必要的审核及对外披露程序。

募投项目的实施不会造成公司对 Intel 公司的依赖，Intel 作为公司股东无法控制公司，不会对公司的独立性产生影响。本次发行满足准则规定的“对公司的独立性不产生不利影响”的相关规定。

17.2 保荐机构和发行人律师的核查过程和核查意见：

保荐机构和发行人律师获取并审阅发行人与 Intel、清华大学签署的合作备忘录；获取并审阅了发行人与 Intel 签署的合作协议；对发行人董事长、总经理进行访谈；获取并审阅了报告期内公司收入明细表；获取并审阅了公司募投项目可研报告。

经核查，保荐机构和发行人律师认为该募投项目的实施不会造成发行人对 Intel 公司的依赖，Intel 作为公司股东无法控制公司，不会对发行人的独立性产生影响。本次发行满足准则规定的“对发行人的独立性不产生不利影响”的相关规定。

17.3 补充披露情况

发行人已在招股说明书“第六节 业务与技术”之“六、公司的技术与研发情况（二）研发项目及进展情况”中补充披露：

3、公司与清华大学、Intel 合作研发的情况

报告期内，公司与清华大学、Intel 合作研发津逮®服务器 CPU，其中发行人负责整体模块及部分芯片的设计，清华大学提供可重构计算处理器（RCP）的算法，Intel 提供其通用 CPU 内核芯片，并由公司委托第三方进行芯片制造、封装和测试。

2015 年 9 月，公司与清华大学、Intel 就合作事宜签署谅解备忘录，三方约定，将基于英特尔 x86 架构的可重构计算研究与关于存储缓冲器的研究进行结合，以提供一个整体服务器平台解决方案。备忘录中确定了研发成果归属的基本原则：共同开发的知识产权的所有权，将通过公平且各方同意的机制在三方之间进行分配。各方将继续拥有其原有的知识产权，并且对在合作过程中由其单独开发的任何知识产权享有所有权。2016 年 1 月，发行人与 Intel 就合作细节签署了合作协议，双方就合作的具体事宜如分工、知识产权保护及归属等权利义务进行了约定。

该联合研发项目研发成果为津逮®系列服务器 CPU 及其平台，该成果中包含了发行人的核心技术。津逮®服务器 CPU 品牌及产品产权归澜起科技所有。

报告期内，津逮®服务器 CPU 处于研发阶段，其销售收入占发行人收入比重较低，对报告期内发行人的经营影响较小。但该系列产品将作为发行人未来三年的重点发展方向之一。

问题十八

请发行人披露：（1）39项集成电路布图设计专有权的创作者、权利人、创作完成日期，各项集成电路布图设计专有权与发行人产品的对应关系，相关创作者、权利人是否为发行人以外的法人、自然人，如存在，请说明发行人与该创作者、权利人的协议安排；（2）对于即将到期的集成电路布图设计专有权，请说明其对公司生产经营的重要性水平，包括对应的产品型号及业绩贡献，保护期限到期对发行人生产经营的影响。

回复：

18.1 发行人说明

一、39项集成电路布图设计专有权的创作者、权利人、创作完成日期，各项集成电路布图设计专有权与发行人产品的对应关系，相关创作者、权利人是否为发行人以外的法人、自然人，如存在，请说明发行人与该创作者、权利人的协议安排；

截至2019年4月1日，公司共拥有39项集成电路布图设计证书，具体情况如下：

序号	布图设计名称	登记号	申请日	创作完成日	颁证日	权利人	对应产品
1	M88RS2000E	BS.09500385.1	2009-07-14	2008-09-08	2009-09-01	澜起科技	消费电子芯片
2	M88TS2022	BS.09500542.0	2009-10-09	2009-09-03	2009-11-17	澜起科技	消费电子芯片
3	M88CS2200	BS.09500543.9	2009-10-09	2009-09-14	2009-11-17	澜起科技	消费电子芯片
4	M88MB6000	BS.10500704.8	2010-10-19	2010-02-08	2010-12-07	澜起科技	内存接口芯片
5	M88SSTE32882H	BS.10500705.6	2010-10-19	2010-07-26	2010-12-07	澜起科技	内存接口芯片
6	M88TT2800	BS.10500706.4	2010-10-19	2010-06-18	2010-12-07	澜起科技	消费电子芯片
7	M88DS3102	BS.10500707.2	2010-10-19	2010-08-26	2010-12-07	澜起科技	消费电子芯片

序号	布图设计名称	登记号	申请日	创作完成日	颁证日	权利人	对应产品
8	M88CS2200B	BS.10500708.0	2010-10-19	2010-09-06	2010-12-07	澜起科技	消费电子芯片
9	M88TC2800	BS.11500147.6	2011-03-24	2010-11-24	2011-04-20	澜起科技	消费电子芯片
10	M88DD3000 (M88DD3001, M88DD3100)	BS.11500148.4	2011-03-24	2010-09-17	2011-04-20	澜起科技	消费电子芯片
11	M88TS2022C	BS.11500955.8	2011-10-10	2011-05-04	2011-11-08	澜起科技	消费电子芯片
12	M88DS3102D	BS.11500956.6	2011-10-10	2011-05-23	2011-11-08	澜起科技	消费电子芯片
13	M88CS2200B2	BS.11500957.4	2011-10-10	2011-07-05	2011-11-08	澜起科技	消费电子芯片
14	M88VS3001	BS.12501356.6	2012-10-09	2012-07-20	2012-11-21	澜起科技	消费电子芯片
15	M88TC3000	BS.12501354.X	2012-10-09	2012-07-10	2012-11-21	澜起科技	消费电子芯片
16	M88RM3000	BS.12501355.8	2012-10-09	2012-04-30	2012-11-21	澜起科技	消费电子芯片
17	M88MB6000B	BS.11500383.5	2011-06-02	2011-03-22	2011-08-22	澜起科技	内存接口芯片
18	M88MB6000C	BS.12500210.6	2012-02-22	2011-10-12	2012-03-06	澜起科技	内存接口芯片
19	M88MCB-LP01	BS.12500900.3	2012-07-16	2012-03-27	2012-09-05	澜起科技	内存接口芯片
20	M88MB6000D1	BS.12501357.4	2012-10-09	2012-08-06	2012-11-21	澜起科技	内存接口芯片
21	M88VS3001B	BS.13500607.4	2013-06-04	2013-05-16	2013-08-08	澜起科技	消费电子芯片
22	M88DDR4DB01	BS.13501090.X	2013-08-21	2013-04-03	2013-10-15	澜起科技	内存接口芯片
23	M88SSTE32882H6	BS.145500144	2014-03-03	2012-03-25	2014-04-09	澜起科技	内存接口芯片
24	M88DDR4RCD01B	BS.145001253	2014-03-03	2013-10-25	2014-04-09	澜起科技	内存接口芯片
25	M88DDR4DB01A	BS.14500127X	2014-03-03	2014-01-13	2014-04-09	澜起科技	内存接口芯片

序号	布图设计名称	登记号	申请日	创作完成日	颁证日	权利人	对应产品
26	M88DDR4RCD01C	BS.145501272	2014-06-10	2014-05-26	2014-07-02	澜起科技	内存接口芯片
27	M88DDR4DB01B	BS.145501264	2014-06-10	2014-01-13	2014-07-02	澜起科技	内存接口芯片
28	M88DDR4RCD02	BS.155505033	2015-05-20	2015-01-20	2015-06-12	澜起科技	内存接口芯片
29	M88DDR4DB02	BS.15550908X	2015-11-19	2015-08-04	2015-12-16	澜起科技	内存接口芯片
30	M88DR4RCD02+	BS.16551571.6	2016-08-28	2016-03-31	2016-09-21	澜起科技	内存接口芯片
31	M88DR4DB02P	BS.16551823.5	2016-11-03	2016-06-30	2016-11-21	澜起科技	内存接口芯片
32	M88MB6000DS	BS.175521549	2017-01-10	2014-05-12	2017-01-26	澜起科技	内存接口芯片
33	M88RCD4XS2P	BS 17553473X	2017-10-17	2016-09-30	2017-12-05	澜起科技	津逮 [®] 服务器平台
34	M88RCD4HS2P	BS 175534705	2017-10-17	2016-12-22	2017-12-04	澜起科技	津逮 [®] 服务器平台
35	M88DB4HS2P	BS 175534691	2017-10-17	2017-01-06	2017-12-04	澜起科技	津逮 [®] 服务器平台
36	M88RCD4XS2P-B1	BS.185561403	2018-08-19	2018-04-17	2018-09-28	澜起科技	津逮 [®] 服务器平台
37	M88DR4DB02P-A4	BS.18556139X	2018-08-19	2018-03-20	2018-09-28	澜起科技	内存接口芯片
38	M88DR4RCD02P	BS. 185569684	2018-11-07	2017-04-19	2018-12-04	澜起科技	内存接口芯片
39	M88DDR4RCD01	BS.13501087.X	2013-08-21	2013-04-03	2013-10-15	澜起电子 昆山	内存接口芯片

根据《集成电路布图设计保护条例》中有关于权利人和创作者的描述，“布图设计权利人，是指依照本条例的规定，对布图设计享有专有权的自然人、法人或者其他组织；布图设计专有权属于布图设计创作者，本条例另有规定的除外”，“由法人或者其他组织主持，依据法人或者其他组织的意志而创作，并由法人或

者其他组织承担责任的布图设计，该法人或者其他组织是创作者”。

公司对上述集成电路布图设计享有专有权，因此公司为权利人。上述集成电路布图设计属于由公司主持，依据公司的意志而创作，并由公司承担责任的布图设计，因此公司为创作者。

综上，上述集成电路布图设计的权利人和创作者同为公司，各项集成电路布图设计专有权与公司产品存在一一对应关系，创作者、权利人不存在公司以外的法人、自然人。

二、对于即将到期的集成电路布图设计专有权，请说明其对公司生产经营的重要性水平，包括对应的产品型号及业绩贡献，保护期限到期对发行人生产经营的影响。

布图设计专有权的保护期为 10 年。在 2019 年内即将到期的布图设计专有权（登记号：M88RS2000E、M88TS2022、M88CS2200）共有三项，均为消费电子芯片相关产品的布图设计。公司现有的消费电子芯片布图设计均因技术迭代，相关产品已不再销售，且公司已于 2017 年 8 月后不再从事消费电子芯片相关业务，所以此三项布图登记的过期对公司未来的生产经营不会造成任何影响。

公司所从事的集成电路设计行业技术更新较快，某一款产品从设计研发、登记布图设计到量产销售，直至产品生命周期结束通常不超过 10 年。所以，一方面，在新产品研发成功后，积极申请布图设计专有权登记有利于保护公司知识产权；另一方面，一旦相关布图设计专有权保护期到期后，该产品的生命周期基本结束，不会给公司的后续经营造成实质性影响。对于后续即将到期的集成电路布图设计专有权，公司主要通过不断进行技术创新，推陈出新，积极申请新的布图设计专有权以增强公司技术竞争力。

18.2 保荐机构的核查过程和核查意见

核查过程：

1、保荐机构取得了公司集成电路布图设计专有权的相关资料，与公司产品的对应关系，以及相关创作人、权利人的信息；

2、查阅了集成电路布图设计的创作完成日期，分析了对今年内即将到期的集成电路布图设计专有权对应的产品型号及业绩贡献。

核查结论：

经核查，保荐机构认为：

1、集成电路布图设计的权利人和创作人同为发行人，各项集成电路布图设计专有权与发行人产品存在一一对应关系，创作者、权利人不存在发行人以外的法人、自然人。

2、布图设计专有权的保护期为 10 年。在 2019 年内即将到期的布图设计专有权（登记号：M88RS2000E、M88TS2022、M88CS2200）共有三项，均为消费电子芯片相关产品的布图设计。公司现有的消费电子芯片布图设计均因技术迭代，相关产品已不再销售，且公司已于 2017 年 8 月后不再从事消费电子芯片相关业务，所以此三项布图登记的过期对公司未来的生产经营不会造成任何影响。

18.3 补充披露情况

发行人已在招股说明书“第六节 业务与技术”之“五、主要固定资产及无形资产（二）无形资产”中补充披露：

（3）集成电路布图设计

截至 2019 年 4 月 1 日，公司共拥有 39 项集成电路布图设计证书，具体情况如下：

序号	布图设计名称	登记号	申请日	创作完成日	颁证日	权利人	对应产品
1	M88RS2000E	BS. 09500385. 1	2009-07-14	2008-09-08	2009-09-01	澜起科技	消费电子芯片
2	M88TS2022	BS. 09500542. 0	2009-10-09	2009-09-03	2009-11-17	澜起科技	消费电子芯片
3	M88CS2200	BS. 09500543. 9	2009-10-09	2009-09-14	2009-11-17	澜起科技	消费电子芯片
4	M88MB6000	BS. 10500704. 8	2010-10-19	2010-02-08	2010-12-07	澜起科技	内存接口芯片
5	M88SSTE32882H	BS. 10500705. 6	2010-10-19	2010-07-26	2010-12-07	澜起科技	内存接口芯片

序号	版图设计名称	登记号	申请日	创作完成日	颁证日	权利人	对应产品
6	M88TT2800	BS. 10500706. 4	2010-10-19	2010-06-18	2010-12-07	澜起科技	消费电子芯片
7	M88DS3102	BS. 10500707. 2	2010-10-19	2010-08-26	2010-12-07	澜起科技	消费电子芯片
8	M88CS2200B	BS. 10500708. 0	2010-10-19	2010-09-06	2010-12-07	澜起科技	消费电子芯片
9	M88TC2800	BS. 11500147. 6	2011-03-24	2010-11-24	2011-04-20	澜起科技	消费电子芯片
10	M88DD3000 (M88DD3001, M88DD3100)	BS. 11500148. 4	2011-03-24	2010-09-17	2011-04-20	澜起科技	消费电子芯片
11	M88TS2022C	BS. 11500955. 8	2011-10-10	2011-05-04	2011-11-08	澜起科技	消费电子芯片
12	M88DS3102D	BS. 11500956. 6	2011-10-10	2011-05-23	2011-11-08	澜起科技	消费电子芯片
13	M88CS2200B2	BS. 11500957. 4	2011-10-10	2011-07-05	2011-11-08	澜起科技	消费电子芯片
14	M88VS3001	BS. 12501356. 6	2012-10-09	2012-07-20	2012-11-21	澜起科技	消费电子芯片
15	M88TC3000	BS. 12501354. X	2012-10-09	2012-07-10	2012-11-21	澜起科技	消费电子芯片
16	M88RM3000	BS. 12501355. 8	2012-10-09	2012-04-30	2012-11-21	澜起科技	消费电子芯片
17	M88MB6000B	BS. 11500383. 5	2011-06-02	2011-03-22	2011-08-22	澜起科技	内存接口芯片
18	M88MB6000C	BS. 12500210. 6	2012-02-22	2011-10-12	2012-03-06	澜起科技	内存接口芯片
19	M88MCB-LP01	BS. 12500900. 3	2012-07-16	2012-03-27	2012-09-05	澜起科技	内存接口芯片
20	M88MB6000D1	BS. 12501357. 4	2012-10-09	2012-08-06	2012-11-21	澜起科技	内存接口芯片
21	M88VS3001B	BS. 13500607. 4	2013-06-04	2013-05-16	2013-08-08	澜起科技	消费电子芯片
22	M88DDR4DB01	BS. 13501090. X	2013-08-21	2013-04-03	2013-10-15	澜起科技	内存接口芯片
23	M88SSTE32882H6	BS. 145500144	2014-03-03	2012-03-25	2014-04-09	澜起科技	内存接口芯片

序号	布图设计名称	登记号	申请日	创作完成日	颁证日	权利人	对应产品
24	M88DDR4RCD01B	BS. 145001253	2014-03-03	2013-10-25	2014-04-09	澜起科技	内存接口芯片
25	M88DDR4DB01A	BS. 14500127X	2014-03-03	2014-01-13	2014-04-09	澜起科技	内存接口芯片
26	M88DDR4RCD01C	BS. 145501272	2014-06-10	2014-05-26	2014-07-02	澜起科技	内存接口芯片
27	M88DDR4DB01B	BS. 145501264	2014-06-10	2014-01-13	2014-07-02	澜起科技	内存接口芯片
28	M88DDR4RCD02	BS. 155505033	2015-05-20	2015-01-20	2015-06-12	澜起科技	内存接口芯片
29	M88DDR4DB02	BS. 15550908X	2015-11-19	2015-08-04	2015-12-16	澜起科技	内存接口芯片
30	M88DR4RCD02+	BS. 16551571. 6	2016-08-28	2016-03-31	2016-09-21	澜起科技	内存接口芯片
31	M88DR4DB02P	BS. 16551823. 5	2016-11-03	2016-06-30	2016-11-21	澜起科技	内存接口芯片
32	M88MB6000DS	BS. 175521549	2017-01-10	2014-05-12	2017-01-26	澜起科技	内存接口芯片
33	M88RCD4XS2P	BS 17553473X	2017-10-17	2016-09-30	2017-12-05	澜起科技	津逮®服务器平台
34	M88RCD4HS2P	BS 175534705	2017-10-17	2016-12-22	2017-12-04	澜起科技	津逮®服务器平台
35	M88DB4HS2P	BS 175534691	2017-10-17	2017-01-06	2017-12-04	澜起科技	津逮®服务器平台
36	M88RCD4XS2P-B1	BS. 185561403	2018-08-19	2018-04-17	2018-09-28	澜起科技	津逮®服务器平台
37	M88DR4DB02P-A4	BS. 18556139X	2018-08-19	2018-03-20	2018-09-28	澜起科技	内存接口芯片
38	M88DR4RCD02P	BS. 185569684	2018-11-07	2017-04-19	2018-12-04	澜起科技	内存接口芯片
39	M88DDR4RCD01	BS. 13501087. X	2013-08-21	2013-04-03	2013-10-15	澜起电子 昆山	内存接口芯片

上述集成电路布图设计的权利人和创作者同为公司，各项集成电路布图设

计专有权与发行人产品存在一一对应关系，创作者、权利人不存在发行人以外的法人、自然人。

布图设计专有权的保护期为 10 年。在 2019 年内即将到期的布图设计专有权（登记号：M88RS2000E、M88TS2022、M88CS2200）共有三项，均为消费电子芯片相关产品的布图设计。公司现有的消费电子芯片布图设计均因技术迭代，相关产品已不再销售，且公司已于 2017 年 8 月后不再从事消费电子芯片相关业务，所以此三项布图登记的过期对公司未来的生产经营不会造成任何影响。

公司所从事的集成电路设计行业技术更新较快，某一款产品从设计研发、登记布图设计到量产销售，直至产品生命周期结束通常不超过 10 年。所以，一方面，在新产品研发成功后，积极申请布图设计专有权登记有利于保护公司知识产权；另一方面，一旦相关布图设计专有权保护期到期后，该产品的生命周期基本结束，不会给公司的后续经营造成实质性影响。对于后续即将到期的集成电路布图设计专有权，公司主要通过不断进行技术创新，推陈出新，积极申请新的布图设计专有权以增强公司技术竞争力。

问题十九

招股说明书披露，公司发明的 DDR4 全缓冲“1+9”架构被采纳为国际标准。

请发行人补充披露：（1）内存接口芯片技术的行业平均水平，结合行业技术水平和对行业的贡献，并与主要竞争对手的技术架构、技术水平、芯片性能指标等进行对比，说明发行人技术水平的优势与劣势，充分披露“1+9”架构的技术先进性；（2）发行人的核心技术是否取得专利或其他技术保护措施、核心技术的科研实力和成果情况；（3）发行人报告期内通过核心技术开发产品（服务）的情况，报告期内核心技术产品（服务）的生产和销售数量，核心技术产品（服务）在细分行业的市场占有率，发行人依靠核心技术开展生产经营所产生收入的构成、占比、变动情况及原因等。

请保荐机构根据《问答》及《科创板企业上市推荐指引》的要求，对上述事项进行核查并发表明确意见。

回复：

19.1 发行人说明

一、内存接口芯片技术的行业平均水平，结合行业技术水平和对行业的贡献，并与主要竞争对手的技术架构、技术水平、芯片性能指标等进行对比，说明发行人技术水平的优势与劣势，充分披露“1+9”架构的技术先进性；

因为内存接口芯片需满足 JEDEC 制定的相关行业标准，凡是可提供相关产品且经认证的公司，其技术水平均已满足 JEDEC 基本标准。

在 DDR4 世代，澜起科技发明了“1+9”分布式缓冲内存子系统框架，并贡献给行业组织，成为 DDR4 内存接口芯片的重要标准之一。在符合行业标准的前提下，各市场参与者在产品能耗、信号完整性、产品可靠性等方面进行竞争，其产品具体的实现方式和实现路径等存在差异。

1、“1+9”分布式缓冲内存子系统框架与传统架构对比：

性能对比项	传统架构	“1+9” 分布式缓冲内存子系统框架
技术架构	数据连接线长，负载重，数据延迟大	信号走线短，负载轻，数据延迟小

性能对比项	传统架构	“1+9” 分布式缓冲内存子系统框架
技术水平	信号完整性差，带宽低： - 最高工作速度仅能达到 1866MT/s - 最大容量为 64GB	信号完整性好，数据带宽高： - 工作速度可达 3200MT/s - 最大容量为 128GB
芯片性能	功耗集中，散热问题突出	功耗分散，散热性好

2、“1+9” 分布式缓冲内存子系统框架对行业的贡献：

“1+9” 架构已被 JEDEC 采纳为国际标准，成为 DDR4 LRDIMM 的标准设计，提升了公司的国际话语权，凸显了公司的技术水平及技术能力。

3、“1+9” 架构的技术先进性：

由公司发明的“1+9” 分布式缓冲内存子系统框架，突破了 DDR2、DDR3 的集中式架构设计，创新性采用 1 颗寄存缓冲控制器为核心、9 颗数据缓冲器芯片的分布结构布局，大幅减少了 CPU 与 DRAM 颗粒间的负载，降低了信号传输损耗，解决了内存子系统大容量与高速度之间的矛盾。

二、发行人的核心技术是否取得专利或其他技术保护措施、核心技术的科研实力和成果情况：

公司的核心技术均已申请专利或集成电路布图设计专有权，保障公司核心技术的安全。截至 2019 年 4 月 1 日，公司已获授权的国内外专利达 90 项，获集成电路布图设计证书 39 项。

公司具备自有的集成电路设计平台，包括数字信号处理技术、内存管理与数据缓冲技术、模拟电路设计技术、高速逻辑与接口电路设计技术以及低功耗设计技术，方案集成度高，可有效提高系统能效和产品性能。

上述“1+9” 分布式缓冲内存子系统框架对应专利包括：

序号	国别	知识产权类别	授权号	名称
1	美国	授权发明专利	US9201817	Method for Allocating Addresses to Data Buffers in Distributed Buffer Chipset
2	美国	授权发明专利	US9836415	BUFFER DEVICE, METHOD AND APPARATUS FOR CONTROLLING ACCESS TO INTERNAL MEMORY
3	中国	授权发明专利	ZL201110221491.9	分布式缓存芯片组中的数据缓存器

				的地址分配方法
4	中国	授权发明专利	ZL200910200826.1	存储器模组及存储器模组内的数据交换方法

公司提出了一种内存接口校准算法，发明了新型高速、低抖动收发器，解决了多点通讯、突发模式下内存总线的信号完整性问题。在服务器内存最大负载情况下，该技术可支持 DDR4 内存实现最高速率(3200MT/s)，达到国际领先水平。

上述内存接口校准算法对应专利包括：

序号	国别	知识产权类别	授权号	名称
1	中国	授权发明专利	ZL201110443575.7	用于内存系统的电压与时序校准方法
2	中国	授权发明专利	ZL201110193167.0	写入电路、读取电路、内存缓冲器及内存条
3	中国	授权发明专利	ZL200910054716.9	产生读使能信号的方法以及采用该方法的存储系统
4	中国	授权发明专利	ZL200910161562.3	已注册 DIMM 存储器系统
5	中国	授权发明专利	ZL200610066292.4	低功耗的高速收发器

此外，公司还提出一种先进的内存子系统的低功耗设计技术，发明了新型自适应电源管理电路，并采用动态时钟分配等创新技术，显著降低了相关内存接口芯片产品的功耗。上述发明对应专利包括：

序号	国别	知识产权类别	授权号	名称
1	美国	授权发明专利	US9240758	Voltage Regulator and Method of Regulating Voltage
2	美国	授权发明专利	US9231576	DEVICE AND METHOD FOR CLOCK SIGNAL LOSS DETECTION
3	美国	授权发明专利	US7558980	Systems and methods for the distribution of differential clock signals to a plurality of low impedance receivers
4	中国	授权发明专利	ZL201110449754.1	主从式超前负载补偿稳压装置
5	中国	授权发明专利	ZL201410041038.3	一种稳压器及稳压的方法
6	中国	授权发明专利	ZL201110349001.3	一种信号延迟控制电路

三、发行人报告期内通过核心技术开发产品（服务）的情况，报告期内核心技术产品（服务）的生产和销售数量，核心技术产品（服务）在细分行业的市场占有率，发行人依靠核心技术开展生产经营所产生收入的构成、占比、变动情况及原因等；

报告期内，公司通过核心技术开发的产品包括内存接口芯片、津逮®服务器平台和消费电子芯片（2017年8月后不再销售），合计销售内存接口芯片数量18,629.93万颗，合计销售津逮®服务器CPU及混合安全内存模组数量为3,343个，合计销售消费电子芯片数量为10,260.34万颗。

其中，内存接口芯片市场规模及占有率目前没有权威的行业统计数据。根据IDT和Rambus定期报告公开披露数据和公司相关收入推算，报告期内公司的市场占有率从25-35%提升至40-50%之间。

报告期内，公司由内存接口芯片、消费电子芯片及津逮®服务器平台所带来的收入均为核心技术开展所产生的收入，具体情况如下：

核心技术 产品名称	2018年度		2017年度		2016年度	
	收入	占比	收入	占比	收入	占比
内存接口芯片	174,865.26	99.49%	93,466.80	76.14%	55,832.67	66.08%
消费电子芯片	-	-	21,291.01	17.34%	28,482.17	33.71%
津逮®服务器平台	901.20	0.51%	759.64	0.62%	-	-
合计	175,766.46	100.00%	115,517.45	94.10%	84,314.84	99.79%

报告期内，公司主营业务收入主要依靠核心技术开展经营所得，上述收入构成变动原因，主要包括：（1）随着产品竞争力不断提升，内存接口芯片收入快速上升，其占主营业务收入比重不断提高；（2）2017年7月公司将消费电子芯片业务相关资产转让给成都澜至及其关联方，2017年8月后公司不再开展相关业务；（3）津逮®服务器平台在报告期内主要处于研发阶段，其销售收入来源主要系向客户及合作伙伴销售的工程样品和第一代津逮®服务器平台产品所得。

19.2 保荐机构的核查过程和核查意见

核查过程：

- 1、保荐机构查阅了关于内存接口芯片技术的相关行业报告，取得了发行人关于公司行业技术水平、对行业的贡献以及“1+9”架构的技术先进性的说明；
- 2、获取了发行人专利、集成电路布图设计专有权清单及相关资料，以及核

心技术发明相关申报材料；

3、取得了发行人核心技术产品与销售情况的对应关系和同行业可比公司的定期报告。

核查结论：

经核查，保荐机构认为：

1、公司发明的“1+9”分布式缓冲内存子系统框架较传统架构具有明显的技术先进性；

2、公司的核心技术均已申请专利或集成电路布图设计专有权，保障公司核心技术的安全；

3、报告期内，公司依靠核心技术开展生产经营所产生收入构成变动原因具有合理性。

19.3 补充披露情况

发行人已在招股说明书“第六节 业务与技术”之“二、行业基本情况（六）行业技术水平及特点”中补充披露：

3、内存接口芯片技术的行业平均水平以及“1+9”架构的技术先进性

因为内存接口芯片需满足 JEDEC 制定的相关行业标准，凡是可提供相关产品且经认证的公司，其技术水平均已满足 JEDEC 基本标准。

在 DDR4 世代，澜起科技发明了“1+9”分布式缓冲内存子系统框架，并贡献给行业组织，成为 DDR4 内存接口芯片的重要标准之一。在符合行业标准的前提下，各市场参与者在产品能耗、信号完整性、产品可靠性等方面进行竞争，其产品具体的实现方式和实现路径等存在差异。

(1) “1+9”分布式缓冲内存子系统框架与传统架构对比：

性能对比项	传统架构	“1+9” 分布式缓冲内存子系统框架
技术架构	数据连接线长，负载重，数据延迟大	信号走线短，负载轻，数据延迟小

性能对比项	传统架构	“1+9” 分布式缓冲内存子系统框架
技术水平	信号完整性差，带宽低： - 最高工作速度仅能达到 1866MT/s - 最大容量为 64GB	信号完整性好，数据带宽高： - 工作速度可达 3200MT/s - 最大容量为 128GB
芯片性能	功耗集中，散热问题突出	功耗分散，散热性好

(2) “1+9” 分布式缓冲内存子系统框架对行业的贡献：

“1+9” 架构已被 JEDEC 采纳为国际标准，成为 DDR4 LRDIMM 的标准设计，提升了公司的国际话语权，凸显了公司的技术水平及技术能力。

(3) “1+9” 架构的技术先进性：

由公司发明的“1+9” 分布式缓冲内存子系统框架，突破了 DDR2、DDR3 的集中式架构设计，创新性采用 1 颗寄存缓冲控制器为核心、9 颗数据缓冲器芯片的分布结构布局，大幅减少了 CPU 与 DRAM 颗粒间的负载，降低了信号传输损耗，解决了内存子系统大容量与高速度之间的矛盾。

问题二十

招股说明书披露，目前全球市场中可提供内存接口芯片的厂商共有三家，分别为澜起科技、IDT 和 Rambus，但在 DDR2 阶段行业参与者超过 10 家。公司成为全球可提供从 DDR2 到 DDR4 内存全缓冲/半缓冲完整解决方案的主要供应商之一，相关产品已占据全球市场的主要份额。

请发行人披露：（1）目前内存市场上 DDR2、DDR3、DDR4 内存的市场分布情况，是否仍有其他厂商提供 DDR2、DDR3 阶段的内存接口芯片，“目前全球市场中可提供内存接口芯片的厂商共有三家”的表述是否准确；（2）发行人 DDR2、DDR3、DDR4 内存接口芯片的具体推出时间，报告期内占公司内存接口芯片总销售数量、金额的比例，以及价格差异情况；（3）内存接口芯片的发展演变情况，包括但不限于每个技术阶段的技术水平、主要厂商、市场规模、时间跨度等，明确引用第三方数据的来源，确保有权威、客观、独立的依据；（4）与主要竞争对手 IDT 和 Rambus 进行对比，并充分说明发行人的市场地位。

请保荐机构对上述事项进行核查并发表明确意见。

回复：

20.1 发行人说明

一、目前内存市场上 DDR2、DDR3、DDR4 内存的市场分布情况，是否仍有其他厂商提供 DDR2、DDR3 阶段的内存接口芯片，“目前全球市场中可提供内存接口芯片的厂商共有三家”的表述是否准确；

根据公司报告期内相关产品的销售情况，目前内存市场上 DDR4 为主流产品，该世代产品占公司内存接口芯片销售数量的 95% 以上。

经查询公开行业研究报告及行业内相关公司官网，除澜起科技、IDT、Rambus 以外，目前未发现市场上有其他厂商销售内存接口芯片的情形。此外，经查询 CPU 厂商 Intel 以及内存厂商三星电子官网资料，均只有澜起科技、IDT、Rambus 三家公司通过了其 DDR4 内存接口芯片产品的认证。但严谨起见，相应表述修正为“目前全球市场中可提供内存接口芯片的主要厂商共有三家”。

二、发行人 DDR2、DDR3、DDR4 内存接口芯片的具体推出时间，报告期

内占公司内存接口芯片总销售数量、金额的比例，以及价格差异情况；

公司于 2008 年 6 月、2011 年 8 月、2013 年 10 月，推出 DDR2、DDR3、DDR4 内存接口芯片并通过 CPU 厂商认证。

报告期内，公司 DDR2、DDR3、DDR4 内存接口芯片占内存接口芯片总销售数量比例分别为 0.00%、2.05%、97.95%，金额比例分别为 0.00%、2.64%、97.36%。

DDR2、DDR3、DDR4 内存接口芯片随着技术演进，相关技术架构发生较大变化，相关产品单价不具有直接可比性。

报告期内，DDR4 的平均单价较 DDR3 降低 22.89%，主要原因系 DDR4 内存接口芯片采用公司发明的“1+9”分布式缓冲内存子系统框架，突破了传统集中式架构设计，形成由 1 颗寄存缓冲控制器为核心、9 颗数据缓冲器芯片的布局，其中 DDR4 世代采用的 9 颗数据缓冲器芯片取代了 DDR3 世代的 1 颗内存缓冲芯片的功能，导致单颗芯片的价格有所下降。

三、内存接口芯片的发展演变情况，包括但不限于每个技术阶段的技术水平、主要厂商、市场规模、时间跨度等，明确引用第三方数据的来源，确保有权威、客观、独立的依据；

内存接口芯片的发展演变情况如下：

内存接口芯片世代	技术特点	主要厂商	研发时间跨度
DDR2	最低可支持 1.5V 工作电压	TI (德州仪器)、Intel、西门子、Inphi、澜起科技、IDT 等	2004 年-2008 年
DDR3	最低可支持 1.25V 工作电压，最高可支持 1866 MT/s 的运行速率	Inphi、IDT、澜起科技、Rambus、TI (德州仪器) 等	2008 年-2014 年
DDR4	最低可支持 1.2V 工作电压，最高可支持 3200MT/s 的运行速率	澜起科技、IDT、Rambus	2013 年-2017 年
DDR5	最低可支持 1.1V 工作电压，可实现 4800MT/s 的运行速率，并在此产品基础上，继续研发 5600MT/s，6400MT/s 的产品	澜起科技、IDT、Rambus	2017 年至今

其中，内存接口芯片市场较为细分，公开信息较为有限，市场规模目前没有权威的行业统计数据。根据 IDT 和 Rambus 定期报告公开披露数据和公司相关收入推算，报告期内，内存接口芯片的市场规模约为 2.8 亿美元、3.8 亿美元和 5.7 亿美元。

上述信息主要通过查询 Intel、三星、TI、IDT、Rambus 等官方网站公开信息汇总统计。

四、与主要竞争对手 IDT 和 Rambus 进行对比，并充分说明发行人的市场地位；

根据公开数据，2016 年以来澜起科技、IDT 和 Rambus 对应的内存接口芯片业务收入均呈现持续增长趋势。根据 IDT、Rambus 披露的定期报告统计，总体上看，2018 年澜起科技和 IDT 在内存接口芯片领域的收入较为接近，Rambus 占比则相对较小。

IDT 可提供 DDR3 和 DDR4 内存接口芯片。根据 IDT 2019 年财年前三季度定期报告统计，其 2019 财年（2018 年 4 月 1 日-2019 年 3 月 31 日）前三季度营业收入 70,458.70 万美元，净利润 8,782.60 万美元，其中内存接口芯片领域收入为 20,678.70 万美元，约占总收入比例为 30%。

Rambus 可提供 DDR3 和 DDR4 内存接口芯片。根据 Rambus 2018 年年报披露，其 2018 年营业收入 23,120.10 万美元，净利润-15,795.70 万美元，其中内存接口芯片领域收入为 3,640.00 万美元，约占总收入比例为 15%。

澜起科技从成立至今一直从事内存接口芯片的研发，凭借其长期的技术积累，在 DDR4 世代确立了行业领先优势。公司 2018 年营业收入 175,766.46 万元，净利润 73,687.84 万元。澜起科技发明了 DDR4 全缓冲“1+9”架构，最终被 JEDEC 国际标准采纳。公司凭借具有自主知识产权的高速、低功耗技术，为新一代服务器平台提供完全符合 JEDEC 标准的高性能内存接口解决方案，同时正积极参与 DDR5 JEDEC 标准的制定，是全球可提供从 DDR2 到 DDR4 内存全缓冲/半缓冲完整解决方案的主要供应商之一，在该领域拥有重要话语权。

综上，报告期内澜起科技内存接口芯片业务收入迅速攀升，已成为该市场的领先企业。

20.2 保荐机构的核查过程和核查意见

核查过程：

1、保荐机构通过官方网站查询、行业资料收集、DRAM 市场的国际龙头企业访谈方式确认目前内存市场的分布情况；

2、取得了公司各代内存接口芯片产品具体的推出时间，并收集了报告期内内存接口芯片的销售数量、金额及价格情况；

3、通过网络公开查询了内存接口芯片的发展演变情况，并就行业内技术特点、主要参与厂商、研发时间跨度等情况取得了相关外部资料和公司的说明性文件；

4、查阅了同行业可比公司 IDT 和 Rambus 相关的定期报告、研究报告等。

核查结论：

经核查，保荐机构认为：

1、严谨起见，相应表述修正为“目前全球市场中可提供内存接口芯片的主要厂商共有三家；

2、公司 DDR2、DDR3、DDR4 内存接口芯片的具体推出时间紧跟 DDR 技术的更迭，报告期内销售数量和金额主要以 DDR4 内存接口芯片产品为主，产品价格变动情况具有合理性；

3、内存接口芯片的发展演变情况明确有权威、客观、独立的依据；

4、2018 年澜起科技和 IDT 在内存接口芯片领域的收入较为接近，Rambus 占比则相对较小。报告期内公司内存接口芯片业务收入迅速攀升，已成为内存接口芯片市场的领先企业。

20.3 补充披露情况

发行人已在招股说明书“第六节 业务与技术”之“二、行业基本情况（十）行业发展态势”中补充披露：

2、市场供给状况

目前全球市场中可提供内存接口芯片的主要厂商共有三家，分别为澜起科技、IDT 和 Rambus。根据三家公司的定期报告显示，内存接口芯片相关业务收入均保持较快增速。由于服务器数据存储和处理的负载能力不断提升，服务器中配置内存条的数量快速增长，因此内存接口芯片的增长率预计将高于服务器增长速度。

结合全球服务器出货量的未来增长预期，以及内存技术和服务器发展趋势，可以推测内存接口芯片的市场规模仍将保持快速增长。

发行人已在招股说明书“第六节 业务与技术”之“二、行业基本情况（三）行业发展情况及未来发展趋势”中补充披露：

（3）内存接口芯片发展概况

内存接口芯片是服务器内存模组的核心逻辑器件，其主要作用是提升内存数据访问的速度及稳定性，满足服务器 CPU 对内存模组日益增长的高性能及大容量需求。

内存接口芯片的发展演变情况如下：

内存接口芯片	技术特点	主要厂商	研发时间跨度
DDR2	最低可支持 1.5V 工作电压	TI（德州仪器）、Intel、西门子、NEC、Inphi、澜起科技、IDT 等	2004 年-2008 年
DDR3	最低可支持 1.25V 工作电压，最高可支持 1866 MT/s 的运行速率	Inphi、IDT、澜起科技、Rambus、TI（德州仪器）等	2008 年-2014 年
DDR4	最低可支持 1.2V 工作电压，最高可支持 3200MT/s 的运行速率	澜起科技、IDT、Rambus	2013 年-2017 年
DDR5	最低可支持 1.1V 工作电压，可实现 4800MT/s 的运行速率，并在此产品基础上，继续研发 5600MT/s，6400MT/s 的产品	澜起科技、IDT、Rambus	2017 年至今

目前全球市场中可提供内存接口芯片的主要厂商共有三家，分别为澜起科技、IDT 和 Rambus。根据公开数据，2018 年以来上述三家公司对应的内存接口芯片业务收入均呈现持续增长趋势。由于内存接口芯片的价格较为稳定，其市场规模的增长主要来源于内存出货量的增加。相比于全球服务器出货量的增长，由于服务器数据存储和处理的负载能力不断提升，服务器中配置内存数量也随之增长，导致内存接口芯片的增长率高于服务器市场的增速。

发行人已在招股说明书“第六节 业务与技术”之“二、行业基本情况（八）与同行业可比公司的比较情况”中补充披露：

1、同行业可比公司经营情况

目前，国内公司中暂无与公司在业务模式、产品种类上均完全可比的竞争对

手。在全球范围内，现阶段从事研发并量产服务器 DDR4 内存接口芯片的主要有 3 家公司，分别为澜起科技、IDT 和 Rambus。根据可比公司披露的定期报告统计，总体上看，2018 年澜起科技和 IDT 在内存接口芯片领域的收入较为接近，Rambus 占比则相对较小。上述相关的公司基本情况如下：

.....

(2) Rambus (RMBS.O)

Rambus 成立于 1990 年，总部位于美国，是一家技术解决方案研发公司，并同时提供 IP 授权、安全研发、面向服务器的内存接口芯片组、高级 LED 照明设备和显示器以及拟真移动媒体领域的产品于服务。Rambus 从创立之初便致力于高端存储产品的研究与开发，目前产品应用于高性能个人电脑、图形工作站、服务器和其他对带宽和时间延迟有一定要求的设备。根据 Rambus 2018 年年报披露，其 2018 年营业收入 23,120.10 万美元，净利润-15,795.70 万美元，其中内存接口芯片领域收入为 3,640.00 万美元，约占总收入比例为 15%。

2、市场地位、技术实力、业务数据及指标情况

澜起科技成立于 2004 年，是全球内存接口芯片的主要供应商之一，凭借领先的技术水平，在 DDR4 阶段逐步确立了行业领先优势，公司 2018 年营业收入 175,766.46 万元，净利润 73,687.84 万元。澜起科技发明了 DDR4 全缓冲“1+9”架构，最终被 JEDEC 国际标准采纳。公司凭借具有自主知识产权的高速、低功耗技术，为新一代服务器平台提供完全符合 JEDEC 标准的高性能内存接口解决方案，同时正积极参与 DDR5 JEDEC 标准的制定，是全球可提供从 DDR2 到 DDR4 内存全缓冲/半缓冲完整解决方案的主要供应商之一，在该领域拥有重要话语权。目前，公司根据内存模组制造商的研发进度，积极布局研发 DDR5 内存接口芯片，新一代产品能够有效支持 DDR5 的高速、低功耗等要求。公司将全力确保领先的研发进度，保证公司能够在现有的市场份额基础上实现持续稳定增长。报告期内澜起科技内存接口芯片业务收入迅速攀升，已成为该市场的领先企业。

问题二十一

2017年，澜起有限将消费电子芯片业务资产按评估值整体出售给成都澜至、澜至半导体及Montage Group，以2017年5月31日作为评估基准日，境内资产交易价格为17,145.06万元，境外资产交易价格1,130.99万美元。

请发行人披露：（1）消费电子芯片业务2017年终止经营前已实现净利润3,010.29万元，发行人将该项业务剥离的原因，该等业务是否存在违法违规或重大瑕疵等情形；（2）转让资产是否经审计；相关资产的评估值以及评估值与账面值的差异情况、评估基准日至交割日的调整情况及依据；（3）消费电子芯片业务整体转让采用资产基础法进行评估的合理性，评估作价约2.5亿元远低于2014年境外私有化的价格，结合消费电子芯片业务在发行人业务中的占比情况，分析转让价格的公允性，是否与业务占比相匹配，是否存在利益输送，是否损害发行人的利益，是否存在纳税调整的风险；（4）上述交易是否履行了必要的决策程序，消费电子芯片业务相关的资产、债权、债务的处置情况，是否存在纠纷或潜在纠纷，是否需要取得相关债权人的书面同意；（5）消费电子芯片业务相关人员的划转以及新劳动合同的签订情况，转移人员的结构、转让方与受让方的对应关系，是否存在关联方为发行人代垫人力成本的情况；（6）主要未履行完毕的合同的承接方式、补充协议的签订及后期回款情况；（7）2018年末成都澜至仍有尚未支付的相关资产转让余款4,218.84万元，相关款项长期未支付的原因，结合转让合同的付款条款说明是否违反合同约定，是否构成对发行人的资金占用，截至目前的资金回收情况，是否存在较大的信用风险；（8）报告期内公司其他应付款中代付员工股权激励款的产生原因，款项来源及支付对象，报告期内持续存在且波动较大的原因；（9）2017年8月后发行人不再开展消费电子芯片业务，请在“主营业务、主要产品或服务、主要经营模式的演变情况”部分如实披露相关业务、产品的变化情况。

请发行人提供成都澜至、澜至半导体及Montage Group近3年的主要财务数据以及购买消费电子芯片业务后的经营情况说明。

请保荐机构、发行人律师及申报会计师对上述事项进行核查并发表明确意见。

回复：

21.1 发行人说明

一、消费电子芯片业务2017年终止经营前已实现净利润3,010.29万元，发行人将该项业务剥离的原因，该等业务是否存在违法违规或重大瑕疵等情形；

1、公司将该项业务资产转让的原因

自公司原境外母公司 Montage Group 成立以来，一直保持了持续的运营及研发，发展出内存接口芯片及消费电子芯片两条产品线，消费电子芯片应用于家庭和移动终端，而内存接口芯片应用于云端数据中心。两者在应用领域、产品形态、技术基础、销售渠道、客户构成、业务发展方向等均存在显著差异，且在运营上均有独立的销售、市场以及研发人员支持，业务相对独立。由于原消费电子芯片业务分散在 Montage Group 各个子公司内，2017 年管理层及股东为优化资源配置、提升运营效率、提高团队自主性及积极性，决定澜起有限聚焦于服务器芯片领域，成都澜至聚焦于消费电子芯片领域，让不同业务在不同的主体内独立发展，因此决定进行资产重组，将公司体系内的消费电子芯片业务相关资产转让给成都澜至及其关联方。

2、该等业务是否存在违法违规或重大瑕疵等情形

报告期内公司未受到任何处罚。公司董监高已取得无犯罪记录证明，公司及其境内子公司已取得市场监督管理局等相关主管部门的合规证明，公司境外子公司已取得境外律师出具的法律意见书等。所以，报告期内该等业务在公司体系内不存在重大违法违规或重大瑕疵等情形。

二、转让资产是否经审计；相关资产的评估值以及评估值与账面值的差异情况、评估基准日至交割日的调整情况及依据

（一）转让资产是否经审计

因转让资产只涉及消费电子芯片业务相关的资产，且相关资产的数量明确、权属关系清晰，因此转让资产未经审计。

（二）相关资产的评估值以及评估值与账面值的差异情况

公司转让资产的评估基准日是 2017 年 5 月 31 日，转让资产的评估值及账面

值差异具体情况如下表：

单位：万元

项目	评估值	账面值	差异	增值率
存货	15,971.70	15,373.39	598.31	3.89%
固定资产	1,087.31	615.77	471.53	76.58%
无形资产	8,162.03	3,181.51	4,980.53	156.55%
其他资产	23.71	23.29	0.42	1.81%
合计	25,244.75	19,193.96	6,050.79	31.52%

相关资产的评估值与账面值主要差异集中在无形资产，主要是因为根据公司会计政策将研发支出全部费用化，账面值均为外购无形资产形成，而转让资产中相关技术类无形资产采用收益法进行评估导致评估增值所致。

（三）评估基准日与交割日的调整情况和依据

评估基准日 2017 年 5 月 31 日与交割日 2017 年 7 月 31 日资产价值调整情况及依据如下：

1、存货：因评估基准日与交割日时间间隔较短，消费电子芯片价格保持总体稳定，公司按照评估的单价乘以 2017 年 7 月 31 日消费电子芯片的结存数量得出交割日的资产价值。

2、固定资产：公司以评估基准日转让资产的评估值按照评估预测的未来使用年限计提 2 个月折旧后作为交割日的资产价值。

3、无形资产：对专利及技术类无形资产，按照收益法确认其评估值，因评估基准日与交割日相近，且市场环境等评估假设未发生变化，因此公司采用评估基准日的评估值作为交割日的资产价值。

4、其他资产：其他资产主要涉及办公室装修费，公司以评估基准日的转让资产的评估值按照评估预测的未来使用年限计提 2 个月摊销后作为交割日的资产价值。

三、消费电子芯片业务转让采用资产基础法进行评估的合理性，评估作价约 2.5 亿元远低于 2014 年境外私有化的价格，结合消费电子芯片业务在发行人业务中的占比情况，分析转让价格的公允性，是否与业务占比相匹配，是否

存在利益输送，是否损害发行人的利益，是否存在纳税调整的风险

（一）消费电子芯片业务资产转让所用评估方法的合理性

自公司原境外母公司 **Montage Group** 成立以来，一直保持了持续的运营及研发，发展出内存接口芯片及消费电子芯片两条产品线，消费电子芯片应用于家庭和移动终端，而内存接口芯片应用于云端数据中心，原消费电子芯片业务资产分散在 **Montage Group** 下属包括公司在内的各子公司内。2017 年管理层及股东为优化资源配置、提升运营效率、提高团队自主性及积极性，决定澜起有限聚焦于服务器芯片领域，成都澜至聚焦于消费电子芯片领域，让不同业务在不同的主体内独立发展，因此决定进行资产重组，将公司体系内的消费电子芯片业务相关资产转让给成都澜至及其关联方。对于 **Montage Group** 而言，该资产重组属于同一控制下的业务和资产整合；对于公司而言，该资产重组属于资产转让。

资产基础法是指通过估算被评估资产的市场公允价值，从而确定被评估资产价值的方法。该类评估方法一般适用于资产转让的资产价值评估，符合消费电子芯片业务除无形资产外其他资产的特性。

收益法是指通过估算被评估资产的未来预期收益并折算成现值，从而确定被评估资产价值的方法。消费电子芯片业务中的无形资产采用了收益法进行估值，收益法通过预测未来无形资产的收益额并将其折现来确定其价值，经评估机构分析，无形资产未来年度的收益额及所承担的风险均可通过适当的方法合理估测，因此无形资产采用收益法评估具有合理性。

综上，消费电子芯片业务转让的评估方法具有合理性。

（二）转让价格的公允性

2014 年 3 月 10 日，**Montage Group** 宣布其董事会接到上海浦东科技投资有限公司初步的非约束性私有化要约。根据该要约，浦东科投将以每股 21.5 美元的现金收购 **Montage Group** 全部股份。参考 2014 年 3 月 7 日 **Montage Group** 收盘价每股普通股 17.16 美元，其首次要约报价相比发布前一天市场公开价格溢价 25.29%，之后根据多次谈判，2014 年 6 月 11 日，**Montage Group** 发布公告，**Montage Group** 同上海浦东科技投资有限公司签署合并计划与协议，该协议已经公司董事

会通过，协议约定私有化交易价格为每股普通股 22.60 美元，相比公告前一天市场公开价格溢价 31.70%。由此可见，公司原境外母公司 Montage Group 私有化定价主要是投资人参考二级市场价格加上一定溢价得出，是基于 Montage Group 当时股东的全部权益价值，且当时私有化买方主要看中内存接口芯片业务，即估值的主要部分是针对内存接口芯片业务。

报告期内公司消费电子芯片业务的收入及占比呈下滑趋势，其占当期总收入的比例从 2016 年的 33.78% 下降到 2017 年 1-7 月的 19.39%。2017 年 1-7 月公司消费电子芯片业务贡献的毛利 3,311.24 万元，占当期公司总毛利的 9.02%，占比较小。（注：2017 年 1-7 月公司的消费电子芯片收入、毛利和当期收入总额均剔除 2017 年 7 月 31 日转让消费电子芯片业务相关资产的影响）。

综上，消费电子芯片业务在公司的收入占比不断下降，毛利占比影响较小。结合前述公司原境外母公司 Montage Group 私有化定价依据，该私有化价格与公司本次消费电子芯片业务相关资产转让价格不具有可比性。

2017 年消费电子芯片业务资产是参考评估机构出具的专项评估报告确定，且较账面价值有一定增值，因此消费电子芯片业务相关资产转让价格具有公允性，与业务占比相匹配；该次转让不存在利益输送、损害公司的利益以及纳税调整的风险。

四、上述交易是否履行了必要的决策程序，消费电子芯片业务相关的资产、债权、债务的处置情况，是否存在纠纷或潜在纠纷，是否需要取得相关债权人的书面同意

（一）消费电子芯片业务资产处置的决策程序

2017 年 7 月 31 日，Montage Holdings 董事会通过书面决议，同意澜起有限及其子公司出售其消费电子芯片业务相关资产给成都澜至、澜至半导体及 Montage Group。交易价格以 2017 年 5 月 31 日的评估价值为基础，同时结合交割日的实际情况确定，其中境内资产交易价格为 17,145.06 万元，境外资产交易价格 1,130.99 万美元。

综上，转让消费电子芯片业务相关资产履行了必要的决策流程。

（二）消费电子芯片业务相关的资产、债权和债务的处置情况

2017年7月31日，公司及其子公司将其持有的消费电子芯片业务相关资产转让给成都澜至、澜至半导体及 Montage Group，2017年7月31日前已经产生的消费电子业务相关的债权和债务，由公司承担，债权由公司收回，债务由公司支付。

对于未执行完毕的订单，公司与受让方与合同相关的债权人协商，取得客户和供应商的同意，将未执行完毕的订单通过替换、重新下单等形式由受让人承接，不存在纠纷或者潜在纠纷。

五、消费电子芯片业务相关人员的划转以及新劳动合同的签订情况，转移人员的结构、转让方与受让方的对应关系，是否存在关联方为发行人代垫人力成本的情况

原服务于消费电子芯片业务的澜起有限员工于2017年7月31日与澜起有限终止劳动关系，并于2017年8月1日正式与澜至半导体签订劳动合同。

转移人员的结构、转让方与受让方的对应关系如下：

人员类别	人数	转让方	受让方
销售人员	31	澜起有限	澜至半导体
管理人员	9	澜起有限	澜至半导体
研发人员	88	澜起有限	澜至半导体
合计	128		

综上，公司原消费电子芯片相关人员自2017年8月1日起均转移至澜至半导体，并与澜至半导体签订了新的劳动合同，相关转移人员后续的所有薪资及福利待遇均由澜至半导体承担，相关人员转移后不再为公司提供服务，不存在关联方为公司代垫人力成本的情况。

六、主要未履行完毕的合同的承接方式、补充协议的签订及后期回款情况

主要未履行完毕的合同由消费电子芯片业务资产的受让方承接。未履行完毕的销售订单，与客户沟通协商后，由客户重新下订单给由受让方，并取消与公司未履行完毕的销售订单。未完成的采购订单，经与供应商协商后，由受让方重新

下采购订单给供应商，并取消与公司未履行完毕的采购订单。受让人在销售和采购订单完成后负责回收和支付相应的款项。

七、2018 年末成都澜至仍有尚未支付的相关资产转让余款 4,218.84 万元，相关款项长期未支付的原因，结合转让合同的付款条款说明是否违反合同约定，是否构成对发行人的资金占用，截至目前的资金回收情况，是否存在较大的信用风险

按照成都澜至与公司签订的资产转让协议及其补充协议规定，资产交割日后三个月内支付 50%的款项，剩余款项需在 2019 年 6 月 30 日前全部支付完毕，且对于 2018 年末尚未支付的相关资产转让余款按照年利率 4.35% 计息。

2019 年 4 月 4 日，成都澜至支付公司资产转让的全部余款 4,218.84 万元及其利息，至此公司对成都澜至的应收账款已全部收回。

相关款项支付安排系根据双方合同约定，并不存在违反相关合同约定的情况。截至本问询函回复出具日，相关资产转让款已全部收回，不构成对公司资金占用，也不存在信用风险。

八、报告期内公司其他应付款中代付员工股权激励款的产生原因，款项来源及支付对象，报告期内持续存在且波动较大的原因

(一) 其他应付款中代付员工期权激励款产生的原因

公司原境外母公司 Montage Group 境外上市期间曾实施股权激励方案，向员工发行限制性股票和期权。在私有化方案中，Montage Holding 收购 Montage Group 100% 股权，包括发放的员工期权和限制性股票。因此，Montage Holding 已于私有化时将员工股权激励价款支付给了 Montage Group，国内员工的限制性股票和期权的价款由 Montage Group 支付给公司，再由公司支付给国内员工。Montage Group 经与员工协商，相关股权激励款采用了分期支付的方式。Montage Group 做出支付安排后，公司在履行完代扣代缴个人所得税义务后支付给相关国内员工。

综上，报告期内各期末，公司将已收到该笔款项而暂未支付给国内员工的余额，在“其他应付款中代付员工股权激励款”归集核算。

（二）款项来源、支付对象及波动较大的原因

该笔款项的来源为 Montage Holding 对 Montage Group 进行私有化的收购款，支付对象是私有化前 Montage Group 授予限制性股票和股票期权的国内员工。

代付员工期权激励款波动的原因系该笔款项是在 Montage Group 做出支付安排后，公司在履行完代扣代缴个人所得税义务后才支付给私有化前授予限制性股票和股票期权的国内员工，公司无法控制该款项的支付进度，因此容易产生波动。

截至本问询函回复出具日，该款项已全部支付给私有化前被授予限制性股票和股票期权的国内员工。

九、2017 年 8 月后发行人不再开展消费电子芯片业务，请在“主营业务、主要产品或服务、主要经营模式的演变情况”部分如实披露相关业务、产品的变化情况

公司已在招股说明书“第六节 业务与技术”之“一、公司的主营业务、主要产品及服务（三）主营业务、主要产品或服务、主要经营模式的演变情况”中补充披露。

21.2 保荐机构、发行人律师及申报会计师的核查过程和核查意见

核查过程：

1、通过访谈发行人管理层和成都澜至管理层，查阅成都澜至官方网站产品信息、客户清单等材料，取得了发行人对消费电子芯片业务转让的说明性文件、发行人董监高无犯罪记录证明、发行人及其境内子公司的合规证明、发行人境外子公司的法律意见书。

2、检查发行人消费电子芯片业务资产转让相关的评估报告、会计记录和发行人原境外母公司 Montage Group 董事会决议文件，检查评估基准日与转让资产交割日评估值的调整情况及依据，评价资产评估报告所采用的评估方法的恰当性、折现率等主要参数的合理性，从而判断资产处置定价的公允性；

3、取得了消费电子芯片业务相关人员划转时的名单及劳动合同范本、取得并查阅资产受让方的财务报表；

4、访谈受让方运营人员，了解关于未完成订单及相关债权债务的承接情况，取得并检查了部分未履行完毕订单的承接相关文件；

5、查阅了公司与成都澜至签订的资产转让协议和补充协议，检查成都澜至应收账款的回款情况及期后收款记录情况；

6、检查在私有化中 Montage Holding 收购 Montage Group 100% 股权的相关文件及收购款的支付情况。检查私有化实施主体支付给该次员工股权激励所涉及员工清单及金额，抽查了发行人代付给员工的支付记录。

核查结论：

经核查，保荐机构、发行人律师及申报会计师认为：

1、发行人消费电子芯片业务资产转让具备合理的商业理由，该业务不存在违法违规或重大瑕疵；

2、消费电子芯片业务转让采用资产基础法进行评估具有合理性，转让价格公允，与业务占比相匹配，不存在利益输送、损害发行人利益及纳税调整的风险；

3、消费电子芯片业务相关的交易已履行相关的决策程序，不存在纠纷或潜在纠纷，不需要取得相关债权人的书面同意；

4、消费电子芯片业务相关人员划转后签订新劳务合同，不存在关联方为发行人代垫人力成本的情况；主要未履行完毕的合同已由受让方承接，由受让方后期收款或支付；

5、2018 年末成都澜至资产转让余额未支付未违反合同约定，不构成对发行人资金占用，截止目前已全部收回，不存在信用风险；

6、报告期内其他应付款中代付员工股权激励款产生于私有化时私有化实施主体 100% 收购全部境外上市股权，包括境外发放的员工期权，Montage Group 需向授予限制性股票和股票期权的国内员工支付该部分款项，发行人该代付员工股权激励款持续存在且波动较大具有合理性。

21.3 补充披露情况

发行人已在招股说明书“第五节 发行人基本情况”之“五、发行人重大资

产重组情况（二）其他对公司有一定影响的资产重组情况”中披露如下：

（1）转让的主要原因

自发行人原境外母公司 Montage Group 成立以来，一直保持了持续的运营及研发，发展出内存接口芯片及消费电子芯片两条产品线，消费电子芯片应用于家庭和移动终端，而内存接口芯片应用于云端数据中心。两者在应用领域、产品形态、技术基础、销售渠道、客户构成、业务发展方向等均存在显著差异，且在运营上均有独立的销售、市场以及研发人员支持，业务相对独立。由于原消费电子芯片业务分散在 Montage Group 各个子公司内，2017 年管理层及股东为优化资源配置、提升运营效率、提高团队自主性及积极性，决定澜起有限聚焦于服务器芯片领域，成都澜至聚焦于消费电子芯片领域，让不同业务在不同的主体内独立发展，因此决定进行资产重组，将发行人体系内的消费电子芯片业务相关资产转让给成都澜至及其关联方。

.....

（3）转让的具体情况

1) 消费电子芯片业务资产处置的相关程序

2017 年 7 月 31 日，Montage Holdings 董事会通过书面决议，同意澜起有限及其子公司出售其消费电子芯片业务相关资产给成都澜至、澜至半导体及 Montage Group。交易价格以 2017 年 5 月 31 日的评估价值为基础，同时结合交割日的实际情况确定，其中境内资产交易价格为 17,145.06 万元，境外资产交易价格 1,130.99 万美元。

2017 年 7 月 31 日，发行人及其子公司已将其持有的消费电子芯片业务相关资产转让给成都澜至、澜至半导体及 Montage Group，2017 年 7 月 31 日前已经产生的消费电子业务相关的债权和债务，由发行人承担，债权由发行人收回，债务由发行人支付。

2017 年 7 月 31 日，主要未履行完毕的合同由消费电子芯片业务资产的受让方承接。未履行完毕的销售订单，与客户沟通协商后，由客户重新下订单给由受让方。未完成的采购订单，与供应商协商，晶圆采购订单由受让人重新下单置换发行人原订单，封装测试由发行人关闭工单后，由受让人重新下新的工单

的形式承接。受让人在销售和采购订单完成后负责回收和支付相应的款项。

.....

转移人员的结构、转让方与受让方的对应关系如下：

人员类别	人数	转让方	受让方
销售人员	31	澜起有限	澜至半导体
管理人员	9	澜起有限	澜至半导体
研发人员	88	澜起有限	澜至半导体
合计	128		

(4) 转让相关资产的评估值以及评估值与账面值的差异情况、评估基准日至交割日的调整情况

1) 资产评估方式

资产基础法是指通过估算被评估资产的市场公允价值，从而确定被评估资产价值的方法。该类评估方法一般适用于资产转让的资产价值评估，符合消费电子芯片业务除无形资产外其他资产的特性。

收益法是指通过估算被评估资产的未来预期收益并折算成现值，从而确定被评估资产价值的方法。消费电子芯片业务中的无形资产采用了收益法进行估值，收益法通过预测未来无形资产的收益额并将其折现来确定其价值，经评估机构分析，无形资产未来年度的收益额及所承担的风险均可通过适当的方法合理估测。

2) 相关资产的评估值以及评估值与账面值的差异情况

发行人转让资产的评估基准日是 2017 年 5 月 31 日，转让资产的评估值及账面值差异具体情况如下表：

单位：万元

项目	评估值	账面值	差异	增值率
存货	15,971.70	15,373.39	598.31	3.89%
固定资产	1,087.31	615.77	471.53	76.58%
无形资产	8,162.03	3,181.51	4,980.53	156.55%
其他资产	23.71	23.29	0.42	1.81%

合计	25,244.75	19,193.96	6,050.79	31.52%
----	-----------	-----------	----------	--------

相关资产的评估值与账面值主要差异集中在无形资产，主要是因为根据公司会计政策将研发支出全部费用化，账面值均为外购无形资产形成，而转让资产中相关技术类无形资产采用收益法进行评估导致评估增值所致。

3) 评估基准日与交割日的调整情况和依据

评估基准日 2017 年 5 月 31 日与交割日 2017 年 7 月 31 日资产价值调整情况及依据如下：

①存货：因评估基准日与交割日时间间隔较短，消费电子芯片价格保持总体稳定，发行人按照评估的单价乘以 2017 年 7 月 31 日消费电子芯片的结存数量得出交割日的资产价值。

②固定资产：发行人以评估基准日转让资产的评估值按照评估预测的未来使用年限计提 2 个月折旧后作为交割日的资产价值。

③无形资产：对专利及技术类无形资产，按照收益法确认其评估值，因评估基准日与交割日相近，且市场环境等评估假设未发生变化，因此发行人采用评估基准日的评估值作为交割日的资产价值。

④其他资产：其他资产主要涉及办公室装修费，发行人以评估基准日的转让资产的评估值按照评估预测的未来使用年限计提 2 个月摊销后作为交割日的资产价值。

发行人已在招股说明书“第六节 业务与技术”之“一、公司的主营业务、主要产品及服务（三）主营业务、主要产品或服务、主要经营模式的演变情况”中补充披露如下：

2017 年管理层及股东出于优化资源配置、提升运营效率、提高团队自主性及积极性的考虑，公司转让消费电子芯片业务相关资产给成都澜至及其关联方，由其独立运营消费电子芯片业务，自 2017 年 8 月以后公司不再销售及研发消费电子芯片。

在报告期内，除上述产品变化以外，公司主营业务、主要产品和主要经营模式未发生重大变化。

问题二十二

公司拥有3家境内全资子公司以及5家境外全资子公司，境外的采购及销售主要通过澜起澳门开展，根据澳门特别行政区法律制度，该子公司豁免企业所得税，该等优惠自2021年1月1日起失效。

请发行人披露：（1）各子公司所从事的主要业务活动，母公司与子公司的业务分工安排以及做出该安排的主要考虑；（2）母子公司之间的内部交易方式、定价机制、资金流转情况，是否利用内部转移定价进行税务筹划，相关交易安排是否具有商业合理性，2018年母公司营业成本为0的原因；（3）通过澜起澳门进行境外采购及销售的原因，母公司与澜起澳门的业务合作模式、定价原则及价格的公允性；（4）根据当地税法的要求，结合澜起澳门的业务实质，分析澜起澳门是否符合“离岸业务”的要求，贸易环节未缴纳所得税是否存在被澳门主管税务部门处罚的风险，量化分析税收优惠取消后对发行人经营业绩的影响，并在“风险因素”部分进行补充披露；（5）截至2018年12月31日，澜起澳门经审计的总资产为26,459.36万美元、净资产为8,900.06万美元，2018年度净利润8,357.88万美元，请发行人按照《准则》第十三条的要求，参照准则的规定披露澜起澳门的相关信息，并提供其单独的审计报告。

请保荐机构及申报会计师对上述事项进行核查并发表明确意见。

回复：

22.1 发行人说明

一、各子公司所从事的主要业务活动，母公司与子公司的业务分工安排以及做出该安排的主要考虑

1、子公司的主要业务活动

子公司	主要业务活动
澜起电子昆山	从事研发活动
澜起半导体	从事产品销售
澜起电子上海	报告期末开展经营活动
澜起开曼	境外公司的控股平台
澜起澳门	承担境外采购、产品的销售

澜起美国	提供销售支持服务
澜起宝石	报告期末开展经营活动
澜起香港	报告期末开展经营活动

2、母公司与子公司业务分工安排及主要考虑

主体	业务分工	主要考虑
母公司	决策主体及研发、运营职能	母公司作为集团业务的决策主体，承担部分研发及运营职能
澜起电子昆山	研发职能	业务的区域布局和研发能力的分工与扩展
澜起半导体	从事产品销售	负责部分产品销售
澜起电子上海	从事研发及销售	业务的区域布局和研发能力的分工与扩展
澜起开曼	投资控股	控股境外公司
澜起澳门	境外采购及产品销售	由于公司的客户和供应商大部分位于境外或者使用境外主体与公司进行交易，因此为了简化交易，公司通过澜起澳门进行境外采购及销售。
澜起美国	销售支持服务	为美国等境外客户提供支持
澜起宝石	投资控股	拟用于境外投资、收购
澜起香港	投资控股	拟用于境外投资、收购

二、母子公司之间的内部交易方式、定价机制、资金流转情况，是否利用内部转移定价进行税务筹划，相关交易安排是否具有商业合理性，2018 年母公司营业成本为零的原因

1、母子公司之间的内部交易方式、定价机制、资金流转情况

母子公司之间的内部交易方式、定价机制、资金流转情况如下：

内部交易方式	定价机制	资金流转情况
销售商品	市场价格	消费电子芯片产品在国内生产后，母公司销售产品给澜起澳门，澜起澳门向母公司支付货款
提供技术开发服务	市场价格	澜起澳门委托母公司对新产品进行研发，并支付给母公司技术开发费用
收取特许权费用	市场价格	对于母公司提供技术的产品，母公司根据销售额向澜起澳门收取产品的特许权费用

2、是否利用内部转移定价进行税务筹划，相关交易安排是否具有商业合理性

2016年至2017年转让消费电子芯片业务相关资产之前，母公司负责芯片产品开发及测试的职能，是公司重要的研发中心，为公司新产品研发及试产提供重要保障，母子公司之间的内部交易方式采用澜起澳门委托母公司提供技术开发服务，并向母公司支付技术开发费用。

2017年转让消费电子芯片业务相关资产之后，母公司定位于主要承担战略决策、研发和运营的职能，母公司根据自身价值贡献情况向使用母公司技术的销售子公司收取特许权使用费，具有合理的商业理由。其次，公司综合考虑各母子公司研发价值、运营价值、销售水平等因素进行内部转移定价，该定价机制合理，不存在利用内部转移定价进行税务筹划的情况。

3、2018年母公司营业成本为零的原因

2018年母公司的收入是向澜起澳门收取特许权费用产生的，根据公司会计政策母公司将研发费用全部费用化，从而导致该部分特许权收入无对应的成本，2018年母公司营业成本为0。

三、通过澜起澳门进行境外采购及销售的原因，母公司与澜起澳门的业务合作模式、定价原则及价格的公允性

（一）通过澜起澳门进行境外采购及销售的原因

公司采取 Fabless 的生产模式，将晶圆制造、封装和测试均交由外协厂商负责。由于公司的晶圆制造、封装和测试的供应商及公司客户大部分位于境外或者使用境外主体与公司进行交易，因此为了简化交易，公司通过澜起澳门进行境外采购及销售。

（二）母公司与澜起澳门的业务合作模式、定价原则及价格的公允性

母公司及澜起澳门业务合作模式为：母公司主要承担战略决策、研发和运营的职能，向澜起澳门提供技术授权并收取特许权使用费；澜起澳门依托于母公司的芯片设计成果将产品的生产和封装测试外包至境外第三方工厂，之后将产成品芯片直接销售至第三方客户。

鉴于母公司及澜起澳门均承担了各自的职能，对最终产品销售作出了各自的经济贡献，因此双方参考市场价格，并根据双方对于价值创造的贡献程度进行利

润分配。母公司与澜起澳门之间内部交易的定价原则及价格具有公允性。

四、根据当地税法的要求，结合澜起澳门的业务实质，分析澜起澳门是否符合“离岸业务”的要求，贸易环节未缴纳所得税是否存在被澳门主管税务部门处罚的风险，量化分析税收优惠取消后对发行人经营业绩的影响，并在“风险因素”部分进行补充披露

(一) 澜起澳门是否符合当地税法对“离岸业务”的要求

根据澳门特别行政区颁布的第 58/99/M 号离岸业务法律制度“第十二条一、获许可在澳门地区营运之离岸机构享有下列优惠：a) 豁免从事离岸业务获得之收益之所得补充税”，以及澳门贸易投资促进局《澳门离岸机构运作参考指引》规定：“投资者在取得准照在澳门从事（非金融）离岸服务业时，必须遵守以下之基本条件，包括：（一）不可采用澳门币作为交易及结算之货币；（二）销售对象为非澳门特区居民（个人及公司）；（三）澳门特区以外的市场。”

1、根据《离岸法令》第 62 条，非金融类别的离岸服务准照由澳门贸易投资促进区发出，澜起澳门取得澳门投资促进局颁发的编号 DSO/092/2002 的离岸服务许可证。

2、澜起澳门以美元作为交易及计算货币，销售对象均是非澳门地区居民，且均是澳门特区以外的市场，符合澳门贸易投资促进局《澳门离岸机构运作参考指引》中关于从事“离岸业务”的基本条件的规定。

基于以上几点，澜起澳门符合澳门特别行政区对“离岸业务”的要求，贸易环节未缴纳所得税不存在被澳门主管税务部门处罚的风险。

(二) 量化分析税收优惠取消后对公司经营业绩的影响

该税收优惠取消后对澜起澳门以前年度的经营业绩不产生任何影响，不会产生纳税调整。但为了量化分析，假设税收优惠取消发生在报告期初，则对报告期内经营业绩的影响如下：

单位：万元

项目	2018 年度	2017 年度	2016 年度
澜起澳门利润总额	55,203.13	19,929.40	4,025.96

项目	2018 年度	2017 年度	2016 年度
适用税率	12.00%	12.00%	12.00%
所得税费用	6,624.38	2,391.53	483.12
当期净利润	73,687.84	34,691.60	9,280.43
占当期净利润的比例	8.99%	6.89%	5.21%

如上表所示，若澜起澳门无税收优惠，报告期内公司净利润将相应减少 483.12 万元、2,391.53 万元及 6,624.38 万元。

五、截至 2018 年 12 月 31 日，澜起澳门经审计的总资产为 26,459.36 万美元、净资产为 8,900.06 万美元，2018 年度净利润 8,357.88 万美元，请发行人按照《准则》第十三条的要求，参照准则的规定披露澜起澳门的相关信息，并提供其单独的审计报告。

公司于招股说明书“第五节 发行人基本情况”之“八、发行人控股、参股子公司及分公司情况简介”之“(二) 发行人的境外全资子公司情况”进行了补充披露：

“

澜起澳门原名为“Triple Win Macao Commercial Offshore Limited”（以下简称“Triple 澳门”）于 2003 年 5 月 12 日由 Triple Win Holdings Inc.完成商业登记注册，股本数为 50 万澳门元，注册地为澳门，2007 年 1 月 17 日，Triple 澳门更名为“Sonoma Macao Commercial Offshore Limited”（以下简称“Sonoma 澳门”）。2013 年 4 月 18 日 Triple Win Holdings Inc.将其所持有的 Sonoma 澳门出资额转让给了 Montage Group，同时 Sonoma 澳门公司名称变更为 Montage Technology Macao Commercial Offshore Limited(澜起澳门)。2016 年 2 月 5 日，Montage Group 将其持有的澜起澳门出资额转让给了澜起开曼。2018 年 6 月 5 日，澜起澳门在韩国设立外国公司分支机构，住址为京畿道城南市盆唐区 Banga-ro21，2 楼。

截至本回复签署日，公司通过全资子公司澜起开曼间接持有澜起澳门的 100% 股权，澜起澳门的董事为杨崇和及 Stephen Kuong-Io Tai，主要负责境外采购和产品销售。

截至 2018 年 12 月 31 日，澜起澳门经京澳会计师事务所审计的总资产为

26,459.36 万美元、净资产为 8,900.06 万美元, 2018 年度净利润 8,357.88 万美元。

”

22.2 保荐机构和申报会计师的核查过程和核查意见

核查过程:

1、查阅发行人及其子公司的工商档案和会计记录, 确认发行人及其子公司的业务活动, 询问发行人管理层设立各子公司主体的主要考虑;

2、检查发行人及子公司之间交易的具体情形、转移定价的相关文件及内部转移定价的原则、依据;

3、检查澜起澳门的客户与供应商情况, 通过公开信息查询确认澳门离岸业务是否符合澳门税务部门的规定。取得澜起澳门税收优惠取消的规定, 测算其对报告期经营的影响;

4、取得澜起澳门的境外法律意见书, 确认其是否被澳门主管税务部门处罚;

5、取得并检查澜起澳门税收优惠取消的规定, 根据澜起澳门的财务数据, 检查税收优惠取消后发行人测算的对报告期经营的影响金额的正确性。

核查结论:

经核查, 保荐机构及申报会计师认为:

1、发行人母公司与子公司的业务分工安排具有合理的商业理由;

2、母子公司之间的内部交易不存在利用内部转移定价进行税务筹划的情况, 相关交易安排具有商业合理性, 发行人母公司将研发费用全部费用化, 从而导致该部分特许权收入无对应的成本, 2018 年母公司营业成本为 0 符合企业会计准则的规定;

3、发行人通过澜起澳门进行境外采购及销售具有合理的商业理由, 定价原则合理, 价格公允;

4、澜起澳门符合澳门当地税务机关关于“离岸业务”的要求, 贸易环节未缴纳所得税不存在被澳门主管税务部门处罚的风险。

22.3 补充披露情况

发行人已在招股说明书“第五节 发行人基本情况”之“八、发行人控股、参股子公司及分公司情况简介（四）发行人各子公司业务情况”中进行了补充披露：

1、子公司的主要业务活动

子公司	主要业务活动
澜起电子昆山	从事研发活动
澜起半导体	从事产品销售
澜起电子上海	报告期未开展经营活动
澜起开曼	境外公司的控股平台
澜起澳门	承担境外采购、产品的销售
澜起美国	提供销售支持服务
澜起宝石	报告期未开展经营活动
澜起香港	报告期未开展经营活动

2、母公司与子公司业务分工安排及主要考虑

主体	业务分工	主要考虑
母公司	决策主体及研发、运营职能	母公司作为集团业务的决策主体，承担部分研发及运营职能
澜起电子昆山	研发职能	业务的区域布局和研发能力的分工与扩展
澜起半导体	从事产品销售	负责部分产品销售
澜起电子上海	从事研发及销售	业务的区域布局和研发能力的分工与扩展
澜起开曼	投资控股	控股境外公司
澜起澳门	境外采购及产品销售	由于发行人的客户和供应商大部分位于境外或者使用境外主体与发行人进行交易，因此为了简化交易，发行人通过澜起澳门进行境外采购及销售。
澜起美国	销售支持服务	为美国等境外客户提供支持
澜起宝石	投资控股	拟用于境外投资、收购
澜起香港	投资控股	拟用于境外投资、收购

发行人已在招股说明书“第五节 发行人基本情况”之“八、发行人控股、参股子公司及分公司情况简介（五）母子公司之间的内部交易方式”中进行了补充披露：

1、母子公司之间的内部交易方式、定价机制、资金流转情况

母子公司之间的内部交易方式、定价机制、资金流转情况如下：

内部交易方式	定价机制	资金流转情况
销售商品	市场价格	消费电子芯片产品在国内生产后，母公司销售产品给澜起澳门，澜起澳门向母公司支付货款
提供技术开发服务	市场价格	澜起澳门委托母公司对新产品进行研发，并支付给母公司技术开发费用
收取特许权费用	市场价格	对于母公司提供技术的产品，母公司根据销售额向澜起澳门收取产品的特许权费用

2、内部转移定价安排情况

2016年至2017年转让消费电子芯片业务相关资产之前，澜起澳门主要负责境外采购及销售的职能，而母公司负责芯片产品开发及测试的职能，是公司重要的研发中心，为公司新产品研发及试产提供重要保障，母子公司之间的内部交易方式采用澜起澳门委托母公司提供技术开发服务，并向母公司支付技术开发费用。

2017年转让消费电子芯片业务相关资产之后，母公司定位于主要承担战略决策、研发和运营的职能，母公司根据自身价值贡献情况向使用母公司技术的销售子公司收取特许权使用费。

发行人已在招股说明书“第五节 发行人基本情况”之“八、发行人控股、参股子公司及分公司情况简介（二）发行人的境外全资子公司情况”中进行了补充披露：

发行人采取 Fabless 的生产模式，将晶圆制造、封装和测试均交由外协厂商负责。由于发行人的晶圆制造、封装和测试的供应商及发行人客户大部分位于境外或者使用境外主体与发行人进行交易，因此为了简化交易，发行人通过澜起澳门进行境外采购及销售。

母公司及澜起澳门业务合作模式为：澜起科技主要负责技术开发，并向澜起澳门提供技术授权并收取特许权使用费；澜起澳门依托于母公司的芯片设计成果将产品的生产和封装测试外包至境外第三方工厂，之后将产成品芯片直接

销售至第三方客户。

发行人已在招股说明书“第四节 风险因素”之“四、财务风险（一）税收优惠政策风险”中进行了补充披露：

该税收优惠取消后对澜起澳门以前年度的经营业绩不产生任何影响，不会产生纳税调整。若澜起澳门无税收优惠，报告期内发行人净利润将相应减少**483.12 万元、2,391.53 万元及 6,624.38 万元**。

发行人已在招股说明书“第五节 发行人基本情况”之“八、发行人控股、参股子公司及分公司情况简介（二）发行人的境外全资子公司情况”中进行了补充披露：

澜起澳门原名为“Triple Win Macao Commercial Offshore Limited”（以下简称“Triple 澳门”）于 2003 年 5 月 12 日由 Triple Win Holdings Inc.完成商业登记注册，股本数为 50 万澳门元，注册地为澳门，2007 年 1 月 17 日，Triple 澳门更名为“Sonoma Macao Commercial Offshore Limited”（以下简称“Sonoma 澳门”）。2013 年 4 月 18 日 Triple Win Holdings Inc.将其所持有的 Sonoma 澳门出资额转让给了 Montage Group，同时 Sonoma 澳门公司名称变更为 Montage Technology Macao Commercial Offshore Limited（澜起澳门）。2016 年 2 月 5 日，Montage Group 将其持有的澜起澳门出资额转让给了澜起开曼。2018 年 6 月 5 日，澜起澳门在韩国设立外国公司分支机构，住址为京畿道城南市盆唐区 Banga-ro21，2 楼。

截至本招股书签署日，公司通过全资子公司澜起开曼间接持有澜起澳门的 100% 股权，澜起澳门的董事为杨崇和及 **Stephen Kuong-Io Tai**，主要负责境外采购和产品销售。

截至 2018 年 12 月 31 日，澜起澳门经京澳会计师事务所审计的总资产为 26,459.36 万美元、净资产为 8,900.06 万美元，2018 年度净利润 8,357.88 万美元。

问题二十三

发行人的主营业务是为云计算和人工智能领域提供以芯片为基础的解决方案,目前主要产品包括内存接口芯片、津逮®服务器 CPU 以及混合安全内存模组。

请发行人披露:(1)下游主要客户是否属于云计算和人工智能行业;(2)内存接口芯片在云计算和人工智能领域发挥的具体作用 and 市场份额;(3)按照《准则》第四十九条的要求,清晰、准确、客观地披露主营业务、主要产品或服务的情况;(4)津逮®服务器 CPU 的所有权归属,发行人是否具有主导权,是否存在对 Intel 的重大技术依赖;(5)公司在向客户提供内存接口芯片用于内存模组制造的同时,自身也开发混合安全内存模组 HSDIMM®,该产品的定位、用途、拟实现的商业目的,是否与客户产品形成竞争关系,是否存在向客户采购的情况,具体采购的内容、金额等;(6)津逮®服务器平台的具体架构,服务器平台从设计、采购、生产、销售或提供技术服务的整个流程以及发行人技术的具体体现,向第三方采购具体产品或服务的内容以及在服务器平台中的重要性,该平台实现收入的方式以及相关参与方的利益分享机制;(7)发行人是否具备将内存接口芯片的技术积累拓展至服务器平台的能力;津逮®服务器平台 2017 年、2018 年少量收入的来源;2018 年底研发成功距离预计量产的时间,目前客户开拓情况,是否已有在手订单;请发行人对津逮®服务器平台业务面临的不确定性风险作重大事项提示;(8)津逮®CPU 如何实现“先进的异构计算与互联技术”的融合,除预检测和动态安全监控功能外,津逮®CPU 是否具备其他功能,是否为发行人的技术;(9)2018 年来自 Intel 的研发费用补贴较 2017 年有较大幅度下降的原因。

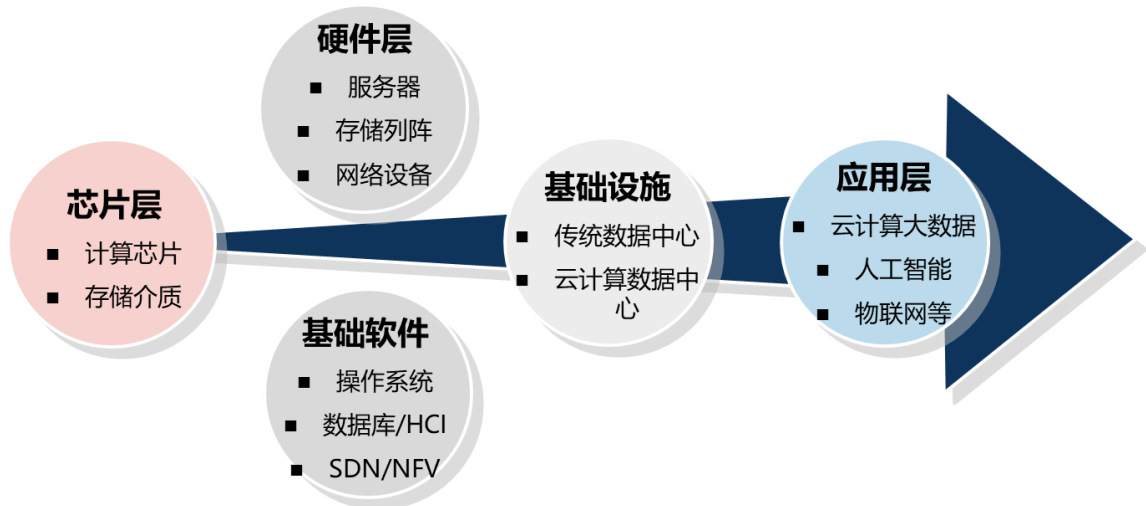
请保荐机构对上述事项进行核查并发表明确意见。

回复:

23.1 发行人说明

一、下游主要客户是否属于云计算和人工智能行业;

公司所处的产业链架构如下图所示:



服务器是云计算和人工智能行业的基础设施，而 CPU 和 DRAM 内存是服务器的两大核心部件。公司目前的主营产品均属于产业链的芯片层环节，其中内存接口芯片直接面向 DRAM 存储器市场，津逮®服务器 CPU 及其平台直接面对服务器市场，而公司的终端客户则覆盖云计算和人工智能行业，因此公司为云计算和人工智能领域提供以芯片为基础的解决方案，下游主要客户也属于云计算和人工智能行业的重要参与者。

二、内存接口芯片在云计算和人工智能领域发挥的具体作用 and 市场份额；

内存接口芯片是服务器内存模组的核心逻辑器件，包含寄存时钟驱动器（RCD）和数据缓冲器（DB），其位于 CPU 到内存模组存储颗粒的命令地址总线通路和数据总线通路上，是内存模组的核心控制芯片。内存接口芯片主要作用是提升内存数据访问的速度及稳定性，满足服务器 CPU 对内存模组日益增长的高性能及大容量需求。

而服务器是支持云计算和人工智能的重要硬件平台，云计算和人工智能服务厂商均需要采购大量服务器，甚至组建专用数据中心。因此公司的主要产品——内存接口芯片作为服务器中的核心芯片之一，是云计算和人工智能领域重要的电子元器件之一。

公司研发的用于云计算和人工智能领域的内存接口芯片具体作用包括：

（1）通过将数据从 CPU 装载到内存模组上来计算，从而实现减轻 CPU 运算负担，同时在内存端将大量原始数据精炼出有效数据供 CPU 处理。

（2）公司产品加入了矢量运算模块来专门支持人工智能应用里的矩阵运算，达到加速人工智能计算的目的。

根据 Gartner 公司公布的 2018 年第四季度以及 2018 年度全球 X86 服务器市场调查报告，2018 年全年全球服务器出货量为 1,290.4 万台，销售额为 705.3 亿美元。根据 IDT 和 Rambus 定期报告公开披露数据和公司相关收入推算，2018 年全球内存接口芯片市场规模约为 5.7 亿美元，占全球服务器市场规模的份额为 0.81%。

三、按照《准则》第四十九条的要求，清晰、准确、客观地披露主营业务、主要产品或服务的情况；

公司将逐条核对《准则》第四十九条的要求，具体补充披露的内容参见本题补充披露部分。

四、津逮®服务器 CPU 的所有权归属，发行人是否具有主导权，是否存在对 Intel 的重大技术依赖；

津逮®服务器 CPU 是公司与清华大学、Intel 联合研发的产品，其所有权及品牌归属为澜起科技。公司已就津逮®服务器 CPU 所涉及的独立研发核心技术申请专利和集成电路布图设计专有权。在本产品上，通用 CPU 内核芯片由 Intel 提供，可重构计算处理器（RCP）的算法由清华大学提供，公司完成整体模块及其他部分芯片设计，并委托第三方进行芯片制造、封装和测试。Intel 仅为公司的合作伙伴和供应商，公司不存在对 Intel 的重大技术依赖。

五、公司在向客户提供内存接口芯片用于内存模组制造的同时，自身也开发混合安全内存模组 HSDIMM®，该产品的定位、用途、拟实现的商业目的，是否与客户产品形成竞争关系，是否存在向客户采购的情况，具体采购的内容、金额等；

混合安全内存模组采用澜起科技具有自主知识产权的 Mont-ICMT®（Montage, Inspection & Control on Memory Traffic）内存监控技术，可为高端服务器平台提供更为安全、可靠的内存解决方案。目前，澜起科技推出两大系列混合安全内存模组：标准版混合安全内存模组（HSDIMM®）和精简版混合安全内存模组（HSDIMM®-Lite），可为不同应用场景提供不同级别的数据安全解决方案。

因此，公司所提供的混合安全内存模组其主要功能是数据保护和动态管控，而客户开发的内存模组是标准化内存产品，两者所对应的是不同的市场需求，不存在直接竞争关系。报告期内，公司不存在向客户直接采购的情形，公司通过向

相关代理商采购 DRAM 内存颗粒的合计金额为 1,850.80 万元，主要用于混合安全内存模组 HSDIMM[®]工程样品的研发。

六、津逮[®]服务器平台的具体架构，服务器平台从设计、采购、生产、销售或提供技术服务的整个流程以及发行人技术的具体体现，向第三方采购具体产品或服务的内容以及在服务器平台中的重要性，该平台实现收入的方式以及相关参与方的利益分享机制；

津逮[®]服务器平台具体架构包括如下方面：在硬件层面，包括津逮[®]服务器 CPU、混合安全内存模组；在固件层面，包括专用服务器 BIOS 和可重构处理器固件；在软件层面，用于实现动态安全监控的服务管理软件等。

服务器平台的整体设计由澜起科技负责，其中津逮[®]服务器 CPU 是由澜起科技与清华大学、Intel 联合研发，混合安全内存模组由澜起科技独立研发，可重构处理器固件由澜起科技和清华大学联合研发，专用服务器 BIOS 和用于实现动态安全监控的服务管理软件由清华大学及其他合作伙伴研发并提供。

津逮[®]服务器 CPU 和混合安全内存模组产品的所有权及品牌归属为澜起科技。相关产品由澜起科技整体设计后委托第三方进行生产制造、封装测试，其中向 Intel 采购其通用 CPU 内核芯片，向 DRAM 内存厂商采购内存颗粒。相关产品成品后由澜起科技统一销售。该产品销售所产生的收入完全归澜起科技所有，目前在收入层面不存在利益分享机制。澜起科技通过向相关合作伙伴采购产品或服务的方式支付相应成本。

七、发行人是否具备将内存接口芯片的技术积累拓展至服务器平台的能力；津逮[®]服务器平台 2017 年、2018 年少量收入的来源；2018 年底研发成功距离预计量产的时间，目前客户开拓情况，是否已有在手订单；请发行人对津逮[®]服务器平台业务面临的不确定性风险作重大事项提示；

公司在内存接口芯片领域已深耕多年，与服务器、内存、CPU 厂商等建立了长期稳定的合作关系，积累了一定的技术储备。2018 年底，经过三年研发，公司已推出第一代津逮[®]服务器 CPU 及混合安全内存模组，现已进入市场推广阶段，已初步具备拓展至服务器平台的能力。

津逮[®]服务器平台 2017 年、2018 年的收入来源主要系向客户及合作伙伴销

售的工程样品和第一代津逮®服务器平台产品所得。

目前第一代津逮®服务器平台已具备量产能力，将根据客户订单安排生产及销售。目前国内知名服务器厂商如联想、新华三、长城、宝德等均已推出支持津逮® CPU 的服务器产品。截至本反馈回复签署之日，公司已有一定数量的在手订单。

公司已在招股说明书“第四节 风险因素”之“二、经营风险（七）津逮®服务器平台业务面临的不确定性风险”中补充披露。

八、津逮®CPU 如何实现对“先进的异构计算与互联技术”的融合，除预检测和动态安全监控功能外，津逮®CPU 是否具备其他功能，是否为发行人的技术；

津逮®服务器平台主要由津逮®服务器 CPU 和混合安全内存模组构成。津逮®CPU 除了通用 CPU 的基本功能以外，其可重构计算模块实现了先进的异构计算，高速数据跟踪模块与混合安全内存模组之间实现了互联技术，从而达到了对“先进的异构计算与互联技术”的融合。

津逮®服务器 CPU 除预检测和动态安全监控功能外，还包括支持国密算法的加解密、可信启动等功能。津逮®服务器平台包含公司的技术，同时还融合了合作伙伴的相应功能模块。

九、2018 年来自 Intel 的研发费用补贴较 2017 年有较大幅度下降的原因；

2018 年来自 Intel 的研发费用补贴较 2017 年有一定程度下降，主要系公司与 Intel 签订的相关协议中，约定了研发费用的补贴条件系根据津逮®服务器平台达成具体研发进度时发放。根据协议，触发相关研发补贴的主要节点均发生在 2017 年，因此在 2017 年中确认的研发费用补贴较高。

23.2 保荐机构的核查过程和核查意见

核查过程：

1、保荐机构查阅了公司所处产业链的研究报告，取得了公司报告期内主要客户清单；

2、访谈公司核心技术人员，并取得了公司对内存接口芯片在云计算和人工智能领域的具体作用的说明性文件；

3、查阅了津逮®服务器 CPU 相关专利和集成电路布图设计专有权，以及公司与 Intel 合作开发津逮®服务器 CPU 的协议；

4、取得了公司关于混合安全内存模组定位、用途、拟实现的商业目的的说明性文件，了解了公司向客户采购所涉的金额及用途；

5、对津逮®服务器平台的具体架构及相关情况进行了访谈，并取得了公司在津逮®服务器平台中技术的具体体现，第三方采购产品在平台中的作用及利益分享机制的说明性文件；

6、取得了公司津逮®服务器平台的收入来源情况，量产计划，客户拓展及在手订单情况；

7、获取了公司对津逮®CPU 功能性的说明文件；

8、查阅了 Intel 与公司签署的津逮®服务器平台的研发费用补贴协议，并核对了津逮®服务器平台的研发进度情况。

核查结论：

1、公司为云计算和人工智能领域提供以芯片为基础的解决方案，下游主要客户也属于云计算和人工智能行业的重要参与者；

2、公司研发的内存接口芯片是云计算和人工智能领域重要的电子元器件之一，2018 年全球内存接口芯片市场规模约占全球服务器市场规模的 0.81%。

3、津逮®服务器 CPU 的所有权及品牌归属为澜起科技，Intel 仅为公司的合作伙伴和供应商，公司不存在对 Intel 的重大技术依赖；

4、公司所提供的混合安全内存模组其主要功能是数据保护和动态管控，而客户开发的内存模组是标准化内存产品，两者所对应的是不同的市场需求，不存在直接竞争关系；

5、津逮服务器平台销售所产生的收入归澜起科技所有，目前在收入层面不存在利益分享机制；

6、公司已初步具备将内存接口芯片的技术积累拓展至服务器平台的能力；

7、津逮®服务器 CPU 除预检测和动态安全监控功能外，还包括支持国密算法的加解密、可信启动等功能。津逮®服务器平台包含公司的技术，同时还融合了合作伙伴的相应功能模块；

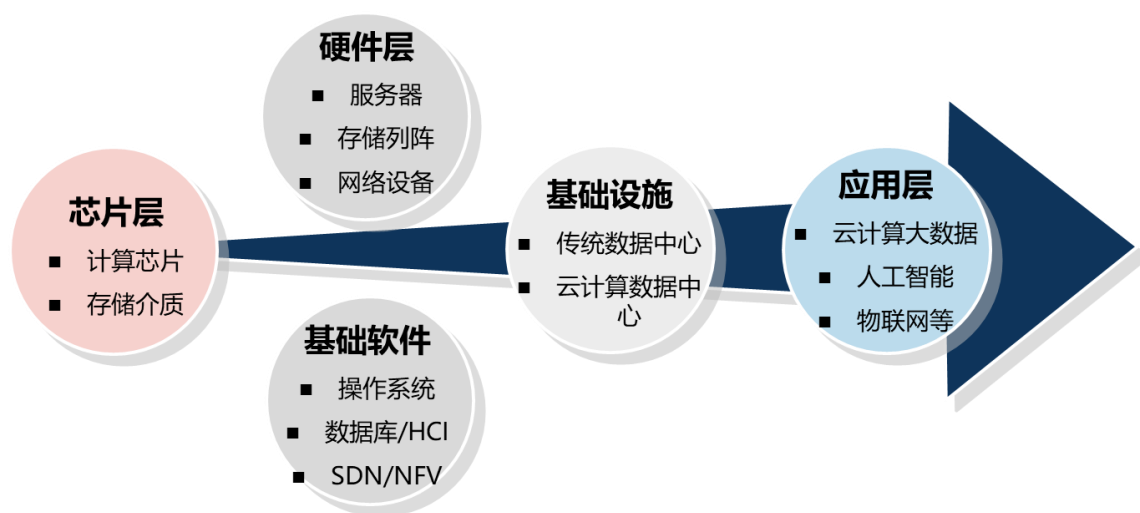
8、Intel 的研发费用补贴根据公司与 Intel 签订的协议，按照津逮®服务器平台具体研发进度发放。根据协议，触发相关研发补贴的主要节点均发生在 2017 年，因此在 2017 年中确认的研发费用补贴较高，具有合理性。

23.3 补充披露情况

发行人已在招股说明书“第六节 业务与技术”之“三、公司销售情况（四）公司下游产业链情况”中披露如下：

（四）公司下游产业链情况

公司所处的产业链架构如下图所示：



服务器是云计算和人工智能行业的基础设施，而 CPU 和 DRAM 内存是服务器的两大核心部件。公司目前的主营产品均属于产业链的芯片层环节，其中内存接口芯片直接面向 DRAM 存储器市场，津逮®服务器 CPU 及其平台直接面对服务器市场，而公司的终端客户则覆盖云计算和人工智能行业，因此公司为云计算和人工智能领域提供以芯片为基础的解决方案，下游主要客户也属于云计算和人工智能行业的重要参与者。

发行人已在招股说明书“第六节 业务与技术”之“二、行业基本情况（三）

行业发展情况及未来发展趋势”披露如下：

4、数据中心及服务器市场概况

.....

(3) 内存接口芯片发展概况

.....

根据 Gartner 公司公布的 2018 年第四季度以及 2018 年度全球 X86 服务器市场调查报告，2018 年全年全球服务器出货量为 1,290.4 万台，销售额为 705.3 亿美元。根据 IDT 和 Rambus 定期报告公开披露数据和发行人相关收入推算，2018 年全球内存接口芯片市场规模约为 5.7 亿美元，占全球服务器市场规模的份额为 0.81%。

发行人已在招股说明书“第六节 业务与技术”之“一、公司主营业务、主要产品及服务（七）主营业务、主要产品或服务、主要经营模式的演变情况”披露如下：

2017 年管理层及股东出于优化资源配置、提升运营效率、提高团队自主性及积极性的考虑，公司转让消费电子芯片业务相关资产给成都澜至及其关联方，由其独立运营消费电子芯片业务，自 2017 年 8 月以后公司不再销售及研发消费电子芯片。

在报告期内，除上述产品变化以外，公司主营业务、主要产品和主要经营模式未发生重大变化。

发行人已在招股说明书“第六节 业务与技术”之“六、公司的技术与研发情况（一）公司的核心技术情况”披露如下：

1、内存接口芯片在云计算和人工智能领域发挥的具体作用

内存接口芯片是服务器内存模组的核心逻辑器件，包含寄存时钟驱动器（RCD）和数据缓冲器（DB），其位于 CPU 到内存模组存储颗粒的命令地址总线通路和数据总线通路上，是内存模组的核心控制芯片。内存接口芯片主要作用是提升内存数据访问的速度及稳定性，满足服务器 CPU 对内存模组日益增长的高性能及大容量需求。

而服务器是支持云计算和人工智能的重要硬件平台，云计算和人工智能服

务厂商均需要采购大量服务器，甚至组建专用数据中心。因此公司的主要产品——内存接口芯片作为服务器中的核心芯片之一，是云计算和人工智能领域重要的电子元器件之一。

公司研发的用于云计算和人工智能领域的内存接口芯片具体作用包括：

(1) 通过将数据从 CPU 装载到内存模组上来计算，从而实现减轻 CPU 运算负担，同时在内存端将大量原始数据精炼出有效数据供 CPU 处理。

(2) 公司产品加入了矢量运算模块来专门支持人工智能应用里的矩阵运算，达到加速人工智能计算的目的。

2、津逮[®]服务器平台的具体架构及公司的技术体现

津逮[®]服务器平台具体架构包括如下方面：在硬件层面，包括津逮[®]服务器 CPU、混合安全内存模组；在固件层面，包括专用服务器 BIOS 和可重构处理器固件；在软件层面，用于实现动态安全监控的服务管理软件等。

服务器平台的整体设计由澜起科技负责，其中津逮[®]服务器 CPU 是由澜起科技与清华大学、Intel 联合研发，混合安全内存模组由澜起科技独立研发，可重构处理器固件由澜起科技和清华大学联合研发，专用服务器 BIOS 和用于实现动态安全监控的服务管理软件由清华大学及其他合作伙伴研发并提供。

津逮[®]服务器 CPU 和混合安全内存模组产品的所有权及品牌归属为澜起科技。相关产品由澜起科技整体设计后委托第三方进行生产制造、封装测试，其中向 Intel 采购其通用 CPU 内核芯片，向 DRAM 内存厂商采购内存颗粒。相关产品成品后由澜起科技统一销售。该产品销售所产生的收入完全归澜起科技所有，目前在收入层面不存在利益分享机制。澜起科技通过向相关合作伙伴采购产品或服务的方式支付相应成本。

3、津逮[®]CPU 对“先进的异构计算与互联技术”的融合和其他功能的介绍

津逮[®]服务器平台主要由津逮[®]服务器 CPU 和混合安全内存模组构成。津逮[®]CPU 除了通用 CPU 的基本功能以外，其可重构计算模块实现了先进的异构计算，高速数据跟踪模块与混合安全内存模组之间实现了互联技术，从而达到了对“先进的异构计算与互联技术”的融合。津逮[®]服务器 CPU 除预检测和动态安全监控功能外，还包括支持国密算法的加解密、可信启动等功能。津逮[®]服务器平台包含公司的技术，同时还融合了合作伙伴的相应功能模块。

4、混合安全内存模组 HSDIMM[®]的定位、用途、拟实现的商业目的，以及公司向客户采购的情况

混合安全内存模组采用澜起科技具有自主知识产权的 Mont-ICMT[®] (Montage, Inspection & Control on Memory Traffic) 内存监控技术，可为高端服务器平台提供更为安全、可靠的内存解决方案。目前，澜起科技推出两大系列混合安全内存模组：标准版混合安全内存模组 (HSDIMM[®]) 和精简版混合安全内存模组 (HSDIMM[®]-Lite)，可为不同应用场景提供不同级别的数据安全解决方案。公司所提供的混合安全内存模组其主要功能是数据保护和动态管控，而客户开发的内存模组是标准化内存产品，两者所对应的是不同的市场需求，不存在直接竞争关系。

发行人已在招股说明书“第四节 风险因素”之“二、经营风险（七）津逮[®]服务器平台业务面临的不确定性风险”披露如下：

津逮[®]服务器平台项目具有高投入、高风险的特点。服务器市场既是未来数据中心市场的重要组成部分，也是公司布局云计算、人工智能等新兴领域的重要抓手。但津逮[®]服务器平台技术壁垒高，独创性强，需要公司投入大量资金、人力和时间成本，且目前第一代产品刚刚推出，需要一定的测试、认证、推广周期，如最终推广效果不及预期，可能在短期内无法为公司带来相应的收入和利润，具有较大的不确定性。

发行人已在招股说明书“第七节 公司治理及独立性”之“八、关联方、关联关系和关联交易（二）关联交易”披露如下：

1、经常性关联交易

……

(4) 同 Intel 之间的津逮[®]服务器 CPU 开发项目款项

……

2018 年来自 Intel 的研发费用补贴较 2017 年有一定程度下降，主要系公司与 Intel 签订的相关协议中，约定了研发费用的补贴条件系根据津逮[®]服务器平台达成具体研发进度时发放。根据协议，触发相关研发补贴的主要节点均发生在 2017 年，因此在 2017 年中确认的研发费用补贴较高。

问题二十四

发行人的主要经营模式是 Fabless 模式，芯片的制造和封装测试通过委外方式完成。

请发行人披露：（1）结合主要合同条款说明与委外厂商的权利义务划分、定价机制及付款政策、产品质量控制措施，并在“重要会计政策和会计估计”部分结合业务流程披露委外生产的会计处理原则；（2）发行人的具体验收流程、验收项目、验收标准，与晶圆厂、封装厂、测试厂在验收环节的合作与分工，产品质量的责任划分与承担机制，良品与不良品的划分标准，报告期内成品的不良率以及不良品的具体处置情况；（3）存货委托委外供应商和委外仓库进行储存保管，相关保管、毁损、灭失等风险承担机制；（4）将第 125 页的工艺流程示意图修改为包含公司芯片设计、销售业务在内的完整流程图，并明确哪些环节公司自主完成或参与，哪些由委外厂商完成。

请保荐机构及申报会计师对上述事项进行核查，说明对发行人委外业务的核查方式、过程及依据，并发表明确意见。

回复：

24.1 发行人说明

一、结合主要合同条款说明与委外厂商的权利义务划分、定价机制及付款政策、产品质量控制措施，并在“重要会计政策和会计估计”部分结合业务流程披露委外生产的会计处理原则

（一）与委外厂商的权利义务划分、定价机制及付款政策、产品质量控制措施

1、与委外厂商的权利义务划分

公司负责及时提供采购预测，下达采购订单、生产工单，在收到成品时确认发票并及时付款；供应商应在商定的交货期内，及时按照订单和工单的要求交付符合质量要求的晶圆和成品，及时通报和处理产线上的异常情况，及时提供存货的库存信息。封装测试供应商还需要提供成品的仓储和向公司的客户直接发货服

务。

2、定价机制及付款政策

定价根据市场价格与供应商协商确定。总原则是在质量符合要求的供应商中，选择性价比最优的。付款政策由公司和供应商分别协商确定，一般为月结 30-60 天。

3、产品质量控制措施

(1) 进行严格的供应商管理。所有新供应商在进入合格供应商名录之前，必须经过公司的审核和评估；定期对供应商进行基于技术、质量、交期、服务等项目的评估，并发送评估报告给供应商以提升供应商的质量水平和服务能力，对不能满足需求的供应商实行淘汰制度。

(2) 通过检测等手段对生产过程中产品质量进行控制。

(3) 检测质量管理。运营部与研发部、市场应用技术部合作，建立测试流程，包括测试机台，测试程序，测试规格，QA 流程，以及良率要求等等，并完成工程验证数据分析，确认供应商的测试能力满足产品需求。

(二) 委外生产的会计处理原则

公司采用 Fabless 模式进行经营，自身不直接从事芯片的生产环节，将芯片生产环节的晶圆生产、封装测试环节均委托专业厂商进行。公司通常结合自身对市场的判断和客户的需求拟定采购计划，向晶圆制造企业下订单，晶圆制造企业接到订单后排期并安排生产。晶圆制造完毕后进行晶圆测试，符合公司良品率要求的晶圆，直接发往公司指定的封装企业进行封装，封装完成后进行测试，完成芯片的测试后，芯片产成品发送至公司指定的客户。

从晶圆代工厂采购的晶圆作为原材料核算，向封装测试厂采购的封装测试服务费用计入委托加工物资核算，库存商品（发出商品）成本包括晶圆采购成本、加工成本（封装测试代工费）等。原材料、委托加工物资和库存商品在领入和发出时按标准成本计价，实际成本和标准成本之间产生的成本差异按实际销售情况在存货与营业成本之间分摊。

二、发行人的具体验收流程、验收项目、验收标准，与晶圆厂、封装厂、测试厂在验收环节的合作与分工，产品质量的责任划分与承担机制，良品与不良品的划分标准，报告期内成品的不良率以及不良品的具体处置情况

公司的具体验收流程、验收项目、验收标准，与委外厂商在验收环节的合作与分工如下：

晶圆在出厂之前均需进行 WAT 电性测试和自动光学检查，运营部对晶圆生产过程中关键参数进行制程能力指数（CPK）管理，将晶圆测试以及封装后测试的良率反馈给晶圆厂，以提高晶圆的质量。

封装测试供应商按来料质量检验（IQC）的标准对收到的晶圆进行检查；确定封装的良率目标和良率控制线，低于目标良率的需提供分析报告和改善措施，低于良率控制线的批次需暂扣并通知运营部进行处理；建立了生产数据自动报告系统，定期提供生产报表和良率信息，以方便运营部监控生产流程；建立了量产可靠性评估体系，封装厂和公司按照 JEDEC 的标准进行定期的可靠性评估，确保产品的质量和可靠性。

公司验收：测试完成后对于完成品进行 100% 的外观检查，确保产品质量。每批次产品入库前进行 QA 的电性和外观检查，确保测试过程无异常。

产品质量的责任划分与承担机制，良品与不良品的划分标准，报告期内成品的不良率以及不良品的具体处置情况。

晶圆厂的产品如未达到公司的工艺要求，则需重新提供满足要求的相关产品；封装厂商的产品如未达到公司的工艺要求，则除需重新提供满足要求的相关产品外，还需要赔偿晶圆的损失。产品出厂后如因供应商责任造成客户的损失，则公司有权向供应商追溯赔偿。

公司对于封装和测试的产品质量均有明确的规范。报告期内公司的产品良率一直维持在较高水平。

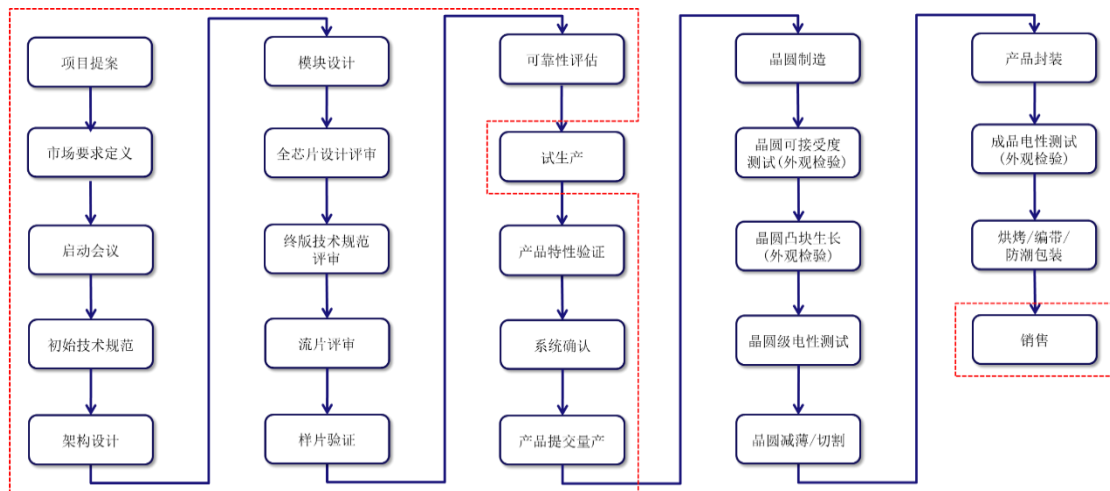
不良品清单由封装测试厂定期发送给公司，低于良率的生产工单会与供应商共同研究其原因，运营部根据实际情况对不良品进行隔离，定期对隔离的不良品进行报废处理，报废处理需得到相关负责人审批同意后进行。

三、存货委托委外供应商和委外仓库进行储存保管，相关保管、毁损、灭失等风险承担机制

所有存货均委托委外供应商和委外仓库进行储存保管，并要求供应商提供及时WIP报表和库存报表能及时查询详细讯息。在供应商生产场地发生的毁损、灭失由供应商承担责任。

四、将第125页的工艺流程示意图修改为包含公司芯片设计、销售业务在内的完整流程图，并明确哪些环节公司自主完成或参与，哪些由委外厂商完成

公司主要产品的业务流程示意图如下：



注：红色框线标注为公司自主完成，其余由委外厂商完成。

上述流程图中项目提案、市场要求定义、启动会议、初始技术规范、架构设计、模块设计、全芯片设计评审、终版技术规范评审、流片评审、样片验证、可靠性评估、产品特性验证、系统确认、产品提交量产、销售等环节系由公司自主完成，其余环节由委外厂商完成。

24.2 保荐机构和申报会计师核查意见

核查过程：

- 1、检查与委外采购相关的内部控制制度及其执行情况；
- 2、查阅了发行人委外加工相关合同及订单相关条款，访谈了发行人采购负责人，并现场访谈了发行人的委外厂商，核对发行人采购流程、定价机制、结算条款、验收条款等；

核查结论:

经核查,保荐机构和申报会计师认为:

发行人与委外厂商之间确立了明确的权利义务关系,并制定了严格的质量控制制度,且会计处理符合相关准则规定。

24.3 补充披露情况

发行人已在招股书“第六节 业务与技术”之“一、公司的主营业务、主要产品及服务”之“(二)主要经营模式”中补充披露如下:

发行人与委外厂商合作情况如下:

(1) 与委外厂商的权利义务划分

发行人负责及时提供采购预测,下达采购订单、生产工单,在收到成品时确认发票并及时付款;供应商应在商定的交货期内,及时按照订单和工单的要求交付符合质量要求的晶圆和成品,及时通报和处理产线上的异常情况,及时提供存货的库存信息。封装测试供应商还需要提供成品的仓储和向公司的客户直接发货服务。

(2) 定价机制及付款政策

定价根据市场价格与供应商协商确定。总原则是在质量符合要求的供应商中,选择性价比最优的。付款政策由发行人和供应商分别协商确定,一般为月结 30-60 天。

(3) 产品质量控制措施

1) 进行严格的供应商管理。所有新供应商在进入合格供应商名录之前,必须经过公司的审核和评估;定期对供应商进行基于技术、质量、交期、服务等项目的评估,并发送评估报告给供应商以提升供应商的质量水平和服务能力,对不能满足需求的供应商实行淘汰制度。

2) 通过检测等手段对生产过程中产品质量进行控制。

(4) 发行人委外加工验收程序

晶圆在出厂之前均需进行 WAT 电性测试和自动光学检查，运营部对晶圆生产过程中关键参数进行制程能力指数（CPK）管理，将晶圆测试以及封装后测试的良率反馈给晶圆厂，以提高晶圆的质量。

封装测试供应商按来料质量检验（IQC）的标准对收到的晶圆进行检查；确定封装的良率目标和良率控制线，低于目标良率的需提供分析报告和改善措施，低于良率控制线的批次需暂扣并通知运营部进行处理；建立了生产数据自动报告系统，定期提供生产报表和良率信息，以方便运营部监控生产流程；建立了量产可靠性评估体系，封装厂和公司按照 JEDEC 的标准进行定期的可靠性评估，确保产品的质量和可靠性。

公司验收：运营部与研发部、市场应用技术部合作，在测试厂建立测试流程，包括测试机台，测试程序，测试规格，质量保证（QA）流程，以及良率要求等，并完成工程验证数据分析，确认供应商的测试能力满足产品需求。测试完成后对于完成品进行 100% 的外观检查，确保产品质量。每批次产品入库前进行 QA 的电性和外观检查，确保测试过程无异常。

产品质量的责任划分与承担机制，良品与不良品的划分标准，报告期内成品的不良率以及不良品的具体处置情况。

晶圆厂的产品如未达到发行人的工艺要求，则需重新提供满足要求的相关产品；封装厂商的产品如未达到发行人的工艺要求，则除需重新提供满足要求的相关产品外，还需要赔偿晶圆的损失。产品出厂后如因供应商责任造成客户的损失，则发行人有权向供应商追溯赔偿。

发行人对于封装和测试的产品质量均有明确的规范。报告期内公司的产品良率一直维持在较高水平。

不良品清单由封装测试厂定期发送给发行人，低于良率的生产工单会与供应商共同研究其原因，运营部根据实际情况对不良品进行隔离，定期对隔离的不良品进行报废处理，报废处理需得到相关负责人审批同意后进行。

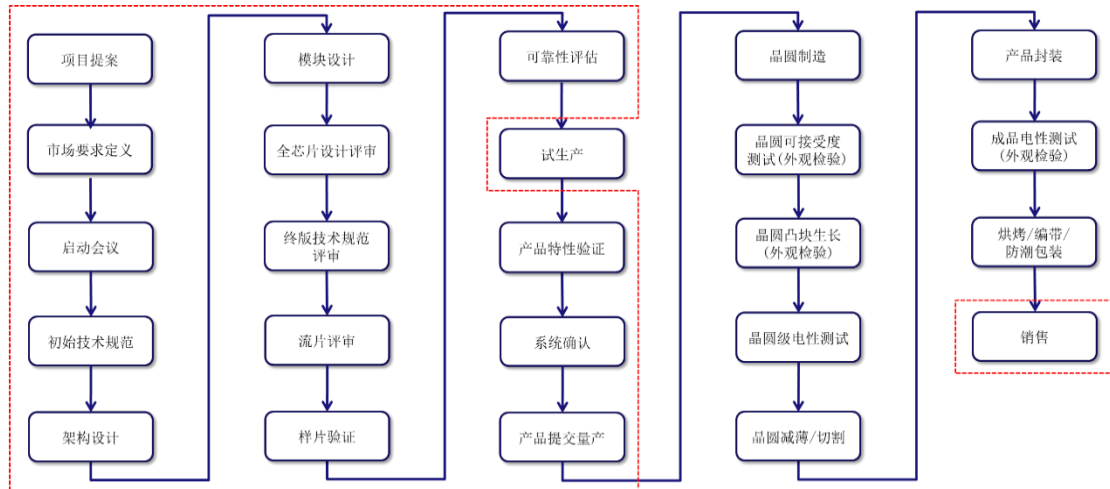
（5）委外加工存货保管情况

所有存货均委托委外供应商和委外仓库进行储存保管，并要求供应商提供及

时 **WIP** 报表和库存报表能及时查询详细讯息。在供应商生产场地发生的毁损、灭失由供应商承担责任。

发行人已在招股书“第六节 业务与技术”之“一、公司的主营业务、主要产品及服务（四）工艺流程示意图”中补充披露如下：

公司主要产品的业务流程示意图如下：



注：红色框线标注为公司自主完成，其余由委外厂商完成。

上述流程图中项目提案、市场要求定义、启动会议、初始技术规范、架构设计、模块设计、全芯片设计评审、终版技术规范审议、流片评审、样片验证、可靠性评估、产品特性验证、系统确认、产品提交量产、销售等环节系由公司自主完成，其余环节由委外厂商完成。”

问题二十五

报告期内，发行人境外销售收入分别为57,372.76万元、73,337.49万元、118,964.30万元，占营业收入的比例为67.90、59.74、67.68。

请发行人披露：（1）境外经营的总体情况，并对有关业务活动进行地域性分析；（2）境外销售的具体产品类型及竞争优势，境外客户的开发方式、销售模式、定价策略等，境外客户的开发情况以及主要境外客户的基本情况，产品的最终销售实现情况；（3）境外资产的内容、规模、所在地、运营及盈利情况等；（4）境外采购、销售是否会受贸易摩擦的影响，如存在受相关国家或地区管制的风险，请充分揭示风险。

请发行人说明：（1）报告期内汇兑损益与对外销售/采购的匹配性；（2）发行人与外销业务相关的内部控制制度建设和执行情况；（3）境外销售收入回款方与签订合同客户是否一致，如存在第三方回款的，请说明原因、商业合理性以及合法合规性。

请保荐机构及申报会计师对上述事项进行核查并发表明确意见，说明对发行人报告期境外业务的核查方式、过程及依据，并对境外销售的真实性发表明确意见。请发行人律师对境外业务是否符合国家外汇、税务等相关法律法规的规定发表明确意见。

回复：

25.1 发行人说明

一、境外经营的总体情况，并对有关业务活动进行地域性分析

公司的供应商及客户大部分位于境外或者使用境外实体与公司进行交易，公司的主要境外经营主体包括澜起澳门、澜起美国，其中公司通过澜起澳门进行境外采购及销售，通过澜起美国为美国等境外客户提供支持。

公司的境外销售收入按国家和地区分类的构成如下：

单位：万元

序号	国别或地区	2018 年度		2017 年度		2016 年度	
		收入	占比	收入	占比	收入	占比
1	韩国	51,522.89	29.31%	28,929.27	23.57%	43,232.96	51.17%
2	新加坡	37,400.30	21.28%	27,716.45	22.58%	7,572.90	8.96%
3	菲律宾	13,760.43	7.83%	1,623.96	1.32%	116.89	0.14%
4	美国	7,969.77	4.53%	8,077.69	6.58%	2,724.46	3.22%
5	其他	8,310.91	4.73%	6,990.13	5.69%	3,725.56	4.41%
合计		118,964.30	67.68%	73,337.50	59.74%	57,372.77	67.90%

注：上述占比是相关境外区域占营业收入的比例

公司的境外销售区域主要包括韩国、新加坡、菲律宾和美国等地，其中 2017 年韩国销售占比下降主要系 2017 年原三星电子相关业务由三星苏州作为交易主体向公司进行采购所致；2017 年新加坡销售占比上升主要系 2017 年新加坡经销商富昌电子的采购上升所致；2018 年韩国及新加坡的销售占比较上年基本保持平稳，菲律宾销售占比上升主要系部分客户将产能转移到菲律宾公司所致。

二、境外销售的具体产品类型及竞争优势，境外客户的开发方式、销售模式、定价策略等，境外客户的开发情况以及主要境外客户的基本情况，产品的最终销售实现情况

1、境外销售的具体产品类型及竞争优势

报告期内公司境外销售的具体产品类型包括内存接口芯片和消费电子芯片，其中内存接口芯片境外销售占整个报告期境外销售的比重达到 95% 以上。

内存接口芯片的竞争优势为公司发明了 DDR4 全缓冲“1+9”架构，最终被 JEDEC 国际标准采纳。澜起科技凭借具有自主知识产权的高速、低功耗技术，为新一代服务器平台提供完全符合 JEDEC 标准的高性能内存接口解决方案，是全球可提供从 DDR2 到 DDR4 内存全缓冲/半缓冲完整解决方案的主要供应商之一，在该领域拥有重要话语权。

2、境外客户的开发方式、销售模式、定价策略

(1) 境外客户开发方式

内存接口芯片的主要客户为 DRAM 厂商，大部分都在境外，公司与他们建

立了长期稳定的合作关系，与他们均有直接联系。

消费电子芯片的境外开发方式主要通过自身拓展下游客户。

(2) 境外销售模式

公司在境外的销售模式以直销为主，代销为辅。

(3) 定价策略

公司境外销售的定价策略主要是基于市场价格经买卖双方协商确定。

3、境外客户的开发情况以及主要境外客户的基本情况

公司主要的境外客户主要包括三星电子、海力士、富昌电子、金士顿等。

三星电子为韩国上市公司，主要从事电子产品的制造和销售，是世界知名的半导体及电子企业。

海力士是一家世界知名的存储半导体制造商。其主要产品包括动态随机存取记忆体(DRAM)产品，multi-chip 产品和 NAND 闪存半导体。

富昌电子成立于 1968 年，是全球领先的电子元器件分销商，富昌电子的总部设在加拿大蒙特利尔，经营业务遍布全球 44 个国家 169 个办事处。

金士顿是全球最大的独立内存产品制造商之一。金士顿的全球总部设在美国加州，在全球拥有超过 3,000 名员工。

4、产品的最终销售实现情况

公司在境外销售的内存接口芯片的代销商仅有一家为富昌电子，其最终客户为美光科技。公司通过代销商实现的收入均是在销售给最终客户后确认。

三、境外资产的内容、规模、所在地、运营及盈利情况等

1、境外全资子公司的基本情况

(1) Montage Technology Holdings Company Limited（澜起开曼）

澜起开曼成立于 2010 年 6 月 17 日，发行股数为 50,000 股，每股 1 美元。根据开曼群岛法律，澜起开曼合法有效存续。公司持有澜起开曼 100%的股权。

截至 2018 年 12 月 31 日，澜起开曼经审计的总资产为 18,292.27 万美元、净资产为 14,292.27 万美元，2018 年度净利润 9,997.70 万美元。

(2) Montage Technology Inc. (澜起美国)

澜起美国成立于 2005 年 10 月 17 日，股本数为 1,000 股，注册地为美国加州。根据美国法律，澜起美国合法有效存续。公司通过全资子公司澜起开曼间接持有澜起美国的 100% 股权。

截至 2018 年 12 月 31 日，澜起美国经审计的总资产为 338.08 万美元、净资产为-99.22 万美元，2018 年度净利润 30.15 万美元。

(3) Porsche Acquisition Sub, Inc. (澜起宝石)

澜起宝石于 2015 年 9 月 22 日完成商业登记注册，股本数为 1,000 股，注册地为美国加州。根据美国法律，澜起宝石合法有效存续。公司通过全资子公司澜起美国间接持有澜起宝石的 100% 股权。

截至 2018 年 12 月 31 日，澜起宝石经审计的总资产为 3.17 万美元、净资产为-0.46 万美元，2018 年度净利润-0.12 万美元。

(4) Montage Hong Kong Holdings Company Limited (澜起香港)

澜起香港于 2016 年 4 月 21 日完成商业登记注册，发行股数为 1 股，每股 1 港币，注册地为香港。公司通过全资子公司澜起开曼间接持有澜起香港的 100% 股权。

2016 年 6 月 8 日，澜起香港在台湾设立外国公司办事处，住址为 114 台北市内湖区基湖路 3 巷 47 号 2 楼。

截至 2018 年 12 月 31 日，澜起香港股东尚未完成出资，澜起香港尚未开展任何经营或发生任何交易。

(5) Montage Technology Macao Commercial Offshore Limited (澜起澳门)

澜起澳门原名为“Triple Win Macao Commercial Offshore Limited”（以下简称“Triple 澳门”）于 2003 年 5 月 12 日由 Triple Win Holdings Inc. 完成商业登记

注册，股本数为 50 万澳门元，注册地为澳门，2007 年 1 月 17 日，Triple 澳门更名为“Sonoma Macao Commercial Offshore Limited”(以下简称“Sonoma 澳门”)。2013 年 4 月 18 日 Triple Win Holdings Inc.将其所持有的 Sonoma 澳门出资额转让给了 Montage Group，同时 Sonoma 澳门公司名称变更为 Montage Technology Macao Commercial Offshore Limited(澜起澳门)。2016 年 2 月 5 日，Montage Group 将其持有的澜起澳门出资额转让给了澜起开曼。2018 年 6 月 5 日，澜起澳门在韩国设立外国公司分支机构，住址为京畿道城南市盆唐区 Banga-ro21，2 楼。

截至本回复签署日，公司通过全资子公司澜起开曼间接持有澜起澳门的 100% 股权，澜起澳门的董事为杨崇和及 Stephen Kuong-Lo Tai，主要负责境外采购和产品销售。

截至 2018 年 12 月 31 日，澜起澳门经京澳会计师事务所审计的总资产为 26,459.36 万美元、净资产为 8,900.06 万美元，2018 年度净利润 8,357.88 万美元。

四、境外采购、销售是否会受贸易摩擦的影响，如存在受相关国家或地区管制的风险，请充分揭示风险

公司主要通过澜起澳门进行境外采购和销售，目前没有受到贸易摩擦的影响。

五、报告期内汇兑损益与对外销售/采购的匹配性

公司报告期内汇兑损益主要是境内公司对境外销售和采购、外币兑换业务和期末外币货币性项目调整产生的。公司发生的外币交易在初始确认时，按交易日的上月的月末汇率折算为记账本位币金额，资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，公司发生的外币兑换业务，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额，由此产生汇兑损益。

公司主要通过境外子公司澜起澳门进行对外采购和销售，交易和结算的货币均是美元，且其他境外子公司也都是用美元来交易和结算，不会产生汇兑损益。境外子公司报告期的汇兑损益是由于其持有的少量非美元货币造成的，2016-2018 年分别是 1.39 万元、-0.30 万元和 0.93 万元，与美元汇率走势一致。报告期内公司境内公司产生的汇兑损益-1,450.32 万元、1,016.21 万元和-1,354.33 万元，与当期美元兑人民币走势相匹配。

汇兑损益受到汇率变化、销售采购的时点、外币兑换及期末外币货币性项目的计量等多种因素共同的影响，与对外销售和采购并没有明显的匹配关系。

六、发行人与外销业务相关的内部控制制度建设和执行情况

公司已建立《销售管理制度》，制定销售流程，不断完善销售制度和流程，明确销售、发货、收款等环节的职责和审批权限，按照规定的权限和程序处理销售业务，定期检查分析销售中的薄弱环节，进行销售业务的管理和控制。与外销业务相关的内部控制及执行情况如下：

- 1、制定销售计划，督促销售目标的实现；
- 2、建立客户名录进行客户管理；
- 3、进行市场调查，合理确认定价机制和信用方式；
- 4、建立规范的销售合同签订与审批流程；
- 5、确保销售记录、会计记录和仓储记录一致；
- 6、做好应收账款的管理；
- 7、完善客户服务，加强销售退换货的管理。

七、境外销售收入回款方与签订合同客户是否一致，如存在第三方回款的，请说明原因、商业合理性以及合法合规性。

公司境外销售收入回款方与签订合同客户一致，不存在第三方回款的情形。

25.2 保荐机构和申报会计师核查过程和核查意见

核查过程：

1、了解和评价发行人与销售、采购及存货管理的相关内部控制制度的设计和执行，对发行人的业务处理流程进行穿行测试，检查内部控制是否合理且有效执行；

2、对报告期内境外业务执行分析性程序，重点关注产品收入成本、毛利率、销售方式、存货及跌价准备等科目变动的合理性，对变动较大的科目重点检查；

3、检查与境外业务相关的采购和销售合同，对境外客户和供应商进行现场访谈，重点关注报告期定价及交易金额、合作历史及稳定性、业务流程、结算方式、关联关系等情形；

4、函证境外银行账户、客户、供应商及最终客户，函证内容包括银行账户信息、销售收入金额、采购金额、期末存货余额、应收账款、应付账款等财务数据；

5、发行人存货主要放置在境外，由供应商代为管理，年末发行人到境外供应商处进行存货盘点，对发行人的存货盘点执行存货监盘程序；

6、根据发行人的销售方式，检查收入确认的时点及收入政策是否符合企业会计准则的规定，采取抽样检查的方式检查销售收入对应的合同、订单、发货单、签收单、海关单据、代销商的代销清单、发票情况，检查客户的期后回款情况，检查会计期末前后的出入库单、运输单据等业务单据，对收入和存货进行截止性检查。

核查结论：

经核查，保荐机构和申报会计师认为：

1、发行人报告期内汇兑损益受到汇率变化、销售采购的时点、外币兑换及期末外币货币性项目的计量等多种因素共同的影响，与对外销售和采购没有明显的匹配关系；

2、发行人与外销业务相关的内部控制制度设计合理并得到有效执行；

3、发行人境外销售收入回款方与签订合同客户一致，不存在第三方回款的情形；

4、通过核查，发行人境外销售是真实的。

25.3 补充披露情况

发行人已在招股书“第六节 业务与技术”之“七、公司境外经营情况”中进行披露：

公司的供应商及客户大部分位于境外或者使用境外实体与公司进行交易，公司的主要境外经营主体包括澜起澳门、澜起美国，其中发行人通过澜起澳门进行境外采购及销售，通过澜起美国为美国等境外客户提供支持。

报告期内公司境外销售的具体产品类型包括内存接口芯片和消费电子芯片，其中内存接口芯片境外销售占整个报告期境外销售的比重达到 95%以上。由于内存接口芯片的主要客户为 DRAM 厂商，大部分都在境外，公司在境外分支机构与其进行直接联系，并已建立了长期稳定的合作关系。

公司在境外的销售模式以直销为主，代销为辅。定价策略主要是基于市场价格经买卖双方协商确定。

发行人已在招股书“第八节 财务会计信息与管理层分析”之“六、经营成果分析（一）营业收入结构及趋势分析”中进行补充披露：

公司的境外销售收入按国家和地区分类的构成如下：

单位：万元

序号	国别或地区	2018 年度		2017 年度		2016 年度	
		收入	占比	收入	占比	收入	占比
1	韩国	51,522.89	29.31%	28,929.27	23.57%	43,232.96	51.17%
2	新加坡	37,400.30	21.28%	27,716.45	22.58%	7,572.90	8.96%
3	菲律宾	13,760.43	7.83%	1,623.96	1.32%	116.89	0.14%
4	美国	7,969.77	4.53%	8,077.69	6.58%	2,724.46	3.22%
5	其他	8,310.91	4.73%	6,990.13	5.69%	3,725.56	4.41%
合计		118,964.30	67.68%	73,337.50	59.74%	57,372.77	67.90%

注：上述占比是相关境外区域占营业收入的比例

公司经过多年的发展，在行业内建立了良好口碑，积累了较为丰富的客户资源，销售区域覆盖中国大陆、亚洲、欧洲、美洲等地，其中 2016 年公司在韩国、中国大陆和新加坡的销售收入占比较高，占比分别为 51.17%、32.10%和 8.96%；2017 年公司在中国大陆、韩国和新加坡的销售收入占比较高，占比分别为 40.26%、23.57%和 22.58%；2018 年公司在中国大陆、韩国和新加坡的销售收入占比较高，占比分别为 32.32%、29.31%和 21.28%。公司的境外销售区域主要包括韩国、新

加坡、菲律宾和美国等地，其中 2017 年韩国销售占比下降主要系 2017 年原三星电子相关业务由三星苏州作为交易主体向公司进行采购所致；2017 年新加坡销售占比上升主要系 2017 年新加坡代销商富昌电子的采购上升所致；2018 年韩国及新加坡的销售占比较上年基本保持平稳，菲律宾销售占比上升主要系部分客户将产能转移到菲律宾公司所致。

公司主要通过澜起澳门进行境外采购和销售，目前没有受到贸易摩擦的影响。

问题二十六

报告期内, 发行人前五名客户销售收入占比分别为70.18%、83.69%、90.10%, 比例逐年上升。

请发行人披露: (1) 区分内存接口芯片、消费电子芯片分别披露报告期各期前五名客户情况, 包括客户名称、销售金额及占比、是否为最终使用客户; (2) 报告期内前五名客户发生变动的, 请披露变动原因; (3) 结合与主要客户签订的合同类型、期限、合作历史等, 充分披露与前五名客户合作的稳定性及可持续性; (4) 发行人为减少大客户依赖所采取的应对措施。

请发行人说明: (1) 前五名客户是否对发行人产品具有依赖性, 是否与发行人及其关联方存在关联关系, 相关交易的定价是否公允; (2) 报告期前五名客户中新增客户的基本情况, 包括成立时间、注册资本、股权结构、实际控制人或主要股东、规模、经营状况等。

请保荐机构及申报会计师对上述事项进行核查并发表明确意见。

回复:

26.1 发行人说明

一、区分内存接口芯片、消费电子芯片分别披露报告期各期前五名客户情况, 包括客户名称、销售金额及占比、是否为最终使用客户

1、内存接口芯片报告期前五名客户情况

报告期内, 发行人内存接口芯片主要客户为富昌电子、海力士、海太半导体、金士顿、三星电子、Hanyang Digitech Co.,Ltd 等。

(1) 2018 年内存接口芯片前五名客户情况如下表:

单位: 万元

序号	客户名称	销售金额	占营业收入比例	是否最终客户
1	客户 A	47,335.46	26.93%	是
2	客户 B	44,462.00	25.30%	是

序号	客户名称	销售金额	占营业收入比例	是否最终客户
3	客户 C	36,518.00	20.78%	否
4	客户 D	15,882.96	9.04%	是
5	客户 E	14,150.43	8.05%	是
合计		158,348.84	90.10%	

注：上述销售金额按照同一控制下企业合并计算，下同。

(2) 2017 年内存接口芯片前五名客户情况如下表：

单位：万元

序号	客户名称	销售金额	占营业收入比例	是否最终客户
1	客户 A	29,245.46	23.82%	是
2	客户 C	27,733.52	22.59%	否
3	客户 B	21,680.19	17.66%	是
4	客户 E	8,062.88	6.57%	是
5	客户 D	2,361.08	1.92%	是
合计		89,083.13	72.57%	

(3) 2016 年内存接口芯片前五名客户情况如下表：

单位：万元

序号	客户名称	销售金额	占营业收入比例	是否最终客户
1	客户 A	23,456.88	27.76%	是
2	客户 B	13,645.89	16.15%	是
3	客户 C	7,576.79	8.97%	否
4	客户 D	4,414.16	5.22%	是
5	客户 F	3,520.70	4.17%	是
合计		52,614.42	62.27%	

2、消费电子芯片报告期前五名客户情况

报告期内，公司消费电子芯片主要客户为成都澜至、北京东方广视科技股份有限公司、虹日科技、巨联信息科技（上海）有限公司、淇诺科技、中电器材、ILDO Korea Co., Ltd.等。

(1) 2017 年消费电子芯片前五名客户情况如下表：

单位：万元

序号	客户名称	销售金额	占营业收入比例	是否最终客户
1	成都澜至	15,621.38	12.73%	否
2	淇诺科技	5,794.89	4.72%	否
3	中电器材	1,915.58	1.56%	否
4	北京东方广视科技股份有限公司	1,280.84	1.04%	是
5	虹日科技	1,087.66	0.89%	否
	合计	25,700.35	20.94%	

注：成都澜至销售金额包括成都澜至和 Montage Group；

(2) 2016 年消费电子芯片前五名客户情况如下表：

单位：万元

序号	客户名称	销售金额	占营业收入比例	是否最终客户
1	淇诺科技	9,837.03	11.64%	否
2	虹日科技	4,607.12	5.45%	否
3	中电器材	4,560.85	5.40%	否
4	ILDO Korea Co., Ltd.	2,609.48	3.09%	否
5	巨联信息科技（上海）有限公司	1,771.36	2.10%	是
	合计	23,385.84	27.68%	

二、报告期内前五名客户发生变动的，请披露变动原因

报告期内，内存接口芯片前五名客户基本保持稳定，金士顿 2016 年已经是公司的客户，2017 年金士顿代替 Hanyang Digitech Co., Ltd 成为公司前五大客户，主要是公司进一步开拓美国市场，对金士顿销售增长。

2017 年 7 月，公司转让消费电子芯片业务相关的存货给成都澜至及其关联方，从而使其变成 2017 年消费电子芯片业务第一大客户，2016 年北京东方广视科技股份有限公司已经是公司的客户，销售金额 413.96 万元，2017 年销售有所增长，成为公司前五大客户。巨联信息科技（上海）有限公司 2017 年不再是公司前五大客户，但其仍然是公司客户，销售额 768.69 万元。2017 年 ILDO Korea Co., Ltd.不再是公司前五大客户是因为其代销的产品发生变化所致。

三、结合与主要客户签订的合同类型、期限、合作历史等，充分披露与前

五名客户合作的稳定性及可持续性

因 2017 年 7 月公司已将消费电子芯片业务相关资产出售给成都澜至及其关联方，自此公司不再从事消费电子芯片业务。因此公司仅从内存接口芯片的前五名客户角度分析合作的稳定性及可持续性。

公司名称	合作历史
金士顿	自 2010 年开始合作至今
三星电子	自 2012 年开始合作至今
海力士	自 2012 年开始合作至今
富昌电子	自 2013 年开始合作，2018 年末结束合作，公司与其最终客户美光科技建立直接业务联系
海太半导体	自 2013 年开始合作

由上表可以看出，公司与前五名主要客户的合作时间较长，且自开始合作后一直延续，合作稳定持续。

四、发行人为减少大客户依赖所采取的应对措施。

1、公司不存在大客户依赖的情形

根据相关行业统计数据，2018 年前三季度，在 DRAM 市场，三星电子、海力士、美光科技位居行业前三名，市场占有率合计超过 90%，该行业集中度较高。而三星电子、海力士、美光科技均为公司的客户，因此造成公司大客户收入占比较高。综上，公司大客户集中度较高系由于下游高集中度的市场环境所致，且公司已经覆盖了下游市场的主要参与者，报告期内公司第一大客户占公司营业总收入的比重始终未超过 30%，不存在对单一大客户重大依赖的情形。

2、减少大客户依赖所采取的应对措施

2016 年以来，澜起科技与清华大学、Intel 鼎力合作，研发出津逮®系列服务器 CPU。基于津逮®CPU 及澜起科技的混合安全内存模组而搭建的津逮®服务器平台，实现了芯片级实时安全监控功能，为云计算数据中心提供更为安全、可靠的运算平台。该系列产品已于 2018 年底研发成功，目前正在市场推广阶段。随着相关产品的推广，相关服务器厂商将成为公司的客户。

公司始终坚持以技术研发为核心，不断研发新产品，丰富产品多样性，同时加强市场及客户拓展力度，增加下游客户多样性，从而降低客户集中度较高的风险。

五、前五名客户是否对发行人产品具有依赖性，是否与发行人及其关联方存在关联关系，相关交易的定价是否公允

（一）内存接口芯片业务

公司报告期内的主要产品是内存接口芯片产品。目前在全球范围内从事研发并量产内存接口芯片的公司主要包括 3 家，分别为澜起科技、IDT 和 Rambus。公司发明的 DDR4 全缓冲“1+9”架构被 JEDEC（全球微电子产业的领导标准机构）采纳为国际标准，相关产品已成功进入国际主流内存、服务器和云计算领域，并占据全球市场的主要份额。

综上所述，公司在细分领域中竞争对手较少，且产品具备先进性，并建立了一定的市场竞争优势，因此前五名客户与公司之间建立良好的合作关系。但由于仍然存在竞争对手，因此不存在前五名客户对公司产品的依赖。公司的前五名客户均是国际知名企业，与公司不存在关联关系，双方之间的交易价格按照市场价格协商确定，定价公允。

（二）消费电子芯片业务

公司消费电子芯片产品主要是机顶盒芯片和 Wi-Fi 芯片，该类产品市场上制造厂商众多，技术稳定，市场竞争激烈，前五名客户对公司的产品无依赖性。2017 年消费电子芯片第一大客户成都澜至及其关联方属于公司的关联方，主要系公司转让消费电子芯片资产所致，除此之外，公司与前五大客户不存在关联关系，双方之间的交易价格按照市场价格协商确定，定价公允。

六、报告期前五名客户中新增客户的基本情况，包括成立时间、注册资本、股权结构、实际控制人或主要股东、规模、经营状况等。

报告期前五名中新增客户系成都澜至及其关联方 Montage Group，其基本情况如下表所示：

1、成都澜至

名称	澜至电子科技（成都）有限公司
成立时间	2017-3-30
注册资本	50,000.00 万元人民币
股权结构	Montage HK 持股 100%，无实际控制人
规模	2018 年资产总额为 37,050.61 万元
经营状况	2018 年营业收入为 27,167.32 万元

2、Montage Group

名称	Montage Technology Group Limited
成立时间	2004-3-29
股权结构	Montage Holding 持股 100%，无实际控制人
规模	2018 年资产总额为 31,338.48 万美元
经营状况	2018 年营业收入为 4,393.19 万美元

26.2 保荐机构和申报会计师核查过程和核查意见

核查过程：

1、获取销售发行人报告期内各年度的销售明细，对报告期内主要客户包括前五名客户的收入进行函证，重点关注前五名客户的变化及其原因，询问管理层合作的稳定性及可持续性，并与会计记录进行比对；

2、通过公开信息查询发行人客户基本信息，重点关注股东结构、规模及成立时间，检查是否与发行人存在关联关系；

3、了解发行人与销售相关的内控控制的设计及执行情况，检查发行人的销售合同及订单，检查发行人与客户关于定价的条款，并现场走访发行人的主要客户，了解与发行人的合作历史、合作方式、定价原则及结算条款、是否存在关联交易、是否存在潜在的利益安排等情形；

4、通过访谈发行人管理层和查询公开信息，了解发行人行业、主要竞争对手和产品的情况，了解发行人的行业地位、市场占有率等与发行人业务有关的情况。

核查结论：

经核查，保荐机构和申报会计师认为：

发行人 2017 年出售消费电子芯片业务相关资产给成都澜至和 Montage Group，该关联交易定价公允，除 2017 年前五大客户中的成都澜至和 Montage Group 属于发行人的关联方外，其他客户与发行人不存在关联关系，相关交易的定价具备公允性。

26.3 补充披露情况

发行人已在招股说明书“第八节 财务会计信息与管理层分析”之“六、经营成果分析（一）营业收入结构及趋势分析”中补充披露如下：

1、内存接口芯片报告期前五名客户情况

报告期内，发行人内存接口芯片主要客户为富昌电子、海力士、海太半导体、金士顿、三星电子、Hanyang Digitech Co.,Ltd 等。

(1) 2018 年内存接口芯片前五名客户情况如下表：

单位：万元

序号	客户名称	销售金额	占营业收入比例	是否最终客户
1	客户 A	47,335.46	26.93%	是
2	客户 B	44,462.00	25.30%	是
3	客户 C	36,518.00	20.78%	否
4	客户 D	15,882.96	9.04%	是
5	客户 E	14,150.43	8.05%	是
合计		158,348.84	90.10%	

注：上述销售金额按照同一控制下企业合并计算，下同。

(2) 2017 年内存接口芯片前五名客户情况如下表：

单位：万元

序号	客户名称	销售金额	占营业收入比例	是否最终客户
1	客户 A	29,245.46	23.82%	是
2	客户 C	27,733.52	22.59%	否
3	客户 B	21,680.19	17.66%	是
4	客户 E	8,062.88	6.57%	是

序号	客户名称	销售金额	占营业收入比例	是否最终客户
5	客户 D	2,361.08	1.92%	是
合计		89,083.13	72.57%	

(3) 2016 年内存接口芯片前五名客户情况如下表：

单位：万元

序号	客户名称	销售金额	占营业收入比例	是否最终客户
1	客户 A	23,456.88	27.76%	是
2	客户 B	13,645.89	16.15%	是
3	客户 C	7,576.79	8.97%	否
4	客户 D	4,414.16	5.22%	是
5	客户 F	3,520.70	4.17%	是
合计		52,614.42	62.27%	

2、消费电子芯片报告期前五名客户情况

报告期内，发行人消费电子芯片主要客户为成都澜至、北京东方广视科技股份有限公司、虹日科技、巨联信息科技（上海）有限公司、淇诺科技、中电器材、ILDO Korea Co., Ltd.等。

(1) 2017 年消费电子芯片前五名客户情况如下表：

单位：万元

序号	客户名称	销售金额	占营业收入比例	是否最终客户
1	成都澜至	15,621.38	12.73%	否
2	淇诺科技	5,794.89	4.72%	否
3	中电器材	1,915.58	1.56%	否
4	北京东方广视科技股份有限公司	1,280.84	1.04%	是
5	虹日科技	1,087.66	0.89%	否
合计		25,700.35	20.94%	

注：成都澜至销售金额包括成都澜至和 Montage Group；

(2) 2016 年消费电子芯片前五名客户情况如下表：

单位：万元

序号	客户名称	销售金额	占营业收入比例	是否最终客户
1	淇诺科技	9,837.03	11.64%	否
2	虹日科技	4,607.12	5.45%	否
3	中电器材	4,560.85	5.40%	否
4	ILDO Korea Co., Ltd.	2,609.48	3.09%	否
5	巨联信息科技（上海）有限公司	1,771.36	2.10%	是
合计		23,385.84	27.68%	

报告期内，内存接口芯片前五名客户基本保持稳定，且均保持了长期的合作关系。2017年7月，发行人转让消费电子芯片业务相关的存货给成都澜至及其关联方，从而使其变成2017年消费电子芯片业务第一大客户。

报告期内，公司前五大客户销售相对集中，主要原因系根据相关行业统计数据，2018年前三季度，在DRAM市场，三星电子、海力士、美光科技位居行业前三名，市场占有率合计超过90%，该行业集中度较高。而三星电子、海力士、美光科技均为公司的客户，因此造成公司客户收入占比较高。发行人已经覆盖了下游市场的主要参与者，报告期内发行人第一大客户占公司营业总收入的比重始终未超过30%，不存在对单一大客户重大依赖的情形。

2016年以来，澜起科技与英特尔及清华大学鼎力合作，研发出津逮®系列服务器CPU。基于津逮®CPU及澜起科技的混合安全内存模组而搭建的津逮®服务器平台，实现了芯片级实时安全监控功能，为云计算数据中心提供更为安全、可靠的运算平台。该系列产品已于2018年底研发成功，目前正在市场推广阶段。随着相关产品的推广，相关服务器厂商将成为公司的客户。

公司始终坚持以技术研发为核心，不断研发新产品，丰富产品多样性，同时加强市场及客户拓展力度，增加下游客户多样性，从而降低客户集中度较高的风险。

”

问题二十七

报告期内,发行人对外采购晶圆、封装和测试等的金额分别为49,535.97万元、59,090.96万元、59,066.94万元,向前五名供应商采购占比分别为93.24%、80.16%、73.80%。

请发行人披露:(1) 2018 年晶圆等材料成本较 2017 年大幅下降的原因,报告期内采购量与产品销售、库存的匹配关系;(2) 区分晶圆、封装测试等分别提供采购数量、平均单价、采购金额,并分析报告期内的变动趋势及原因;(3) 区分晶圆、封装测试等主要采购内容分别披露报告期各期前五名供应商情况,包括供应商名称、采购金额及占比,是否存在对单一供应商的重大依赖,如存在,请充分揭示风险;(4) 报告期内前五名供应商发生变动的,请披露变动原因;(5) Intel 作为关联方,既是客户又是供应商的商业合理性;(6) 结合与主要供应商签订的合同类型、期限、合作历史等,充分披露与前五名供应商合作的稳定性及可持续性,相关供应商是否能够保证公司的生产需求。

请发行人说明:(1) 对主要供应商采购定价的依据及公允性,供应商是否与发行人及其关联方存在关联关系;(2) 报告期内前五名供应商中新增供应商的基本情况,包括成立时间、注册资本、股权结构、实际控制人或主要股东、规模、经营状况等。

请保荐机构及申报会计师对上述事项进行核查并发表明确意见。

回复:

27.1 发行人说明

一、2018 年晶圆等材料成本较 2017 年大幅下降的原因,报告期内采购量与产品销售、库存的匹配关系;

1、2018 年晶圆等材料成本较 2017 年大幅下降的原因

2017 年晶圆采购成本包括了内存接口芯片和消费电子芯片两部分的采购金额,2018 年晶圆等材料采购成本较 2017 年大幅下降的原因,主要是 2017 年数据中包含 2017 年 1-7 月消费电子芯片的晶圆等材料采购金额 9,691.85 万元。剔

除消费电子芯片的采购金额后 2017 年数据为 15,402.23 万元，2018 年晶圆等直接材料成本金额为 19,445.85 万元，采购金额较 2017 年有所增长。

2、报告期内采购量与产品销售、库存的匹配关系

报告期内采购量与产品销售、库存的匹配关系如下表：

单位：万元

项目	2018 年度	2017 年度	2016 年度
1、采购金额	59,066.94	59,090.96	49,535.97
2、产品销售成本	51,773.40	57,095.23	41,230.91
3、期末库存余额	20,143.71	21,762.42	34,131.88
4、采购金额/产品销售成本	1.14	1.03	1.20
5、期末库存/采购金额	0.34	0.37	0.69

2016 年至 2018 年采购金额与产品销售成本的比率分别为 1.20、1.03 和 1.14，基本保持稳定。2017 年公司转让了消费电子芯片相关资产（包括对应存货），存货余额大幅下降。2017 年和 2018 年期末库存与采购金额的比率分别为 0.37 和 0.34，基本保持稳定。综上所述，公司的采购量与产品销售、库存余额具有较好的匹配性。

二、区分晶圆、封装测试等分别提供采购数量、平均单价、采购金额，并分析报告期内的变动趋势及原因；

报告期内，晶圆、封装测试等分别提供采购数量、平均单价、采购金额如下：

分类		2018 年度	2017 年度	2016 年度
晶 圆	采购金额（万元）	19,445.85	23,610.77	26,590.55
	采购数量指数	67.32	86.13	100.00
	平均单价指数	108.64	103.09	100.00
封 装 测 试	采购金额（万元）	29,709.44	24,047.95	18,628.81
	采购数量指数	131.07	118.66	100.00
	平均单价指数	121.68	108.79	100.00

注：晶圆、封装测试的采购数量和平均单价以 2016 年为基数，基准指数为 100，2017 年、2018 年相关数据对应 2016 年基数的增长或下降情况

由于技术架构及工艺不同，公司的内存接口芯片成本构成中封装测试占比较大，消费电子芯片成本构成中晶圆占比较大。2017 年 7 月公司将消费电子芯片

业务相关资产进行了转让，此后不再从事消费电子芯片相关业务。因此，报告期内公司晶圆采购数量及金额均呈下降趋势。随着内存接口芯片销售量不断提升，封装测试的采购数量及金额均呈上升趋势。

由于内存接口芯片的工艺要求比消费电子芯片高，其晶圆和封装测试的单位成本比消费电子芯片高，所以随着报告期内公司内存接口芯片销售占比不断上升，晶圆和封装测试的采购单价呈逐年上升趋势。

三、区分晶圆、封装测试等主要采购内容分别披露报告期各期前五名供应商情况，包括供应商名称、采购金额及占比，是否存在对单一供应商的重大依赖，如存在，请充分揭示风险；

1、报告期内晶圆采购前五名供应商情况

年度	供应商名称	采购金额（万元）	占采购总额比例
2018 年度	供应商 H	17,532.17	29.68%
	供应商 I	1,868.21	3.16%
	供应商 R	45.46	0.08%
	小计	19,445.85	32.92%
2017 年度	供应商 H	14,944.85	25.29%
	供应商 Q	5,713.91	9.67%
	供应商 R	2,668.49	4.52%
	供应商 I	283.51	0.48%
	小计	23,610.77	39.96%
2016 年度	供应商 Q	15,938.22	32.18%
	供应商 H	10,143.39	20.48%
	供应商 R	316.03	0.64%
	供应商 I	192.91	0.39%
	小计	26,590.55	53.68%

注：上述晶圆采购金额不包括流片费用，报告期内公司合作的晶圆厂包括富士通电子、台积电、联华电子和中芯国际

2、报告期内封装测试采购前五名供应商情况

年度	供应商名称	采购金额（万元）	占采购总额比例
2018 年度	供应商 L	28,358.35	48.01%
	供应商 K	1,343.95	2.28%

年度	供应商名称	采购金额（万元）	占采购总额比例
	供应商 S	7.14	0.01%
	小计	29,709.44	50.30%
2017 年度	供应商 L	20,376.03	34.48%
	供应商 K	3,612.85	6.11%
	供应商 T	53.89	0.09%
	供应商 U	4.27	0.01%
	供应商 V	0.90	0.00%
	小计	24,047.95	40.70%
2016 年度	供应商 L	12,127.82	24.48%
	供应商 K	6,501.00	13.12%
	小计	18,628.81	37.61%

注：报告期内公司合作的封装测试供应商包括 Raytek Semiconductor, Inc、深圳市小瑞科技股份有限公司、通富微电子股份有限公司、星科金朋、矽品科技、中芯长电半导体（江阴）有限公司

在 Fabless 模式下，公司专注于集成电路的设计，而芯片的生产制造、封装测试则通过委外方式完成，因此公司需要向晶圆制造厂采购晶圆，向封装测试厂采购封装、测试服务。为实现规模经济效益，公司会向部分供应商进行集中采购，上述供应商的采购占比分布符合行业规律。报告期内公司第一大供应商占公司采购总额的比重始终未超过 50%，不存在对单一大供应商重大依赖的情形。

四、报告期内前五名供应商发生变动的，请披露变动原因；

报告期内，公司前五名供应商变动较小，其中主要封装测试厂商均为星科金朋和矽品科技。晶圆采购前五名供应商主要变化为中芯国际自 2017 年 8 月起不再是公司的晶圆供应商，因中芯国际是公司消费电子芯片的主要晶圆供应商，公司于 2017 年 7 月转让消费电子芯片业务相关资产后暂不再向其采购晶圆。

五、Intel 作为关联方，既是客户又是供应商的商业合理性；

2016 年公司向 Intel 相关主体销售的是内存接口芯片，2017 年及 2018 年公司向 Intel 相关主体销售的是混合安全内存模组产品。2016 年、2017 年和 2018 年，公司分别向 Intel 相关主体合计销售 15.06 万元、757.56 万元和 560.93 万元，占营业收入比重均未超过 1%。

公司与清华大学、Intel 联合研发的津逮®系列服务器 CPU 于 2018 年研发成功，因此公司于 2018 年开始向 Intel 相关主体采购其通用 CPU 内核芯片，合计 2,705.58 万元。

综上，公司与关联方 Intel 之间既是客户又是供应商是基于不同产品的正常商业往来，具有合理性。

六、结合与主要供应商签订的合同类型、期限、合作历史等，充分披露与前五名供应商合作的稳定性及可持续性，相关供应商是否能够保证公司的生产需求。

报告期内，公司主要供应商包括富士通电子、中芯国际、台积电、Intel、联华电子、星科金朋和矽品科技，公司主要通过采购订单的形式向供应商采购。

供应商名称	采购内容	合作历史
富士通电子	晶圆加工	自 2006 年开始合作至今
联华电子	晶圆加工	自 2006 年开始合作至今
星科金朋	封装测试	自 2006 年开始合作至今
矽品科技	封装测试	自 2006 年开始合作至今
中芯国际	晶圆加工	自 2008 年开始合作，2017 年 8 月后暂不再向其采购
台积电	晶圆加工	自 2014 年开始合作至今
Intel	通用 CPU 内核芯片	自 2006 年开始合作至今 但自 2018 年开始作为公司供应商合作

公司的前五名供应商均为国际领先的晶圆代工、封测或服务器 CPU 供应商，与公司保持了长期良好的合作关系，具备稳定性及可持续性，能够保障公司的生产需求。同时，公司也在不断认证新的合格供应商，降低供应商集中度较高的潜在风险。

七、对主要供应商采购定价的依据及公允性，供应商是否与发行人及其关联方存在关联关系

公司主要生产模式系 Fabless 的模式，其主要供应商系晶圆制造商和封装测试厂商。公司在实际操作中，对每个特定的产品与供应商实行定期价格谈判，具体定价主要根据市场价格与供应商协商确定，定价公允。除 Intel 外，公司与其

他主要供应商不存在关联关系。

八、报告期内前五名供应商中新增供应商的基本情况，包括成立时间、注册资本、股权结构、实际控制人或主要股东、规模、经营状况等。

公司报告期内新增的前五名供应商包括台积电和 Intel，其具体情况如下：

1、台积电

台积电成立于 1987 年，是全球最大的晶圆代工半导体制造厂，其总部位于台湾新竹市新竹科学工业园区。台积电已于 NASDAQ 上市，2018 年营业收入为 10,314.74 亿新台币（336.97 亿美元），净利润为 3,631.06 亿新台币（118.62 亿美元），截至 2018 年 12 月 31 日总资产 20,900.31 亿新台币（682.79 亿美元）。

台积电在报告期初就是公司的供应商，只是随着交易金额的增长进入 2018 年前五大供应商行列。

2、Intel

Intel 成立于 1968 年，是世界知名的半导体公司，也是第一家推出 x86 架构处理器的公司，总部位于美国加利福尼亚州圣克拉拉。Intel 已于 NASDAQ 上市，2018 年营业收入为 708.48 亿美元，净利润为 210.53 亿美元，截至 2018 年 12 月 29 日总资产 1,279.63 亿美元。

27.2 保荐机构和申报会计师核查过程和核查意见

核查过程：

1、获取销售发行人报告期内各年度的采购明细，对报告期内对主要供应商包括前五名供应商的采购数量及金额进行函证，重点关注前五名供应商的变化及其原因，询问管理层与供应商合作的稳定性及可持续性，并与会计记录进行比对，询问管理层是否对前五大供应商形成依赖及判断原因；

2、通过公开信息查询发行人供应商的基本信息，重点关注股东结构、规模及成立时间，检查是否与发行人存在关联关系。现场走访发行人的主要供应商，重点访谈了与发行人的合作历史、合作内容、定价原则及结算条款、是否存在关

联交易、是否存在潜在的利益安排等情形等相关事项；

3、了解发行人采购相关的内部控制制度的设计及执行情况，检查发行人的采购合同及订单，检查发行人与供应商定价的机制及条款，对发行人采购情况进行实质性分析程序，检查采购数量、价格等因素各期变动及其原因；

4、通过访谈发行人管理层和查询公开信息，检查发行人与 Intel 签订的合同订单，了解发行人与 Intel 合作开发的背景，权利义务划分等情况。

核查结论：

经核查，保荐机构和申报会计师认为：

- 1、发行人不存在单一供应商的重大依赖情况；
- 2、2018 年晶圆等材料成本较 2017 年大幅下降具有合理性，报告期内发行人的采购量与产品销售、库存余额具有较好的匹配性；
- 3、发行人报告期内的采购数量、平均单价、采购金额变动具有合理性；
- 4、发行人不存在对单一供应商的重大依赖；
- 5、Intel 作为关联方，既是客户又是供应商具备商业合理性；
- 6、发行人与前五名供应商合作的稳定，并且具备可持续性，相关供应商能够保证公司的生产需求；
- 7、除 Intel 外发行人与主要供应商不存在关联关系，且发行人向其采购的定价具备公允性。

27.3 补充披露情况

发行人已在招股书“第六节 业务与技术”之“四、公司采购情况（一）采购产品、原材料、能源或接受服务的情况”中补充披露如下：

报告期内，晶圆、封装测试等分别提供采购数量、平均单价、采购金额变动情况如下：

分类		2018年度	2017年度	2016年度
晶圆	采购金额（万元）	19,445.85	23,610.77	26,590.55

分类		2018年度	2017年度	2016年度
	采购数量指数	67.32	86.13	100.00
	平均单价指数	108.64	103.09	100.00
封装测试	采购金额(万元)	29,709.44	24,047.95	18,628.81
	采购数量指数	131.07	118.66	100.00
	平均单价指数	121.68	108.79	100.00

注：晶圆、封装测试的采购数量和平均单价以2016年为基数，基准指数为100，2017年、2018年相关数据对应2016年基数的增长或下降情况

由于技术架构及工艺不同，公司的内存接口芯片成本构成中封装测试占比较大，消费电子芯片成本构成中晶圆占比较大。2017年7月公司将消费电子芯片业务相关资产进行了转让，此后不再从事消费电子芯片相关业务。因此，报告期内公司晶圆采购数量及金额均呈下降趋势。随着内存接口芯片销售量不断提升，封装测试的采购数量及金额均呈上升趋势。

由于内存接口芯片的工艺要求比消费电子芯片高，其晶圆和封装测试的单位成本比消费电子芯片高，所以随着报告期内公司内存接口芯片销售占比不断上升，晶圆和封装测试的采购单价呈逐年上升趋势。

2018年晶圆等材料采购成本较2017年大幅下降的原因，主要是2017年数据中包含2017年1-7月消费电子芯片的晶圆等材料采购金额9,691.85万元。

报告期内采购量与产品销售、库存的匹配关系如下表：

单位：万元

项目	2018年度	2017年度	2016年度
采购金额	59,066.94	59,090.96	49,535.97
产品销售成本	51,773.40	57,095.23	41,230.91
期末库存	20,143.71	21,762.42	34,131.88
采购金额/产品销售成本	1.14	1.03	1.20
期末库存/采购金额	0.34	0.37	0.69

2016年至2018年采购金额与产品销售成本的比率分别为1.20、1.03和1.14，基本保持稳定。2017年发行人转让了消费电子芯片相关资产（包括对应存货），存货余额大幅下降。2017年和2018年期末库存与采购金额的比率分别为0.37

和 0.34，基本保持稳定。综上所述，发行人的采购量与产品销售、库存余额具有较好的匹配性。

发行人已在招股书“第六节 业务与技术”之“四、公司采购情况（二）报告期内前五大供应商采购情况”中补充披露如下：

1、报告期内晶圆采购前五名供应商情况

年度	供应商名称	采购金额（万元）	占采购总额比例
2018 年度	供应商 H	17,532.17	29.68%
	供应商 I	1,868.21	3.16%
	供应商 R	45.46	0.08%
	小计	19,445.85	32.92%
2017 年度	供应商 H	14,944.85	25.29%
	供应商 Q	5,713.91	9.67%
	供应商 R	2,668.49	4.52%
	供应商 I	283.51	0.48%
	小计	23,610.77	39.96%
2016 年度	供应商 Q	15,938.22	32.18%
	供应商 H	10,143.39	20.48%
	供应商 R	316.03	0.64%
	供应商 I	192.91	0.39%
	小计	26,590.55	53.68%

注：上述晶圆采购金额不包括流片费用，报告期内公司合作的晶圆厂包括富士通电子、台积电、联华电子和中芯国际

2、报告期内封装测试采购前五名供应商情况

年度	供应商名称	采购金额（万元）	占采购总额比例
2018 年度	供应商 L	28,358.35	48.01%
	供应商 K	1,343.95	2.28%
	供应商 S	7.14	0.01%
	小计	29,709.44	50.30%
2017 年度	供应商 L	20,376.03	34.48%
	供应商 K	3,612.85	6.11%
	供应商 T	53.89	0.09%
	供应商 U	4.27	0.01%

年度	供应商名称	采购金额 (万元)	占采购总额比例
	供应商 V	0.90	0.00%
	小计	24,047.95	40.70%
2016 年度	供应商 L	12,127.82	24.48%
	供应商 K	6,501.00	13.12%
	小计	18,628.81	37.61%

注：报告期内公司合作的封装测试供应商包括 Raytek Semiconductor, Inc、深圳市小瑞科技股份有限公司、通富微电子股份有限公司、星科金朋、矽品科技、中芯长电半导体（江阴）有限公司

在 Fabless 模式下，公司专注于集成电路的设计，而芯片的生产制造、封装测试则通过委外方式完成，因此公司需要向晶圆制造厂采购晶圆，向封装测试厂采购封装、测试服务。为实现规模经济效益，公司会向部分供应商进行集中采购，上述供应商的采购占比分布符合行业规律。报告期内发行人第一大供应商占公司采购总额的比重始终未超过 50%，不存在对单一大供应商重大依赖的情形。

报告期内，发行人前五名供应商变动较小，其中主要封装测试厂商均为星科金朋和矽品科技。晶圆采购前五名供应商主要变化为中芯国际自 2017 年 8 月起不再是发行人的晶圆供应商，因中芯国际是发行人消费电子芯片的主要晶圆供应商，发行人于 2017 年 7 月转让消费电子芯片业务相关资产后暂不再向其采购晶圆。

公司的前五名供应商均为国际领先的晶圆代工、封测或服务器 CPU 供应商，与发行人保持了长期良好的合作关系，具备稳定性及可持续性，能够保障公司的生产需求。同时，公司也在不断认证新的合格供应商，降低供应商集中度较高的潜在风险。

问题二十八

2017 年，澜起有限将消费电子芯片业务资产转让至澜至电子科技（成都）有限公司及其关联公司，Montage Holding 同时控制了上海澜至、澜至半导体等公司。

请发行人说明：（1）成都澜至、上海澜至、澜至半导体的实际控制人，穿透后直接和间接股东与发行人的直接或间接股东是否存在重叠的情形；（2）成都澜至、上海澜至、澜至半导体的主营业务、业务规模（收入和毛利）等情况，其历史沿革、资产、人员、技术、主营业务（包括但不限于产品服务的具体特点、商标商号等）等方面与发行人是否存在关系；（3）成都澜至、上海澜至、澜至半导体的主营业务与发行人相比是否具有替代性、竞争性、是否有利益冲突，报告期内是否与发行人存在人员、技术、业务或资金往来，销售渠道、主要客户及供应商是否存在重叠。

请保荐机构和发行人律师对上述事项进行核查，说明核查方式、过程及依据，并就成都澜至、上海澜至、澜至半导体是否与发行人构成重大不利影响的同业竞争发表明确核查意见。

回复：

28.1 发行人说明

一、成都澜至、上海澜至、澜至半导体的实际控制人，穿透后直接和间接股东与发行人的直接或间接股东是否存在重叠的情形；

截至 2018 年 12 月 31 日，成都澜至、上海澜至和澜至半导体穿透后的股东均为 Montage Holding，无实际控制人。Montage Holding 穿透后直接和间接股东与公司的直接或间接股东存在部分重叠的情形。

二、成都澜至、上海澜至、澜至半导体的主营业务、业务规模（收入和毛利）等情况，其历史沿革、资产、人员、技术、主营业务（包括但不限于产品服务的具体特点、商标商号等）等方面与发行人是否存在关系；

2017 年 3 月，Montage HK 在成都市双流区投资设立成都澜至，注册资本为人民币 5 亿元。成都澜至主营业务为消费电子及家庭智能娱乐芯片的设计和 sales，成都澜至提供机顶盒整体解决方案，提供调谐器、解调器和解码器 SoC 全套芯

片以及为客户定制的软件，支持有线、卫星、地面数字电视的免费和付费市场及 IPTV/OTT 网络机顶盒的应用；同时提供 Wi-Fi 应用处理器 SoC，网络接口控制器（NIC）和物联网（IoT）Wi-Fi MCU 等芯片及解决方案。2018 年成都澜至未经审计的营业收入为 27,167.32 万元，毛利润为 7,825.03 万元。

2017 年 5 月，成都澜至和上海澜至在上海投资设立了上海澜至半导体有限公司，注册资本金为 1000 万元。澜至半导体主要从事消费电子芯片相关业务的研发和设计工作。2018 年澜至半导体未经审计的营业收入为 7,594.34 万元，毛利润为 2,817.23 万元。

2016 年 7 月 6 日，Montage HK 在上海投资设立了澜至电子科技（上海）有限公司，注册资本金为 200 万美元。上海澜至原主要从事消费电子芯片相关业务的研发支持工作。自 2018 年起无实质经营。

Montage Group 自成立以来，一直保持了持续的运营及研发，发展出内存接口芯片及消费电子芯片两条产品线，消费电子芯片应用于家庭和移动终端，而内存接口芯片应用于云端数据中心。由于原消费电子芯片业务分散在 Montage Group 各个子公司内，2017 年管理层及股东为优化资源配置、提升运营效率、提高团队自主性及积极性，决定公司聚焦于服务器芯片领域，成都澜至聚焦于消费电子芯片领域，让不同业务在不同的主体内独立发展，因此决定进行资产重组。2017 年 7 月 31 日，Montage Holding 作出董事会决议，同意将澜起有限所持有的消费电子芯片业务相关资产出售给成都澜至、澜至半导体及 Montage Group。同时，原服务于消费电子芯片业务的澜起有限员工的劳动关系转移至澜至半导体。

自上述资产转让后，公司同成都澜至并不存在业务往来。公司保留的业务与成都澜至在技术应用、产品形态、技术基础、销售渠道、客户构成、业务发展方向等均存在显著差异，商标商号、资产、人员等均保持独立。公司同成都澜至之间的业务区别详见本题回复第三部分。

三、成都澜至、上海澜至、澜至半导体的主营业务与发行人相比是否具有替代性、竞争性、是否有利益冲突，报告期内是否与发行人存在人员、技术、业务或资金往来，销售渠道、主要客户及供应商是否存在重叠

截至本问询函回复签署日，成都澜至及其关联方与公司均独立运作，虽均属于集成电路设计行业，但公司从事的以内存接口芯片为主的服务器芯片业务与成

都澜至及其关联方从事的以机顶盒芯片为主的消费电子芯片业务存在明显差异。

（1）应用领域及产品形态不同

公司目前主要产品包括内存接口芯片、津逮[®]服务器平台解决方案，其中内存接口芯片应用于内存条，是协助中央处理器存取内存数据，提升内存数据访问速度及稳定性的核心器件，CPU 是解释计算机指令以及处理计算机软件中的数据的核心器件，两类产品的终端应用均为计算机，主要应用于数据中心和云计算相关领域。成都澜至的机顶盒芯片是机顶盒核心器件与配套软件，作用是优化机顶盒的信号处理性能和接收性能，其终端应用为机顶盒，主要应用于家庭娱乐领域。公司产品同成都澜至产品在产品线构造、产成品类型、产成品功能用途方面存在显著差异。

（2）技术基础不同

公司作为集成电路设计公司，其技术水平及技术应用决定了产品的核心竞争力，公司主要产品中，内存接口芯片需遵循内存接口芯片技术标准，主要为 JEDEC 之 DDR 标准，例如 DDR2，DDR3，DDR4，DDR5 等，其产品主要通过 CPU、内存、服务器 OEM 厂商的认证。公司的津逮[®]CPU 是公司在英特尔至强处理器的基础上，结合清华的可重构运算架构和公司自身的安全内存技术，实现安全可控的处理器技术。成都澜至的机顶盒芯片技术遵循机顶盒芯片技术标准，即广播模式下的机顶盒声音标准和影像标准，包括 DVB 标准（国际通用广播模式标准）、MPEG2/4（解压缩标准）等，其产品的主要的方式为高安认证。除上述技术、认证、标准不同外，公司同成都澜至产品在技术路线、架构和工艺等方面，均存在明显不同，相关专利及研发人员均完全独立及分开，公司同成都澜至在产品技术上存在明显差异。

（3）销售渠道及客户构成不同

公司主要产品内存接口芯片以及津逮[®]服务器平台主要应用于数据中心及云计算，其销售模式以直销为主，公司主要客户包括三星、海力士、金士顿等主要内存厂商及联想、长城等服务器 OEM 厂商。成都澜至由于终端客户为使用机顶盒的普通消费者，其销售主要采取经销模式，通过机顶盒领域的专业经销商包括

淇诺、CEAC、Hongri 等，将产品销售至机顶盒制造厂商如长虹、Dream-link、Vestel 等。公司与成都澜至主要客户不存在重叠，双方在销售渠道、客户性质、客户所处行业和客户主营业务均存在显著差异。

（4）业务发展方向不同

公司未来三年的发展目标是通过持续不断的研发创新，提升公司在细分行业的市场地位和影响力。其中，在内存接口芯片业务领域，巩固公司的市场领先地位，在未来三年完成第一代 DDR5 内存接口芯片的研发和产业化；在数据中心业务领域，持续升级津逮®服务器 CPU 及其平台，为数据中心提供高性能、高安全、高可靠性的 CPU、混合安全内存模组等产品，持续提升市场份额；在人工智能芯片领域，公司将聚焦客户需求，挖掘潜在商机，研发有竞争力的芯片解决方案，为公司的可持续发展提供新的业务增长点。成都澜至主要目标为完善产品符合国际高安方案如 Verimatrix, Irdeto, Conax, Nagra, NDS 等进而提升产品价值。公司与成都澜至在未来的业务发展方向上存在显著差异。

综上所述，公司同成都澜至、上海澜至、澜至半导体在应用领域、技术基础、销售渠道及业务方向上存在显著差异，同时在技术层面的工艺、技术路线、架构上均存在明显不同。公司同成都澜至、上海澜至、澜至半导体主营业务不具有替代性、竞争性、不存在利益冲突。除招股说明书已披露的关联交易和资金往来外，报告期内成都澜至、上海澜至、澜至半导体与公司不存在人员、技术、业务或资金往来。

公司同成都澜至仅存在个别客户和供应商重叠，自 2017 年 8 月出售消费电子芯片业务相关资产后，仅有中电器材一家重叠的客户，且 2018 年公司对其销售占公司营业收入的比例低于 0.2%。自 2017 年 8 月出售消费电子芯片业务相关资产后，公司同成都澜至的重叠供应商包括联华电子、矽品科技。其中联华电子和矽品科技是成都澜至的主要供应商，但 2018 年公司向联华电子和矽品科技采购占公司总采购额的比例合计低于 3%，且公司产品同成都澜至产品在生产工艺上完全不同，采购订单完全区分，独立议价，独立采购，不存在交叉采购、代垫成本费用等情形。

综上所述，公司与成都澜至及其关联方之间不存在同业竞争。

28.2 保荐机构和发行人律师核查意见

核查过程：

1、保荐机构和发行人律师获取并审阅了成都澜至穿透至 Montage Holding 的股东变更情况登记表；审阅了公司及成都澜至自设立以来历次股权变化的工商文件；审阅了成都澜至的公司章程；访谈了成都澜至总经理并对公司股权变化进行充分的了解；

2、获取并审阅了成都澜至、上海澜至、澜至半导体的财务报表，查询了三家公司的工商信息等基本资料，访谈了成都澜至总经理、研发工程副总裁及财务总监，对公司的主营业务和业务规模进行充分的了解，并就成都澜至的历史沿革、资产、人员、技术、主营业务等方面与发行人之间的关系进行访谈，获取并审阅了发行人与成都澜至签署的相关文件，获取并审阅了双方签署的一系列资产转让协议；

3、获取并审阅了发行人主营业务相关的核心技术名称、性质、取得方式、用途、使用情况，获取并审阅了发行人报告期内的销售及客户明细和采购及供应商明细；

4、取得了各主要股东出具的《澜起科技股份有限公司股东关于避免同业竞争的承诺函》，并对公司及成都澜至管理层进行了访谈。

核查结论：

经核查，保荐机构和发行人律师认为，成都澜至及其关联方的主营业务与发行人相比不具有替代性、竞争性、不存在利益冲突，除招股说明书已披露的关联交易和资金往来外，报告期内成都澜至、上海澜至、澜至半导体与发行人不存在人员、技术、业务或资金往来。

发行人与成都澜至及其关联方之间不存在同业竞争。

问题二十九

2018年11月,Intel、SVIC在发行人申报前进行增资,分别取得发行人10%、1.111%的股份,发行人与Intel之间的关联交易预计持续发生,2017年,发行人同Intel签署合作协议,由Intel向发行人提供研发支持,招股说明书未将与三星公司的交易认定为关联交易。

请发行人说明:(1)招股说明书是否严格按照《公司法》、企业会计准则及中国证监会有关规定披露关联方,三星公司是否应当认定为发行人的关联方;(2)请结合Intel、三星公司直接或间接持股发行人的情况,说明发行人与Intel、三星公司的合作背景及历史,Intel、SVIC入股发行人的原因及商业合理性,是否为行业惯例;(3)报告期内发行人与上述企业交易的必要性、合理性及公允性,以及相关交易的交易内容、交易金额、交易背景、相关交易与发行人主营业务之间的关系。请结合可比市场公允价格、第三方市场价格、关联方与其他交易方的价格等,披露相关交易的公允性;(4)Intel入股发行人后交易金额大幅增加的原因,结合与Intel的具体合作、Intel入股后相关业务的发展情况、津逮[®]服务器平台的发展规划等,充分分析与Intel的关联交易是否存在持续增加的趋势,未来如何保证关联交易定价的公允性,必要时请作重大事项提示;(5)Intel向发行人提供研发支持的具体情况,包括合作模式、主要协议约定、研发支持的主要项目、研发成果的所有权等,相关研发成果是否属于发行人的核心技术,对发行人生产经营的重要程度,发行人核心技术及未来生产经营是否存在对Intel的重大依赖;(6)报告期内,发行人与上述企业及其他关联交易是否履行了必要的决策程序,相关内部控制制度是否健全且得到有效执行;(7)结合Intel、三星公司的财务状况和经营情况、交易产生的收入、利润总额等,披露该等交易是否影响发行人的经营独立性、发行人是否构成对该等客户的依赖,是否存在通过该等交易调节发行人收入利润或成本费用、对发行人利益输送的情形,必要时请作重大事项提示。

请保荐机构及发行人律师基于谨慎性原则,对上述事项进行核查,说明核查方式、过程及依据,并对发行人是否存在严重影响独立性或显示公平的关联交易发表明确意见。

回复:

29.1 发行人说明

一、招股说明书是否严格按照《公司法》、企业会计准则及中国证监会有关规定披露关联方，三星公司是否应当认定为发行人的关联方；

招股说明书已严格按照《公司法》、企业会计准则及中国证监会有关规定披露关联方，三星电子的关联方 SVIC No. 28 Investment 在公司的持股比例为 1.111%，根据关联方的认定规则，三星电子不属于公司的关联方。

二、请结合 Intel、三星公司直接或间接持股发行人的情况，说明发行人与 Intel、三星公司的合作背景及历史，Intel、SVIC 入股发行人的原因及商业合理性，是否为行业惯例；

1、公司与 Intel、三星公司的合作背景及历史

Intel 与公司于 2006 年建立合作关系，双方在内存接口芯片上展开业务合作。并从 2016 年开始公司同清华大学、Intel 开展合作，联合研发津逮®服务器 CPU。

公司与三星电子于 2012 年开始建立业务合作关系，主要向三星电子销售内存接口芯片。

公司自创立以来，一直从事内存接口芯片的设计与研发工作，经过长期的技术积累和持续创新，不断推出符合行业标准的新产品，并同 Intel、三星电子建立了长期的稳定合作关系。上述合作均基于正常的商务合作，具有合理性。

2、Intel、SVIC 入股公司的原因及商业合理性，是否为行业惯例

伴随着公司与 Intel 和三星电子在合作领域的不断深入，Intel Capital、SVIC No. 28 Investment 较为看好公司未来盈利前景及技术水平，有意进一步加深合作，同时获取投资回报，因此 Intel Capital、SVIC No. 28 Investment 选择入股公司，具有商业合理性，符合行业惯例。

三、报告期内发行人与上述企业交易的必要性、合理性及公允性，以及相关交易的交易内容、交易金额、交易背景、相关交易与发行人主营业务之间的关系。请结合可比市场公允价格、第三方市场价格、关联方与其他交易方的价格等，披露相关交易的公允性；

报告期内公司相关交易的情况如下：

1、公司与三星电子的交易

公司主要产品内存接口芯片是内存模组（又称内存条）的核心器件，三星电

子作为全球最大的内存厂商，在市场上占据了主要的市场份额，是公司产品的直接下游客户。报告期内，公司同三星电子均有交易，且交易额随着公司市场占有率的提升逐年上升，2018 年销售收入超过 4 亿元。公司同其开展合作具有必要性及合理性。由于商业机密等原因，公司与三星电子的交易无公开的可比市场公允价格及第三方市场价格。但公司销售给三星电子的产品单价同销售给其他第三方的产品单价不存在显著差异。同时三星电子关联方入股公司后，公司向三星电子销售的内存接口芯片产品单价和定价方式与三星电子关联方入股前基本一致，不存在重大变化，公司同三星电子的相关交易定价公允。

2、公司与 Intel 的交易

Intel 作为全球最大的 CPU 厂商，在 x86 处理器领域占有主要的市场地位。报告期内，公司同关联方 Intel 进行合作，并于 2018 年开始采购其通用 CPU 内核芯片用于研发，预计随着公司津逮®服务器平台的研发成功，公司将持续采购其通用 CPU 内核芯片用于生产。同时 Intel 向公司采购混合安全内存模组等用于其自身的研发、实验生产等，相关交易将持续发生，具有必要性、合理性。

报告期内的交易情况具体如下：

(1) 采购商品

报告期内，公司向 Intel 及其关联方采购的情况如下：

单位：万元

项目	2018 年度	2017 年度	2016 年度
采购金额	2,708.58	-	-
占公司总采购的比例	3.68%	-	-

公司同关联方 Intel 进行合作，并于 2018 年开始采购其 CPU 用于研发，2018 年公司向 Intel 采购的金额为 2,708.58 万元，占 2018 年度总采购金额的比例为 3.68%，占比较小。由于双方为合作关系相关产品采购为合作研发使用，且涉及商业机密，因此无第三方价格或市场公开价格。在 Intel 入股公司后，公司向 Intel 采购的服务器 CPU 单价和定价方式与 Intel 入股前基本一致，不存在重大变化，相关交易定价公允。

(2) 销售商品

报告期内，公司向 Intel 及其关联方销售的情况如下：

单位：万元

项目	2018 年度	2017 年度	2016 年度
销售金额	560.93	757.56	15.06
占公司营业收入的比例	0.32%	0.62%	0.02%

报告期内，公司根据 Intel 采购需求，向其销售混合安全内存模组等产品，销售价格为双方协商按公允价格销售。2016 年、2017 年及 2018 年销售金额分别为 15.06 万元、757.56 万元及 560.93 万元，占公司营业收入比分别为 0.02%，0.62% 及 0.32%，销售金额占比较小。相关混合安全内存模组销售价格同公司销售给第三方价格不存在重大差异，相关交易定价公允。此外，Intel 入股公司后，公司暂未向 Intel 销售相关产品。

四、Intel 入股发行人后交易金额大幅增加的原因，结合与 Intel 的具体合作、Intel 入股后相关业务的发展情况、津逮®服务器平台的发展规划等，充分分析与 Intel 的关联交易是否存在持续增加的趋势，未来如何保证关联交易定价的公允性，必要时请作重大事项提示；

2015 年 9 月，公司与清华大学、Intel 就合作事宜签署谅解备忘录，公司与清华大学、Intel 合作研发津逮®服务器 CPU，其中公司负责整体模块及部分芯片的设计，清华大学提供可重构计算处理器（RCP）的算法，Intel 提供其通用 CPU 内核芯片，并由公司委托第三方进行芯片制造、封装和测试。

津逮®服务器 CPU 于 2018 年研发成功，并进入市场推广阶段。因此 2018 年起，公司开始向 Intel 采购相关通用 CPU 内核芯片用以生产，导致公司同 Intel 的交易金额增加。

此项合作早于 Intel Capital 投资公司，是先有合作关系再有投资关系，并非因投资造成交易金额大量上升。

津逮®CPU 是澜起科技推出的一系列具有预检测和动态安全监控功能的 x86 架构处理器，适用于津逮®或其他通用的服务器平台。津逮®CPU 在英特尔 x86 处理器的基础上集成了清华大学的 DSC 技术，可与澜起科技的混合安全内存模组（HSDIMM®）搭配而组成津逮®服务器平台，为云计算服务器提供芯片级的

动态安全监控功能。此外，津逮[®]CPU 还融合了先进的异构计算与互联技术，可为未来人工智能和大数据应用提供强大的综合数据处理和计算力支撑。为保持津逮[®]服务器平台总体技术水平与国际先进水平同步，要求公司紧跟英特尔最新 CPU 产品和内存技术的发展，不断更新产品。因此，随着津逮[®]服务器平台的量产及推广，公司与 Intel 的关联交易存在持续增加的可能。

公司已制定了《澜起科技股份有限公司关联交易制度》，对关联交易的决策程序进行了详细地约定，保证按照正常的商业条件进行交易，保证交易价格的公允性。同时，相关交易将严格履行公司内部决策程序，相关董事、股东回避表决，并将充分履行披露义务。

五、Intel 向发行人提供研发支持的具体情况，包括合作模式、主要协议约定、研发支持的主要项目、研发成果的所有权等，相关研发成果是否属于发行人的核心技术，对发行人生产经营的重要程度，发行人核心技术及未来生产经营是否存在对 Intel 的重大依赖；

Intel 与公司的合作模式为合作研发，研发支持的主要项目为津逮[®]服务器 CPU 项目。

其中 2016 年 1 月，公司与 Intel 签署了合作协议，合作协议的具体约定包括：

1、各方影响另一方提供途径或权限使用其相关的背景技术并用于指定目的，同时各方保留其背景技术的所有权利和利益的全部独家所有权；

2、Intel 将为公司提供英特尔系统架构和英特尔专有外部代理平台接口等英特尔交付技术，同时各方授予对方相关的许可用于津逮[®]服务器平台产品的测试、演示和验证；

3、任何单独创造的知识产权均由研发该技术的一方独立拥有；共同发明的专利权将通过指导委员会会议对共同发行的专利权的所有权进行分配；

4、如果在选择过程结束时，仍有尚未分配的共同发明，那么这些共同发明的所有权将自动成为双方共同拥有。

2017 年，公司同 Intel 签署相关合作协议，为支持津逮[®]服务器 CPU 的应用和推广，由 Intel 向公司提供研发支持 210 万美元。

该研发项目研发成果为津逮[®]服务器 CPU 及其平台，该产品所有权及品牌归公司所有。该成果中包含了公司的核心技术，相关技术为公司自主研发所得。

报告期内，津逮[®]服务器 CPU 及其平台处于研发阶段，其销售收入占公司收入比重低于 1%，对报告期内公司的经营影响较小。在未来三年，内存接口芯片业务仍将为公司主要收入和利润来源。为丰富公司的产品线布局，储备未来业务的增长点，提升公司的综合竞争能力，公司同清华大学及 Intel 联合研发了津逮[®]服务器 CPU，其品牌及产品产权归公司所有，且由公司委托第三方进行芯片制造、封装和测试，形成最终产品后由公司统一销售。公司向 Intel 相关主体采购其通用 CPU 内核芯片，是基于前述背景的正常业务合作与采购。

综上所述，公司核心技术及未来生产经营不存在对 Intel 的重大依赖。

六、报告期内，发行人与上述企业及其他关联交易是否履行了必要的决策程序，相关内部控制制度是否健全且得到有效执行；

2018 年 10 月 28 日，公司召开第一届董事会第一次会议审议通过了《关于公司与英特尔公司 2018 年日常关联交易预计的议案》，同日，公司召开创立大会暨 2018 年第一次股东大会，审议通过了《关于澜起科技股份有限公司关联交易制度的议案》。

2019 年 2 月 22 日，公司召开第一届董事会第四次会议审议通过了《关于确认公司 2016、2017、2018 年度各项关联交易的议案》，2019 年 3 月 5 日，公司召开 2019 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于确认公司 2016、2017、2018 年度各项关联交易的议案》。

报告期内，公司与上述企业及其他关联交易已履行了必要的决策程序，公司具备健全的相关内部控制制度且得到了有效执行。

七、结合 Intel、三星公司的财务状况和经营情况、交易产生的收入、利润总额等，披露该等交易是否影响发行人的经营独立性、发行人是否构成对该等客户的依赖，是否存在通过该等交易调节发行人收入利润或成本费用、对发行人利益输送的情形，必要时请作重大事项提示。

2018 财年 Intel 的营业收入为 708.48 亿美元，主营业务成本为 271.11 亿美元，2018 年公司向 Intel 采购的金额为 2,708.58 万元，占 Intel 收入的比例低于万分之一。

报告期内公司向 Intel 销售产生的收入及占比情况如下：

关联方	2018 年度	2017 年度	2016 年度
Intel 销售金额（万元）	560.93	757.56	15.06
占营业收入比例	0.32%	0.62%	0.02%

由上表可知,2016 年至 2018 年公司向 Intel 销售产生的收入占营业收入的比例分别为 0.02%、0.62%和 0.32%，总体占比较小，同时公司相关销售占 Intel 同期主营业务成本的比例可以忽略不计。因此，与 Intel 的交易不影响公司的经营独立性、公司对 Intel 不构成重大依赖。

2018 财年三星电子的营业收入为 243.77 万亿韩元，主营业务成本为 132.394 万亿韩元，2018 年公司公司向三星电子销售的金额占三星电子主营业务成本的比重低于千分之一。

报告期内，三星电子一直是公司的前五大客户，但公司来自于三星电子的销售占公司营业收入的比例均不超过 30%，且三星电子不属于公司的关联方，相关销售均按照正常的商业条件进行交易，不影响公司的经营独立性、公司对三星电子不构成重大依赖。三星电子不属于公司的关联方，相关销售均按照正常的商业条件进行交易，不影响公司的经营独立性、公司对三星电子不构成重大依赖。

综上，上述交易不影响公司的经营独立性、公司对该等客户不存在重大依赖，不存在通过该等交易调节公司收入利润或成本费用、不存在对公司利益输送的情形。

29.2 保荐机构和发行人律师核查意见

核查过程:

1、保荐机构和发行人律师获取并审阅了发行人的工商底稿。

2、访谈了 Intel、三星苏州和三星电子，对发行人与 Intel、三星苏州和三星电子的合作背景与历史以及入股发行人的背景及原因；获取并审阅了 Intel、发行人和清华大学签署的谅解备忘录、Intel 和发行人签署的合作协议；对发行人的业务部门进行了访谈，对内存接口芯片的产业链及与服务器厂商和内存模组厂商的关系进行了充分的了解。

3、获取并审阅了发行人内存接口芯片的销售明细；获取并审阅了发行人与

Intel 的关联销售明细。

4、对发行人的研发人员及业务人员进行了访谈，针对 Intel 与公司的具体合作以及津逮®服务器平台的发展规划进行了充分的了解；获取并审阅了发行人制定的关联交易制度、发行人审议通过的《关于确认公司 2016、2017、2018 年度各项关联交易的议案》及《关于公司与英特尔公司 2018 年日常关联交易预计的议案》；

核查结论：

经核查，保荐机构和发行人律师认为：

1、招股说明书已严格按照《公司法》、企业会计准则及中国证监会有关规定披露关联方，三星公司不属于发行人的关联方。

2、Intel Capital、SVIC No. 28 Investment 入股发行人具有商业合理性，符合行业惯例。

3、发行人同 Intel 及三星的交易具有必要性及合理性，销售价格按照市场原则来确定，定价公允。

4、发行人与 Intel 的关联交易存在持续增加的可能，发行人对关联交易的决策程序进行了规定，保证按照正常的商业条件进行交易并按照法规履行披露义务，并将能够充分保证此类关联交易价格的公允性。

5、发行人核心技术及未来生产经营不存在对 Intel 的重大依赖。

6、报告期内，发行人与上述企业及其他关联交易已履行了必要的决策程序，发行人具备健全的相关内部控制制度且得到了有效执行。

7、发行人与 Intel 和三星电子的交易不影响发行人的经营独立性、发行人对该等客户不存在依赖，不存在通过该等交易调节发行人收入利润或成本费用、不存在对发行人利益输送的情形。

问题三十

请发行人根据《准则》第六十八条的规定，披露与财务会计信息相关的重大事项或重要性水平的判断标准；根据《准则》第七十一条的规定，结合自身业务活动实质、经营模式特点及关键审计事项等，披露对公司财务状况和经营成果有重大影响的会计政策和会计估计，针对性披露相关会计政策和会计估计的具体标准，不应简单重述一般会计原则；根据《准则》第七十五条的规定，以管理层的视角，结合“业务与技术”中披露的业务、经营模式、技术水平、竞争力等要素披露报告期内取得经营成果的逻辑。

回答：

30.1 发行人补充披露

公司已在招股说明书“第八节 财务会计信息与管理层分析”之“二、重要会计政策和会计估计”中补充披露如下：

经营成果方面主要分析影响营业收入、利润总额和净利润 5%以上事项；资产质量方面主要分析占流动资产或非流动资产比例 5%以上事项；偿债能力方面主要分析占负债总额 5%以上事项；上述三个方面年度间财务数据变动，主要分析变动金额重大且变动比例超过 30%的事项；现金流量表主要分析经营活动现金流量；其他方面分析主要考虑会对公司未来经营成果、财务状况、现金流量、流动性及持续经营能力造成重大影响以及可能会影响投资者投资判断的事项。

（一）会计期间

本公司的会计期间为公历 1 月 1 日至 12 月 31 日。

（二）记账本位币

人民币为公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币，公司及境内子公司以人民币为记账本位币。公司之境外子公司根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定美元为其记账本位币。公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

（三）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

1、同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

2、非同一控制下企业合并

发行人报告期内不存在非同一控制下企业合并。

（四）合并财务报表的编制方法

本公司合并范围包括公司及全部控制的子公司。

（五）现金及现金等价物的确定标准

公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及公司持有的期限短（一般为从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

（六）外币业务和外币报表折算

（1）外币交易的折算方法

公司发生的外币交易在初始确认时，按交易日的上月的月末汇率折算为记账本位币金额，但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。

(2) 对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除：①属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理；②用于境外经营净投资有效套期的套期工具的汇兑差额（该差额计入其他综合收益，直至净投资被处置才被确认为当期损益）；以及③可供出售的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，均计入当期损益。

以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

(3) 外币财务报表的折算方法

编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，作为“外币报表折算差额”确认为其他综合收益；处置境外经营时，计入处置当期损益。

境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表：资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；股东权益类项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的上月的月末汇率折算。年初未分配利润为上一年折算后的年末未分配利润；年末未分配利润按折算后的利润分配各项目计算列示；折算后资产类项目与负债类项目和股东权益类项目合计数的差额，作为外币报表折算差额，确认为其他综合收益。处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生日的上月的月末汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

年初数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。

（七）金融工具

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关的交易费用直接计入损益；对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

（1）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。金融工具不存在活跃市场的，公司采用估值技术确定其公允价值。

（2）金融资产的分类、确认和计量

金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。

报告期内，发行人金融资产主要系应收款项。应收款的金融资产包括应收票据、应收账款、应收利息、应收股利及其他应收款等。

（3）金融资产减值

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，公司在每个资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。

公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

应收款项减值是以成本或摊余成本计量的金融资产将其账面价值减记至预

计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。金融资产在确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，金融资产转回减值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

(5) 金融负债

报告期内，发行人不存在金融负债。

(八) 应收款项

应收款项包括应收账款、其他应收款等。

(1) 坏账准备的确认标准

公司在资产负债表日对应收款项账面价值进行检查，对存在下列客观证据表明应收款项发生减值的，计提减值准备：①债务人发生严重的财务困难；②债务人违反合同条款（如偿付利息或本金发生违约或逾期等）；③债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；④其他表明应收款项发生减值的客观依据。

(2) 坏账准备的计提方法

① 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法

公司将金额为人民币500.00万元以上的应收款项确认为单项金额重大的应收款项。

公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。

② 按信用风险组合计提坏账准备的应收款项的确定依据、坏账准备计提方法

A. 信用风险特征组合的确定依据

公司对单项金额不重大以及金额重大但单项测试未发生减值的应收款项，按信用风险特征的相似性和相关性对金融资产进行分组。这些信用风险通常反映债务人按照该等资产的合同条款偿还所有到期金额的能力，并且与被检查资产的未来现金流量测算相关。

不同组合的确定依据：

项目	确定组合的依据
账龄组合	账龄
其他组合	(1) 合并范围内及对关联公司资金拆借的应收款项 (2) 房租押金

B. 根据信用风险特征组合确定的坏账准备计提方法

按组合方式实施减值测试时，坏账准备金额系根据应收款项组合结构及类似信用风险特征（债务人根据合同条款偿还欠款的能力）按历史损失经验及目前经济状况与预计应收款项组合中已经存在的损失评估确定。

不同组合计提坏账准备的计提方法：

项目	计提方法
账龄组合	账龄分析法
其他组合	个别认定法

a. 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的组合计提方法

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1年以内 (含1年, 下同)		
其中: 3个月以内	0.00	0.00
3~12个月	5.00	5.00
1-2年	10.00	10.00
2-3年	30.00	30.00
3年以上	100.00	100.00

b. 组合中，采用个别认定法计提坏账准备的计提方法说明

组合名称	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
其他组合	对组合内关联方应收款项、房租押金单独测试计提坏账	

③ 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

公司将金额为人民币500.00万元以下的应收款项确认为单项金额不重大的应收款项。

公司对于单项金额虽不重大但具备以下特征的应收款项，单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。如：应收关联方款项；与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。

(3) 坏账准备的转回

如有客观证据表明该应收款项价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该应收款项在转回日的摊余成本。

(九) 存货

(1) 存货的分类

存货主要包括原材料、委托加工物资、库存商品、发出商品等。

(2) 存货取得和发出的计价方法

存货在取得时按计划成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。对计划成本和实际成本之间的差异，通过成本差异科目核算，并按期结转发出存货应负担的成本差异，将计划成本调整为实际成本。

(3) 存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值

低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备；对在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，可合并计提存货跌价准备。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

(4) 存货的盘存制度为永续盘存制。

(5) 低值易耗品的摊销方法

低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销；包装物于领用时按一次摊销法摊销。

(十) 长期股权投资

本公司长期股权投资主要是对子公司的投资。本公司对子公司投资采用成本法核算。

(十一) 固定资产

(1) 固定资产确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入公司，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。

(2) 各类固定资产的折旧方法

固定资产从达到预定可使用状态的次月起，采用年限平均法在使用寿命内计提折旧。各类固定资产的使用寿命、预计净残值和年折旧率如下：

类别	折旧方法	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
电子设备	年限平均法	3-5	0	20.00-33.33
办公设备	年限平均法	3-5	0	20.00-33.33

预计净残值是指假定固定资产预计使用寿命已满并处于使用寿命终了时的预期状态，公司目前从该项资产处置中获得的扣除预计处置费用后的金额。

(3) 固定资产的减值测试方法及减值准备计提方法

固定资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见本章节“(十七) 长期资产减值”。

(十二) 在建工程

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。

在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见本章节“(十七) 长期资产减值”。

(十三) 无形资产

(1) 无形资产

无形资产是指公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入公司且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值减去预计净残值和已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

(2) 研究与开发支出

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

① 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

② 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

③ 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

④ 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

⑤ 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

(3) 无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见本章节“(十六) 长期资产减值”。

(十四) 长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。公司的长期待摊费用主要包括租赁房屋装修款等。长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。

(十五) 长期资产减值

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则

估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

（十六）职工薪酬

公司职工薪酬主要包括短期职工薪酬、离职后福利、辞退福利以及其他长期职工福利。其中：

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。公司在职工为公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

离职后福利主要包括基本养老保险、失业保险以及年金等。离职后福利计划包括设定提存计划。采用设定提存计划的，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受

裁减而提出给予补偿的建议，在公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，和公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

职工内部退休计划采用与上述辞退福利相同的原则处理。公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定受益计划进行会计处理。

（十七）预计负债

当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，确认为预计负债：（1）该义务是公司承担的现时义务；（2）履行该义务很可能导致经济利益流出；（3）该义务的金额能够可靠地计量。

在资产负债表日，考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。

如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

（十八）股份支付

股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

（十九）收入

报告期内公司主要收入为商品销售收入。收入确认原则系：在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，既没有保留通常与所有权相联系的继续

管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

本公司销售模式分为三类：直销、经销、代销。

对于直销、经销：本公司的商品销售根据与客户签订的销售合同（订单）发货，在商品送达客户指定的交货地点，取得对方客户确认时作为风险报酬的转移时点，确认销售收入；其中本公司的出口销售业务，根据与客户签订的销售合同（订单）发货，公司持发票、送货单等原始单证进行报关出口，完成出口报关手续作为风险报酬的转移时点，根据出库单、发票和报关文件确认销售收入。

对于代销：如客户购买本公司的产品超过一定期限仍未实现对外销售时，客户可以退货给本公司的，或产品最终售价在客户销售给最终客户时才能确定的，则在收到客户对外销售的清单时，确认销售收入。

（二十）政府补助

政府补助是指公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府以投资者身份并享有相应所有者权益而投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：（1）政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；（2）政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额

计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

公司对于政府补助通常在实际收到时，按照实收金额予以确认和计量。但对于期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件预计能够收到财政扶持资金，按照应收的金额计量。按照应收金额计量的政府补助应同时符合以下条件：（1）应收补助款的金额已经过有权政府部门发文确认，或者可根据正式发布的财政资金管理办法的有关规定自行合理测算，且预计其金额不存在重大不确定性；（2）所依据的是当地财政部门正式发布并按照《政府信息公开条例》的规定予以主动公开的财政扶持项目及其财政资金管理办法，且该管理办法应当是普惠性的（任何符合规定条件的企业均可申请），而不是专门针对特定企业制定的；（3）相关的补助款批文中已明确承诺了拨付期限，且该款项的拨付是有相应财政预算作为保障的，因而可以合理保证其可在规定期限内收到。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。

同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，将其整体归类为与收益相关的政府补助。

与公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务的实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

已确认的政府补助需要退回时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。

（二十一）递延所得税资产/递延所得税负债

（1）当期所得税

资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），以按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量。计算当期所得

税费用所依据的应纳税所得额系根据有关税法规定对本报告期税前会计利润作相应调整后计算得出。

(2) 递延所得税资产及递延所得税负债

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

此外，对与子公司相关的应纳税暂时性差异，如果公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

于资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

(3) 所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

除确认为其他综合收益或直接计入股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

(4) 所得税的抵销

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，公司当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，公司递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

(二十二) 其他重要的会计政策和会计估计

终止经营，是指满足下列条件之一的、能够单独区分且已被公司处置或划分为持有待售类别的组成部分：①该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；②该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；③该组成部分是专为转售而取得的子公司。

(二十三) 重大会计判断和估计

公司在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，公司需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于公司管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及

资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的实际结果可能与公司管理层当前的估计存在差异，进而造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

公司对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。

于资产负债表日，公司需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下：

(1) 租赁的归类

公司根据《企业会计准则第 21 号——租赁》的规定，将租赁归类为经营租赁和融资租赁，在进行归类时，管理层需要对是否已将与租出资产所有权有关的全部风险和报酬实质上转移给承租人，或者公司是否已经实质上承担与租入资产所有权有关的全部风险和报酬，作出分析和判断。

(2) 坏账准备计提

公司根据应收款项的会计政策，采用备抵法核算坏账损失。应收款项减值是基于评估应收款项的可收回性。鉴定应收款项减值要求管理层的判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响应收款项的账面价值及应收款项坏账准备的计提或转回。

(3) 存货跌价准备

公司根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

(4) 长期资产减值准备

公司于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿命不确定的无形资产，除每年进行的减值测试外，当其存在减值迹象时，也进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。

当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。

公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。

在预计未来现金流量现值时，需要对该资产（或资产组）的产量、售价、相关经营成本以及计算现值时使用的折现率等作出重大判断。公司在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料，包括根据合理和可支持的假设所作出有关产量、售价和相关经营成本的预测。

公司至少每年测试商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组或者资产组组合的未来现金流量的现值进行预计。对未来现金流量的现值进行预计时，公司需要预计未来资产组或者资产组组合产生的现金流量，同时选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。

（5）折旧和摊销

公司对投资性房地产、固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。公司定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是公司根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

（6）递延所得税资产

在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，公司就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要公司管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

(7) 所得税

公司在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异，则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。

(8) 预计负债

公司根据合约条款、现有知识及历史经验，对产品质量保证、预计合同亏损、延迟交货违约金等估计并计提相应准备。在该等或有事项已经形成一项现时义务，且履行该等现时义务很可能导致经济利益流出公司的情况下，公司对或有事项按履行相关现时义务所需支出的最佳估计数确认为预计负债。预计负债的确认和计量在很大程度上依赖于管理层的判断。在进行判断过程中公司需评估该等或有事项相关的风险、不确定性及货币时间价值等因素。

其中，公司会就出售、维修及改造所售商品向客户提供的售后质量维修承诺预计负债。预计负债时已考虑公司近期的维修经验数据，但近期的维修经验可能无法反映将来的维修情况。这项准备的任何增加或减少，均可能影响未来年度的损益。

发行人已在招股说明书“第八节 财务会计信息与管理层分析”之“六、经营成果分析”中补充披露取得经营成果的逻辑如下：

报告期内随着云计算和人工智能对服务器需求的持续增长，推动服务器内存及内存接口芯片需求的持续增长。

公司经过多年的技术积累，是全球可提供从 DDR2 到 DDR4 内存全缓冲/半缓冲完整解决方案的主要供应商之一，公司发明的 DDR4 全缓冲“1+9”架构被 JEDEC（全球微电子产业的领导标准机构）采纳为国际标准。因此，随着产品竞争力的不断提高，报告期内公司内存接口芯片的市场占有率不断提升，从而推动公司内存接口芯片销量和收入快速增长。

公司坚持自主创新并注重知识产权保护，截至 2019 年 4 月 1 日，公司已获授权专利 90 项，获集成电路布图设计证书 39 项。2016 年度、2017 年度和 2018

年度，公司研发投入分别为 19,822.69 万元、18,826.93 万元和 27,669.52 万元，研发投入较大，且占营业收入的比例保持在 15%以上，高研发投入形成了公司的核心竞争力，使得公司的内存接口芯片毛利率维持在较高水平。

报告期内公司客户和供应商关系稳定，且主要客户均为国际知名企业，综合实力较强，业务规模较大，有利于公司业务发展的稳定性和持续性。而且公司主要客户的资产规模较大，信用状况良好，应收账款均可按相关约定及时回款，从而保障报告期内公司经营性现金流三年总额与净利润总额相匹配，体现了较高的盈利质量。

问题三十一

报告期内，发行人增值税缴纳金额分别为 0、2,033.05万元、203.38 万元，波动较大，且期末增值税应缴税额为 0 元。请发行人结合具体业务模式、不同业务及主体所适用的增值税政策、业务规模及适用税率等说明报告期内增值税的具体计算缴纳情况。

请保荐机构及申报会计师对上述事项进行核查，并发表明确意见。

回复：

31.1 发行人说明

1、公司境外子公司按照境外税收政策不需要缴纳增值税，缴纳增值税的主体主要是母公司及境内子公司，境内子公司主要业务情况如下：

境内主体	2016 年度		2017 年度		2018 年度	
	业务模式	适用政策	业务模式	适用政策	业务模式	适用政策
母公司	向境外销售产品	出口免抵退	向境外销售产品	出口免抵退	向澜起澳门提供特许权服务	免征增值税
	为澜起澳门提供技术开发服务	适用增值税零税率	为澜起澳门提供技术开发服务	适用增值税零税率		
			向澜起澳门提供特许权服务	免征增值税		
			转让消费电子芯片资产	按适用税率缴纳		
澜起苏州	向境外澜起澳门提供技术开发服务	适用增值税零税率	向境外澜起澳门提供技术开发服务	适用增值税零税率	无实际业务并注销	
			转让消费电子芯片资产	按适用税率缴纳		
澜起电子昆山	未成立		无收入		销售产品	按适用税率缴纳
					提供技术开发服务	按适用税率缴纳
澜起半导体	未成立		未成立		销售产品	适用保税区增值税政策

2、公司境内主体适用的增值税政策及适用税率如下：

公司报告期内的增值税率为免税、零税率、6%、11%/10%、17%/16%。

根据《财政部国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》财税（2016）36号附件3第一条第（二十六）款，纳税人提供技术转让免征增值税。因此本公司提供特许权使用免征增值税。

根据《财政部国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》财税（2016）36号附件4第一条第（三）款，向境外单位提供的完全在境外消费的研发服务适用增值税零税率。因此本公司向境外公司提供技术开发服务适用零税率。

公司其他经营租赁服务适用税率11%/10%，其他现代服务适用税率6%。

根据《财政部税务总局关于调整增值税税率的通知》财税（2018）32号规定，自2018年5月1日起，纳税人发生增值税应税销售行为或者进口货物，原适用17%/11%税率的，税率分别调整为16%/10%。

根据以上说明，境内主体向境外提供技术开发服务适用零税率，提供特许权使用免征增值税，向境外销售芯片产品执行出口免抵退，因此公司在2016年缴纳增值税0元。2017年公司境内主体缴纳2,033.05万元增值税主要是公司将消费电子芯片相关资产转让给成都澜至等公司所致。2018年1月公司缴纳203.38万元增值税主要为支付母公司2017年12月的应缴增值税。2018年公司境内主体业务无需缴纳增值税。

31.2 保荐机构和申报会计师核查过程和核查意见

核查过程：

保荐机构和申报会计师询问发行人申报增值税业务人员，查询发行人适用的增值税缴纳政策，取得税务机关出具的合规证明；根据业务情况，检查发行人及其子公司的增值税销项税额与销售数据的匹配关系，检查报告期内增值税申报和实际缴纳情况。

核查结论：

经核查，保荐机构和申报会计师认为发行人按照增值税相关法律法规的规定申报缴纳增值税，不存在违法违规的情况。

问题三十二

报告期内公司分别实现营业收入 84,494.46 万元、122,751.49 万元、175,766.46 万元，主要采用直销、代销模式。

请发行人披露：（1）报告期内产品销售单价持续上升的原因，是否与竞争对手的产品价格变动趋势一致；（2）2017年其他业务收入的单价高于主营业务收入单价的原因，内存接口芯片与消费电子芯片在技术水平、销售定价等方面的差异；（3）区分内存接口芯片、消费电子芯片分别提供报告期内的销量及价格变动情况，分析销量及价格变动的原因，量化分析销量、价格变动对营业收入的影响；（4）区分内存接口芯片、消费电子芯片分别披露直销、代销、经销收入及占比情况；（5）采用代销模式的原因，主要代销商的基本情况，代销协议有关双方权利义务关系、风险承担方式、退换货等方面的约定，2018 年末结束代销关系的原因，代销业务的会计处理原则及是否符合企业会计准则的规定；（6）韩国地区销售收入在报告期内先下降再大幅增长的原因；（7）销量或合同订单完成量等业务执行数据与收入确认数据的一致性；（8）营业收入的季节性波动情况及原因；（9）结合2018年前五名客户销售占比情况说明“不存在严重依赖少数客户的情况”的表述是否准确。

请发行人说明主要代销商的基本情况，包括成立时间、注册资本、股权结构、实际控制人或主要股东、规模、经营状况等，是否与发行人及其关联方存在关联关系。

请保荐机构说明对代销模式的核查方式、过程及依据，对上述事项进行核查并发表明确意见。

32.1 发行人说明

一、报告期内产品销售单价持续上升的原因，是否与竞争对手的产品价格变动趋势一致

报告期内，公司产品销售单价持续上升，其具体原因如下：

（1）公司于 2017 年 7 月转让了产品平均单价较低的消费电子芯片业务相关

资产，自 2017 年 8 月后不再从事消费电子芯片业务；而随着产品平均单价较高的内存接口芯片销售收入不断增长，其占总收入的比重不断提高。

(2) 内存接口芯片某一代具体产品的生命周期里，销售单价逐步降低；但随着技术迭代后，新产品因技术先进而导致售价将有所提高，因此内存接口芯片产品的平均销售单价在报告期内稳中有升。

二、2017年其他业务收入的单价高于主营业务收入单价的原因，内存接口芯片与消费电子芯片在技术水平、销售定价等方面的差异

1、2017 年其他业务收入的单价情况

2017 年其他业务收入的单价高于主营业务收入单价的原因系：一、2017 年其他业务收入中包含 4,791.88 万元的消费电子芯片业务的晶圆原材料的销售，单片晶圆成片的单价格较高；二、2017 年其他业务收入中包含房租的转租收入 402.63 万元，无对应的数量。

2、内存接口芯片与消费电子芯片在技术水平、销售定价等方面的差异

公司消费电子芯片应用于家庭娱乐终端如机顶盒和 Wi-Fi，内存接口芯片应用于服务器端，技术门槛相对较高，相关产品在产品设计和工艺技术上均存在较大差异，不具有可比性。

相关芯片的销售定价主要取决于市场供求关系，消费电子芯片市场竞争主体相对较多，而内存接口芯片目前市场竞争主体数量较少，因此，双方在销售定价上有所不同。

三、区分内存接口芯片、消费电子芯片分别提供报告期内的销量及价格变动情况，分析销量及价格变动的原因，量化分析销量、价格变动对营业收入的影响

报告期内随着云计算和人工智能对服务器需求的持续增长，推动服务器内存及内存接口芯片需求的持续增长。

公司经过多年的技术积累，是全球可提供从 DDR2 到 DDR4 内存全缓冲/半缓冲完整解决方案的主要供应商之一，公司发明的 DDR4 全缓冲“1+9”架构被 JEDEC（全球微电子产业的领导标准机构）采纳为国际标准。因此，随着产品竞

竞争力的不断提高，报告期内公司内存接口芯片的市场占有率不断提升，从而推动公司内存接口芯片销量和收入快速增长。

内存接口芯片某一代具体产品的生命周期里，销售单价逐步降低；但随着技术迭代后，新产品因技术先进而导致售价将有所提高，因此内存接口芯片产品的平均销售单价在报告期内稳中有升。

消费电子芯片销量基本保持稳定，其单价下降的主要原因为消费电子芯片市场竞争充分，在没有大的技术升级前提下，销售单价降低属正常现象。

销量、价格变动对主营业务收入的影响量化分析如下：

产品类别	影响因素	2018 年度	2017 年度
内存接口芯片	主营业务收入增长率	87.09%	67.41%
	销量增长率	79.90%	47.71%
	平均单价增长率	4.00%	13.34%
消费电子芯片	主营业务收入增长率	-	-25.25%
	销量增长率	-	5.04%
	平均单价增长率	-	-28.84%

内存接口芯片中销量增长对内存接口芯片营业收入变动影响大，消费电子芯片业务中价格下降对消费电子芯片营业收入影响大。

四、区分内存接口芯片、消费电子芯片分别披露直销、代销、经销收入及占主营业务收入的比例情况

报告期内，公司主营业务收入主要销售模式情况如下：

单位：万元

产品类别	销售模式	2018 年度		2017 年度		2016 年度	
		收入	占比	收入	占比	收入	占比
内存接口芯片	直销	138,045.67	78.54%	65,650.52	56.83%	48,036.29	56.97%
	代销	36,819.58	20.95%	27,816.28	24.08%	7,796.39	9.25%
	经销	-	-	-	-	-	-
	合计	174,865.26	99.49%	93,466.80	80.91%	55,832.67	66.22%
消费电子芯片	直销	-	-	12,492.88	10.81%	6,057.65	7.18%
	代销	-	-	8,795.66	7.61%	19,001.96	22.54%
	经销	-	-	2.48	0.00%	3,422.56	4.06%

	合计	-	-	21,291.01	18.43%	28,482.17	33.78%
--	----	---	---	-----------	--------	-----------	--------

公司内存接口芯片采取直销为主的销售模式，而消费电子芯片采取代销为主的销售模式。2016年至2018年，内存接口芯片直销收入占比分别为56.97%、56.83%和78.54%，2017年和2018年内存接口芯片代销收入逐年上升，主要系来自代销商富昌电子的销售收入逐年上升所致；2017年消费电子芯片直销收入上升主要系公司2017年转让消费电子芯片业务相关资产所致。

五、采用代销模式的原因，主要代销商的基本情况，代销协议有关双方权利义务关系、风险承担方式、退换货等方面的约定，2018年末结束代销关系的原因，代销业务的会计处理原则及是否符合企业会计准则的规定；

1、采用代销模式的原因：

(1) 可使用代销商现成销售渠道和客户关系，有利于全面铺开市场；

(2) 更全面的市场信息反馈。多家代理商在市场全面进行产品推广，能够在短时间内集中收集客户反馈的信息；

(3) 将公司自身精力集中到研发上，加快产品更新换代的速度，更快的抢占市场。

2、主要代销商的基本情况

详情参见本问询函回复之“问题三十二”之“32.1 发行人的说明”之“十”。

3、代销协议的基本情况

(1) 消费电子芯片的代销商权利义务关系、风险承担方式、退换货等方面的约定

根据代销协议，代销商需在公司指定的地区开展产品的销售和市场推广活动，代销商应严格执行甲方所规定的市场最低价，代销商需按时提供产品代销清单以及未来若干月的销售预测。公司有责任保证发出商品的质量；有责任组织产品的销售培训；提供相应的文件资料（产品说明，货单，价格表等等），对代销商进行产品培训等。代销商除因质量问题不得退换货。

(2) 内存接口芯片的代销商权利义务关系、风险承担方式、退换货等方面

的约定

公司的内存接口芯片代销商只有一家，代销商销售的终端客户系美光科技，根据代销协议，代销商有责任保证合理库存以保证及时发货给终端客户；需要在每个月结束后按时提供销售报告。公司需要为代销商提供支持，包括产品相关的信息及市场资料。公司有责任保证发出商品的质量；代销商每 6 个月可以将符合条件的未销售存货退还给公司，并且如出现质量问题可以退换货。

4、2018 年末结束代销关系的原因

富昌电子是美光科技指定的与公司合作的代销商（买方代理）。经过多年合作，公司已成为美光科技合格供应商。因此，2018 年末，经公司与美光科技、富昌电子协商确定，后续由公司直销给美光科技，从而结束与富昌电子的代销关系。

5、代销业务的会计处理原则及是否符合企业会计准则的规定

根据《企业会计准则第 14 号-收入》第四条“销售商品收入同时满足下列条件的，才能予以确认：（一）企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；（二）企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；（三）收入的金额能够可靠地计量；（四）相关的经济利益很可能流入企业；（五）相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。”《企业会计准则第 14 号-收入》应用指南“四、销售商品收入确认条件的具体应用、5.销售商品采用支付手续费方式委托代销的，在收到代销清单时确认收入。”的规定。

公司认为在收到代销商的代销清单确认商品销售给最终客户之后才能满足收入确认的条件，因为收到代销清单后，（1）公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；（2）公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；（3）收入的金额能够可靠地计量；（4）相关的经济利益很可能流入企业；（5）发生的成本能够可靠地计量。

公司代销业务的会计处理符合企业会计准则的规定。

六、韩国地区销售收入在报告期内先下降再大幅增长的原因；

报告期内公司在韩国地区销售收入分别为 51.17%、23.57%和 29.31%，呈现先大幅下降再增长的趋势。2017 年韩国地区销售收入大幅下降主要是 2017 年三星电子通过其在境内的苏州子公司采购公司产品，导致 2017 年韩国地区销售收入比例下降。2018 年韩国地区销售收入大幅增长主要是公司对海力士的销售增长较快所致。

七、销量或合同订单完成量等业务执行数据与收入确认数据的一致性；

公司系根据订单完成交货后确认收入。因此，报告期内公司销量等业务执行数据与收入确认数据具备一致性。

八、营业收入的季节性波动情况及原因

公司报告期内的各季度的主营业务收入变化情况如下：

季度	2018 年度	2017 年度	2016 年度
第一季度	33,705.61	23,999.83	17,475.95
第二季度	37,207.48	31,234.01	18,837.43
第三季度	54,206.42	35,622.14	20,155.38
第四季度	50,646.95	24,661.47	27,846.08
合计	175,766.46	115,517.45	84,314.84

根据上表显示，公司一季度销售金额相对其它季度较低，下半年销售金额比上半年销售金额相对较高，主要原因是受下游行业周期性及季节性需求波动影响。

九、结合2018年前五名客户销售占比情况说明“不存在严重依赖少数客户的情况”的表述是否准确

根据相关行业统计数据，2018 年前三季度，在 DRAM 市场，三星电子、海力士、美光科技位居行业前三名，市场占有率合计超过 90%，该行业集中度较高。而三星电子、海力士、美光科技均为公司的客户，因此造成公司大客户收入占比较高。综上，公司大客户集中度较高系由于下游高集中度的市场环境所致，且公司已经覆盖了下游市场的主要参与者。2018 年，公司前五大客户中任一客户占公司营业总收入的比重均未超过 30%，不存在对单一大客户重大依赖的情形。因此，“不存在严重依赖少数客户的情况”的表述准确。

十、请发行人说明主要代销商的基本情况，包括成立时间、注册资本、股

权结构、实际控制人或主要股东、规模、经营状况等，是否与发行人及其关联方存在关联关系。

报告期内公司主要代销商基本情况如下：

(1) CEAC International Limited（中国电子器材国际有限公司）

中国电子器材国际有限公司成立于 2009 年 8 月 21 日；无注册资本，由深圳中电国际信息科技有限公司 100% 持股，主营业务为电子元器件的批发。截至 2018 年其未经审计的资产总额为 21.16 亿元。

(2) Qinuo (Hong Kong) Limited（淇诺（香港）有限公司）

淇诺（香港）有限公司成立于 2015 年 8 月 26 日；无注册资本，由深圳淇诺科技有限公司 100% 持股，主营业务为电子元器件分销。截至 2018 年其未经审计的资产总额为 12.1 亿元。

(3) 上海虹日国际电子有限公司

上海虹日国际电子有限公司成立于 1997 年 6 月 26 日；注册资本为 500 万美元，其主要股东为上海华虹(集团)有限公司、株式会社先端电子（日本）和丰田通商株式会社；主营业务为电子元器件分销。截至 2018 年其未经审计的资产总额为 5.2 亿元。

(4) Future Electronics Inc.(Distribution) PTE Ltd.

Future Electronics Inc.(Distribution) PTE Ltd. 成立于 1992 年，注册资本：5,200 万新加坡元；其主要股东为富昌电子，富昌电子成立于 1968 年，是世界知名的电子元器件分销商。

上述代销商与公司不存在关联关系。

32.2 保荐机构核查过程和核查意见

核查过程：

1、查阅了发行人与代销商之间的代销合同，通过公开渠道查询了代销商的基本信息，并走访了发行人代销商以及代销商的终端客户；

2、核算了发行人产品单价，查阅了相关行业研究报告，访谈了发行人消费电子芯片和内存接口芯片相关技术人员；

3、统计了各销售模式下发行人销售情况，并向各客户进行函证确认。

核查结论：

经核查，保荐机构认为：

- 1、发行人产品单价上升具备合理性；
- 2、“不存在严重依赖少数客户的情况”的表述具备准确性；
- 3、发行人代销商与发行人及其关联方不存在关联关系。

32.3 补充披露情况

发行人已在招股说明书“第六节 业务与技术”之“三、公司销售情况（二）销量及价格变动情况”中补充披露如下：

发行人报告期内的销量及价格变动情况如下表：

分类		2018 年度	2017 年度	2016 年度
内存接口 芯片	销售数量（颗）	96,418,800	53,595,657	36,284,845
	平均单价（元）	18.14	17.44	15.39
消费电子 芯片	销售数量（颗）	—	52,563,431	50,040,043
	平均单价（元）	—	4.05	5.69

报告期内，发行人产品销售单价持续上升，其具体原因如下：

（1）发行人于 2017 年 7 月转让了产品平均单价较低的消费电子芯片业务相关资产，自 2017 年 8 月后不再从事消费电子芯片业务；而随着产品平均单价较高的内存接口芯片销售收入不断增长，其占总收入的比重不断提高。

（2）内存接口芯片某一代具体产品的生命周期里，销售单价逐步降低；但随着技术迭代后，新产品因技术先进而导致售价将有所提高，因此内存接口芯片产品的平均销售单价在报告期内稳中有升。

2017 年其他业务收入的单价高于主营业务收入单价的原因系：①2017 年其他业务收入中包含 4,791.88 万元的消费电子芯片业务的晶圆原材料的销售，单

片晶圆的价格较高；②2017年其他业务收入中包含房租的转租收入402.63万元，无对应的数量。

发行人已在招股说明书“第八节 财务会计信息与管理层分析”之“六、经营成果分析（一）营业收入结构及趋势分析”中补充披露如下：

6、营业收入季节性分析

发行人报告期内的各季度的主营业务收入变化情况如下：

季度	2018年度	2017年度	2016年度
第一季度	33,705.61	23,999.83	17,475.95
第二季度	37,207.48	31,234.01	18,837.43
第三季度	54,206.42	35,622.14	20,155.38
第四季度	50,646.95	24,661.47	27,846.08
合计	175,766.46	115,517.45	84,314.84

根据上表显示，公司一季度销售金额相对其它季度较低，下半年销售金额比上半年销售金额相对较高，主要原因是受下游行业周期性及季节性需求波动影响。

发行人已在招股说明书“第八节 财务会计信息与管理层分析”之“六、经营成果分析（一）营业收入结构及趋势分析”中补充披露如下：

2、主营业务收入的销售模式构成

报告期内，公司分主要产品及销售模式的具体情况如下：

单位：万元

产品类别	销售模式	2018年度		2017年度		2016年度	
		收入	占比	收入	占比	收入	占比
内存接口芯片	直销	138,045.67	78.54%	65,650.52	56.83%	48,036.29	56.97%
	代销	36,819.58	20.95%	27,816.28	24.08%	7,796.39	9.25%
	经销	-	-	-	-	-	-
	合计	174,865.26	99.49%	93,466.80	80.91%	55,832.67	66.22%
消费电子芯片	直销	-	-	12,492.88	10.81%	8,667.13	10.28%

	代销	-	-	8,795.66	7.61%	19,001.96	22.54%
	经销	-	-	2.48	0.00%	813.08	0.96%
	合计	-	-	21,291.01	18.43%	28,482.17	33.78%

公司消费电子芯片采取代销为主的销售模式，而内存接口芯片采取直销为主的销售模式。2016年至2018年，内存接口芯片直销收入占比分别为56.97%、56.83%和78.54%，2017年和2018年内存接口芯片代销收入逐年上升，主要系来自代销商富昌电子的销售收入逐年上升所致；2017年消费电子芯片直销收入上升主要系公司2017年转让消费电子芯片业务相关资产所致。

问题三十三

报告期内，公司综合毛利率分别为 51.20、53.49和70.54。

请发行人披露：(1)毛利率处于较高水平且逐年上升的原因，结合主要产品、直销/代销模式、境内/境外的毛利率数据以及产品结构变化情况等量化分析毛利率的主要影响因素及变化趋势；(2) 毛利率显著高于可比公司的原因，与境外主要竞争对手产品毛利率的差异情况及原因；(3) 结合产品技术水平特点、主要客户的稳定性和可持续性、对上下游客户的议价能力等分析毛利率较高的水平是否具有可持续性，随着 DDR5 相关产品的推出公司是否面临毛利率大幅下降的风险，相关风险揭示是否充分；(4) 结合自身业务模式披露生产成本的具体核算方法，主营业务成本中制造费用的主要构成，分析直接材料、封装测试、制造费用的变动影响因素，以及报告期内的变动情况与业务数据的匹配性。

请保荐机构及申报会计师对上述事项进行核查，并对成本核算的准确性、完整性发表明确意见。

回复：

33.1 发行人说明

一、毛利率处于较高水平且逐年上升的原因，结合主要产品、直销/代销模式、境内/境外的毛利率数据以及产品结构变化情况等量化分析毛利率的主要影响因素及变化趋势

报告期内，公司主营业务分产品的毛利率数据分析如下表：

项目		报告期毛利率		
		2018 年度	2017 年度	2016 年度
主营业务 毛利率	内存接口芯片	70.82%	65.84%	63.00%
	消费电子芯片	-	18.49%	28.40%

2016 年、2017 年、2018 年，公司内存接口芯片的毛利率分别为 63.00%、65.84%和 70.82%。

内存接口芯片某一代具体产品的生命周期里，销售单价逐步降低；但随着技

术迭代后，新产品因技术先进而导致售价将有所提高，因此内存接口芯片产品的平均销售单价在报告期内稳中有升，从而推动报告期内公司内存接口芯片毛利率逐年上升。

随着公司的内存接口芯片收入及其占总收入的比重逐年提高（2016年至2018年公司内存接口芯片销售占比分别为66.08%、76.14%和99.49%），公司综合毛利率快速上升。

二、毛利率显著高于可比公司的原因，与境外主要竞争对手产品毛利率的差异情况及原因

集成电路设计行业国内A股上市公司中，尚无公司与本公司研发销售相同的产品。公司根据经营规模、业务模式和盈利能力选取的可比公司为汇顶科技（603160）和兆易创新（603986），两家可比公司与本公司在终端应用、上下游细分市场情况、竞争状况等方面存在一定差异，且公司产品在其细分市场上技术先进且具有较强的市场竞争力，因此毛利率有所差异。

公司的境外主要竞争对手情况如下：

（1）IDT（IDTLO）

IDT成立于1980年，总部位于美国，是一家为通信、计算机和消费类行业提供组合信号半导体解决方案的公司。IDT可提供DDR3和DDR4 LRDIMM存储器接口解决方案、Serial RapidIO[®]、PCI Express[®]交换机和网桥、信号完整性产品和电源管理解决方案，以满足企业服务器应用的需求。根据2019年财年前三季度定期报告统计，IDT 2019财年前三季度营业收入70,458.70万美元，净利润8,782.60万美元，其中内存接口芯片领域收入为20,678.70万美元，约占总收入比为30%。

（2）Rambus（RMBS.O）

Rambus成立于1990年，总部位于美国，是一家技术解决方案研发公司，并同时提供IP授权、安全研发、面向服务器的内存接口芯片组、高级LED照明设备和显示器以及拟真移动媒体领域的产品于服务。Rambus从创立之初便致力于高端存储产品的研究与开发，目前产品应用于高性能个人电脑、图形工作站、服

务器和其他对带宽和时间延迟有一定要求的设备。根据 Rambus 2018 年年报披露，其 2018 年营业收入 23,120.10 万美元，净利润-15,795.70 万美元，其中内存接口芯片领域收入为 3,640.00 万美元，约占总收入比例为 15%。

同行业可比公司及境外主要竞争对手与本公司的综合毛利率比较情况如下：

公司/项目名称	2018 年度	2017 年度	2016 年度
Rambus	76.77%	79.87%	80.07%
IDT	60.95%	57.76%	60.46%
汇顶科技	52.18%	47.12%	47.14%
兆易创新	38.25%	39.16%	26.72%
行业本期平均毛利率	57.04%	55.98%	53.60%
澜起科技	70.54%	53.49%	51.20%
与平均毛利率差异	13.50%	-2.49%	-2.40%

注：Rambus、汇顶科技和兆易创新均采用2018年度数据，IDT由于截至回复签署日前尚未公告2019财年年报，因此IDT采用2018.4.2-2018.12.30（三季度）数据

汇顶科技和兆易创新与本公司在终端应用、上下游细分市场情况、竞争状况等方面存在一定差异，且公司产品在其细分市场上技术先进，具有较强的市场竞争力，因此毛利率有所差异。公司竞争对手 IDT 和 Rambus 仅披露了综合毛利率，没有披露内存接口芯片的产品毛利率。总体来看，三家公司均体现了高毛利特征。其中 IDT 产品线较多，内存接口芯片占其收入比重为 30%左右，而 Rambus 主要收入来源为 IP 版税收入且版税业务的毛利率较高，因此毛利率有所差异。

三、结合产品技术水平特点、主要客户的稳定性和可持续性、对上下游客户的议价能力等分析毛利率较高的水平是否具有可持续性，随着 DDR5 相关产品的推出公司是否面临毛利率大幅下降的风险，相关风险揭示是否充分

根据目前 JEDEC 组织关于 DDR5 内存接口芯片的初步定义，其基本技术框架是基于 DDR4 世代基础上进行性能升级和技术突破，主要表现为功耗降低的同时提升工作频率和传输速度，基本技术框架未发生重大变化。

公司的内存接口芯片客户为全球主要内存模组厂商，报告期内相关销售业务稳定，且具有可持续性。公司经过长期的竞争，已经形成了自身的核心技术和独特竞争力，在 DDR4 世代，公司的内存接口芯片的毛利率维持了较高水平，且

在报告期内稳中有升，议价能力具有可持续性。

目前公司正在积极开展第一代 DDR5 内存接口芯片的研发工作，若能如期及时研发成功，推出高质量产品，则公司内存接口芯片在第一代 DDR5 内存接口芯片量产阶段暂无毛利率大幅下降风险。但公司新产品的开发仍存在相关风险，相关风险提示详见招股说明书“第四节 风险因素”之“一、技术风险”之“（一）产品研发风险”和“四、财务风险”之“（四）毛利率波动风险”。

四、结合自身业务模式披露生产成本的具体核算方法，主营业务成本中制造费用的主要构成，分析直接材料、封装测试、制造费用的变动影响因素，以及报告期内的变动情况与业务数据的匹配性

（一）自身业务模式披露生产成本的具体核算方法及主营业务成本中制造费用的主要构成

公司采用 Fabless 模式进行经营，自身不直接从事芯片的生产环节，将芯片生产环节的晶圆生产、封装测试环节均委托专业厂商进行。公司通常结合自身对市场的判断和客户的需求拟定采购计划，向晶圆制造企业下订单，晶圆制造企业接到订单后排期并安排生产。晶圆制造完毕后进行晶圆测试，符合公司良品率要求的晶圆，直接发往公司指定的封装企业进行封装，封装完成后进行测试，完成芯片的测试后，芯片产成品发送至公司指定的客户。

从晶圆代工厂采购的晶圆作为原材料核算，向封装测试厂采购的封装测试服务费用计入委托加工物资核算，库存商品（发出商品）成本包括晶圆采购成本、加工成本（封装测试代工费）等。原材料、委托加工物资和库存商品在领入和发出时按标准成本计价，实际成本和标准成本之间产生的成本差异按实际销售情况在存货与营业成本之间分摊。

制造费用主要是单独发生的检测费用等无法直接归集到某一批次产品上的费用构成，实际发生时直接计入营业成本。

（二）分析直接材料、封装测试、制造费用的变动影响因素，以及报告期内的变动情况与业务数据的匹配性

报告期内公司主营业务成本按照类别的金额构成如下：

单位：万元

项目	2018 年度		2017 年度		2016 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
直接材料	20,676.55	39.94%	25,965.03	52.07%	23,244.85	56.62%
封装测试	28,979.03	55.97%	21,761.21	43.64%	16,728.21	40.75%
制造费用	2,117.83	4.09%	2,134.95	4.28%	1,078.23	2.63%
合计	51,773.40	100.00%	49,861.19	100.00%	41,051.29	100.00%

由于技术架构及工艺不同，公司的内存接口芯片成本构成中封装测试占比较大，消费电子芯片成本构成中晶圆占比较大。2017 年 7 月公司将消费电子芯片业务相关资产进行了转让，此后不再从事消费电子芯片相关业务。因此，报告期内公司晶圆等直接材料的成本金额占比均呈下降趋势。随着内存接口芯片销售量不断提升，封装测试的成本金额占比均呈上升趋势。

2017 年制造费用较 2016 年上升主要系内存接口芯片产品的成品测试费用增加所致。2018 年制造费用较 2017 年基本保持稳定。

33.2 保荐机构和申报会计师核查过程和核查意见

1、了解并检查发行人采购与成本相关的流程和内部控制，对发行人的存货管理系统执行信息系统审计，检查发行人的内部控制制度是否健全有效；

2、对比发行人报告期各产品、各销售模式和境内境外的毛利率，与可比公司、境外主要竞争对手的毛利率进行比较，并分析原因，对存货和成本执行实质性分析程序，对比各期成本构成、存货周转率等财务数据；

3、访谈发行人技术人员和管理层，取得并审阅了 DDR5 产品的技术水平及市场预期等相关资料；

4、检查发行人成本核算方法是否符合企业会计准则的规定，对采购数量和金额、报告期期末存货进行函证，对期末存货盘点执行监盘程序，检查资产负债表日前后的出入库，检查存货和成本的真实性和完整性。

核查结论：

经核查，保荐机构和申报会计师认为：

1、发行人的毛利率变动具有合理性，与同行业可比公司和主要竞争对手的毛利率存在差异，但差异的原因具有合理性；

2、发行人已就与 DDR5 产品相关的风险进行披露与我们了解的情况一致；

3、发行人已充分披露的成本核算方法、制造费用的主要成本构成及直接材料、封装测试、制造费用的变动影响因素与我们了解的情况基本一致，报告期内的变动情况与业务数据相匹配，相关数据具有准确性和完整性；

4、发行人的成本核算方法符合企业会计准则的规定，成本核算准确完整。

33.3 补充披露情况

发行人已在招股说明书“第八节 财务会计信息与管理层分析”之“六、经营成果分析（三）营业毛利及毛利率分析”中补充披露如下：

3、主营业务毛利率分析

报告期内，发行人主营业务分主要产品的毛利率数据分析如下表：

项目		报告期毛利率		
		2018 年度	2017 年度	2016 年度
主营业务 毛利率	内存接口芯片	70.82%	65.84%	63.00%
	消费电子芯片	-	18.49%	28.40%

内存接口芯片某一代具体产品的生命周期里，销售单价逐步降低；但随着技术迭代后，新产品因技术先进而导致售价将有所提高，因此内存接口芯片产品的平均销售单价在报告期内稳中有升，从而推动报告期内公司内存接口芯片毛利率逐年上升。2016年、2017年、2018年，公司内存接口芯片的毛利率分别为63.00%、65.84%和70.82%。

2016年至2018年公司内存接口芯片销售占比分别为66.08%、76.14%和99.49%，随着发行人的内存接口芯片收入及其占总收入的比重逐年提高，报告期内公司综合毛利率快速上升。

.....

发行人的境外主要竞争对手为 IDT 和 Rambus，同行业可比公司与本公司

的综合毛利率比较情况如下：

公司/项目名称	2018 年度	2017 年度	2016 年度
Rambus	76.77%	79.87%	80.07%
IDT	60.95%	57.76%	60.46%
汇顶科技	52.18%	47.12%	47.14%
兆易创新	38.25%	39.16%	26.72%
行业本期平均毛利率	57.04%	55.98%	53.60%
澜起科技	70.54%	53.49%	51.20%
与平均毛利率差异	13.50%	-2.49%	-2.40%

注：Rambus、汇顶科技和兆易创新均采用2018年度数据，IDT由于截至回复签署日前尚未公告2019财年年报，因此IDT采用2018.4.2-2018.12.30（三季度）数据

汇顶科技和兆易创新与本公司在终端应用、上下游细分市场情况、竞争状况等方面存在一定差异，且发行人产品在其细分市场上技术先进且具有较强的市场竞争力，因此毛利率有所差异。公司竞争对手 IDT 和 Rambus 仅披露了综合毛利率，没有披露内存接口芯片的产品毛利率。总体来看，Rambus、IDT 和澜起科技三家公司均体现了高毛利特征。其中 IDT 产品线较多，内存接口芯片占其收入比重为 30%左右，而 Rambus 主要收入来源为 IP 版税收入且版税业务的毛利率较高，因此毛利率与发行人有所差异。

发行人已在招股说明书“第八节 财务会计信息与管理层分析”之“六、经营成果分析（二）营业成本构成及趋势分析”中补充披露如下：

由于技术架构及工艺不同，公司的内存接口芯片成本构成中封装测试占比较大，消费电子芯片成本构成中晶圆占比较大。2017 年 7 月公司将消费电子芯片业务相关资产进行了转让，此后不再从事消费电子芯片相关业务。因此，报告期内公司晶圆等直接材料的成本金额占比均呈下降趋势。随着内存接口芯片销售量不断提升，封装测试的成本金额占比均呈上升趋势。

2017 年制造费用较 2016 年上升主要系内存接口芯片产品的成品测试费用增加所致。2018 年制造费用较 2017 年基本保持稳定。

问题三十四

报告期内,公司的期间费用分别为 28,355.08 万元、31,206.23万元、48,218.01 万元, 占营业收入的比重分别为33.56、25.42和 27.43。

请发行人结合与费用明细项目直接相关的具体业务数据(如员工数量、销售数量、物流方式、运输距离)等披露:(1)销售费用、管理费用、研发费用主要明细项目变动的原因;并与同行业可比公司、主要竞争对手的费用率进行对比,说明差异原因及合理性;(2)与境外销售服务代理机构合作的原因及必要性,是否符合行业惯例;境外销售服务代理机构的基本情况,是否与发行人客户存在关联关系或其他利益安排;有关销售佣金计提的具体合同约定,报告期内佣金计提比例迅速提高的原因,销售佣金增长是否与销售收入增长相匹配;是否存在通过外聘机构进行直接或变相商业贿赂的情况;(3)2018 年职工薪酬尤其是董事长、总经理的薪酬大幅增长的原因及合理性,薪酬变动是否与员工人数、薪酬水平、人员结构的变动相匹配;(4)管理费用中专业服务及咨询费的主要构成、服务提供方、服务内容及相关费用结算约定;(5)研发费用中工程费用、协作开发费、工具费、许可证费的主要构成及变动原因,在研发项目中的具体用途;研发费用中职工薪酬支出是否与发行人的技术水平相匹配;研发费用与研发项目的匹配关系,对应研发项目的整体预算、费用支出金额、实施进度等情况。

请发行人说明:研发费用的支出范围和归集方法,是否按照研发项目设立台账据实归集核算研发费用,折旧费等如何在研发与其他环节之间进行分摊,相关内部控制制度是否健全有效。

请保荐机构及申报会计师对上述事项进行核查并发表明确意见。请申报会计师对期间费用的相关会计处理是否符合企业会计准则的规定发表明确意见。

回复:

34.1 发行人说明

一、销售费用、管理费用、研发费用主要明细项目变动的原因;并与同行业可比公司、主要竞争对手的费用率进行对比,说明差异原因及合理性

(一)销售费用、管理费用、研发费用主要明细项目变动的原因

报告期内公司期间费用主要明细项目的变动情况如下表：

单位：万元

费用类型	项目	2018 年度	2017 年度	2016 年度
销售费用	职工薪酬	4,354.40	2,937.12	3,064.94
	销售佣金	7,268.71	2,795.95	810.96
	物流相关费用	99.79	135.62	189.45
管理费用	职工薪酬	8,774.98	2,826.39	2,225.87
	租赁费	773.44	904.82	1,110.43
	专业服务及咨询费	765.19	615.08	600.55
研发费用	职工薪酬	17,659.63	9,973.58	11,827.03
	工程费用	3,774.74	4,646.75	3,948.09
	协作开发费	1,568.70	1,059.69	1,368.25

(1) 2017 年 7 月公司将消费电子芯片业务相关资产进行转让，相关员工人数因此有所下降，其后根据业务发展需要，2018 年公司员工人数有所增长。因此，报告期内销售费用和研发费用的职工薪酬均出现 2017 年下降，2018 年上升的情况。此外，由于 2018 年公司业绩较好，员工薪酬及福利有所增长。

(2) 报告期内销售佣金的增长，主要是由于销售增长所致。

(3) 报告期内物流相关费用的下降。由于内存接口芯片与消费电子芯片的交付方式不同，内存接口芯片的物流费用相对较低，随着内存接口芯片销售占比逐年上升，物流相关费用逐年下降。

(4) 报告期内租赁费下降，主要是由于转让消费电子芯片业务相关资产后，所需办公场所面积减少所致。

(5) 报告期内管理费用中专业服务及咨询费增长，主要是公司聘请中介机构产生的相关费用。

(6) 报告期内研发费用中工程费用先上升后下降，工程费用主要是流片费用，流片费用的产生主要受研发项目的进度影响，一旦达到流片阶段就需列支工程费用。因此，该费用的波动具有合理性。

(7) 报告期内研发费用中协作开发费先下降后上升，2017 年协作开发费下降主要系公司不再从事消费电子芯片业务后，相关委托第三方协作开发项目终止；2018 年协作开发费上升主要系公司开发津逮®服务器 CPU 需采购部分第三方技术开发服务所致。

(二) 与同行业可比公司、主要竞争对手的费用率进行对比，说明差异原因及合理性

1、同行业可比公司期间费用占当期营业收入的比率比较如下表：

费用类型	公司名称	费用占营业收入的比例		
		2018 年度	2017 年度	2016 年度
销售费用	汇顶科技	8.66%	6.04%	3.16%
	兆易创新	3.43%	3.56%	3.54%
	公司	7.24%	5.62%	6.18%
管理费用	汇顶科技	2.31%	1.64%	3.48%
	兆易创新	5.63%	5.73%	5.77%
	公司	6.42%	4.22%	5.65%
研发费用	汇顶科技	22.53%	16.21%	10.00%
	兆易创新	9.26%	7.08%	6.87%
	公司	15.74%	15.34%	23.46%

由上表可知，公司与可比公司的费用率比较可知，公司销售费用率除 2016 年略高于可比公司外，2017 年和 2018 年均高于兆易创新而低于汇顶科技，销售费用率总体保持平稳。

管理费用率 2016 年和 2017 年高于汇顶科技而低于兆易创新，2018 年略高于可比公司，2018 年有所上升主要系管理人员薪酬增长所致。

报告期内研发费用率均高于行业平均值，主要系公司致力于集成电路设计领域的科技创新，注重研发的持续高投入，2018 年公司研发技术人员占总员工人数的 70.98%，研发驱动也是公司保持核心竞争力的关键因素之一，因此研发投入占比较高具有合理性。

2、同主要竞争对手的期间费用占营业收入的比率比较如下表：

费用类型	公司名称	费用占营业收入的比例		
		2018 年度	2017 年度	2016 年度
销售和管理费用	IDT	21.05%	20.01%	19.94%
	Rambus	44.94%	28.22%	28.27%
	公司	13.66%	9.84%	11.83%
研发费用	IDT	24.16%	24.05%	22.67%
	Rambus	68.49%	37.94%	38.58%
	公司	15.74%	15.34%	23.46%
三大期间费用率	IDT	45.21%	44.06%	42.61%
	Rambus	113.43%	66.16%	66.85%
	公司	29.40%	25.18%	35.29%

注：IDT 是财年数据，由于 IDT 财年是指由上一年 3 月至本年 3 月的期间。其 2016 年度、2017 年度和 2018 年度费用率分别取 2017 财年、2018 财年及 2019 财年前三季度的费用率。

由上表可知，公司主要竞争对手三大期间费用率均比公司高，主要原因是竞争对手均为美国公司，以人工成本为代表的各项费用较高。

二、与境外销售服务代理机构合作的原因及必要性，是否符合行业惯例；境外销售服务代理机构的基本情况，是否与发行人客户存在关联关系或其他利益安排；有关销售佣金计提的具体合同约定，报告期内佣金计提比例迅速提高的原因，销售佣金增长是否与销售收入增长相匹配；是否存在通过外聘机构进行直接或变相商业贿赂的情况

（一）与境外销售服务代理机构合作的原因及必要性

经过多年发展，集成电路行业已经非常成熟，在设计、晶圆代工、封装、测试及销售等细分领域均产生很多成熟的大型企业，公司属于集成电路设计企业，在境外销售方面与境外销售服务代理机构合作，主要是为利用境外销售服务机构的专业能力和销售渠道，推动销售的增长，并且可以将自身的主要精力放在产品的研发上，与境外销售服务代理机构合作的模式属于行业惯例。

（二）境外销售服务代理机构的基本情况，是否与发行人客户存在关联关系或其他利益安排

1、境外主要销售服务代理机构的基本情况

公司名称	ILDO Korea Co., Ltd	First Source of Idaho, Inc.
成立时间	2004-11-04	1990年8月
注册资本	871,220,030.00 韩元	5 万美元
股东名单	Park, Tae Sic(TS)、Kim, Young Lee、Lim, Chang Wan、Liu, Yen-Liang、EDOM Technology Co., Ltd	David Head 与 Ginger Head 各持股 50%
与公司开始合作时间	2008 年	2014 年

EDOM Technology Co., Ltd 为公司的客户，销售金额占比低于 1%，占比较小，且 ILDO Korea Co., Ltd 的销售佣金与来自 EDOM Technology Co., Ltd 的销售收入无关。除此之外，上述境外销售服务代理机构与公司客户不存在关联关系或其他利益安排。

（三）有关销售佣金计提的具体合同约定，报告期内佣金计提比例迅速提高的原因，销售佣金增长是否与销售收入增长相匹配；是否存在通过外聘机构进行直接或变相商业贿赂的情况

ILDO Korea Co., Ltd 主要为公司内存接口芯片提供销售支持服务，主要面向韩国地区市场。根据公司与其签订的合同，根据其协助公司实现的销售金额计算佣金，对其当年实现的销售按一定比例计提，对超过上一年的销售额增量给予额外佣金奖励。

First Source of Idaho, Inc. 主要为公司内存接口芯片提供销售支持服务，主要面向美国等地区市场。根据其协助公司实现的销售金额计算佣金，对其当年实现的销售按一定比例计提。

销售佣金的增长高于销售收入增长，主要是因为 2017 年及 2018 年公司内存接口芯片销售额增量较大，因此给予 ILDO 的佣金奖励金额增长也较大。

公司不存在通过外聘机构进行直接或变相商业贿赂的情况。

三、2018 年职工薪酬尤其是董事长、总经理的薪酬大幅增长的原因及合理性，薪酬变动是否与员工人数、薪酬水平、人员结构的变动相匹配；

2018 年职工薪酬的变动情况如下表所示：

单位：万元

项目	2018 年	2017 年	增长比例
销售费用-职工薪酬	4,354.40	2,937.12	48.25%
管理费用-职工薪酬	8,774.98	2,826.39	210.47%
研发费用-职工薪酬	17,659.63	9,973.58	77.06%
合计	30,789.01	15,737.09	95.65%

2018 年职工薪酬大幅度增长主要原因是：（1）2018 年公司为奖励员工，留住关键人才为员工购买的年金产品增加；（2）由于董事长和总经理超额完成业绩目标，获取了一定金额的奖金。

2018 年公司实现净利润 7.37 亿元，较 2017 年 3.47 亿元增长 112.39%，相关职工薪酬增加了 95.65%。职工薪酬的增长幅度与公司业绩的增长幅度基本匹配，具有合理性。

根据董事会决议，董事长、总经理因超额完成 2018 年经营业绩，公司向其发放奖金，从而导致其薪酬大幅度增长，具有合理性。

公司职工人数从 2017 年末的 204 人增长到 2018 年末的 255 人，与职工薪酬的增长为同向变动。在此期间，公司的人员结构未发生重大变化，始终是研发技术人员为主。

四、管理费用中专业服务及咨询费的主要构成、服务提供方、服务内容及相关费用结算约定

1、管理费用中专业服务及咨询费的主要构成如下表：

单位：万元

主要构成	2018 年度	2017 年度	2016 年度
咨询顾问费	290.78	333.64	396.5
法律服务费	312.37	118.81	48.43
审计费及资产评估费	118.83	137.54	117.19
人力资源服务费	43.21	25.01	38.42

主要构成	2018 年度	2017 年度	2016 年度
合计	765.19	615.08	600.55

2、管理费用中专业服务及咨询费的服务提供方、服务内容及相关费用结算约定

报告期内公司专业服务及咨询费的主要服务提供方信息如下表所示：

序号	服务提供方	服务内容	相关费用结算约定
1	ROPES & GRAY LLP、国浩律师（上海）事务所	法律服务	按照合同约定，以银行汇款方式付款
2	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）	审计、验资服务	按照合同约定，以银行汇款方式付款
3	上海德勤税务师事务所有限公司	咨询顾问服务	按照合同约定，以银行汇款方式付款
4	北京中企华资产评估有限责任公司	资产评估服务	按照合同约定，以银行汇款方式付款
5	北京锐仕方达人力资源集团有限公司、米高蒲志国际招聘咨询公司	人力资源服务	按照合同约定，以银行汇款方式付款

五、研发费用中工程费用、协作开发费、工具费、许可证费的主要构成及变动原因，在研发项目中的具体用途；研发费用中职工薪酬支出是否与发行人的技术水平相匹配；研发费用与研发项目的匹配关系，对应研发项目的整体预算、费用支出金额、实施进度等情况。

（一）研发费用中工程费用、协作开发费、工具费、许可证费的主要构成及变动原因，在研发项目中的具体用途

项目	主要构成	具体用途	变动原因
工程费用	相关光罩、晶圆、封测等费用	研发工程样品试生产	产品更新换代，研发需要
协作开发费	委托对外技术开发服务	研发中需要的技术	产品更新换代，研发需要
工具费	研发工具采购	研发需要的工具	产品更新换代，研发需要
许可证费	短期及长期 IP 授权的许可费及摊销	研发所用 EDA 软件、License	产品更新换代，研发需要

（二）研发费用中职工薪酬支出是否与发行人的技术水平相匹配

集成电路行业是人才密集型行业，公司为保持技术先进性，需要招聘并激励研发人员。2016年6月，中国电子学会认定公司“低功耗DDR系列内存缓冲控制器芯片设计技术整体技术达到国际领先水平”。2018年11月公司荣获2018年第十三届“中国芯”年度重大创新突破产品。这些荣誉体现了公司的技术水平在相关领域具有先进性。公司2018年研发费用中的职工薪酬较2017年增长77.06%，与公司业绩增长与技术水平相匹配。

（三）研发费用与研发项目的匹配关系，对应研发项目的整体预算、费用支出金额、实施进度等情况

报告期内研发费用与研发项目的匹配关系如下表：

单位：万元

项目名称	整体预算	费用支出金额			项目进度
		2016年度	2017年度	2018年度	
消费电子芯片	17,875.00	12,684.49	3,314.65	-	2017年在转让相关资产后已终止
Gen 2 plus DDR4 内存接口芯片	15,632.72	5,523.34	7,918.25	170.30	2018年已完成初步研发
Gen 1.0 津逮®CPU 及混合安全内存模组	26,095.01	1,614.86	6,873.80	14,670.31	2018年底已完成研发
Gen 1.0 DDR5 内存接口芯片	24,589.87	-	720.22	12,828.91	设计优化
合计	84,192.60	19,822.69	18,826.92	27,669.52	

六、请发行人说明：研发费用的支出范围和归集方法，是否按照研发项目设立台账据实归集核算研发费用，折旧费等如何在研发与其他环节之间进行分摊，相关内部控制制度是否健全有效

公司的研发费用支出范围包括研发人员薪酬、研发工程样品的光罩、晶圆、封装及检测费用等工程费用、研发IP授权费用的摊销、专业技术服务费、研发工具费、研发机器设备的折旧、差旅费等与研发项目有关的费用支出。

公司研发费用按照研发项目进行归集，按照研发项目设立台账进行归集核算。

折旧费是按照固定资产的用途及使用部门进行分配，其中研发部门使用的固定资产对应的折旧费计入研发费用。公司购买的 IP 授权均用于研发活动，按照购买 IP 时的约定使用年限进行摊销。

为了规范公司的研究与开发流程，核算研发费用支出，公司建立了《研发费用管理制度》。公司研发费用对研发费用的预算立项、支出范围、归集方法、分摊原则及最终的专利及技术成果的认证做出规定并遵照执行，相关内控制度健全有效。

34.2 保荐机构和申报会计师核查过程和核查意见

核查过程：

1、检查了期间费用的明细构成及变动情况，与可比公司进行对比分析，并对大额费用的合同、发票、付款等情况进行检查；

2、了解职工薪酬相关的内控制度的设计及执行情况；对职工薪酬的计提和发放情况进行检查，对比分析发行人的报告期各部门平均薪酬的变化及其原因，检查与董事长及总经理薪酬相关的董事会决议，对董事长和总经理的薪酬进行函证；

3、访谈发行人管理层，了解与销售代理服务机构合作的原因，对销售佣金的合同、计提和支付进行检查，并对主要相关企业进行走访，重点关注合同签订、佣金的计算标准及支付安排、是否存在关联关系、是否收到处罚等情况；

4、了解发行人研发费用相关的内部控制制度涉及及执行，检查研发费用的支出范围、归集和核算方法是否符合企业会计准则的规定；对研发费用的工程费用采购进行函证，重新计算与研发费用相关的折旧与摊销。

核查结论：

保荐机构和申报会计师认为：

1、发行人的期间费用变动具有合理性，与同行业可比公司基本一致，不存在重大差异；

2、与境外销售服务代理机构合作符合行业惯例，具有合理性，除 ILDO Korea

Co., Ltd 的股东 EDOM Technology Co., Ltd 为发行人的客户外，其他境外服务代理机构与发行人客户不存在关联关系或其他利益安排，但发行人对 EDOM Technology Co., Ltd 的销售金额占比低于 1%，且 ILDO 的销售佣金与来自 EDOM Technology Co., Ltd 的销售收入无关，不存在其他利益安排；销售佣金增长与销售收入增长相匹配；报告期内未发现发行人通过外聘机构进行直接或变相商业贿赂的情况；

3、职工薪酬尤其是董事长、总经理的薪酬大幅增长具有合理性，发行人人员结构未发生重大变化，薪酬变动与员工人数和发行人业绩增长幅度相匹配；

4、发行人对管理费用中专业服务及咨询费的相关披露真实准确；

5、发行人对的研发费用的相关披露真实准确；研发费用中职工薪酬支出与发行人的技术水平相匹配；研发费用相关的内部控制制度健全有效。

34.3 补充披露情况

发行人已在招股说明书“第八节 财务会计信息与管理层分析”之“六、经营成果分析（四）期间费用分析”中补充披露如下：

（四）期间费用分析

.....

2、管理费用

.....

其中，报告期内租赁费下降，主要是由于转让消费电子芯片业务相关资产后，所需办公场所面积减少所致；报告期内专业服务及咨询费增长，主要是公司聘请中介机构产生的相关费用。

管理费用中专业服务及咨询费的主要构成如下表：

单位：万元

主要构成	2018 年度	2017 年度	2016 年度
------	---------	---------	---------

主要构成	2018 年度	2017 年度	2016 年度
咨询顾问费	290.78	333.64	396.5
法律服务费	312.37	118.81	48.43
审计费及资产评估费	118.83	137.54	117.19
人力资源服务费	43.21	25.01	38.42
合计	765.19	615.08	600.55

.....

3、研发费用

.....

研发费用中协作开发费先下降后上升，2017 年协作开发费下降主要系公司不再从事消费电子芯片业务后，相关委托第三方协作开发项目终止；2018 年协作开发费上升主要系公司开发津逮®服务器 CPU 需采购部分第三方技术开发服务所致。

研发费用中工程费用、协作开发费、工具费、许可证费的主要构成及变动原因如下：

项目	主要构成	具体用途	变动原因
工程费用	相关光罩、晶圆、封测等费用	研发工程样品试生产	产品更新换代，研发需要
协作开发费	委托对外技术开发服务	研发中需要的技术	产品更新换代，研发需要
工具费	研发工具采购	研发需要的工具	产品更新换代，研发需要
许可证费	短期及长期 IP 授权的许可费及摊销	研发所用 EDA 软件、License	产品更新换代，研发需要

问题三十五

Montage Group 2013年9月在美国Nasdaq上市发行价为10美元/股，2014年11月私有化价格为22.6美元/股。报告期内，发行人存在多次增资和股权转让，2018年3月臻石一号、臻石二号、臻石三号等六方增资价格约5.68元/1元注册资本，2018年12月Intel Capital, SVIC No.28 Investment增资价格约11.5元/股。

请发行人披露：(1)增资及股权转让对象的最终权益持有人与发行人的关系，是否为发行人的职工（含持股平台）、客户、供应商等，相关股份获取是否与发行人获得其服务相关；(2)入股前后，作为发行人股东的供应商、客户是否对发行人的生产经营和独立性产生重大影响，采购、销售协议中关于产品定价、采购/供货量、信用政策、收付款政策、返利政策等主要条款在入股前后是否存在变化，与其他供应商、客户是否一致，与其他供应商、客户的价格对比分析采购/销售价格的公允性，有无潜在利益安排；(3)报告期发行人与Intel同时采购、销售，且2018年金额大幅增加，是否与Intel入股相关；(4)增资及股权转让的定价依据，2018年3月增资以2017年8月31日为评估基准日的评估报告为依据的原因及适当性，结合Montage Group私有化定价、发行人近年来的业务发展及业绩增长情况、本次发行预计市值分析情况等充分说明报告期内增资及股权转让定价的公允性；(5)报告期内的增资及股权转让是否构成股份支付，如是，请披露股份支付的计算依据、方法、权益工具的公允价值及确定方法，以及是否计入非经常性损益；(6)短期内估值迅速增长的原因，保荐机构在对本次发行预计市值进行分析时，是否参考了报告期外部股权融资情况，评估依据是否充分，评估结果是否谨慎、合理。

请保荐机构及申报会计师对上述事项进行核查并发表明确意见。请保荐机构及申报会计师对报告期内发生的股份变动是否适用《企业会计准则第11号——股份支付》进行核查，并对以下问题发表明确意见：股份支付相关权益工具公允价值的计量方法及结果是否合理，与同期可比公司估值是否存在重大差异及原因；对于存在与股权所有权或收益权等相关的限制性条件的，相关条件是否真实、可行，服务期的判断是否准确，服务期各年/期确认的员工服务成本或费用是否准确；发行人报告期内股份支付相关会计处理是否符合企业会计准则的规定。

回复：

35.1 发行人说明

一、增资及股权转让对象的最终权益持有人与发行人的关系，是否为发行人的职工（含持股平台）、客户、供应商等，相关股份获取是否与发行人获得其服务相关。

2018 年，公司共进行过两次增资和一次股权转让，其具体情况如下：

（一）公司第五次增加注册资本

2017 年 8 月，澜起有限拟进行增资，故委托评估机构以 2017 年 8 月 31 日为评估基准日对澜起有限股东全部权益价值进行评估。2017 年 11 月 30 日，澜起有限股东决定，同意由臻石一号、臻石二号、臻石三号、Theon Investment、珠海融扬、珠海融英共六方以不低于上述评估值作为公司投前估值对澜起有限进行现金增资，合计认购澜起有限新增注册资本 146,819,325 元。2018 年 1 月，Montage Holding 董事会决议确定了上述六方主体对澜起有限进行增资的对价。

本次新增股东最终权益持有人均不是公司的客户或供应商。

臻石一号、臻石二号和臻石三号均为在境内备案的私募股权基金。其最终权益持有人中存在部分公司员工（合计 43 人）。珠海融英最终权益持有人为公司总经理的父母。Theon Investment 最终权益持有人中包括 2 名自然人为公司员工。珠海融扬最终受益人中包括 5 名自然人为公司员工。

上述新增股东最终权益持有人中参与投资的公司员工及其亲属获取该部分股份与其是否为公司未来提供服务无关，且获取价格公允。

（二）公司第二次股权转让

2018 年 1 月，Montage Holding 董事会决议同意 Montage HK 将其所持的全部澜起有限的股权转让给 Montage Holding 的普通股股东的指定主体。2018 年 4 月 26 日，澜起有限董事会决议通过股东 Montage HK 将其所持澜起有限 83.757% 股权转让给包括中电投控、嘉兴芯电、WLT 在内的 39 名境内外主体。

此次股权转让的目的实际为公司拆除境外架构以实现公司间接股东直接持

有澜起有限股权，因此股权转让对象均为拆除境外架构时 Montage Holding 普通股股东指定的主体。此次转让中，WLT 和珠海融英最终权益持有人存在部分公司员工及其亲属。

此次股权转让对象获取公司股份与其是否为公司提供服务无关，且获取价格公允。

（三）公司第六次增加注册资本

2018 年 11 月 23 日，公司 2018 年第一次临时股东大会作出决议，同意 Intel Capital 以 175,074,860 美元的价格认购 101,683,250 股新增股份，SVIC No. 28 Investment 以 19,452,762 美元的价格认购 11,298,150 股新增股份，增资价格系公司与增资方协商确定。

本次增资的新进股东最终受益人为 Intel 和三星电子，系公司供应商和客户，但相关股份获取与公司获得其服务无关。

二、入股前后，作为发行人股东的供应商、客户是否对发行人的生产经营和独立性产生重大影响，采购、销售协议中关于产品定价、采购/供货量、信用政策、收付款政策、返利政策等主要条款在入股前后是否存在变化，与其他供应商、客户是否一致，与其他供应商、客户的价格对比分析采购/销售价格的公允性，有无潜在利益安排

2018 年 12 月 Intel Capital, SVIC No.28 Investment 对公司增资，分别持有公司 10.000%和 1.111%的股份。其最终权益持有人 Intel 和三星电子虽然是公司的客户和供应商，但是不对公司的生产经营和独立性产生重大影响。其具体原因如下：

入股前后 Intel 与公司签订的采购、销售协议中关于产品定价、采购/供货量、信用政策、收付款政策、返利政策等主要条款在入股前后未发生变化。报告期内，公司主要向 Intel 采购其通用 CPU 内核芯片，未向其他供应商采购同类产品（Intel 销售的通用服务器 CPU 占全球相关市场份额的 90%以上）。公司向 Intel 的采购/销售价格均是在市场价格的基础上协商确定，无潜在利益安排。

入股前后公司与三星电子签订的销售协议中关于产品定价、供货量、信用政

策、收付款政策、返利政策等主要条款在入股前后未存在变化，公司向三星电子销售的产品与销售给其他客户的价格差异较小，公司向三星电子销售价格均是在市场价格的基础上协商确定，无潜在利益安排。

三、报告期发行人与Intel同时采购、销售，且2018年金额大幅增加，是否与Intel入股相关

2016年公司向Intel相关主体销售的是内存接口芯片，2017年及2018年公司向Intel相关主体销售的是混合安全内存模组产品。2016年、2017年和2018年，公司分别向Intel相关主体合计销售15.06万元、757.56万元和560.93万元，占营业收入比重均未超过1%。报告期内，公司向Intel相关主体出售的产品均系正常的商务往来，且2018年不存在销售金额大幅增长情况。

公司从2016年1月开始与清华大学、Intel联合研发津逮[®]系列服务器CPU。相关合作研发模式为：公司负责整体模块及部分芯片的设计，清华大学提供可重构计算处理器（RCP）的算法，Intel提供津逮[®]服务器平台中的通用CPU内核芯片。上述津逮[®]系列服务器CPU已于2018年下半年研发成功，因此公司于2018年开始向Intel相关主体采购其通用CPU内核芯片，合计2,705.58万元，是基于前述背景的正常业务合作与采购。

综上，公司报告期与Intel之间同时销售和采购，且2018年金额大幅增加与Intel Capital入股无关。

四、增资及股权转让的定价依据，2018年3月增资以2017年8月31日为评估基准日的评估报告为依据的原因及适当性，结合Montage Group私有化定价、发行人近年来的业务发展及业绩增长情况、本次发行预计市值分析情况等充分说明报告期内增资及股权转让定价的公允性

（一）公司第五次增加注册资本以2017年8月31日为评估基准日的评估报告为依据的原因及适当性

2017年8月，澜起有限拟进行增资，故委托评估机构以2017年8月31日为评估基准日对澜起有限股东全部权益价值进行评估。评估机构经过必要的评估程序，于2017年11月24日出具了相关的评估报告。2017年11月30日，澜起

有限股东决定，同意由臻石一号、臻石二号、臻石三号、Theon Investment、珠海融扬、珠海融英共六方以不低于上述评估报告的评估值作为公司投前估值对澜起有限进行现金增资，合计认购澜起有限新增注册资本 146,819,325 元。后经过协商谈判，本次增资投前估值约 43.0 亿元，投后估值约 51.3 亿元，投后估值对应 2017 年扣除非经常性损益后的净利润市盈率为 18.71 倍，属于市场公允价格。因此，本次增资以 2017 年 8 月 31 日为评估基准日的评估报告为依据具有相应的历史背景和适当性。

（二）公司第二次股权转让的定价依据

2018 年 1 月，Montage Holding 董事会决议同意 Montage HK 将其所持的全部澜起有限的股权转让给 Montage Holding 的普通股股东的指定主体，股权转让价款参考公司第五次增资价格，转让估值对应 2017 年扣除非经常性损益后的净利润市盈率为 18.71 倍，属于市场公允价格。

（三）公司第六次增加注册资本的定价依据

2018 年，公司凭借在内存接口芯片领域的技术竞争优势，收入及净利润均保持了快速增长，其中 2018 年净利润较 2017 年净利润上涨 109.44%。本次增资投后估值为 17.51 亿美元，约合 120 亿人民币，对应 2018 年扣非后净利润市盈率为 17.18 倍，与第五次增加注册资本的市盈率倍数基本一致，定价公允。

（四）结合 Montage Group 私有化定价、公司近年来的业务发展及业绩增长情况、本次发行预计市值分析情况等充分说明报告期内增资及股权转让定价的公允性

序号	具体事项	（投后）估值
1	Montage Group 私有化	6.93 亿美元
2	公司第五次增资	51.34 亿人民币
3	公司第二次股权转让	51.34 亿人民币
4	公司第六次增资	17.51 亿美元
5	发行预计市值	不低于 220.10 亿人民币

Montage Group 私有化定价主要是投资人参考二级市场价格加上一定溢价得出，且当时私有化买方主要看中内存接口芯片业务，即估值的主要部分是针对内

存接口芯片业务。公司第五次增资和第二次股权转让的决策时间分别为 2017 年 11 月和 2018 年 1 月，当时公司的主要产品为内存接口芯片，且其估值（投后）对应 2017 年扣非后净利润的市盈率倍数为 18.71，具有合理性。从公司业务发展和业绩增长情况来看，公司 2017 年和 2018 年扣除非经常性损益后净利润分别为 27,437.43 万元和 69,844.59 万元，2018 年较 2017 年增长 154.56%。公司第六次增资投后估值约合 120 亿元，对应 2018 年扣非后净利润的市盈率倍数为 17.18，与第五次增加注册资本的市盈率倍数基本一致，体现了公司 2018 年业绩增长的结果，定价公允。

本次发行预计市值是保荐机构参考可比上市公司相关估值，对公司上市后估值做出的初步预计，理论上应不低于报告期内最近一次的增资价格，但与公司在报告期内非上市状态下的增资和股权转让价格不具备可比性。

综上，公司报告期内增资及股权转让定价具备公允性。

五、报告期内的增资及股权转让是否构成股份支付，如是，请披露股份支付的计算依据、方法、权益工具的公允价值及确定方法，以及是否计入非经常性损益

报告期内的增资及股权转让协议不存在限制性条款，不存在要求员工、供应商或客户承诺提供服务换取投资机会的约定，且相关定价公允，不存在对员工、供应商或客户的激励或补偿。因此，不满足确认股份支付的必要条件，不构成股份支付，相关会计处理符合《企业会计准则》的规定。

六、短期内估值迅速增长的原因，保荐机构在对本次发行预计市值进行分析时，是否参考了报告期外部股权融资情况，评估依据是否充分，评估结果是否谨慎、合理

（一）短期内估值迅速增长的原因

公司短期内估值迅速增长主要原因系：1、公司业绩增长较快；2、投资者认可公司业务价值及未来业绩增长。

（二）保荐机构在对本次发行预计市值进行分析时，是否参考了报告期外部股权融资情况，评估依据是否充分，评估结果是否谨慎、合理

保荐机构在本次发行预计市值分析时，参考了报告期外部股权融资情况，原则上不低于最近一次外部股权融资价格。

保荐机构在本次发行预计市值分析时，参考了同行业上市公司汇顶科技和兆易创新的平均市盈率（P/E）78.18 和平均市销率（P/S）12.52。公司 2018 年度经审计的归属于母公司所有者的净利润及营业收入分别乘以可比上市公司的平均市盈率和平均市销率，可以得到公司按可比公司市盈率比较法及可比公司市销率比较法计算出的估值分别为 576.09 亿元和 220.10 亿元。

保荐机构选取了按可比公司市盈率比较法及可比公司市销率比较法计算出的估值作为市值预测区间，最后预测公司市值将不低于 220.10 亿元。

综上，保荐机构在对本次发行预计市值进行分析时，参考了报告期外部股权融资情况，同时依据可比上市公司相关估值进行评估，评估依据是充分的，评估结果谨慎、合理。

35.2 保荐机构和申报会计师核查过程和核查意见

一、保荐机构和申报会计师对于发行人说明的核查过程及核查意见

核查过程：

1、查阅了发行人股东调查表，穿透核查了相关股东的最终受益人，并通过公开信息核对了发行人股东的相关信息，检查最终受益人是否存在发行人员工、供应商和客户的情况；访谈了发行人的董事长、总经理、董事会秘书等，了解了发行人历次股权变更和估值依据的具体情况。

2、检查入股后，Intel 和三星电子对发行人的持股和董事会构成等情况，判断其是否对发行人的生产经营和独立性产生重大影响；检查 Intel 和三星电子的采购、销售合同及订单中关于产品定价、采购/供货量、信用政策、收付款政策、返利政策等主要条款在入股前后是否发生变化，检查发行人销售和采购记录，判断其与其他供应商、客户是否一致，与其他供应商、客户的价格进行对比，分析 Intel 和三星电子采购/销售价格的公允性，是否存在潜在利益安排；

3、通过访谈发行人管理层和查询公开信息，检查发行人与 Intel 签订的合同订单，了解发行人与 Intel 合作开发的背景，权利义务划分等情况，分析发行人

与 Intel 同时采购、销售，且 2018 年金额大幅增加的原因及合理性；

4、访谈管理层关于历次增资及股权转让的定价依据和考虑因素，对相关的评估报告进行复核，分析估值变化的原因，判断报告期内增资及股权转让的定价依据是否合理，转让定价是否公允

5、根据企业会计准则中关于股份支付的相关规定，检查报告期内增资及股权转让不构成股份支付是否符合企业会计准则的规定。

核查结论：

经核查，保荐机构和申报会计师认为：

1、发行人报告期内的增资及股权转让对象的最终受益人中存在部分发行人员工、客户和供应商，上述股东最终权益持有人中参与投资的发行人员工及其亲属、客户及供应商获取该部分股份与其是否为发行人未来提供或获取服务无关，且获取价格公允；

2、入股前后，作为发行人股东的供应商、客户对发行人的生产经营和独立性不产生重大影响，采购、销售协议中关于产品定价、采购/供货量、信用政策、收付款政策、返利政策等主要条款在入股前后亦不存在变化，且双方交易价格具备公允性，不存在潜在利益安排；

3、报告期发行人与 Intel 同时采购、销售，且 2018 年金额大幅增加具有合理的商业理由，与 Intel 入股无关；

4、发行人第五次增加注册资本以 2017 年 8 月 31 日为评估基准日的评估报告为依据具有相应的历史背景和适当性，报告期内的增资及股权转让定价具备合理性、公允性；

5、报告期内的增资及股权转让不构成股份支付；

6、发行人估值增值迅速与其业绩增速相关，具备合理性，保荐机构对其预计市值分析亦具备合理性，评估依据充分，评估结果谨慎、合理；

7、发行人报告期内股份支付相关会计处理符合企业会计准则的规定。

二、保荐机构和申报会计师对于报告期内发生的股份变动是否适用股份支

付的核查过程及核查意见

（一）股份支付相关权益工具公允价值的计量方法及结果是否合理，与同期可比公司估值是否存在重大差异及原因

1、股份支付相关权益工具公允价值计量方法的相关规定

《企业会计准则第 11 号—股份支付》第四条“权益工具的公允价值，应当按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》确定。”和《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》第五十二条“金融工具不存在活跃市场的，企业应当采用估值技术确定其公允价值。采用估值技术得出的结果，应当反映估值日在公平交易中可能采用的交易价格。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。”

2、发行人相关增资及股权转让公允价值确认情况

（1）2017 年 8 月，澜起有限拟进行增资，故委托评估机构以 2017 年 8 月 31 日为评估基准日对澜起有限股东全部权益价值进行评估。评估机构经过必要的评估程序，于 2017 年 11 月 24 日出具了相关的评估报告。2017 年 11 月 30 日，澜起有限股东决定，同意由蔴石一号、蔴石二号、蔴石三号、Theon Investment、珠海融扬、珠海融英共六方以不低于上述评估报告的评估值作为公司投前估值对澜起有限进行现金增资。2018 年 1 月，Montage Holding 董事会决议确定了上述六方主体对澜起有限进行增资的对价。在确定增资估值时，发行的股份暂未在资本市场流通，当时也没有引入外部机构或战略投资者相对公允的价格，公允价值的获取有一定难度，因此发行人采用专业评估机构评估的评估价值作为发行人权益工具的公允价值具有合理性。

（2）2018 年 1 月，Montage Holding 董事会决议同意 Montage HK 将其所持的全部澜起有限的股权转让给 Montage Holding 的普通股股东的指定主体，股权转让价款参考发行人第五次增资价格，定价公允。

（3）2018 年 12 月 Intel Capital, SVIC No.28 Investment 增资，增资价格系公司与增资方协商确定，不存在对客户和供应商的激励或补偿，其定价公允。

3、发行人与同期可比公司估值是否存在重大差异及原因

发行人的可比公司均为上市公司，而发行人在报告期内尚未上市，因此双方估值不具备可比性。针对发行人的估值，选取同期上市公司收购同行业非上市公司的估值作为可比估值，具体选取的交易包括：四维图新收购杰发科技和东软载波收购上海海尔，同行业非上市公司在交易中对应估值的动态市盈率如下：

项目	杰发科技	上海海尔
动态市盈率	19.2	17.94

发行人第五次增资及第二次股权转让估值（投后）对应 2017 年扣除非经常性损益后的净利润市盈率为 18.71 倍，发行人第六次增资投后估值对应 2018 年扣非后净利润市盈率为 17.18 倍，与同行业非上市公司交易估值的动态市盈率基本一致，不存在重大差异。

（二）对于存在与股权所有权或收益权等相关的限制性条件的，相关条件是否真实、可行，服务期的判断是否准确，服务期各年/期确认的员工服务成本或费用是否准确

报告期内发行人相关增资和股权转让，没有与股权所有权或收益权等相关的限制性条件。

（三）发行人报告期内股份支付相关会计处理是否符合企业会计准则的规定

1、企业会计准则关于股份支付的规定

《企业会计准则第 11 号—股份支付》第二条规定，“股份支付，是指企业为获取职工和其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。”

《企业会计准则第 11 号—股份支付》第四条规定，“以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，应当以授予职工权益工具的公允价值计量。权益工具的公允价值，应当按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》确定。”

《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》第五十二条规定，“金融工具不存在活跃市场的，企业应当采用估值技术确定其公允价值。采用估值技术

得出的结果，应当反映估值日在公平交易中可能采用的交易价格。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。”

《企业会计准则第 11 号——股份支付》应用指南中“一、股份支付的含义：本准则第二条规定，股份支付是指企业为获取职工和其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。企业授予职工期权、认股权证等衍生工具或其他权益工具，对职工进行激励或补偿，以换取职工提供的服务，实质上属于职工薪酬的组成部分，但由于股份支付是以权益工具的公允价值为计量基础，因此由本准则进行规范。”

2、发行人对增资及股权转让相关的会计处理

(1) 发行人确认权益工具的公允价值的考虑。

因发行人的股份暂未在资本市场流通，公允价值的获取有一定难度，发行人采用估值技术确认权益工具的公允价值。通常管理层需要考虑以下三个维度：①以引入外部机构或战略投资者相对公允的价格作为参照依据。从参考时效上，通常考虑六个月之内的股权交易，并考虑近期公司业务是否有重大变化。②引入专业的资产评估机构进行评估，比如首选现金流折现法；③以相同或类似行业市盈率、市净率，作为衡量公允价值的校对依据。最终价格经双方协商确定。

2017 年 11 月 24 日，相关评估机构以 2017 年 8 月 31 日为基准日使用收益法出具了相关评估报告。依据 2017 年 11 月 30 日发行人的股东决定，蔺石一号、蔺石二号、蔺石三号等六方以不低于上述评估报告评估值作为投前估值进行现金增资。在确定增资公允价值前后，发行人既没有引入外部投资者，没有可以参考的股权交易投资价格，发行人的股份也暂未在资本市场流通。因此发行人第五次增资参考 2017 年 8 月 31 日为基准日的评估价值，最终由双方协商确定，不构成股份支付。

发行人第二次股权转让于 2018 年 1 月经 Montage Holding 董事会同意，股权转让价款参考最近一次的增资价格，定价公允。双方按照公允价值进行交易，不构成股份支付。

2018年12月 Intel Capital, SVIC No.28 Investment 对发行人增资，考虑发行人2018年业绩增长情况，按照经协商的公允价值进行增资，并且入股前后采购、销售协议中关于产品定价、采购/供货量、信用政策、收付款政策等主要条款并未存在变化，不形成对客户和供应商的激励或补偿，不构成股份支付。

综上所述，保荐机构和申报会计师认为前述增资及股权转让均是按照权益工具的公允价值达成，不形成对员工、客户和供应商的激励或补偿，从而不确认为股份支付是合理的。

35.3 补充披露情况

发行人已在招股说明书“第五节 发行人基本情况”之“三、发行人股本形成及变化情况（七）第五次增加注册资本”中补充披露如下：

本次新增股东最终受益人均不是发行人的客户或供应商，存在部分发行人员工及其亲属，但上述新增股东最终权益持有人中参与投资的发行人员工及其亲属获取该部分股份与其是否为发行人未来提供服务无关，且获取价格公允。

发行人已在招股说明书“第五节 发行人基本情况”之“三、发行人股本形成及变化情况（八）第二次股权转让”中补充披露如下：

此次股权转让的目的实际为公司拆除境外架构以实现公司间接股东直接持有澜起有限股权，因此股权最终受益人均均为拆除境外架构时的普通股股东指定的主体。此次转让中，WLT 和珠海融英最终权益持有人存在部分发行人员工及其亲属。

发行人已在招股说明书“第五节 发行人基本情况”之“三、发行人股本形成及变化情况（十）第六次增加注册资本”中补充披露如下：

本次增资的新进股东最终受益人为 Intel 和三星电子，系发行人供应商和客户，但相关股份获取与发行人获得其服务无关。

问题三十六

报告期内, 发行人计入损益的政府补助分别为 971.76 万元、1,202.76 万元、2,198.42 万元, 计入递延收益的政府补助分别为 1,808.80 万元、1,982.80 万元和 13,788.38 万元。

请发行人披露: (1) 2018 年政府补助大幅增长的原因; (2) 区分与收益相关或与资产相关分析政府补助对发行人报告期与未来期间的影响; (3) 所承担科研项目的名称、项目类别、实施周期、总预算及其中的财政预算金额、计入当期收益和经常性损益的政府补助金额。

请发行人结合政府补助相关文件要求以及是否含有验收条件, 说明报告期内政府补助转入营业外收入和其他收益的时点、金额、依据; 补充提交政府补助证明文件清单列表, 并注明与政府补助项目的对应关系, 完整提交政府补助证明文件。

请保荐机构及申报会计师对上述事项进行核查, 并对发行人政府补助相关会计处理和非经常性损益列报的合规性发表明确意见。

回复:

36.1 发行人说明

一、2018 年政府补助大幅增长的原因

2018 年政府补助大幅增长的原因如下:

1、按照验收条件, 部分政府支持项目在2018年达到验收条件, 在验收通过后计入当期损益。

2、计入递延收益的政府补助大幅增长的原因是澜起电子昆山当期收到政府补助所致, 其中包括:

(1) 昆山经济开发区为响应国家及地方推进转型升级创新发展的规划与澜起电子昆山签订了专项扶持协议, 给予1亿元专项扶持资金。

(2) 昆山经济开发区投资的集成电路检测中心购置了研发活动相关的授权 IP和设备, 无偿提供给澜起电子昆山使用, 按照会计政策计入政府补助2,716.09

万元，其中562.71万元计入当期损益，2,153.38万元计入递延收益。

二、区分与收益相关或与资产相关分析政府补助对发行人报告期与未来期间的影响；

报告期内，公司计入损益的政府补助金额如下表：

单位：万元

政府补助	对未来期间损益的影响	对报告期内损益的影响		
		2018 年度	2017 年度	2016 年度
与收益相关的政府补助	11,635.00	1,635.71	1,202.76	971.76
与资产相关的政府补助	2,153.38	562.71	-	-
合计	13,788.38	2,198.42	1,202.76	971.76

截至报告期末，公司计入递延收益的与收益相关政府补助为 11,635.00 万元，未来达到验收条件后计入损益。公司收到与资产相关政府补助 2,716.09 万元，其中 2018 年 562.71 万元计入当期损益，剩余 2,153.38 万元计入未来期间。

三、所承担科研项目的名称、项目类别、实施周期、总预算及其中的财政预算金额、计入当期收益和经常性损益的政府补助金额。

澜起科技所承担科研项目的具体情况如下：

单位：万元

科研项目名称	项目类别	实施周期	总预算	财政预算金额	计入当期收益	是否计入经常性损益
2012-2014 年上海市重点技术改造项目专项资金：超低功耗 DDR4 内存缓冲控制器芯片的研发与产业化	研发项目	2012-7-1 至 2014-7-1	2,692.28	168.00	150.30	否
2013 核高基重大专项：DDR3 低功耗低负载内存缓冲控制器产品研发及产业化	研发项目	2013-1-1 至 2015-12-31	3,184.04	1,026.00	1,026.00	否
2013 年科技创新行动计划：用于下一代服务器的 DDR4 超低功耗寄存缓冲控制器芯片	研发项目	2013-7-1 至 2015-6-30	2,485.60	300.00	300.00	否
2014-2015 年上海市科委科技企业培育项目：基于 WIFI 的个人云终端 SOC 芯片	研发项目	2014-1-1 至 2015-12-31	2,685.00	60.00	60.00	否
2014 年度上海市科技小巨人项目	研发项目	2014-1-1 至 2015-12-31	4,390.00	225.00	225.00	否
2015 年科技型中小企业技术创新项目：基于 WIFI 移动云计算 SoC 芯片的研发	研发项目	2014-7-1 至 2016-6-30	290.00	130.00	130.00	否
2015 年姑苏创新创业领军人才专项：基于更先进的机顶盒 SoC 芯片高端 IP 核的研发	研发项目	2014-12-31 至 2016-12-31	650.00	30.00	30.00	否
2015 年上海市企业技术中心能力建设项目	研发项目	2015-1-1 至 2016-12-31	1,032.00	80.00	80.00	否
2015 年上海张江国家自主创新示范区专项发展资金项目：超宽带无线互联芯片研发及产业示范应用	研发项目	2015-9-1 至 2017-8-31	2,330.50	200.00	200.00	否

2016 年上海张江国家自主创新示范区专项发展资金项目：用于云计算的新一代内存缓冲控制器芯片的试制	研发项目	2016-1-1 至 2017-12-31	3,333.00	500.00	500.00	否
2016 年上海市科委项目：用于云计算数据中心的非易失性内存模块的研发	研发项目	2016-7-1 至 2018-6-30	2,287.00	741.00	592.80	否
2017 年上海市工业强基专项：安全可信高端通用服务器 CPU 平台的研发及产业化	研发项目	2017-1-1 至 2019-12-31	6,463.00	1,200.00	-	否
2017 工业强基工程：《基于完全自主知识产权的高性能 DDR4 内存缓冲控制接口芯片实施方案》	研发项目	2017-5-3 至 2019-4-30	7,500.00	1,500.00	-	否
昆山自主可控企业培育项目：低功耗 DDR5 内存接口芯片的研发及产业化	研发项目	2018-1-1 至 2020-12-31	1,000.00	100.00	-	否

四、请发行人结合政府补助相关文件要求以及是否含有验收条件，说明报告期内政府补助转入营业外收入和其他收益的时点、金额、依据

根据《企业会计准则第 16 号-政府补助》的规定，公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。

1、与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。

2、与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。

公司收到含有验收条件的政府补助，收到时确认为递延收益，在完成项目验收后，与该政府补助项目无退回的风险后，与公司日常活动相关的政府补助，按照实际收到的金额，计入其他收益；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。

36.2 保荐机构和申报会计师核查过程和核查意见

核查过程：

1、检查了发行人的政府补助相关文件、收款记录，关注其项目验收条件、进度等事项；

2、比对发行人的科研项目清单及具体进展性与政府补助文件要求，核对企业会计处理是否与合规，金额计量是否正确；

核查结论：

经核查，保荐机构和申报会计师认为：

1、发行人政府补助相关会计处理符合企业会计准则的规定；

2、由于政府补助的偶发性，发行人将计入损益的政府补助作为非经常性损益列报；

3、发行人政府补助的会计处理和非经常性损益的列报合规。

36.3 补充披露情况

发行人已在招股说明书“第八节 财务会计信息与管理层分析”之“六、经营成果分析（六）其他收益”中补充披露如下：

2016年、2017年、2018年，公司其他收益为0元、1,201.76万元和2,198.42万元，主要为政府补助，**2018年公司政府补助增长的主要系公司部分政府支持项目在2018年达到验收条件，在验收通过后计入当期损益所致。**

问题三十七

报告期各期末，公司应收账款分别为5,879.64万元、11,925.79万元、24,114.92万元，应收账款余额占营业收入比例分别为 6.96、9.99、13.96。

请发行人披露：（1）报告期各期末应收账款余额占营业收入比例逐年提高的原因，报告期内应收账款的变动情况是否与信用政策相匹配，信用政策是否发生变化，是否存在放宽信用期刺激销售的情形；（2）应收账款的期后回款情况与信用政策的一致性；（3）结合各期末应收账款的期后回款进度、2018 年末应收账款预期回款情况等，说明坏账准备计提政策是否谨慎，坏账准备计提是否充分；（4）应收账款、其他应收款前五名客户的名称。

请保荐机构及申报会计师对上述事项进行核查并发表明确意见。

回复：

37.1 发行人说明

一、报告期各期末应收账款余额占营业收入比例逐年提高的原因

2016 年末、2017 年末和 2018 年末，公司应收账款余额占当年营业收入的比例分别为 6.96%、9.99%和 13.96%。

（一）2017 年末应收账款余额占营业收入比例高于 2016 年末的原因

2017 年末应收账款余额占营业收入的比例为 9.99%，较 2016 年末上升 3.03 个百分点，主要是由于 2017 年 7 月公司转让消费电子芯片业务产品给成都澜至和 Montage Group 产生的应收账款 7,594.84 万元按照协议未到还款期限所致。剔除该笔应收账款影响后，2017 年应收账款余额占营业收入比例为 4.37%，比 2016 年末的 6.96%降低了 2.59 个百分点。

（二）2018 年末应收账款余额占营业收入比例高于 2017 年末的原因

2018 年末应收账款余额占营业收入的比例为 13.96%，较 2017 年末上升 3.97 个百分点，主要系公司每年末应收账款余额主要来自于第四季度的营业收入，而 2018 年第四季度的营业收入同比增长较快所致。2017 年第四季度营业收入为 24,661.47 万元，2018 年第四季度营业收入为 50,646.95 万元，同比增长 105.37%。

2017 年末及 2018 年末公司应收账款分别为 11,925.79 万元、24,114.92 万元，同比增长 102.21%，与销售增长基本同步。

综上所述，公司报告期各期末应收账款余额占营业收入比例逐年提高具有合理性，报告期内应收账款的变动情况与信用政策相匹配，公司的信用政策未发生重大变化，也不存在放宽信用期刺激销售的情形。

二、应收账款的期后回款情况与信用政策的一致性

公司各期期末应收账款期后回款情况如下表：

单位：万元

年度	期末应收账款余额	期后三个月内回款金额		剔除因转让消费电子芯片业务相关资产的应收账款	
		回款金额	回款比例	应收账款余额	回款比例
2016	5,882.40	5,761.16	97.94%	5,882.40	97.94%
2017	12,258.49	4,662.34	38.03%	4,663.65	99.97%
2018	24,536.81	20,130.07	82.04%	20,317.97	99.08%

公司 2016 年末应收账款在 2017 年 3 月末已回款 97.94%；2017 年期末剔除因转让消费电子芯片相关资产按照协议约定未到期的应收账款余额 7,594.84 万元，则在 2018 年 3 月末已回款 99.97%；2018 年末应收账款剔除因转让消费电子芯片相关资产按照协议约定未到期的应收账款余额 4,218.84 万元，则在 2019 年 3 月末已回款 99.08%。

因此应收账款的期后回款情况与公司给予客户的信用政策基本一致。

三、结合各期末应收账款的期后回款进度、2018 年末应收账款预期回款情况等，说明坏账准备计提政策是否谨慎，坏账准备计提是否充分

（一）公司的应收账款坏账准备计提政策

公司根据信用风险特征组合确定的坏账准备计提方法如下：

1、组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的组合计提方法

账龄	应收账款计提比例（%）
1 年以内（含 1 年，下同）	

账龄	应收账款计提比例 (%)
其中：3 个月以内 (含 3 个月)	0.00
3-12 个月 (含 12 月)	5.00
1-2 年	10.00
2-3 年	30.00
3 年以上	100.00

2、组合中，采用个别认定法计提坏账准备的计提方法

组合名称	应收账款计提比例
其他组合	对组合内关联方应收款项、房租押金单独测试计提坏账

(二) 公司期后回款情况

公司 2016 年末应收账款在 2017 年 3 月末已回款 97.94%；2017 年期末剔除因转让消费电子芯片相关资产按照协议约定未到期的应收账款余额 7,594.84 万元，则在 2018 年 3 月末已回款 99.97%；2018 年末应收账款剔除因转让消费电子芯片相关资产按照协议约定未到期的应收账款余额 4,218.84 万元，则在 2019 年 3 月末已回款 99.08%。

截至本问询函回复签署日，公司 2018 年末的应收账款已全部收回。

公司根据历史经验与目前经济状况制定的坏账准备计提政策，与公司的期后回款实际情况一致，坏账准备计提政策符合企业实际情况，政策谨慎，计提充分。

四、应收账款、其他应收款前五名客户的名称

(一) 应收账款前五名客户

1、应收账款前五名情况

截至 2018 年 12 月 31 日，公司前五名应收账款余额客户情况如下：

单位：万元

公司名称	金额	占比	账龄
客户 B	8,886.39	36.22%	3 个月以内
客户 A	4,285.38	17.47%	3 个月以内
成都澜至	4,218.84	17.19%	1-2 年
客户 C	2,653.30	10.81%	3 个月以内
客户 D	1,861.19	7.58%	3 个月以内

合计	21,905.10	89.27%	
----	-----------	--------	--

截至2017年12月31日，公司前五名应收账款余额客户情况如下：

单位：万元

公司名称	金额	占比	账龄
成都澜至	6,653.84	54.28%	3-12个月
客户A	2,740.90	22.36%	3个月以内
客户E	1,500.91	12.24%	3个月以内
Montage Group	941.00	7.68%	3-12个月
客户O	144.95	1.18%	3个月以内
合计	11,981.60	97.74%	

截至2016年12月31日，公司前五名应收账款余额客户情况如下：

单位：万元

公司名称	金额	占比	账龄
客户B	2,216.93	37.69%	3个月以内
客户A	1,575.36	26.78%	3个月以内
客户D	870.18	14.79%	3个月以内
Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.S. el	499.91	8.50%	1年以内
客户E	378.07	6.43%	3个月以内
合计	5,540.45	94.19%	

2、其他应收款前五名情况

截至2018年12月31日，公司前五名其他应收账款余额客户情况如下：

单位：万元

公司名称	金额	占比	账龄
成都澜至	2,604.82	90.45%	1-2年
上海新兴技术开发区联合发展有限公司	155.47	5.40%	6个月-3年以上
Myoungil Systems	42.88	1.49%	3-12个月
员工A（注）	30.88	1.07%	1-2年
CA-Metro Plaza Limited Partnership	16.22	0.57%	3个月以内-3年以上
合计	2,850.27	98.98%	—

注：员工A系本公司韩国境外分支机构员工，借用公司备用金系用于出差租房的房租押金。

截至2017年12月31日，公司前五名其他应收账款余额欠款方情况如下：

单位：万元

公司名称	金额	占比	账龄
------	----	----	----

CEC Tong Shang Company Limited	19,602.60	77.28%	3-12 个月
成都澜至	2,604.82	10.27%	3-12 个月
Montage Group	1,616.25	6.37%	1 年以内
Intel	784.10	3.09%	3 个月以内
澜至半导体	489.52	1.93%	3-12 个月
合计	25,097.29	98.94%	

截至2016年12月31日，公司前五名其他应收账款余额欠款方情况如下：

单位：万元

公司名称	金额	占比	账龄
应收股利退税	820.00	40.13%	3 个月以内
出口退增值税款	681.20	33.34%	3 个月以内
上海新兴技术开发区联合发展有限公司	293.90	14.38%	3 个月-3 年以上
上海澜至	106.40	5.21%	3 个月以内
苏州工业园区科技发展有限公司	37.51	1.83%	3 年以上
合计	1,939.01	94.89%	

37.2 保荐机构和申报会计师核查过程和核查意见

核查过程：

- 1、了解发行人销售与收款相关的内部控制制度的设计及执行；
- 2、对报告期内应收账款执行实质性分析程序，对报告期的变化及周转率进行比较，分析其原因；
- 3、检查发行人的坏账计提政策是否符合企业会计准则的规定，与发行人历史期应收账款信用情况是否一致，判断发行人的坏账政策是否谨慎；
- 3、划分期末应收账款的账龄，函证了报告期内的期末应收账款余额，检查了销售合同及订单中关于信用政策的约定，检查期后回款的银行回单，比对回款进度是否与信用政策相匹配。

核查结论：

经核查，保荐机构和申报会计师认为：

1、发行人报告期各期末应收账款余额占营业收入比例逐年提高的原因合理，报告期内应收账款的变动情况与信用政策相匹配，信用政策未发生变化，不存在放宽信用期刺激销售的情形；

2、应收账款的期后回款情况与信用政策基本一致，且截至本问询函回复签署日，公司 2018 年末的应收账款已全部收回；

3、发行人坏账准备计提政策谨慎，坏账准备计提充分。

37.3 补充披露情况

发行人已在招股说明书“第八节 财务会计信息与管理层分析”之“七、资产质量分析（二）流动分析”中补充披露如下：

2、应收账款

.....

（1）应收账款变动分析

.....

应收账款 2017 年末较 2016 年末增长 6,046.15 万元，同比增长 102.83%，主要原因是由于 2017 年 7 月发行人转让消费电子芯片业务产品给成都澜至和 Montage Group 产生的应收账款 7,594.84 万元按照协议未到还款期限所致。剔除该笔应收账款影响后，2017 年应收账款余额占营业收入比例为 4.37%，比 2016 年末的 6.96%降低了 2.59 个百分点。

应收账款2018年末较2017年末增长12,189.13万元，同比增长102.21%，主要原因是2018年第四季度的销售同比增长较快所致。公司给客户的信用账期一般不超过90天，所以每年第四季度的营业收入对当年末应收账款的影响较大。2017年第四季度营业收入24,661.47万元，2018年第四季度营业收入50,646.95万元，增长105.37%。2017年末及2018年末公司应收账款分别为11,925.79万元、24,114.92万元，同比增长102.21%，与销售增长基本同步。

.....

（3）应收账款账龄分析

.....

发行人 2016 年末应收账款在 2017 年 3 月末已回款 97.94%；2017 年期末剔除因转让消费电子芯片相关资产按照协议约定未到期的应收账款余额 7,594.84 万元，则在 2018 年 3 月末已回款 99.97%；2018 年末应收账款剔除因转让消费电子芯片相关资产按照协议约定未到期的应收账款余额 4,218.84 万元，则在 2019 年 3 月末已回款 99.08%。应收账款的期后回款情况与发行人给予客户的信用政策基本一致。

截至本招股说明书签署日，2018年末的应收账款已全部收回。

问题三十八

报告期各期末,公司存货账面金额分别为 25,606.94 万元、13,251.29 万元、12,067.35 万元,主要为原材料、委托加工物资、库存商品和发出商品。各期存货跌价准备计提比例分别占各期末存货比重的 24.98%、39.11%、40.09%。

请发行人披露:(1)结合在手订单和期后销售情况进一步披露各期末存货的订单支持率和期后销售实现情况;(2)在产品销售价格持续上升的情况下,存货跌价准备计提比例逐年提高的原因;(3)区分原材料、委托加工物资、库存商品和发出商品分别披露存货跌价准备的计提情况,区分不同产品系列、库龄结构等披露具体的存货跌价准备计提政策,存货跌价准备计提是否充分;(4)报告期内产品的退换货情况以及退换货的处理措施;(5)存货管理、盘点的内部控制制度及执行情况,报告期内的盘点及盘盈亏情况。

请保荐机构及申报会计师说明对存放在委外供应商和委外仓库的存货的实地核查及监盘情况,对上述事项进行核查并发表明确意见。

回复:

38.1 发行人说明

一、结合在手订单和期后销售情况进一步披露各期末存货的订单支持率和期后销售实现情况;

项目	2018 年度	2017 年度	2016 年度
在手订单支持率	43.93%	59.57%	20.35%
库存商品销售实现率	97.59%	63.06%	33.76%

注:在手订单支持率=期末在手订单成本/期末库存商品和发出商品金额

库存商品销售实现率=期后两个月的销售成本/期末库存商品和发出商品金额

二、在产品销售价格持续上升的情况下,存货跌价准备计提比例逐年提高的原因

2016年、2017年和2018年,公司存货跌价准备分别为8,524.94万元、8,511.12万元和8,076.35万元,分别占各期末存货比重为24.98%、39.11%和40.09%。由于公司加强了存货管理且销售持续向好,在报告期内公司存货跌价准备余额总体保持稳定,而存货账面余额逐年下降,从而造成存货跌价准备计提比例逐年提高。

三、区分原材料、委托加工物资、库存商品和发出商品分别披露存货跌价准备的计提情况，区分不同产品系列、库龄结构等披露具体的存货跌价准备计提政策，存货跌价准备计提是否充分；

(一) 区分原材料、委托加工物资、库存商品和发出商品分别披露存货跌价准备的计提情况

报告期内，公司按存货种类的存货跌价准备计提情况如下：

单位：万元

2018-12-31				
项目	账面余额	存货跌价准备	账面价值	计提比例
原材料	3,136.35	1,704.35	1,432.00	54.34%
委托加工物资	10,989.04	3,171.86	7,817.18	28.86%
库存商品	5,956.20	3,200.14	2,756.06	53.73%
发出商品	62.11	-	62.11	-
合计	20,143.70	8,076.35	12,067.35	40.09%
2017-12-31				
项目	账面余额	存货跌价准备	账面价值	计提比例
原材料	1,945.91	1,372.74	573.16	70.54%
委托加工物资	10,015.08	2,455.48	7,559.60	24.52%
库存商品	7,590.32	4,682.90	2,907.43	61.70%
发出商品	2,211.10	-	2,211.10	
合计	21,762.42	8,511.12	13,251.29	39.11%
2016-12-31				
项目	账面余额	存货跌价准备	账面价值	计提比例
原材料	7,798.17	54.11	7,744.06	0.69%
委托加工物资	8,881.10	183.44	8,697.66	2.07%
库存商品	15,103.12	8,287.39	6,815.72	54.87%
发出商品	2,349.50	-	2,349.50	
合计	34,131.88	8,524.94	25,606.94	24.98%

(二) 区分不同产品系列、库龄结构等披露具体的存货跌价准备计提政策，存货跌价准备计提是否充分

1、公司存货跌价准备计提政策

根据《企业会计准则第1号——存货》，公司按照存货成本与可变现净值孰

低的方法确认期末存货跌价准备金额。在具体计算减值时，公司是用预计未来售价减去可对外进行销售的最终产品成本。预计未来售价主要是参考报告期次月的实际对外销售售价、销售订单约定价格、市场询价等。

对于产品的成本，公司根据存货的不同状态，按照产品的生产加工流程，计算不同存货达到可对外销售状态时的后续成本，后续成本与账面成本之和就是可对外进行销售的最终产品的成本，具体计算如下：

①发出商品、库存商品的成本

发出商品和库存商品已完成生产制造，后续成本为其销售费用，其账面价值加上销售费用就是可对外进行销售的最终产成品的成本。

②委托加工半成品的成本

根据公司最近各类委托加工半成品的封测单位成本，预估各类委托加工半成品的封测成本及销售费用；委托加工半成品成本与预估封测成本及销售费用之和即为可对外进行销售的最终产成品的成本。

③原材料的成本

结合公司最近的销售预测情况，预估原材料未来将生产成哪些种类的库存商品，再根据公司最近该产品的平均封测单位成本，预估各类加工产品的封测成本及销售费用，原材料成本与封测成本及销售费用之和即为继续加工后可对外销售的库存商品成本。

2、相关计提政策是否谨慎，计提是否充分的分析

报告期各期末，公司分产品按照成本与可变现净值孰低的方法对存货进行了减值测试，并计提存货跌价准备。确定可变现净值时已考虑了产品及其存货库龄的影响，存货跌价准备的计提是合理、充分的。

四、报告期内产品的退换货情况以及退换货的处理措施；

报告期内退换货金额如下表所示：

单位：万元

项目	2018 年度	2017 年度	2016 年度
退换货金额	373.97	66.30	232.44
营业收入金额	175,766.46	122,751.49	84,494.46
退换货金额占当期	0.21%	0.05%	0.28%

项目	2018 年度	2017 年度	2016 年度
营业收入的比例			

由上表可知，报告期内退换货的金额占当期收入的比例均在 0.30% 以下，主要是因质量问题的退换货。

公司在收到客户的退换货申请后，核实退货的原因，如确实是公司的原因导致的退货，则通过相关部门负责人审批后根据客户的要求退货或换货，对于未经授权审批的退换货委外供应商不予受理。因产品质量退回的产品，运营部门讨论处置方案，在得到相关部门负责人、总经理审批同意后定期进行报废处理。

五、存货管理、盘点的内部控制制度及执行情况，报告期内的盘点及盘盈亏情况。

（一）存货管理、盘点的内部控制制度及执行情况

公司为规范存货的管理，保障资产的安全和运营的效率，公司制定了《存货管理制度》与《存货盘点管理制度》，按照存货管理制度的要求进行管理，定期进行存货盘点，相关的内控制度及执行情况如下：

1、存货管理包括原材料、委托加工物资及产成品等的管理。根据《存货管理制度》相关规定，委外供应商仓库按照制订的要求对各种存货的存储和管理要求进行妥善保管。

2、明确与委外供应商的权利义务关系。公司通过合同、订单、工单的形式委托委外供应商进行制作和加工产品，委外供应商则有按照约定保证产品的数量、质量并按时交货，如存货放置在委外供应商的仓库则其有妥善保管的义务。公司运营部门人员保持与委外供应商的联系，并定期现场走访委外供应商，监督其义务的履行情况。

3、产成品不合格品由委外供应商根据《存货管理制度》中相关规定做识别隔离存放，经公司运营部门内部审批确认后做定期报废。委外厂商的正常加工损耗报废在系统作业时已自动处理，无须另行申请报废。委外加工良率若低于约定良率时，公司运营部协委外供应商共同查明原因并给出解决方案。

4、存货的出货作业由运营部下达指令到委外供应商，委外供应商仓库依照

出货要求,安排相应存货出货至指定地点并提供相应装箱单,供收货方核查确认;

5、运营部门要求委外供应商每日传输出入库明细数据及库存数据,出入库明细数据经运营部门人员确认后,更新至公司 ERP 系统。运营部门人员每周对异常数据进行处理,确保批量数据传输的完整性与准确性。公司财务部每月底针对公司 ERP 系统库存与委外供应商系统库存进行核查是否相符,若不符合时及时向相关部门提出,并追查原因。

6、公司组织人员定期对存货进行盘点。与委外供应商及客户沟通后编制存货盘点计划并通知相关人员,盘点人员需包括运营部门、财务部门及委外存库的管理人员;按照委外仓库提供的《存货盘点明细表》进行盘点,运营部门、财务部门及委外存库的人员共同参与盘点,盘点表需参与盘点人员全部签字;如委外仓库存在盘盈亏则在委外供应商系统调整《存货明细表》。然后按盘点后的《存货盘点明细表》与公司财务系统中的《存货明细表》进行核对,如存在盘盈盘亏的情形,财务部门编写《盘点盈亏报告表》,并填写数额差异原因的说明及对策后,呈报财务部负责人、运营部负责人及总经理审批;对于盘盈盘亏或毁损的存货应分清责任,及时向公司管理层做出书面请示,批复后按规定进行账务处理。

(二) 报告期内的盘点及盘盈亏情况

报告期内公司每年末对存货进行盘点,报告期内没有存货的盘盈亏情况。

六、保荐机构及申报会计师说明对存放在委外供应商和委外仓库的存货的实地核查及监盘情况

保荐机构及申报会计师对存放在委外供应商和委外仓库的存货的实地核查及监盘情况如下:

1、2018 年底对发行人的期末存货盘点执行监盘程序,主要有:

(1) 复核发行人的存货盘点计划,检查发行人的盘点范围是否包含所有的仓库,盘点计划是否合理。

(2) 执行监盘程序,发行人存货放置在委外厂商的仓库中,观察发行人工作人员和委外供应商仓库工作人员的现场盘点过程并进行抽盘,对于原材料和产成品全部盘点,对于产线上的委托加工物资进行抽盘监盘过程中检查存货的状态,

检查盘点记录与汇总记录。经存货盘点程序，发行人存货实物与财务记录相符。

2、对报告期期末存货向委外供应商函证并取得回函，回函无差异。对期末发出商品进行函证，回函无差异。

3、对委外供应商进行现场访谈，询问委外供应商的仓库工作人员，内容包括业务合作情况、存货存放情况等，未发现存货异常。

经对存放在委外供应商的存货进行实地核查及监盘程序，未发现重大差异。

38.2 保荐机构和申报会计师核查过程和核查意见

核查过程：

1、了解并评价与采购及存货相关的内部控制制度的涉及及执行；

2、取得并检查发行人的在手订单和期后销售情况统计表；

3、检查存货跌价准备的计提政策是否符合会计准则规定，复核发行人的存货减值测试表，分析计提存货跌价准备的原因及与存货库龄的匹配情况；

4、对期末存货盘点执行监盘程序并对委外厂商仓库进行函证，现场访谈委外供应商，了解其与发行人合作的具体情况，并与发行人实际情况核对。

核查结论：

经核查，保荐机构和申报会计师认为：

1、在产品销售价格持续上升的情况下，存货跌价准备计提比例逐年提高的原因具有合理性；

2、发行人存货跌价准备计提政策谨慎，存货跌价准备计提充分；

3、通过对存放在委外供应商和委外仓库的存货进行实地核查及监盘，未发现异常。

38.3 补充披露情况

发行人已在招股说明书“第八节 财务会计信息与管理层分析”之“七、资产质量分析（二）流动资产分析”中补充披露如下：

5、存货

.....

(1) 存货规模及变动情况分析

.....

报告期内发行人每年末对存货进行盘点，报告期内无存货的盘盈亏情况。

.....

(2) 存货减值分析

.....

由于公司加强了存货管理且销售持续向好，在报告期内，存货账面余额逐年下降，从而造成存货跌价准备计提比例逐年提高。

发行人已在招股说明书“第六节 业务与技术”之“一、公司的主营业务、主要产品及服务”之“（二）主要经营模式”之“4、销售模式”中补充披露如下：

(5) 退换货的处理措施。公司在收到客户的退换货申请后，核实退货的原因，如确实是发行人的原因导致的退货，则通过相关部门负责人审批后根据客户的要求退货或换货，对于未经授权审批的退换货委外供应商不予受理。因产品质量退回的产品，运营部门讨论处置方案，在得到相关部门负责人、总经理审批同意后定期进行报废处理。

发行人已在招股说明书“第六节 业务与技术”之“四、公司采购情况”中补充披露如下：

(三) 存货管理、盘点的内部控制制度及执行情况

发行人为规范存货的管理，保障资产的安全和运营的效率，发行人制定了《存货管理制度》与《存货盘点管理制度》，按照存货管理制度的要求进行管理，定期进行存货盘点，相关的内控制度及执行情况如下：

1、存货管理包括原材料、委托加工物资及产成品的管理。根据《存货管理

制度》相关规定，委外供应商仓库按照制订的要求对各种存货的存储和管理要求进行妥善保管；

2、明确与委外供应商的权利义务关系。发行人通过合同、订单、工单的形式委托委外供应商进行制作和加工产品，委外供应商则有按照约定保证产品的数量、质量并按时交货，如存货放置在委外供应商的仓库则其有妥善保管的义务。发行人运营部门人员保持与委外供应商的联系，并定期现场走访委外供应商，监督其义务的履行情况。

3、产成品不合格品由委外供应商根据《存货管理制度》中相关规定做识别隔离存放，经发行人运营部门内部审批确认后做定期报废。委外厂商的正常加工损耗报废在系统作业时已自动处理，无须另行申请报废。委外加工良率若低于约定良率时，发行人运营部协委外供应商共同查明原因并给出解决方案。

4、存货的出货作业由运营部下达指令到委外供应商，委外供应商仓库依照出货要求，安排相应存货出货至指定地点并提供相应装箱单，供收货方核查确认；

5、运营部门要求委外供应商每日传输出入库明细数据及库存数据，出入库明细数据经运营部门人员确认后，更新至发行人 ERP 系统。运营部门人员每周对异常数据进行处理，确保批量数据传输的完整性与准确性。发行人财务部每月底针对发行人 ERP 系统库存与委外供应商系统库存进行核查是否相符，若不符合时及时向相关部门提出，并追查原因。

6、发行人组织人员定期对存货进行盘点。与委外供应商及客户沟通后编制存货盘点计划并通知相关人员，盘点人员需包括运营部门、财务部门及委外存库的管理人员；按照委外仓库提供的《存货盘点明细表》进行盘点，运营部门、财务部门及委外存库的人员共同参与盘点，盘点表需参与盘点人员全部签字；如委外仓库存在盘盈亏则在委外供应商系统调整《存货明细表》。然后按盘点后的《存货盘点明细表》与发行人财务系统中的《存货明细表》进行核对，如存在盘盈盘亏的情形，财务部门编写《盘点盈亏报告表》，并填写数额差异原因的说明及对策后，呈报财务部负责人、运营部负责人及总经理审批；对于盘盈盘亏或毁损的存货应分清责任，及时向公司管理层做出书面请示，批复后按

规定进行账务处理。

问题三十九

请发行人补充披露无形资产中 IP 授权的具体内容、授权方、在发行人产品中的具体应用及重要性，报告期内账面价值逐年上升的原因。

回复：

39.1 发行人说明

（一）披露无形资产中 IP 授权的具体内容、授权方、在公司产品中的具体应用及重要性。

IP 授权主要是公司研发设计所需使用的电子设计自动化（EDA）工具，授权方包括 Synopsys、Cadence 及 Mentor 等。EDA 工具为芯片设计的辅助软件工具。利用 EDA 工具，设计工程师可以从概念、算法、协议等开始设计电子系统，通过计算机完成 IC 设计的实现、仿真和验证。EDA 工具的重要性在于保障 IC 设计的准确性，提高产品各项性能指标，减少设计周期和产品测试验证周期。

（二）披露无形资产中 IP 授权在报告期内账面价值逐年上升的原因

公司根据研发设计的需要，采购 EDA 工具等相关 IP 授权，由于研发项目复杂性逐年增强，所需 EDA 工具的相关模块和功能增加，因此每年采购金额有所增加导致账面价值逐年上升。

39.2 保荐机构核查过程和核查意见

核查过程：

保荐机构和申报会计师取得并审阅了无形资产中 IP 授权的具体内容

核查结论：

经核查，保荐机构和申报会计师认为：

发行人报告期内的无形资产中 IP 授权逐年上升具有合理性。

39.3 补充披露情况

发行人已在招股说明书“第八节 财务会计信息与管理层分析”之“七、资产质量分析（三）非流动资产分析”中补充披露如下：

IP授权主要是发行人研发设计所需使用的电子设计自动化（EDA）工具，授权方包括Synopsys、Cadence及Mentor等。EDA工具为芯片设计的辅助软件工具。利用EDA工具，设计工程师可以从概念、算法、协议等开始设计电子系统，通过计算机完成IC设计的实现、仿真和验证。EDA工具的重要性在于保障IC设计的准确性，提高产品各项性能指标，减少设计周期和产品测试验证周期。

问题四十

报告期内，公司投资支付的现金分别为 37,953.30 万元、45,000.00 万元、191,060.00 万元。

请发行人披露：(1) 投资支付现金的资金来源；(2) 报告期内的主要投资方向、投资内容、金额、时间、期限、利率、资金收回情况，履行的内部决策程序以及是否符合内部控制要求；(3) 利息收入、投资收益等与货币资金、投资规模的匹配性；(4) 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金与固定资产、无形资产等长期资产变动的匹配性；(5) 非经常性损益明细表中计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费的产生原因，资金占用方、占用资金规模、期限及费用约定，以及报告期内的变动情况。

请保荐机构及申报会计师对上述事项进行核查并发表明确意见。

回复：

40.1 发行人说明

一、投资支付现金的资金来源

投资支付现金的资金来源全部是公司的自有资金。

二、报告期内的主要投资方向、投资内容、金额、时间、期限、利率、资金收回情况，履行的内部决策程序以及是否符合内部控制要求；

报告期内公司主要投资是购买银行等金融机构的理财产品，在保证流动性的基础上提高闲置资金的回报率，购买的理财产品大部分属于保本型理财产品，安全性和流动性较好，每次购买理财产品均经财务负责人、总经理审批通过，财务部门负责建立投资管理台账，记录购买的理财产品的收益和回收情况，符合公司内部控制的要求。

报告期内公司的投资理财产品的明细如下：

1、2016 年公司投资的理财产品明细

单位：万元

投资方向	产品类型	金额	投资期限	利率	资金回收
------	------	----	------	----	------

投资方向	产品类型	金额	投资期限	利率	资金回收
银行理财产品	无固定期限理财	11,000.00	不限期限， T+1 赎回	一年期存款基 准利率 +1.30%-1.8%	已收回
银行理财产品	固定期限理财	2,000.00	60 天	4.45%	已收回
银行理财产品	美元固定期限理财	19,953.30	6 个月	1.85%	已收回
中国太平养老保障管理产品	固定期限投资	5,000.00	365 天	6.10%	已收回
合计		37,953.30			

2、2017 年公司投资的理财产品明细

单位：万元

投资方向	产品类型	金额	投资期限	利率	资金回收
银行理财产品	固定期限理财	26,000.00	2-6 个月	4.7% - 5%	已收回
银行理财产品	无固定期限理财	19,000.00	不限期限， T+1 赎回	按期限分档： 3.45%-4.65%	已收回
合计		45,000.00			

2、2018 年公司投资的理财产品明细

单位：万元

投资方向	产品类型	金额	投资期限	利率	资金回收
银行理财产品	固定期限理财	48,100.00	3-6 个月	4% - 5.2%	已收回
银行理财产品	无固定期限理财	36,060.00	不限期限， T+1 赎回	按期限分档： 1.80%-4.65%	已收回
银行结构性存款	固定期限存款	103,900.00	35 天-180 天	3.55%-4.5%	已收回
中国太平养老保障管理产品	固定期限投资	3,000.00	180 天	5.30%	已收回
合计		191,060.00			

三、利息收入、投资收益等与货币资金、投资规模的匹配性；

公司的利息收入，包括活期银行存款的利息、定期银行存款的利息及拆借给其他公司的借款利息，投资收益包括购买银行理财的收益及远期结售汇的收益，因浮动收益理财利息收益的不确定性，只有收到利息时才确认投资收益。

报告期内利息收入、投资收益与货币资金、投资规模的匹配性情况如下：

单位：万元

项目	2018 年度	2017 年度	2016 年度
利息收入	2,109.70	722.38	36.12
投资收益中理财产品利息收益	3,044.71	619.58	47.32
银行存款平均余额（（期初余额+期末余额）/2）	218,388.86	57,106.84	37,408.45
其他流动资产-理财余额		23,000.00	27,311.00
投资支付的现金	191,060.00	45,000.00	37,953.30
利息收入/银行存款平均余额	0.97%	1.26%	0.10%
投资收益/(投资支付的现金-理财余额)	1.59%	2.82%	0.44%

由上表并结合公司报告期的理财产品明细可以看出，利息收入/银行存款平均余额及投资收益/（投资支付的现金-理财余额）的比例，2016 年均低于 2017 年，主要因为 2016 年购买的定期存款和理财产品大部分期限较长，2016 年均未到期，利息收入和投资收益于 2017 年确认。2018 年利息收入/银行存款平均余额比例低于 2017 年，是因为 2018 年底大额股东投资款增加了银行存款平均余额；2018 年投资收益/（投资支付的现金-理财余额）的比例低于 2017 年，是因为 2018 年多是购买短期的银行理财产品，利率较低所致。

因此，公司报告期内利息收入和投资收益的变化具有合理性，报告期内利息收入、投资收益与货币资金、投资规模相匹配。

四、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金与固定资产、无形资产等长期资产变动的匹配性；

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金与固定资产、无形资产等长期资产变动如下表：

单位：万元

项目	2018 年度	2017 年度	2016 年度
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,789.44	5,763.49	461.26
长期资产购置			
固定资产	1,375.21	619.52	540.02

项目		2018 年度	2017 年度	2016 年度
情况	在建工程	335.46		
	无形资产	25.26	4,312.05	266.26
	长期待摊费用	-	347.75	29.20
	合计	1,735.93	5,279.32	835.48
差异		53.51	484.18	-374.22

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金与长期资产增加的差异原因是购置长期资产形成的应付账款的变动，购买固定资产的增值税及境外长期资产折算造成的汇兑差异的影响。2016 和 2017 年差异较大的原因主要是 2016 年末应付账款在 2017 年支付造成的差异。

五、非经常性损益明细表中计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费的产生原因，资金占用方、占用资金规模、期限及费用约定，以及报告期内的变动情况。

资金占用费产生的原因系 2017 年 4 月 6 日，CEC TONGSHANG COMPANY LIMITED 向公司借款 3000 万美金所致，期限一年，年利率 3.2%，每六个月付息一次，2018 年 4 月 5 日本金及利息已归还公司。

40.2 保荐机构和申报会计师核查过程和核查意见

核查过程：

1、取得发行人报告期内银行流水及投资明细，核查发行人对外投资的决策程序、投资的支付与收回的银行单据，对银行存款及理财余额进行函证，检查发行人对外借款的合同、利息计算及借款收回情况；

2、检查长期资产变动与现金流项目购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金的匹配关系。

核查结论：

经核查，保荐机构和申报会计师认为：

1、发行人报告期内的利息收入、投资收益等与货币资金、投资规模相匹配；

2、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金与固定资产、无形资产等长期资产变动相匹配。

40.3 补充披露情况

发行人已在招股说明书“第八节 财务会计信息与管理层分析”之“八、偿债能力、流动性与持续经营能力分析（六）现金流量分析”中补充披露如下：

报告期内，发行人投资支付现金的资金来源全部是发行人的自有资金，主要投资是购买银行等金融机构的理财产品，在保证流动性的基础上提高闲置资金的回报率，购买的理财产品大部分属于保本型理财产品，安全性和流动性较好。利息收入和投资收益的变化具有合理性，与货币资金、投资规模相匹配。

问题四十一

发行人在 2018 年 7 月 27 日、2018 年 10 月 30 日及 2019 年 1 月 7 日向太平养老保险股份有限公司购买金额为 3,350.00 万元、2,400.00 万元及 10,000.00 万元的太平金世久久养老保障产品。

请发行人披露：（1）购买年金产品金额的确定依据，短期内支付大量资金多次购买的原因，所履行的审议程序及合规性；（2）产品运作模式、资金的最终流向，参与对象是否全部为发行人的员工，截至目前上述资金或产品是否已经落实到员工个人；（3）年金计划金额与职工薪酬的匹配性，发行人是否对员工负有进一步支付义务，该年金计划作为表外处理的原因及合理性。

请保荐机构及申报会计师对上述事项进行核查，并对年金计划相关会计处理是否符合企业会计准则的规定发表明确意见。

回复：

41.1 发行人说明

一、购买年金产品金额的确定依据，短期内支付大量资金多次购买的原因，所履行的审议程序及合规性

购买年金的产品的金额依据企业 2017 年和 2018 年的经营情况和盈利水平，公司为公司员工购买企业年金是为了奖励员工，保留关键人才，支付金额与公司的盈利能力相符合。公司为员工购买企业年金经总经理办公会通过并向员工公示，符合公司章程的规定。三笔年金分别对应 2017 年奖励、2018 年上半年奖励、2018 年下半年奖励。因此，分笔购买具有合理性。

二、产品运作模式、资金的最终流向，参与对象是否全部为发行人的员工，截至目前上述资金或产品是否已经落实到员工个人

公司为员工购买的是太平金世久久集合型团体养老保障管理产品，按照与太平养老保险股份有限公司签订的《太平金世久久集合型团体养老保障管理产品合同》规定，公司为员工购买的企业年金作为基金管理，在资产托管人交通银行设立资产托管账户，并由太平资产管理有限公司和太平养老保险股份有限公司作为基金资产的管理人进行管理，基金管理人按照约定的投资组合比例进行投资管理，

基金投资所得的收益全部归基金所有，年金基金的最终受益人是公司员工。如受益人退出，投资管理人将受益人的基金份额卖出支付给受益人。

参与对象为公司员工（董事及高管除外），截止目前，2018年7月27日购买的3,350.00万元的员工年金已经分配落实到员工个人，剩余年金将在2019年分配完毕。

三、年金计划金额与职工薪酬的匹配性，发行人是否对员工负有进一步支付义务，该年金计划作为表外处理的原因及合理性。

1、年金计划金额与职工薪酬的匹配性，公司是否对员工负有进一步支付义务

单位：万元

项目	2018年	2017年	增长比例
净利润	73,687.84	34,691.60	112.41%
职工薪酬	30,789.01	15,737.09	95.65%

公司年金计划金额与公司经营业绩、职工薪酬保持同向增长，具体金额系公司根据每年的经营预算、业绩完成情况、对员工的激励需要等多因素综合考虑制定。

截至本问询函回复签署日，公司做出决议的企业年金已经全部支付给太平养老保险股份有限公司，无进一步支付义务。

2、年金计划作为表外处理的原因及合理性

公司为员工购买该年金计划，并向年金的资产管理人支付年金后，按照合同约定，该年金由资产管理人成立专门年金基金进行管理，公司无权要求退回，年金及其投资收益属于年金基金，且公司已经总经理办公会决议并向员工公开承诺最终该年金基金的份额支付给员工。年金计划协议达成之后，公司无法对该年金计划的运作和投资方式进行控制，既不承担该年金运作的风险，也无法享有年金运作形成的投资收益。既无法对受益人处理个人份额进行干预，也无承诺进一步的支付义务。公司已经转移该年金计划资产所有权上的所有风险和报酬，并放弃了该年金计划的控制权，因此该年金计划作为表外处理具有合理性。

四、年金计划相关会计处理是否符合企业会计准则的规定

1、会计准则中关于职工薪酬的规定

《企业会计准则—基本准则》第二十三条规定：“负债是指企业过去的交易或者事项形成的、预期会导致经济利益流出企业的现时义务。”

《企业会计准则第 9 号—职工薪酬》第二条规定：“职工薪酬是指企业为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。”

《企业会计准则第 9 号—职工薪酬》第五条规定：“企业应当在职工为其提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他会计准则要求或允许计入资本成本的除外。”

《企业会计准则第 9 号—职工薪酬》第十一条规定：“设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，企业不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。”

《国际会计准则第 19 号—雇员福利》第 19 段规定：“当且仅当出现下述情形时，主体才应对利润分享和奖金的预期费用进行确认：（1）作为过去事项的结果，主体现在负有做出这类支付的法定或推定义务；以及（2）可以对义务做出可靠的估计。当且仅当主体除了支付以外，没有其他现实选择时，才存在一项现时义务。”

2、公司会计处理符合会计准则规定的原因

公司为员工购买企业年金是为奖励员工报告期内对公司的贡献，且已经总经理办公会批准且向员工公告。

对于企业年金的会计处理，关键在于应当符合权责发生制原则，即职工提供的服务与相关金额的确认相配比。如果员工已经在报告期内提供了服务，确定金额的企业年金被用于相应服务的对价支付，企业因此而产生的现时支付义务可以满足负债的确认条件。

公司将企业年金作为奖励员工在过去已经为公司提供的服务的报酬，相关的支付金额已经确定，公司承担不可撤销的支付义务并承诺全部分配至员工个人，

且未对员工未来的服务年限做出任何要求，因此其符合负债的定义，应当计入应付职工薪酬和当期费用，公司的会计处理符合会计准则的规定。

41.2 保荐机构和申报会计师核查过程和核查意见

核查过程：

1、了解职工薪酬相关的内部控制制度的设计及执行情况，访谈管理层对于发行人购买企业年金的金额确认依据和原因的考虑；

2、通过核查发行人购买年金的总经理办公室决议、与年金资产管理人签订的协议条款，获取并检查员工分配名单和相关的银行回单；

3、结合年金协议，抽查访谈被分配年金的员工，核对是否知悉该年金计划和年金有无服务年限限制的条件等情况。

核查结论：

经核查，保荐机构和申报会计师认为：

1、发行人年金计划金额与公司经营业绩、职工薪酬保持同向增长，具体金额系公司根据每年的经营预算、业绩完成情况、对员工的激励需要等多因素综合考虑制定；

2、截至本问询函回复签署日，发行人做出决议的企业年金已经全部支付给太平养老保险股份有限公司，无进一步支付义务；

3、发行人将年金计划作为表外处理具有合理性，发行人的相关会计处理符合企业会计准则的规定。

41.3 补充披露情况

发行人已在招股说明书“第八节 财务会计信息与管理层分析”之“八、偿债能力、流动性与持续经营能力分析（二）流动负债分析”中补充披露如下：

发行人依据公司经营情况和盈利水平为公司员工购买企业年金是为了奖励员工，保留关键人才，支付金额与发行人的盈利能力相符合，参与对象全部为除发行人董事及高管外的员工。

问题四十二

《准则》是招股说明书信息披露的最低要求，请发行人、保荐机构、证券服务机构务必诚实守信、勤勉尽责，严格按照《准则》的要求进行信息披露，对发行人确实不适用的某些要求，在不影响信息披露完整性的前提下可以作适当调整，但应在提交申请时作明确说明。

回复：

42.1 发行人、保荐机构、证券服务机构的回复

公司、保荐机构、证券服务机构根据《准则》一一进行核对，严格按照《准则》的要求进行信息披露，对公司确实不适用的某些要求，在不影响信息披露完整性的前提作了适当调整。不适用的，已经提交申请时作明确说明，不适用内容如下：

序号	序号	相关规定	说明
1	第五节第四十二条第七款	发行人股东公开发售股份的，应披露公开发售股份对发行人的控制权、治理结构及生产经营产生的影响，并提示投资者关注上述事项；	本公司股东不存在公开发售股份的情形，故本条不适用
2	第五节第四十七条	发行人应披露本次公开发行申报前已经制定或实施的股权激励及相关安排，披露股权激励对公司经营状况、财务状况、控制权变化等方面的影响，以及上市后的行权安排；	本公司不存在已经制定或实施的股权激励及其他相关安排，故本条不适用
3	第六节第五十三条第二款	发行人与他人共享资源要素的，如特许经营权，应披露共享的方式、条件、期限、费用等；	本公司不存在与他人共享资源要素的情形，故本条不适用
4	第七节第五十七条	发行人存在特别表决权股份或类似安排的，应披露相关安排的基本情况，包括设置特别表决权安排的股东大会决议、特别表决权安排运行期限、持有人资格、特别表决权股份拥有的表决权数量与普通股份拥有表决权数量的比例安排、持有人所持特别表决权股份能够参与表决的股东大会事项范围、特别表决权股份锁定安排及转让限制等，还应披露差异化表决安排可能导致的相关风险和对公司治理的影响，以及相关投资者保护措施；	本公司不存在特别表决权股份或类似安排的，故本条不适用
5	第七节第五十八条	发行人存在协议控制架构的，应披露协议控制架构的具体安排，包括协议控制架构涉及的各方法律主体的基本情况、主要合同的核心条款等；	本公司不存在协议控制架构，故本条不适用
6	第八节第	报告期营业成本的分部信息、主要成本项目	公司业务模式为无晶圆

序号	序号	相关规定	说明
	七十六条第二款	构成及变动原因；结合主要原材料、能源等采购对象的数量与价格变动，分析营业成本增减变化的影响因素；	厂集成电路设计企业，只从事集成电路研发和销售，而将晶圆制造、封装和测试环节分别委托给专业厂商完成，因此主营业务不涉及能源采购
7	第八节第七十七条第四款	结合产能、业务量或经营规模变化等因素，分析披露报告期末固定资产的分布特征与变动原因，重要固定资产折旧年限与同行业可比公司相比是否合理；	公司系无晶圆厂集成电路设计企业，固定资产与产品产能、经营规模不存在直接关联，故本条不适用
8	第八节第七十八条第一款	最近一期末银行借款、关联方借款、合同承诺债务、或有负债等主要债项的金额、期限、利率及利息费用等情况；如有逾期未偿还债项应说明原因及解决措施；如存在借款费用资本化情况应说明其依据、时间及金额。发行人应分析可预见的未来需偿还的负债金额及利息金额，结合现金流、融资能力与渠道等情况，分析公司的偿债能力；	公司不存在银行借款、关联方借款、合同承诺债务、或有负债等债务情况，故本条不适用
9	第八节第八十一条	如果发行人认为提供盈利预测信息将有助于投资者对发行人及投资于发行人的股票作出正确判断，且发行人确信能对最近的未来期间的盈利情况作出比较切合实际的预测，发行人可以披露盈利预测信息；	公司未进行盈利预测，故本条不适用
10	第九节第八十五条第八款	募集资金向实际控制人、控股股东及其关联方收购资产，如果对被收购资产有效益承诺的，应披露效益无法完成时的补偿责任；	募集资金不存在向实际控制人、控股股东及其关联方收购资产的情形，故本条不适用
11	第九节第九十二条	发行人存在特别表决权股份、协议控制架构或类似特殊安排，尚未盈利或存在累计未弥补亏损的，应披露依法落实保护投资者合法权益规定的各项措施；	本公司不存在特别表决权股份、协议控制架构或类似特殊安排，尚未盈利或存在累计未弥补亏损的情形，故本条不适用

42.2 保荐机构核查过程和核查意见

经核查，保荐机构认为：

发行人已按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第41号——科创板公司招股说明书》的相关要求，对招股说明书的全文内容查漏补缺、补正完整。

问题四十三

发行人因部分信息涉及商业秘密提出了信息披露豁免，请发行人充分说明：

(1) 仅提供与2家客户的合同条款，却对报告期内主要供应商、客户信息均不予披露的原因及合理性，豁免披露后是否对投资者决策判断构成重大障碍；(2) 发行人是否存在客户及供应商集中的情形，相关信息披露是否符合《准则》第五十一条、五十二条的规定；(3) 同行业可比公司招股说明书是否披露了相关信息。

请发行人结合以上情况，在招股说明书中补充披露相关信息。

回复：

43.1 发行人说明

一、仅提供与 2 家客户的合同条款，却对报告期内主要供应商、客户信息均不予披露的原因及合理性，豁免披露后是否对投资者决策判断构成重大障碍；

经过 10 多年的发展和积淀，目前公司主要产品广泛应用于服务器等领域，相关主要客户和供应商均是国际知名企业，且在公司与主要客户、供应商的商业合同中均有明确且严格的保密条款（提供 2 份合同条款仅是举例说明），要求公司对商业条款、合作信息、产品名称、数量、单价等事项均应履行严格的保密义务，如在公开文件中进行相关信息的披露，将造成公司商业合同中保密条款的违约。

此外，由于公司主要产品内存接口芯片行业的整体集中度均较高，公司也面临着国际知名厂商的激烈竞争。一旦披露相关数据，行业内公司及竞争对手可通过披露的数据掌握公司经营情况等商业机密，对公司的销售和采购将构成不利影响，因此公司在招股说明书中采用代码等方式进行披露，具有合理性和必要性。

公司在招股说明书中已披露主营业务收入及占比，披露了公司主要客户和主要供应商的名称，并用代码方式披露了公司前五大客户及供应商的销售金额及销售占比。上述披露形式对投资者决策判断不构成重大障碍。

二、发行人是否存在客户及供应商集中的情形，相关信息披露是否符合《准则》第五十一条、五十二条的规定；

根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 41 号——科创板公司招股说明书》：

“第五十一条 发行人应披露销售情况和主要客户，包括：

（一）报告期内各期主要产品或服务的规模（产能、产量、销量，或服务能力、服务量）、销售收入、产品或服务的主要客户群体、销售价格的总体变动情况。存在多种销售模式的，应披露各销售模式的规模及占当期销售总额的比重；

（二）报告期内各期向前五名客户合计的销售额占当期销售总额的百分比，向单个客户的销售比例超过总额的 50%的、前五名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的，应披露其名称或姓名、销售比例。该客户为发行人关联方的，应披露产品最终实现销售的情况。受同一实际控制人控制的客户，应合并计算销售额。

第五十二条 发行人应披露采购情况和主要供应商，包括：

（一）报告期内采购产品、原材料、能源或接受服务的情况，相关价格变动趋势；

（二）报告期内各期向前五名供应商合计的采购额占当期采购总额的百分比，向单个供应商的采购比例超过总额的 50%的、前五名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的，应披露其名称或姓名、采购比例。受同一实际控制人控制的供应商，应合并计算采购额。”

2016 年至 2018 年，公司向前五名客户的销售收入占比分别为 70.18%、83.69% 和 90.10%，客户相对集中，主要是因为全球内存接口芯片下游的内存模组 DRAM 市场集中度较高。根据 DRAMeXchange 发布的数据，截至 2018 年 9 月，在 DRAM 市场，三星电子占 45.5%，SK 海力士占 29.1%，美光科技占 21.1%，DRAM 市场集中度较高。综上所述，报告期内公司的客户集中度较高具有合理性。公司前五大客户中不存在单个客户的销售比例超过总额的 50%的情形，且相关销售比例及金额均以代码形式进行了披露，公司因资产转让同成都澜至之间的交易已在重大资产重组及关联交易部分进行了充分披露，符合《准则》第五十一条的相关规定。

2016 年至 2018 年，公司向前五大供应商的采购占比分别为 93.24%、81.05% 和 91.87%，供应商相对集中，主要是因为晶圆制造厂和封装测试厂属于资本和技术密集型产业，符合供应商条件的厂商较为有限，因此公司向前五大供应商采购金额较大且集中度较高，符合行业特性。公司对单一供应商不存在重大依赖。

公司供应商主要为行业内知名企业，采购价格符合市场标准。综上所述，报告期内公司的供应商集中度较高具有合理性。公司前五大供应商中不存在单个供应商的采购比例超过总额的 50% 的情形，且相关采购比例及金额均以代码形式进行了披露，符合《准则》第五十二条的规定。

三、同行业可比公司招股说明书是否披露了相关信息；

目前，A 股上市公司中暂时无与公司在业务模式、产品种类、竞争情况上均完全可比的同行业公司。

在全球范围内，除了澜起科技，现阶段从事研发并量产服务器内存接口芯片的主要有 IDT 和 Rambus，其均未在招股说明书和年报中披露前五大客户及供应商名称等信息。

43.2 保荐机构核查过程和核查意见

通过获取并审阅了发行人主要客户和供应商的合同条款，查阅同行业可比公司 IDT 和 Rambus 的招股说明书和年报，保荐机构认为：

（1）公司已披露报告期内主要供应商、客户基本信息，且用代码方式披露了交易金额和占比，只是没有对主要供应商、客户的交易金额做一一对应，相关信息不予披露具有合理性，豁免披露后对投资者决策判断不构成重大障碍；

（2）由于行业特性，发行人客户及供应商相对集中，相关信息披露符合《准则》第五十一条、五十二条的规定；

（3）同行业竞争对手（IDT 和 Rambus）招股说明书和年报中未披露前五大客户及供应商名称等信息。

43.3 补充披露情况

发行人已在招股说明书中补充披露相关内容。

问题四十四

发行人2018年分红29,827.09万元,并于2019年3月5日通过董事会决议拟分红23,387.15万元,于申报日尚未经股东大会审议批准。招股说明书披露,本次公开发行股票并上市前所滚存的可供股东分配的利润(不含已经公司股东大会决议分配的利润)由发行后的新老股东按照持股比例共享。

请发行人披露:

(1) 报告期内现金分红的资金来源及资金流转情况,是否符合国家外汇、税务等相关法律法规的规定;(2) 发行人是否拟按照2019年3月5日董事会批准的利润分配预案进行现金分红,是否履行股东大会审议程序,请发行人充分论证现金分红的必要性和恰当性,是否与发行人财务状况相匹配,是否可能对财务状况和新老股东利益产生重大影响,并与滚存利润的分配安排保持一致;(3) 报告期内的现金分红比例,在公司上市前后是否将保持一致;(4) 重要子公司的《公司章程》中对子公司分红政策的相关规定,是否能够有效保障子公司向母公司进行分红,以保障母公司具备分红能力。

请保荐机构对发行人进行现金分红的必要性、合理性、合规性进行核查,就实施现金分红对发行人财务状况、生产运营的影响发表明确意见。请保荐机构及发行人律师对现金分红的资金流转是否符合国家外汇、税务等相关法律法规的规定发表明确意见。

回复:

44.1 发行人说明

一、报告期内现金分红的资金来源及资金流转情况,是否符合国家外汇、税务等相关法律法规的规定;

报告期内现金分红的资金来源于公司未分配利润且为公司自有资金,分红资金由公司在履行其代扣代缴义务后支付给全体股东。现金分红的资金流转情况符合国家外汇、税务等相关法律法规的规定。

二、发行人是否拟按照 2019 年 3 月 5 日董事会批准的利润分配预案进行现金分红,是否履行股东大会审议程序,请发行人充分论证现金分红的必要性和

恰当性，是否与发行人财务状况相匹配，是否可能对财务状况和新老股东利益产生重大影响，并与滚存利润的分配安排保持一致；

公司拟按照 2019 年 3 月 5 日董事会批准的年度利润分配预案进行分红，该年度分红预案已经公司 2019 年 4 月 15 日召开的 2018 年年度股东大会审议通过。

根据《澜起科技股份有限公司章程》第一百五十条规定：公司可以采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配股利，公司的利润分配应充分重视投资者的实际利益。公司 2016 年、2017 年、2018 年的净利润分别为 9,280.43 万元、34,691.60 万元、73,687.84 万元，公司经营业绩持续提升，为回报股东，共享公司的成长收益，公司董事会提议了相关利润分配预案。

根据公司 2019 年第一次临时股东大会决议，本次公开发行股票并上市前所滚存的可供股东分配的利润（不含已经公司股东大会决议分配的利润）由发行后的新老股东按照持股比例共享。

综上所述，公司进行现金分红，具有必要性及恰当性，与公司的财务状况相匹配，不会对财务状况和新老股东利益产生重大影响，并与滚存利润的分配安排保持一致。

三、报告期内的现金分红比例，在公司上市前后是否将保持一致；

公司上市后，在公司实现盈利、不存在未弥补亏损、有足够现金实施现金分红且不影响公司正常经营的情况下，会根据《公司章程》，尽量以现金分红的方式进行分红，实现收益股东共享。公司在上市后将根据其于 2019 年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司股东未来分红回报规划的议案》的规划要求进行，公司未来三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的 30%，具体年度的分配比例由董事会根据公司当年经营情况拟定并经股东大会审议。

四、重要子公司的《公司章程》中对子公司分红政策的相关规定，是否能够有效保障子公司向母公司进行分红，以保障母公司具备分红能力。

公司所有子公司均为公司全资持有，公司子公司的《公司章程》中对子公司分红政策并无限制性规定，公司可以确保子公司在符合相关法律法规规定的前提下向公司进行分红。

44.2 保荐机构和发行人律师核查过程和核查意见

保荐机构和发行人律师获取并审阅了发行人 2018 年 7 月 30 日现金分红的临时董事会决议、2019 年第一次临时股东大会决议及 2018 年年度股东大会决议，获取并审阅了现金分红的支付凭证。

经核查，保荐机构和发行人律师认为，发行人现金分红具有必要性、合理性、合规性，实施现金分红不会对发行人财务状况、生产运营产生不良影响。发行人现金分红的资金流转符合国家外汇、税务等相关法律法规的规定。

44.3 补充披露情况

发行人已在招股说明书“第十节 投资者保护”之“三、报告期内的股利分配情况”中补充披露如下：

报告期内，公司于 2018 年 7 月 30 日召开董事会并通过决议，将共计人民币 298,270,863 元（税前）可分配利润分配给股东。

2019 年 3 月 5 日，本公司召开第一届董事会第五次会议，批准 2018 年度利润分配预案，分配现金股利人民币 233,871,475.00 元（税前），该年度分红预案已经发行人 2019 年 4 月 15 日召开的 2018 年年度股东大会审议通过。

报告期内现金分红的资金来源于公司未分配利润且为公司自有资金，分红资金由发行人在履行其应尽的代扣代缴义务后支付给全体股东。现金分红的资金流转情况符合国家外汇、税务等相关法律法规的规定。

问题四十五

发行人 2018 年分红 29,827.09 万元，2018 年末货币资金余额 367,999.13 万元，2019 年拟分红 23,387.15 万元（有待股东大会审议批准）。本次发行拟募集资金 230,019.06 万元，用于新一代内存接口芯片研发及产业化项目、津逮®服务器 CPU 及其平台技术升级项目和人工智能芯片研发项目。

请发行人披露：（1）结合货币资金量、流动资金使用需求、本次募投项目资金需求等充分分析本次募集资金的必要性；（2）募集资金 55,735.89 万元拟用于工程建设费用，具体费用支出构成及用途，是否与发行人轻资产运营的业务模式、员工数量相匹配；（3）人工智能芯片研发项目的技术、人员积累情况，是否具备募投项目的实施基础。

请保荐机构对上述事项进行核查并发表明确意见。

回复：

45.1 发行人说明

一、结合货币资金量、流动资金使用需求、本次募投项目资金需求等充分分析本次募集资金的必要性；

公司是基于 Fabless 模式的芯片设计公司，集成电路产业发展日新月异，技术及产品迭代速度较快。芯片设计公司需要不断地进行创新，同时对市场进行精确的把握与判断，不断推出适应市场需求的新技术、新产品以跟上市场变化。

虽然公司货币资金占总资产的比例较高，但为了增强公司实力，巩固公司的竞争优势和领先的市场地位，追赶世界一流集成电路设计公司，除拟使用募集资金进行募投项目研发投入外，公司仍需要投入大量资金研发新技术、新产品，并在适当时机进行并购，以提升公司竞争力。

世界知名集成电路设计公司——高通公司截至 2018 年 9 月 30 日的总资产为 326.86 亿美元，其中现金及现金等价物达到 117.77 亿美元。由此可见公司资产规模和现金存量虽然在国内的集成电路设计公司中排名相对较高，但同世界知名集成电路设计公司相比仍存在较大差距。

公司拟募集资金，用于新一代内存接口芯片研发及产业化项目、津逮®服务器 CPU 及其平台技术升级项目和人工智能芯片研发项目。募集项目有利于优化

公司的产品结构，通过已有产品的更新换代和新产品的设计推广，强化公司在内存接口芯片领域的领先地位，提升津逮®服务器平台的竞争力，为人工智能时代来临做好必要技术储备，增强公司抗风险的能力。

综上所述，公司本次募集资金具有必要性。

二、募集资金 55,735.89 万元拟用于工程建设费用，具体费用支出构成及用途，是否与发行人轻资产运营的业务模式、员工数量相匹配；

公司募投项目的工程建设费用中包括场地购置费 37,986.89 万元、场地装修费 7,308.00 万元、硬件设备 10,005.50 万元、以及软件费 435.50 万元，具体项目支出构成如下：

项目	工程建设费用明细	金额（万元）
新一代内存接口芯片研发及产业化项目	场地购置费	19,500.00
	场地装修费	3,900.00
	硬件设备	5,794.50
	软件	181.50
津逮®服务器 CPU 及其平台技术升级项目	场地租赁费	2,236.89
	场地装修费	1,458.00
	硬件设备	2,768.50
	软件	254.00
人工智能芯片研发项目	场地购置费	16,250.00
	场地装修费	1,950.00
	硬件设备	1,442.50

为了能够专注研发提高技术水平，公司在资金实力有限的情况下，集中资金用于研发投入和日常经营周转，控制大额设备购置，通过房屋租赁获取办公场所的方式，保证日常经营的顺利进行。随着业务规模的扩大，公司员工人数迅速增加，由 2017 年末的 204 人发展至 2018 年末的 255 人，同比增加 25%。在可预见的未来，公司人员规模将持续增大，对办公及实验场地、研发软硬件的需求也持续扩大，目前的办公及实验环境已经无法满足公司进一步扩大业务发展的需要，公司需要拓展新的研发办公场地、实验室，购置新的软硬件。

公司拟通过本次募集资金加大固定资产投资，以购置、租赁的方式获取研发办公场地、实验室，较好地改善办公环境和研发条件，在吸引更多的优秀技术人才加盟的同时，也可以提高工作效率并保证工作质量，提升公司未来几年内持续

开发、维护、更新产品的能力，进一步提高公司的市场竞争力。

本次募集资金，工程建设费用支出占总募集资金的比重为 24.23%，占比不高。如果本次募集资金成功且如期实施，公司固定资产占资产总额的比重仍不会超过 10%，符合公司轻资产运营的业务模式。

综上所述，公司募集资金 55,735.89 万元拟用于工程建设费用，与公司轻资产运营的业务模式、员工数量相匹配。

三、人工智能芯片研发项目的技术、人员积累情况，是否具备募投项目的实施基础。

本项目将凭借公司在高速、低功耗、内存子系统芯片设计领域的技术和人才基础，开发用于云端数据中心的 AI 处理器芯片和 SoC 芯片。

在集成电路设计领域，公司具备自有的集成电路设计平台，包括数字信号处理技术、内存管理与数据缓冲技术、模拟电路设计技术、高速逻辑与接口电路设计技术以及低功耗设计技术，方案集成度高，可有效提高系统能效和产品性能。

此外，公司培养了一批在高速、低功耗、内存子系统芯片设计领域的专业技术人才，建立了一支高学历、高层次、高素质、专业化的核心研发团队，公司采用创新型人才培养机制，搭建创新型人才梯队，已经形成了金字塔结构的研发团队组织模式，有效保障核心研发团队的稳定性。根据未来行业发展趋势，公司已将人工智能芯片领域作为未来战略发展方向之一，建立了以二十多人为骨干的研发团队，并将根据研发进度及募集资金到位情况进一步扩充研发团队。

综上所述，人工智能芯片研发项目的技术、人员的累积情况，具备募投项目的实施基础。

45.2 保荐机构核查过程和核查意见:

经核查，保荐机构认为，本次募集资金具有必要性；拟用于工程建设费用的募集资金 55,735.89 万元，与公司轻资产运营的业务模式、员工数量相匹配；人工智能芯片研发项目的技术、人员积累情况，具备募投项目的实施基础。

45.3 补充披露情况

发行人已在招股书“第九节 募集资金运用与未来发展规划”之“一、本次发行募集资金运用计划”中补充披露如下：

发行人是基于 Fabless 模式的芯片设计公司，集成电路产业发展日新月异，技术及产品迭代速度较快。芯片设计公司需要不断地进行创新，同时对市场进行精确的把握与判断，不断推出适应市场需求的新技术、新产品以跟上市场变化。

发行人已在招股书“第九节 募集资金运用与未来发展规划”之“三、本次发行募集资金投资项目的具体情况介绍”中补充披露如下：

公司募集资金投资项目工程建设费用情况如下：

项目	工程建设费用明细	金额（万元）
新一代内存接口芯片研发及产业化项目	场地购置费	19,500.00
	场地装修费	3,900.00
	硬件设备	5,794.50
	软件	181.50
津逮®服务器 CPU 及其平台技术升级项目	场地租赁费	2,236.89
	场地装修费	1,458.00
	硬件设备	2,768.50
	软件	254.00
人工智能芯片研发项目	场地购置费	16,250.00
	场地装修费	1,950.00
	硬件设备	1,442.50

为了能够专注研发提高技术水平，公司在资金实力有限的情况下，集中资金用于研发投入和日常经营周转，控制大额设备购置，通过房屋租赁获取办公场所的方式，保证日常经营的顺利进行。随着业务规模的扩大，公司员工人数迅速增加，由 2017 年末的 204 人发展至 2018 年末的 255 人，同比增加 25%。在可预见的未来，公司人员规模将持续增大，对办公及实验场地、研发软硬件的需求也持续扩大，目前的办公及实验环境已经无法满足公司进一步扩大业务发展的需要，公司需要拓展新的研发办公场地、实验室，购置新的软硬件。

公司拟通过本次募集资金加大固定资产投资，以购置、租赁的方式获取研发办公场地、实验室，较好地改善办公环境和研发条件，在吸引更多的优秀技术人才加盟的同时，也可以提高工作效率并保证工作质量，提升公司未来几年内持续开发、维护、更新产品的能力，进一步提高公司的市场竞争力。

本次募集资金，工程建设费用支出占总募集资金的比重为 24.23%，占比不高。如果本次募集资金成功且如期实施，公司固定资产占资产总额的比重仍不会超过 10%，符合公司轻资产运营的业务模式。

发行人已在招股书“第九节 募集资金运用与未来发展规划”之“三、本次募集资金投资项目的具体情况介绍”中补充披露如下：

在集成电路设计领域，公司具备自有的集成电路设计平台，包括数字信号处理技术、内存管理与数据缓冲技术、模拟电路设计技术、高速逻辑与接口电路设计技术以及低功耗设计技术，方案集成度高，可有效提高系统能效和产品性能。

此外，公司培养了一批在高速、低功耗、内存子系统芯片设计领域的专业技术人才，建立了一支高学历、高层次、高素质、专业化的核心研发团队，公司采用创新型人才培养机制，搭建创新型人才梯队，已经形成了金字塔结构的研发团队组织模式，有效保障核心研发团队的稳定性。根据未来行业发展趋势，公司已将人工智能芯片领域作为未来战略发展方向之一，建立了以二十多人为骨干的研发团队，并将根据研发进度及募集资金到位情况进一步扩充研发团队。

问题四十六

请发行人披露重大合同的确定标准和依据，并按照《准则》第九十四条的规定披露对报告期经营活动、财务状况或未来发展等具有重要影响的已履行和正在履行的合同情况，包括合同当事人、合同标的、合同价款或报酬、履行期限及实际履行情况等。

46.1 发行人补充披露

公司在招股说明书第十一节、一、重大合同部分披露内容如下：

公司重大合同的确定标准如下：报告期内，(1)公司已履行的金额超过人民币 5000 万的合同，(2)截至到首次申报时，公司前五大客户、供应商正在履行的典型合同，以及(3)正在履行的对公司业务未来发展具有重要影响的合同。具体情况如下，

(一) 正在执行的销售合同

截至 2019 年 4 月 1 日，公司与主要客户签署的在执行的销售订单情况如下：(因涉及客户保密要求，下属订单中的客户名称用代号表示)

1、2019 年 1 月 26 日，客户 B 向澜起澳门发出采购订单，向澜起澳门采购内存接口芯片，订单金额 8,200,800 美元。

2、2018 年 7 月 5 日，客户 E 向澜起澳门发出采购订单，向澜起澳门采购内存接口芯片，订单金额 1,892,240 美元。

3、2019 年 2 月 8 日，客户 A 向澜起澳门发出采购订单，向澜起澳门采购内存接口芯片，订单金额 677,688.00 美元。

4、2019 年 2 月 12 日，客户 D 向澜起澳门发出采购订单，向澜起澳门采购内存接口芯片，订单金额 433,680 美元。

5、2019 年 2 月 12 日，客户 J 向澜起澳门发出采购订单，向澜起澳门采购内存接口芯片，订单金额 119,000 美元。

(二) 正在执行的采购合同

截至 2019 年 4 月 1 日，公司与主要供应商签署的在执行的采购订单情况如下：(因涉及保密要求，下属订单中的供应商名称用代号表示)

1、2018 年 7 月 6 日，澜起澳门向供应商 G 发出采购订单，采购 CPU 产品，订单金额 1,820,250 美元。

2、2019年1月14日,澜起澳门向供应商H发出采购订单,采购晶圆(Wafer),订单金额261,700美元。

3、2019年2月3日,澜起澳门向供应商I发出采购订单,采购晶圆(Wafer),订单金额163,550.00美元。

4、2019年2月19日,澜起澳门向供应商K发出采购订单,采购晶圆凸块Bump服务,订单金额8,250美元。

5、2019年2月19日,澜起澳门向供应商L发出采购订单,采购封测服务,订单金额92,395美元。

(三) 已履行完毕的合同

1) 2018年2月8日,客户B向澜起澳门发出采购订单,向澜起澳门采购内存接口芯片,订单金额33,754,560美元。

2) 2018年7月3日,客户B向澜起澳门发出采购订单,向澜起澳门采购内存接口芯片,订单金额23,041,800美元。

3) 2017年6月29日,客户B向澜起澳门发出采购订单,向澜起澳门采购内存接口芯片,订单金额13,641,591美元。

4) 2018年7月26日,客户D向澜起澳门发出采购订单,向澜起澳门采购内存接口芯片,订单金额11,623,240美元。

(四) 正在履行的对公司业务未来发展具有重要影响的合同

2015年9月,公司与清华大学、Intel于就合作事宜签署谅解备忘录,三方约定,将基于英特尔x86架构的可重构计算研究与关于存储缓冲器的研究进行结合,以提供一个整体服务器平台解决方案。2016年1月,发行人与Intel就合作细节签署了合作协议,双方就合作的具体事宜如分工、知识产权保护及归属等权利义务进行了约定。

问题四十七

关于承诺事项，(1) 请Intel Capital Corporation、臻石一号、臻石二号、臻石三号、中证投资严格按照《问答》第六条的要求，对持有发行人的股份作出锁定承诺；(2) 请持有发行人5%以上的股东，严格按照有关规定的要求，披露限售期结束后两年内的减持意向，说明届时减持的价格预期、减持股数，不得以“根据市场情况”敷衍；(3) 请发行人、董事、监事及高级管理人员严格依照中国证监会有关规定，作出关于欺诈发行上市的股份购回承诺；(4) 请Tai kui Lap、Chao Iong Wa、李新岗等公司董事或监事的近亲属，比照公司董事、监事作出相关承诺；(5) 请根据《准则》第九十三条的规定，将承诺事项集中披露在“投资者保护”一节中，如发行人认为必要，请在“重大事项提示”中以索引方式提示投资者阅读“投资者保护”一节的相关内容。

回复：

47.1 发行人说明

一、请Intel Capital Corporation、臻石一号、臻石二号、臻石三号、中证投资严格按照《问答》第六条的要求，对持有发行人的股份作出锁定承诺

《问答》第六条对公司无实际控制人股东锁定期要求如下：

“对于发行人没有或难以认定实际控制人的，为确保发行人股权结构稳定、正常生产经营不因发行人控制权发生变化而受到影响，要求发行人的股东按持股比例从高到低依次承诺其所持股份自上市之日起锁定 36 个月，直至锁定股份的总数不低于发行前 A 股股份总数的 51%。

位列上述应予以锁定 51% 股份范围的股东，符合下列情形之一的，不适用上述锁定 36 个月规定：员工持股计划；持股 5% 以下的股东；非发行人第一大股东且符合一定条件的创业投资基金股东。其中，‘符合一定条件的创业投资基金股东’是指符合《私募基金监管问答——关于首发企业中创业投资基金股东的认定标准》的创业投资基金。

对于存在刻意规避股份限售期要求的，本所将按照实质重于形式的原则，要求相关股东参照控股股东、实际控制人的限售期进行股份锁定。”

公司实际执行时，将股东及其关联方持股比例合并计算并排序，筛选出主要股东范围，该部分股东自公司股票上市之日起锁定三十六个月，具体股份锁定情况如下：

公司主要股东中国电子投资控股有限公司及其关联方嘉兴芯电投资合伙企业（有限合伙）；WLT Partners, L.P.及其关联方珠海融英股权投资合伙企业（有限合伙）；上海临理投资合伙企业（有限合伙）及其关联方，包括上海临理投资合伙企业（有限合伙）、上海临丰投资合伙企业（有限合伙）、上海临骥投资合伙企业（有限合伙）、上海临利投资合伙企业（有限合伙）、上海临国投资合伙企业（有限合伙）、上海临桐建发投资合伙企业（有限合伙）、上海临齐投资合伙企业（有限合伙）；嘉兴宏越投资合伙企业（有限合伙）及其关联方，包括嘉兴宏越投资合伙企业（有限合伙）、嘉兴莫奈股权投资合伙企业（有限合伙）、Xinyun Capital Fund I, L.P.、Xinyun Capital Fund, L.P.、Xinyun Capital Fund III, L.P.承诺自公司股票上市之日起锁定三十六个月。

公司持股前 51%的主要股东具体情况如下：

序号	关联方合并口径	股东名称	持股比例	合计持股
第一大 股东	中国电子投资控股有限公司及其关联方	中电投控	15.904%	17.98%
		嘉兴芯电	2.078%	
第二大 股东	WLT Partners, L.P.及其关联方	WLT	8.636%	15.45%
		珠海融英	6.812%	
第三大 股东	上海临理投资合伙企业（有限合伙）及其关联方	上海临理	5.262%	12.79%
		上海临丰	1.830%	
		上海临骥	1.498%	
		上海临利	1.312%	
		上海临国	1.285%	
		临桐建发	0.912%	
第四大 股东	嘉兴宏越投资合伙企业（有限合伙）及其关联方	嘉兴宏越	4.352%	12.12%
		嘉兴莫奈	2.029%	
		Xinyun I	4.352%	
		Xinyun	1.186%	
		Xinyun III	0.204%	

合计	58.34%	58.34%
----	--------	--------

公司主要股东合计持有公司 58.34%的股权，其中中国电子投资控股有限公司及其关联方合计持有 17.98%的股权；WLT Partners, L.P.及其关联方合计持有 15.45%的股权；上海临理投资合伙企业（有限合伙）及其关联方合计持有 12.79%的股权；嘉兴宏越投资合伙企业（有限合伙）及其关联方合计持有 12.12%的股权。

Intel Capital 持股比例排序不属于前 51%范围，但由于其是在申报前 6 个月内入股，因此已承诺锁定期为自增资工商变更日起三十六个月。

蒋石一号、蒋石二号、蒋石三号和中证投资持股比例排序不属于前 51%范围，因此该四名股东已承诺锁定期为自公司股票上市之日起十二个月。

综上，公司的各股东锁定期已经严格按照《问答》第六条的要求，Intel Capital、蒋石一号、蒋石二号、蒋石三号、中证投资的锁定期亦符合相应的监管要求。

二、请持有发行人5%以上的股东，严格按照有关规定的要求，披露限售期结束后两年内的减持意向，说明届时减持的价格预期、减持股数，不得以“根据市场情况”敷衍

（一）公司主要股东持股意向及减持意向的承诺

公司主要股东中国电子投资控股有限公司及其关联方嘉兴芯电投资合伙企业（有限合伙）；WLT Partners, L.P.及其关联方珠海融英股权投资合伙企业（有限合伙）；上海临理投资合伙企业（有限合伙）及其关联方，包括上海临理投资合伙企业（有限合伙）、上海临丰投资合伙企业（有限合伙）、上海临骥投资合伙企业（有限合伙）、上海临利投资合伙企业（有限合伙）、上海临国投资合伙企业（有限合伙）、上海临桐建发投资合伙企业（有限合伙）、上海临齐投资合伙企业（有限合伙）；嘉兴宏越投资合伙企业（有限合伙）及其关联方，包括嘉兴宏越投资合伙企业（有限合伙）、嘉兴莫奈股权投资合伙企业（有限合伙）、Xinyun Capital Fund I, L.P.、Xinyun Capital Fund, L.P.、Xinyun Capital Fund III, L.P.；承诺：

1、本单位所持公司股票锁定期满之日起两年内，采取集中竞价交易方式的，在任意连续 90 日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的 1%；采取大宗交

易方式的，在任意连续 90 日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的 2%。如相关法律法规及证券交易所对减持股数有新的规则，本单位将按新的规则执行。

2、本单位所持公司股票锁定期满之日起两年内，减持价格不低于首次公开发行股票价格（如因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，将按照证券交易所的有关规定作除权除息价格调整）。

3、本单位减持公司股票的方式包括集中竞价交易、大宗交易、协议转让及其他符合中国证监会及证券交易所相关规定的方式。

4、若拟减持公司股票，本单位将严格遵守并执行《上海证券交易所科创板股票上市规则》关于减持计划内容披露、进展披露及结果披露的相关规定。

（二）公司其他 5% 以上股东持股意向及减持意向的承诺

公司除前述主要股东以外的 5% 以上股东，包括 Intel Capital Corporation、嘉兴蔘石一号投资合伙企业(有限合伙)、嘉兴蔘石二号投资合伙企业(有限合伙)、嘉兴蔘石三号投资合伙企业（有限合伙）、中信证券投资有限公司承诺：

1、本单位所持公司股票锁定期满之日起两年内，采取集中竞价交易方式的，在任意连续 90 日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的 1%；采取大宗交易方式的，在任意连续 90 日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的 2%。如相关法律法规及证券交易所对减持股数有新的规则，本单位将按新的规则执行。

2、本单位所持公司股票锁定期满之日起两年内，本单位减持所持有公司股票的价格应符合相关法律法规及证券交易所的规则要求。

3、本单位减持公司股票的方式包括集中竞价交易、大宗交易、协议转让及其他符合中国证监会及证券交易所相关规定的方式。

4、若拟减持公司股票，本单位将严格遵守并执行《上海证券交易所科创板股票上市规则》关于减持计划内容披露、进展披露及结果披露的相关规定。

三、请发行人、董事、监事及高级管理人员严格依照中国证监会有关规定，

作出关于欺诈发行上市的股份购回承诺

（一）发行人关于欺诈上市的股份购回承诺

发行人首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，不存在欺诈发行的行为，本企业对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

若公司本次公开发行股票的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，存在欺诈发行上市，导致对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本公司将依法回购首次公开发行上市的全部新股。公司董事会将在证券监管部门或司法机关出具有关违法违规事实的认定结果之日起三十个工作日内，制订股份回购方案并提交股东大会审议批准。公司将自股份回购方案经股东大会批准或经相关监管部门批准或备案之日起（以较晚完成日期为准）六个月内完成回购。公司承诺，将按照市场价格且不低于首次公开发行股票上市时的价格进行回购。公司首次公开发行股票上市后如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权事项，回购的股份包括首次公开发行的全部新股及其派生股份，且回购价格将相应进行调整。

若招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，构成欺诈发行上市，致使投资者在证券交易中遭受损失的，公司将依法赔偿投资者的直接经济损失。

（二）发行人董事、监事和高级管理人员关于欺诈发行上市的赔偿承诺

发行人首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，不存在欺诈发行行为，本人对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

若公司本次公开发行股票的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，存在欺诈发行行为，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失。

四、请Tai kuai Lap、Chao Iong Wa、李新岗等公司董事或监事的近亲属，比照公司董事、监事作出相关承诺

Tai kuai Lap、Chao Iong Wa、李新岗作出了相关承诺如下：

（一）关于关联交易问题的承诺函

本人现就澜起科技关联交易问题作出如下承诺：

1、本人及本人所控制的其他企业组织将尽量避免或减少与澜起科技（含其合并报表范围子公司，下同）之间的关联交易，对于澜起科技能够通过市场与独立第三方之间发生的交易，将由澜起科技与独立第三方进行。本人及本人所控制的其他企业组织将严格避免向澜起科技拆借、占用澜起科技资金或采取由澜起科技代垫款、代偿债务等方式占用澜起科技资金。

2、对于本人及本人所控制的其他企业组织与澜起科技之间必需的一切交易行为，均将严格遵守市场原则，本着平等互利、等价有偿的一般原则，公平合理地进行。交易定价有政府定价的，执行政府定价；没有政府定价的，执行市场公允价格；没有政府定价且无可参考市场价格的，按照成本加可比较的合理利润水平确定成本价执行。

3、本人及本人所控制的其他企业组织与澜起科技之间的关联交易均以签订书面合同或协议形式明确规定，并将严格遵守澜起科技章程、关联交易管理制度等规定履行必要的法定程序，在澜起科技权力机构审议有关关联交易事项时本人将主动依法履行回避义务；对需报经有权机构审议的关联交易事项，在有权机构审议通过后方予执行。

4、本人保证不通过关联交易取得任何不正当的利益或使澜起科技承担任何不正当的义务。如果因违反上述承诺导致澜起科技损失或利用关联交易侵占澜起科技利益的，澜起科技有权单方终止该等关联交易。

（二）持股锁定承诺

本人现就直接或间接所持公司股份锁定事宜出具承诺如下：

1、自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或委托他人管理本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行公司股份（如有），也不由公司回购直接或间接持有的该部分股份。

2、上述规定的锁定期满后，在本人近亲属担任发行人董事、监事、高级管

理人员期间，本人每年转让所持有的发行人股份数量不超过直接或间接所持有发行人股份总数的百分之二十五；在本人近亲属离职后半年内，不转让直接或间接所持有的发行人股份。

3、如法律、行政法规、部门规章或中国证券监督管理委员会、上海证券交易所规定股份锁定期长于本承诺，则本人所持公司股份锁定期和限售条件自动按该等规定执行。

（三）关于未履行公开承诺的约束性措施

本人在澜起科技股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行股票并上市过程中作出及披露的公开承诺构成本人的义务，若未能履行，则：本人将及时向公司说明原因，由公司公告并向公司股东和社会公众投资者公开道歉，同时采取或接受以下措施以保障投资者合法权益：

1、立即采取措施消除违反承诺事项；

2、提出并实施新的承诺或补救措施；

3、公司有权直接按本人承诺内容向交易所或证券登记机构申请延长本人所持公司股份的锁定期。

五、请根据《准则》第九十三条的规定，将承诺事项集中披露在“投资者保护”一节中，如发行人认为必要，请在“重大事项提示”中以索引方式提示投资者阅读“投资者保护”一节的相关内容。

发行人已根据《准则》第九十三条规定，将承诺事项集中披露在“投资者保护”一节中。

47.2 发行人补充披露

发行人在招股书“第十节 投资者保护”之“六、相关承诺事项”中补充披露如下：

（四）关于持股意向及减持意向的承诺

1、主要股东承诺

公司主要股东中国电子投资控股有限公司及其关联方嘉兴芯电投资合伙企业（有限合伙）；WLT Partners, L.P.及其关联方珠海融英股权投资合伙企业（有限合伙）；上海临理投资合伙企业（有限合伙）及其关联方，包括上海临理投资合伙企业（有限合伙）、上海临丰投资合伙企业（有限合伙）、上海临骥投资合伙企业（有限合伙）、上海临利投资合伙企业（有限合伙）、上海临国投资合伙企业（有限合伙）、上海临桐建发投资合伙企业（有限合伙）、上海临齐投资合伙企业（有限合伙）；嘉兴宏越投资合伙企业（有限合伙）及其关联方，包括嘉兴宏越投资合伙企业（有限合伙）、嘉兴莫奈股权投资合伙企业（有限合伙）、Xinyun Capital Fund I, L.P.、Xinyun Capital Fund, L.P.、Xinyun Capital Fund III, L.P.；承诺：

（1）本单位所持公司股票锁定期满之日起两年内，采取集中竞价交易方式的，在任意连续 90 日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的 1%；采取大宗交易方式的，在任意连续 90 日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的 2%。如相关法律法规及证券交易所对减持股数有新的规则，本单位将按新的规则执行。

（2）本单位所持公司股票锁定期满之日起两年内，减持价格不低于首次公开发行股票价格（如因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，将按照证券交易所的有关规定作除权除息价格调整）。

（3）本单位减持公司股票的方式包括集中竞价交易、大宗交易、协议转让及其他符合中国证监会及证券交易所相关规定的方式。

（4）若拟减持公司股票，本单位将严格遵守并执行《上海证券交易所科创板股票上市规则》关于减持计划内容披露、进展披露及结果披露的相关规定。

2、发行人除上述股东外的 5%以上股东承诺

公司除前述主要股东以外的 5%以上股东，包括 Intel Capital Corporation、嘉兴蔴石一号投资合伙企业（有限合伙）、嘉兴蔴石二号投资合伙企业（有限合伙）、嘉兴蔴石三号投资合伙企业（有限合伙）、中信证券投资有限公司承诺：

(1) 本单位所持公司股票锁定期满之日起两年内，采取集中竞价交易方式的，在任意连续 90 日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的 1%；采取大宗交易方式的，在任意连续 90 日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的 2%。如相关法律法规及证券交易所对减持股数有新的规则，本单位将按新的规则执行。

(2) 本单位所持公司股票锁定期满之日起两年内，本单位减持所持有公司股票的价格应符合相关法律法规及证券交易所的规则要求。

(3) 本单位减持公司股票的方式包括集中竞价交易、大宗交易、协议转让及其他符合中国证监会及证券交易所相关规定的方式。

(4) 若拟减持公司股票，本单位将严格遵守并执行《上海证券交易所科创板股票上市规则》关于减持计划内容披露、进展披露及结果披露的相关规定。

(七) 对欺诈发行上市的股份购回承诺

1、发行人关于欺诈上市的股份购回承诺

发行人首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，不存在欺诈发行的行为，本企业对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

若公司本次公开发行股票的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，存在欺诈发行上市，导致对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本公司将依法回购首次公开发行上市的全部新股。公司董事会将在证券监管部门或司法机关出具有关违法违规事实的认定结果之日起三十个工作日内，制订股份回购方案并提交股东大会审议批准。公司将自股份回购方案经股东大会批准或经相关监管部门批准或备案之日起（以较晚完成日期为准）六个月内完成回购。公司承诺，将按照市场价格且不低于首次公开发行上市时的价格进行回购。公司首次公开发行上市后如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权事项，回购的股份包括首次公开发行的全部新股及其派生股份，且回购价格将相应进行调整。

若招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，构成欺诈发行上市，致使投资者在证券交易中遭受损失的，公司将依法赔偿投资者的直接经济损失。

2、发行人董事、监事和高级管理人员关于欺诈发行上市的赔偿承诺

发行人首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，不存在欺诈发行行为，本人对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

若公司本次公开发行股票的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，存在欺诈发行行为，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失。

(八) 间接持有公司股权的董事、监事和高级管理人员的亲属 Tai kuai Lap、Chao long Wa、李新岗的承诺

1、关于关联交易问题的承诺函

本人现就澜起科技关联交易问题作出如下承诺：

(1) 本人及本人所控制的其他企业组织将尽量避免或减少与澜起科技（含其合并报表范围子公司，下同）之间的关联交易，对于澜起科技能够通过市场与独立第三方之间发生的交易，将由澜起科技与独立第三方进行。本人及本人所控制的其他企业组织将严格避免向澜起科技拆借、占用澜起科技资金或采取由澜起科技代垫款、代偿债务等方式占用澜起科技资金。

(2) 对于本人及本人所控制的其他企业组织与澜起科技之间必需的一切交易行为，均将严格遵守市场原则，本着平等互利、等价有偿的一般原则，公平合理地进行。交易定价有政府定价的，执行政府定价；没有政府定价的，执行市场公允价格；没有政府定价且无可参考市场价格的，按照成本加可比较的合理利润水平确定成本价执行。

(3) 本人及本人所控制的其他企业组织与澜起科技之间的关联交易均以签订书面合同或协议形式明确规定，并将严格遵守澜起科技章程、关联交易管理制度等规定履行必要的法定程序，在澜起科技权力机构审议有关关联交易事项

时本人将主动依法履行回避义务；对需报经有权机构审议的关联交易事项，在有权机构审议通过后方予执行。

(4) 本人保证不通过关联交易取得任何不正当的利益或使澜起科技承担任何不正当的义务。如果因违反上述承诺导致澜起科技损失或利用关联交易侵占澜起科技利益的，澜起科技有权单方终止该等关联交易。

2、持股锁定承诺

本人现就直接或间接所持公司股份锁定事宜出具承诺如下：

(1) 自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或委托他人管理本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行公司股份（如有），也不由公司回购直接或间接持有的该部分股份。

(2) 上述规定的锁定期满后，在本人近亲属担任发行人董事、监事、高级管理人员期间，本人每年转让所持有的发行人股份数量不超过直接或间接所持有发行人股份总数的百分之二十五；在本人近亲属离职后半年内，不转让直接或间接所持有的发行人股份。

(3) 如法律、行政法规、部门规章或中国证券监督管理委员会、上海证券交易所规定股份锁定期长于本承诺，则本人所持公司股份锁定期和限售条件自动按该等规定执行。

3、关于未履行公开承诺的约束性措施

本人在澜起科技股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行股票并上市过程中作出及披露的公开承诺构成本人的义务，若未能履行，则：本人将及时向公司说明原因，由公司公告并向公司股东和社会公众投资者公开道歉，同时采取或接受以下措施以保障投资者合法权益：

(1) 立即采取措施消除违反承诺事项；

(2) 提出并实施新的承诺或补救措施；

(3) 公司有权直接按本人承诺内容向交易所或证券登记机构申请延长本人所持公司股份的锁定期。

问题四十八

请保荐机构和发行人律师核查招股说明书引用数据的真实性,说明数据引用的来源和第三方基本情况,说明数据是否公开、是否专门为本次发行上市准备、以及发行人是否为此支付费用或提供帮助、是否为定制的或付费的报告、一般性网络文章或非公开资料、是否是保荐机构所在证券公司的研究部门出具的报告。

回复:

48.1 发行人说明

招股说明书引用数据及来源列表如下:

序号	数据出现于招股说明书的位置及摘录	第三方名称	权威性
1	《2016年至2018年全球各国家/地区半导体市场规模》	全球半导体贸易统计组织	25年来一直是全球半导体市场统计领域的领先者,组织为会员提供半导体行业最全面最新的总体数据
2	“……2017年全球存储器的销售额达到1,240亿美元,增幅达到61.5%,其中DRAM销售额达到720亿美元,较2016年增长76.8%……”		
3	《2017年全球前十大半导体厂商销售收入》	Gartner	全球领先的IT研究与顾问咨询公司
4	“……2017年全球IT支出约为3.5万亿美元,而云计算市场规模占全球IT支出的比重快速提升,从2010年的1.99%上升到2017年的6.47%,预计到2019年将达到9.25%。对于传统IT的替代是云计算价值的重要体现。2017年全球云计算规模将达到2,602亿美元,预计到2020年将达到4,114亿美元,2018-2020年复合增速将达16.5%。云计算服务规模的扩张带动底层云基础设施建设和上层云具体行业应用相关产业的发展,尤其是对推动数据中心需求在全球范围内持续增长,起到了至关重要的作用。数据中心作为云计算的物理基础,2017年全球数据中心市场规模达534.7亿美元,过去三年全球市场增速基本保持在15%-20%之间,行业成长性突出……”		
5	《2002年-2017年中国集成电路产业规模情况》	中国半导体行业协会	由全国半导体界从事集成电路、半导体分立器件、半导体材料
6	《2013-2017年我国集成电路设计业、芯		

序号	数据出现于招股说明书的位置及摘录	第三方名称	权威性
	片制造业和封装测试业的销售规模及增长率》		和设备的生产、设计、科研、开发、经营、应用、教学的单位、专家及其它相关的支撑企、事业单位自愿结成的行业性的全国性的非营利性的社会组织
7	“……大陆地区集成电路设计业占全行业仅为 38%，封装测试业占比为 35%，而在世界范围内，集成电路设计的产值占比接近 60%，集成电路封装测试环节的份额占比不到 20%。集成电路设计的毛利率水平一般要远高于测试和封装，通常情况下集成电路设计类公司的平均毛利率在 40%左右的水平，晶圆制造类公司的毛利率约为 30%，而测试封装企业的平均毛利率仅在 20%左右……”		
8	“……中国前十大集成电路设计企业 2017 年的市场份额占比在 38.01%，而在全球市场，2017 年前十大集成电路设计企业市场份额高达 73.34%……”		
9	“……2017 年中国集成电路市场进口金额 2,601.4 亿美元，同比增长 14.6%；出口金额 668.8 亿美元，同比增长 9.0%；2017 年进出口逆差 1,932.6 亿美元……”		
10	《2010 年-2017 年中国集成电路设计行业销售额及增长情况》		
11	《2016-2017 年我国 IC 设计业主要地区的发展情况》	ICCAD	全球知名的电子设计技术创新讨论会议
12	“……从全球分布来看，北美占据了半壁江山，其次为亚太地区，占比 30.3%，第三位西欧则为 15.8%。但从增速上来看，亚太地区潜力最大，连续三年增速超过 30%，其中又以中国、印度等国增长最为迅猛，拉动了全球新一代基础设施建设进入高速期。根据中国 IDC 圈数据，2017 年国内 IDC 市场规模接近 950 亿元，过去三年增速保持在 40%左右……”	券商研究报告	中国首批综合类证券公司，上海证券交易所、深圳证券交易所首批会员
13	“……思科预计到 2021 年，全球超大型数据中心数量将超过 600 个，并承载全球数据中心的 53% 的服务器安装量、69% 的运算能力、65% 的数量存储能力，以及 55% 的数据流量……”	Cisco	全球领先的网络解决方案供应商
14	“……近年来全球 IDC 市场并购活动明显趋于频繁，2017 年全球 IDC 市场累计并购额达到 200 亿美元，涉及并购案	Synergy Research	全球知名的网络及通讯行业研究机构

序号	数据出现于招股说明书的位置及摘录	第三方名称	权威性
	例数 48 起……”		
15	《2017 年中国 x86 服务器市场行业结构》	赛迪顾问	直属于中华人民共和国工业和信息化部中国电子信息产业发展研究院的咨询公司
16	《2018-2020 年中国 x86 服务器市场行业销售额结构预测》		
17	《2016 年至 2018 年内存接口芯片市场规模情况》	IDT、Rambus 年报	测算逻辑：内存接口芯片供应商全球主要包括三家，这三家 2016-2018 年销售额之和即约为内存接口芯片市场规模
18	“……数据中心规模服务器集群约占 30%，预计 2021 年超大型数据中心将占服务器安装量 53%，占公有云服务器安装量的 85%。数据中心的 ICT 设备采购成本中服务器约占 70% 以上，总体拥有成本中服务器相关成本占比约 60% 以上……”	券商研究报告	经中国证监会批准设立的大型综合类创新试点证券公司

综上，所有数据均为公开数据，所有报告均不是定制报告，亦不是为本次发行上市专门准备的报告，公司没有为此支付费用或提供帮助，亦不是付费定制的报告和一般性网络文章或非公开资料、亦不是保荐机构所在证券公司的研究部门出具的报告。

48.2 保荐机构和发行人律师核查过程和核查意见

保荐机构和发行人律师通过查阅相关公开数据、访谈发行人业务人员、客户等方式，对发行人产品的市场情况进行了解；通过公开资料查询，对所引用的第三方报告的出处及其准确性、权威性进行查证。

经核查，保荐机构和发行人律师认为，发行人引用的数据均为公开数据，所有报告均不是定制报告，亦不是为本次发行上市专门准备的报告，发行人没有为此支付费用或提供帮助，亦不是付费定制的报告和一般性网络文章或非公开资料、亦不是保荐机构所在证券公司的研究部门出具的报告。

问题四十九

请保荐机构自查与发行人本次公开发行相关的媒体质疑情况,就媒体质疑事项进行核查并发表明确意见。

回复:

49.1 发行人说明

本次公开发行相关的媒体质疑情况主要包括 Montage Group 在境外上市期间被做空相关事宜和与澜起微电子相关事宜。

一、Montage Group在境外上市期间被做空的相关事宜

1、质疑问题

2014年2月, Gravity Research 发布针对 Montage Group 的做空报告, 做空报告中指责 Montage Group 利用其最大的代理商(LQW)进行财务造假。

2、实际情况

Montage Group 2011年以来业绩增长迅速, 销售规模持续扩大, 为加快资金周转, Montage Group 选择跟一家代理商(LQW)进行合作, 使 LQW 公司成为公司的一级代理商, 并给予其一定的销售折扣, 同时 LQW 在提货时就支付全款, 从而帮助 Montage Group 加速资金周转。但 Montage Group 仍采用最终客户提货时才确认收入的方法, 收入确认政策并未发生变化。随着 Montage Group 业务规模的扩大, 对 LQW 的销售收入也同步提升。

Montage Group 在 Nasdaq 上市后, 股价一路上涨, 于 2014 年 1 月达到最高价 26.70 美元/股。2014 年 2 月, 二级市场出现了空单大量激增的现象, 其后一家不知名的机构——Gravity Research 发布做空报告。

在被做空后, Montage Group 董事会审计委员会聘请了国际知名中介机构 Jones Day (众达) 律师事务所进行独立调查。2014 年 4 月 22 日, Montage Group 审计委员会公布初步调查结果, 宣布财务造假指控不实。2014 年 10 月 15 日, Montage Group 发布公告, 根据第三方独立调查机构 Jones Day 律师事务所于 2014 年 10 月 4 日完成“关于 Gravity Research 对 Montage Group 指控事项的独立调查报告”, Montage Group 认为此前发布的财务报告真实可信、无须调整。

2014 年私有化买方团（浦东科投、中电投控等）对 Montage Group 进行了尽职调查，认为 Montage Group “团队优秀、技术领先、财务规范，尤其在内存接口芯片领域的突破创新，非常符合国家相关产业的发展方向，是一家值得投资的企业（引述自每日经济新闻对中电投控的相关采访报道）”。所以相关主体决定对其进行私有化收购，并于 2014 年 11 月完成私有化交割。

同时，Montage Group 于 2014 年 12 月 11 日荣获全球半导体联盟（GSA）颁发的 2014 年“最佳财务管理半导体公司奖”（销售额 5 亿美元以下组）。GSA 奖是全球半导体行业最具影响的奖项之一，主要授予全球半导体行业中取得卓越成就、有着清晰的发展策略、前景十分看好的公司。

3、结论

在被做空后，Montage Group 董事会审计委员会聘请了国际知名中介机构进行历时八个月的独立调查，相关中介机构花费 11,500 小时调查，最终结果显示 Montage Group 财务数据真实可信。而且根据境外法律意见书，在整个过程中，美国证监会并未对 Montage Group 启动任何形式的调查和处罚，Montage Group 在其上市期间运行合法合规。

Gravity Research 发布针对 Montage Group 的做空报告指控不实。申报会计师已对发行人报告期财务数据进行了独立审计，出具了“瑞华审字[2019]01500039 号”标准无保留意见的《审计报告》。

二、与澜起微电子相关事宜

1、质疑问题

根据网络检索，2014 年，相关媒体曾发布“国家新闻出版广电总局发布相关通知要求禁售上海澜起微电子科技有限公司等公司生产销售的芯片”的相关报道，有媒体曾质疑澜起微电子收到相关通知是否会对发行人业务发展造成影响。

2、实际情况

上海澜起微电子科技有限公司（以下简称“澜起微电子”）成立于 2008 年 12 月，澜起有限出资比例为 10%，后经多次股权转让，自 2012 年 6 月起，澜起微电子与澜起有限不再有关联关系。澜起微电子已于 2015 年 8 月更名为上海湛翕微电子科技有限公司，并于 2018 年 11 月完成注销。报告期内公司同澜起微电

子不存在关联关系，也不存在业务往来。

3、结论

报告期内，澜起微电子与发行人不存在关联关系，亦未发生业务往来，澜起微电子是否收到相关通知不会对发行人业务合规发展造成影响，亦对本次发行不造成影响。

49.2 保荐机构核查过程和核查意见

保荐机构查阅了当时的媒体报道信息，试图查询 Gravity Research 的网站但没有成功（该机构网址已无法查到），审阅了 Montage Group 境外公开披露文件，调阅了澜起微电子的工商档案，核对了发行人客户和供应商目录，查阅了发行人报告期内审计报告和银行流水。

经核查，保荐机构认为发行人已对媒体的质疑进行了相应的回复和澄清。申报会计师已对发行人报告期财务数据进行了独立审计并出具了“瑞华审字[2019]01500039号”标准无保留意见的《审计报告》，报告期内发行人未与澜起微电子之间发生任何交易亦不存在关联关系，前述质疑对本次发行不构成负面影响。

（本页无正文，为《澜起科技股份有限公司、中信证券股份有限公司关于<关于澜起科技股份有限公司首次发行股票并在科创板上市申请文件的审核问询函>之回复报告》之签署页）

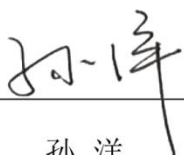


澜起科技股份有限公司


2019年5月5日

(本页无正文，为《澜起科技股份有限公司、中信证券股份有限公司关于<关于澜起科技股份有限公司首次发行股票并在科创板上市申请文件的审核问询函>之回复报告》之签署页)

保荐代表人：



孙洋



王建文




2019年5月5日

保荐机构管理层声明

本人已认真阅读澜起科技股份有限公司本次问询函回复报告的全部内容，了解报告涉及问题的核查过程、本公司的内核和风险控制流程，确认本公司按照勤勉尽责原则履行核查程序，问询函回复报告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对上述文件的真实性、准确性、完整性、及时性承担相应法律责任。

董事长：



张佑君

中信证券股份有限公司 2019年5月5日

